



日月光集團

日月光半導體製造股份有限公司
九十九年度年報



本公司發言人

張洪本 職稱 | 副董事長兼總經理

代理發言人

董宏思 職稱 | 財務長

甘智文 職稱 | 資深經理

電話 | (02) 8780-5489

電子郵件信箱 | ir@aseglobal.com

總公司

地址 | 高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話 | (07) 361-7131

傳真 | (07) 361-3094、361-4546

台北辦公室

地址 | 台北市基隆路一段333號19樓1901室

電話 | (02) 8780-5489、6636-5678

傳真 | (02) 2757-6121

中壢分公司

地址 | 桃園縣中壢市中華路一段550號

電話 | (03) 452-7121

傳真 | (03) 462-8658

註：本公司於100年1月12日董事會決議通過
預計於南投成立分公司。

高雄工廠地址

地址 | 高雄市楠梓加工出口區經三路26號

電話 | (07) 361-7131

中壢工廠地址

地址 | 桃園縣中壢市復華里中華路一段550、516號

電話 | (03) 452-7121

股票過戶機構

統一綜合證券股份有限公司股務代理部

地址 | 台北市松山區東興路8號地下一樓

網址 | <http://www.uni-psg.com>

電話 | (02) 2746-3797

最近年度財務報告簽證會計師

事務所名稱 | 勤業衆信聯合會計師事務所

會計師姓名 | 龔俊吉會計師、邱慧吟會計師

地址 | 高雄市中正三路2號20樓

網址 | <http://www.deloitte.com.tw>

電話 | (07) 238-9988

海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱

紐約證券交易所 (NYSE)

查詢該海外有價證券資訊之方式及公司網址

<http://www.aseglobal.com>

目次

壹

03 聚焦創新・版圖榮耀

04 廣闊視野・巔峰成就

06 匯聚動能・亮麗回饋

08 綻放熱忱・擁抱世界

10 策略夥伴・同步前進

12 致股東報告書

14 經營摘要

貳 九十九年度年報

聚焦創新・版圖榮耀

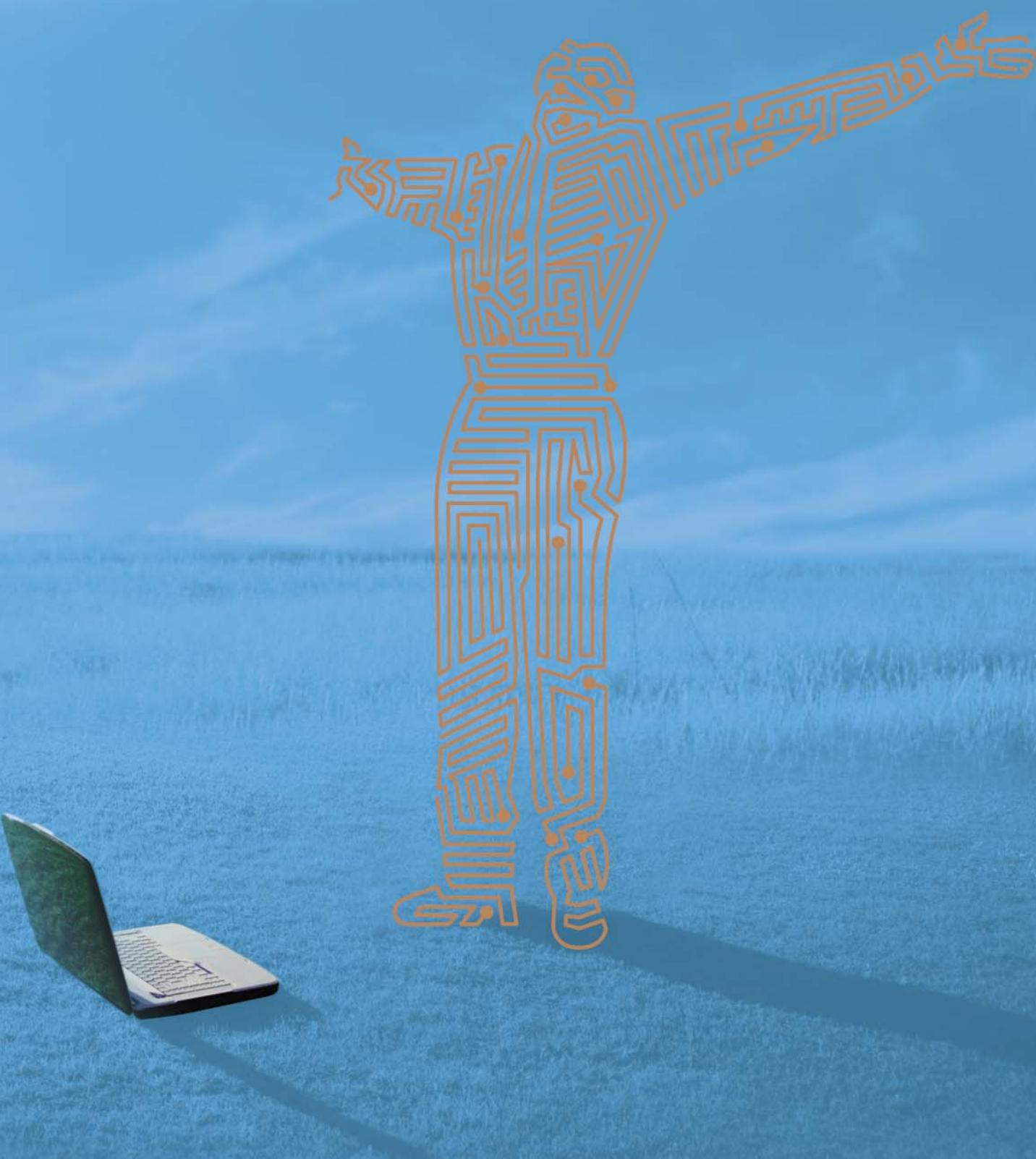
日月光集團戮力創新，聚焦於營運的年年成長，2010年無論在營收和獲利更締造亮麗成果，逐步擴展在全球封測委外代工的產業版圖。

日月光超過四分之一世紀半導體封測領導地位，奠定半導體產業價值鏈中穩固的基礎；我們始終堅持垂直整合的一元化服務，引領4C產業邁向共榮成長之路。

廣闊視野，巔峰成就

視野 · 是決定創新的高度

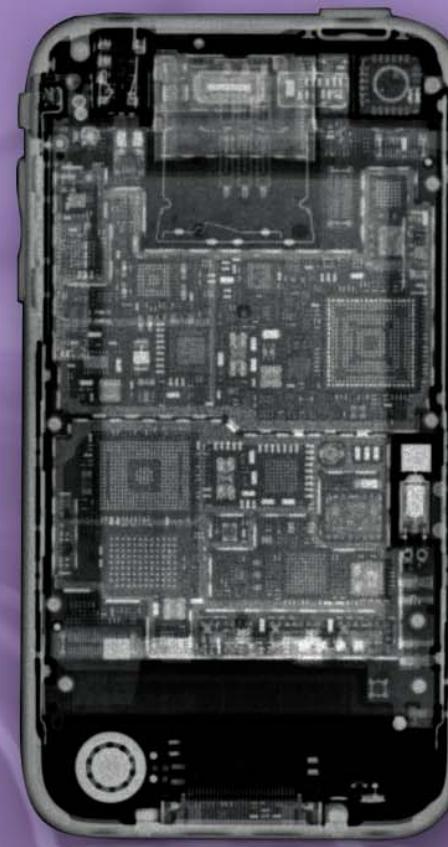
在日經月累的演化中，日月光集團以最開闊的視野，聚焦於變革與創新，在組織的運籌帷幄下，人才的訓練與管理，以更具彈性的營運模式，結合高瞻遠矚的策略，超越市場激烈競爭，得以成就現今日月光，邁向世界之巔。



匯聚動能，亮麗回饋

動能 · 讓日月光得以亮麗回饋

2010年日月光集團的亮麗成果，伴隨全球經濟的復甦，台灣的IC產值在同期有了高度成長，我們持續不斷致力晶片產品應用的封測開發及全球佈局的拓展，推動智慧電子產品的革新與上市時程，讓大眾享受便利且豐富的4C生活。



綻放熱忱，擁抱世界

熱忱 · 使日月光時時擁抱世界

日月光集團充滿熱情洋溢之心，突破重重困難與挑戰，持續多年全心投入半導體封測之綠色產業價值鏈的開創，期盼能為這個地球帶來更環保、更便捷的數位生活。



策略夥伴，同步前進

夥伴 · 讓我們攜手迎向未來

日月光集團整合策略夥伴，深入瞭解市場的需求，投注於半導體先進技術研發，提升高階封裝與生產製程的競爭力，在多年的合作默契之下，堅持超越自我，日月光與夥伴共同攜手迎向更璀璨的未來。



致股東報告書

各位股東女士、先生：

全球經濟在2010年延續了2009年景氣復甦的力道，終於止跌回升。2010年全年的經濟成長可望達到4.8%。根據工研院IEK ITIS計畫之報告，2010年台灣半導體產業產值較2009年大幅成長41.5%，優於全球的半導體成長率31.6%。其中，封裝業產值為新台幣2,970億元，較2009年成長48.8%；測試業產值為新台幣1,327億元，較2009年成長51.5%。儘管景氣回復到金融海嘯前之水準，先進國家與新興國家卻分別呈現了溫和與熱絡雙速成長的局面。在痛苦過後甜美底下依然存在著台幣波動、金價飆升及歐盟的債信危機等疑慮。本公司不僅在獲利與成長力求表現，同時並針對各種挑戰及局勢之變化審慎因應。茲將本公司過去一年來的營運狀況報告如下：

2010年營業結果

1.2010年營業計畫實施成果

本公司2010年合併營收為新台幣1,887億元，較2009年增加1,030億元，成長120%。以封測本業來看，2010年度營收為新台幣1,230億元，成長47%。整體而言，2010年是非常成功的一年，除了業績較相對競爭者與產業有更好的成長，全球封測代工的市佔率更提升了2%，IDM客戶的比重亦逐季推升，來到38~39%。同時，中國本土晶片大廠也成為本公司前十大客戶之一。此外，日本的IDM大廠持續釋出後段代工訂單，佔營收比重達10%。本公司2010年的資本支出創歷年新高，更一舉將銅打線封裝的營收比率提升到18%。另在生產基地的擴充上也大有斬獲：2010年下半年收購了EEMS新加坡廠以提升本公司在東南亞市場的市佔率並強化其區域的競爭力；高雄廠區也以收購及動工興建新廠房的方式擴充產能；下半年計畫在大陸方面對日月光威海公司增資，大幅擴張分離式元件的封測產能，明年的成長性值得期待；加上日月光昆山廠的完工落成啓用更大幅增加了公司未來獲利的能力。

2.預算執行情形

本公司於2010年並未公開財務預測。

3.財務收支及獲利能力分析

本公司截至2010年底止，實收資本額為60,519,872仟元，股東權益為88,556,369仟元佔總資產161,626,460仟元之55%，長期資金佔固定資產比率為350%，流動比率為69%，本年度較前一年度財務比率持平，財務結構及償債能力維持穩健，本年度稅後純益提高為新台幣18,337,500仟元，較2009年度提升172%。整體營運結果及獲利十分良好，且表現亮眼，大幅超越2009年的水準，已提昇到全球經濟衰退之前的水準，其結果值得肯定。

4.研究發展狀況

本公司在2010年成功開發之新技術按技術類別歸類如下：

- (1) 在覆晶封裝計有40奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛、錫鉛覆晶封裝、40奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶晶片堆疊封裝、40微米微間距覆晶及鋅線混合堆疊封裝、銅製程/超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術、微間距非導電覆晶薄膜底材技術。
- (2) 在鋅線封裝計有32奈米銅製程/超低介電係數晶圓之金鋅線封裝、45奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銅鋅線封裝、高密度aQFN封裝。
- (3) 在系統封裝計有200 mm晶圓穿導孔技術、200 mm矽質基板暨封裝、整合被動元件QFN/LGA封裝技術、內埋主、被動元件基板技術、RF無線通訊模組技術、外引腳式覆晶Map PoP。
- (4) 在晶圓級封裝計有200 mm外引腳晶圓級封裝(Fan out WLP)、40微米間距銅柱凸塊(40 um Pitch Cu Pillar Bump)。本公司將持續投注於相關設備及先進封測技術之研發，進而維持本公司在全球封測產業之領導地位。

2011年營業計畫概要

1.經營方針

- (1) 提供客戶「至高品質」的服務
- (2) 為公司及客戶創造長期且穩定的利潤
- (3) 與協力廠商攜手共創榮景
- (4) 在營運中儘可能地保持彈性。

2.預期銷售數量及其依據

依據產業景氣、未來市場需求及本公司之產能狀況，本公司2011年預計銷售量如下：

銷售項目	預計銷售數量
封裝	約101億個
測試	約14億個

3.重要產銷政策

近年來如智慧型手機、平板電腦、智慧型電視及遊戲機等消費性電子產品的熱銷，預期將會帶動半導體產業不斷增長，這些產品同時也是推動本公司未來營收持續成長的主要動力。尤其以平板電腦更不容忽視，本公司主要客戶中大都是該產品相關零組件的主要供應商。同時，本公司也將致力於銅製程的轉換來加強半導體產業供應鏈的合作及降低成本以因應新興國家對於通訊產品的龐大需求及智慧型手機朝低價發展的趨勢。並且在台灣繼續發展高附加價值、高單價、功能複雜及創新性之高階積體電路封測服務，而將低單價、功能簡單、技術層次較低階之分離式元件封測服務，由大陸投資事業生產，以提昇本公司之競爭力，兼顧兩岸發展。

未來公司發展策略

工研院IEK ITIS計畫預估，2011年半導體產業將隨著持續成長但增速趨緩，年成長幅度為8.7%。封裝及測試產業亦分別成長約為10.3%及11.1%。受到金價大漲、同業銅打線製程比重也迎頭趕上及本土IC業者與國外整合元件大廠導入銅製程的意願大增的影響，本公司將以大比重的資本支出來擴增銅打線機台，讓其達到全年打線製程比重的35%。鑑於整合元件廠(IDM)持續擴大委外業務為推升2011年台灣封測產業高成長率的主因。本公司將持續致力於提高IDM客戶營收比重。此外，大陸地區2010年的經濟成長率為東亞新興地區之冠，積極拓展大陸地區的事業版圖亦為本公司持續成長的利基所在。

受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

國際經濟情勢的好轉讓本公司於前兩年的困境中所提出各項人事、產線、成本的規劃與整合方案，終於在近年開花結果，在營收及獲利上雙創新高。政府開放企業西進並簽署ECFA讓本公司能在大陸投資設廠，運用大陸豐沛的人力提高產能，使產品線更完整，增加企業競爭力，市場佔有率更加速了公司的成長。面對台幣匯率的波動及大陸地區封測產業的興起，本公司唯有不斷精益求精的強化公司體質並充分的做好風險管控來應對。本公司及其經營團隊不以既有的成就為滿足，仍將致力於提昇自我競爭力，創造更高利潤以回饋股東的支持為持續努力的目標。



經營摘要

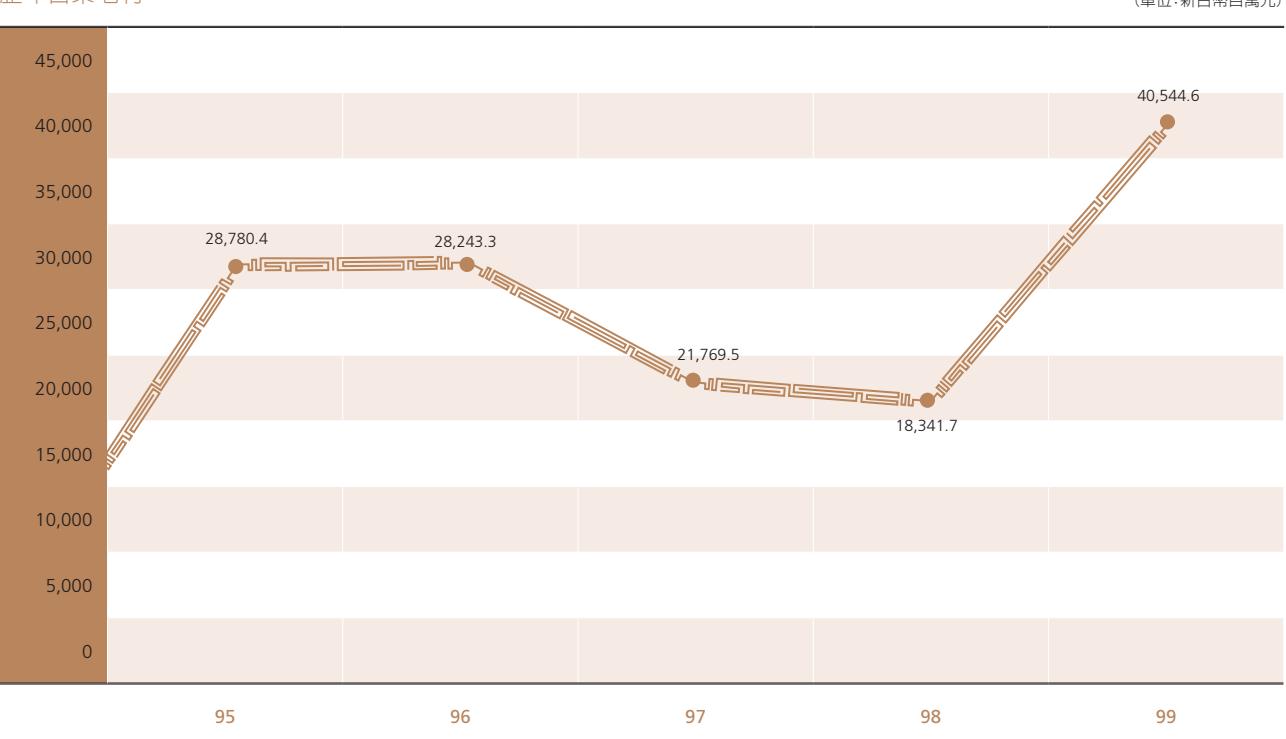
經營摘要(含子公司)

	95	96	97	98	99
營業淨收入	100,423.6	101,163.1	94,430.9	85,775.3	188,742.8
營業毛利	28,780.4	28,243.3	21,769.5	18,341.7	40,544.6
營業利益	20,446.4	18,662.7	11,245.4	9,209.8	24,099.0
稅前淨利	22,251.4	17,351.9	9,475.8	8,388.4	22,823.6
稅後淨利	17,416.2	12,165.2	6,160.1	6,903.5	19,194.9
每股盈餘(元/股,追溯調整後之稀釋每股盈餘)	2.85	1.98	1.02	1.17	3.04
現金股利(元/股)	1.47932234	1.70582756	0.49989186	0.35965662	註1
股票股利(元/股)	1.4793223441	0.289292391	—	0.9990461805	註1
固定資產淨額	73,543.8	81,788.3	84,758.0	79,363.9	99,853.9
股東權益淨額	66,019.9	75,173.4	69,672.0	74,713.7	91,839.3
資產總額	137,040.9	152,377.5	152,190.0	161,974.8	208,139.8
員工總數(人)	26,986	29,942	26,977	29,538	48,901
日月光各年總市值(註2)	170,618.5	177,646.0	67,150.8	158,352.7	203,482.7

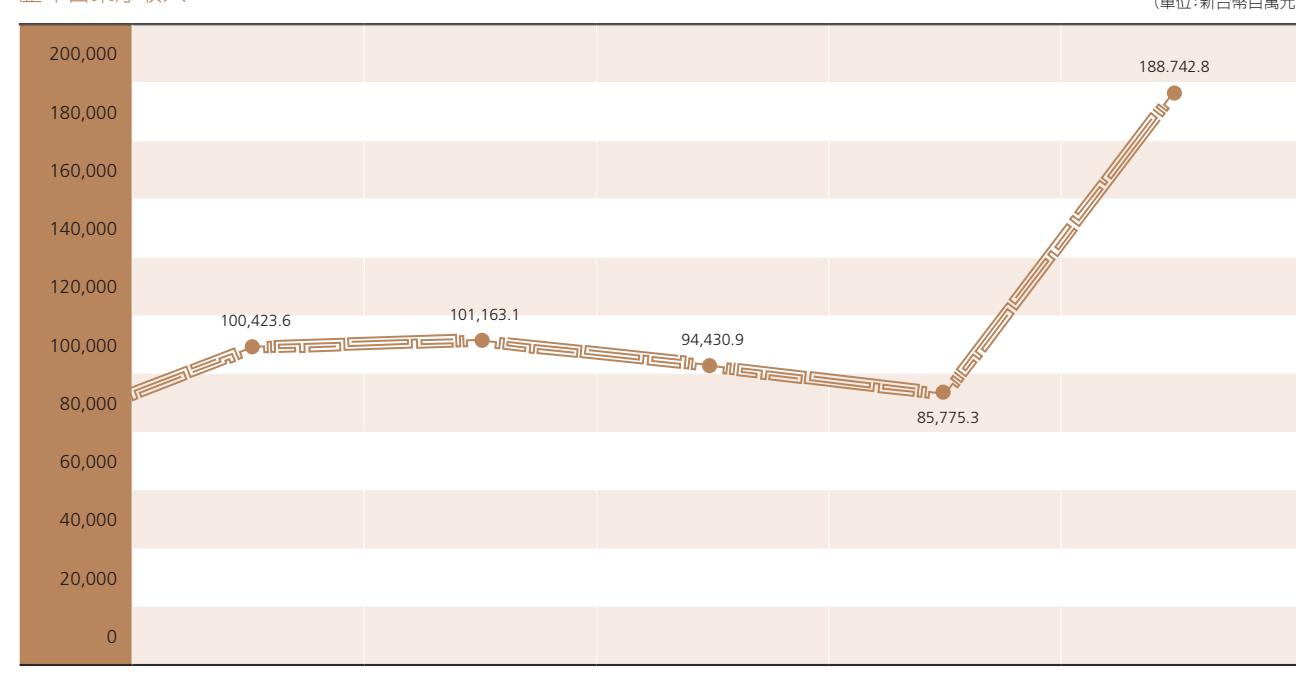
註1：俟股東會決議後定案。

註2：總市值=年底收盤價*流通在外股數。

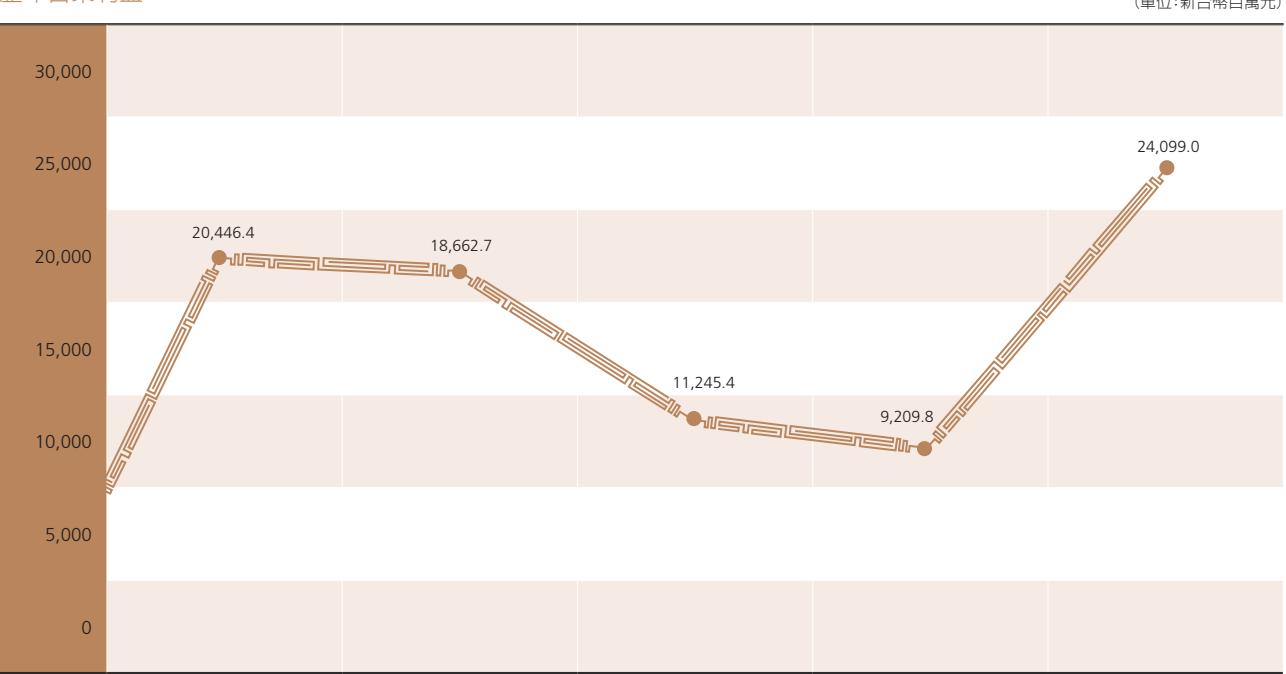
歷年營業毛利



歷年營業淨收入

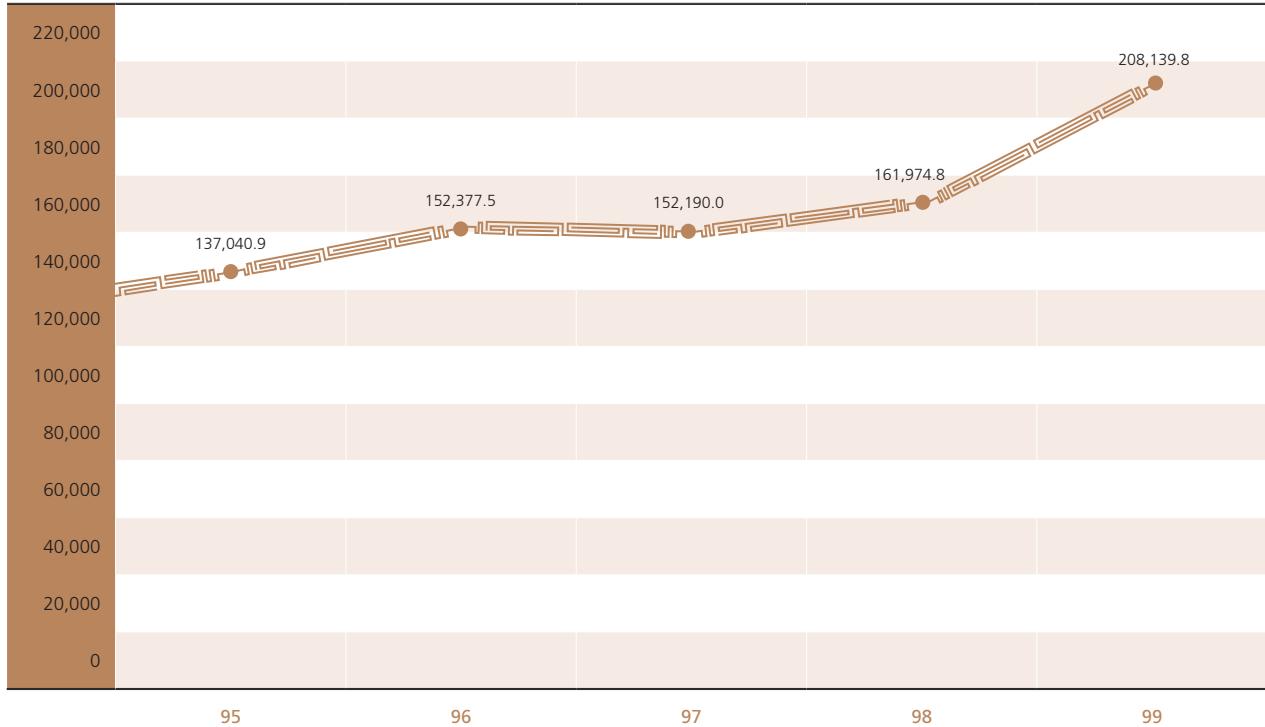


歷年營業利益



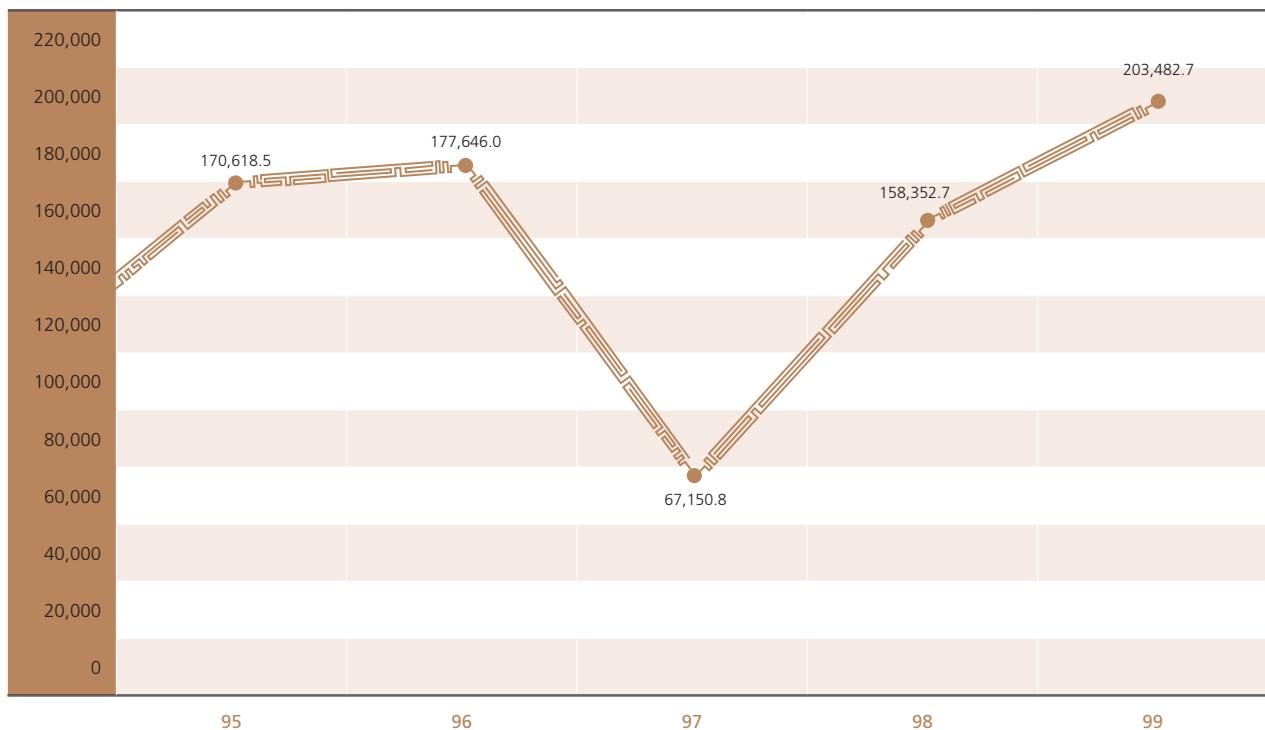
歷年資產總額

(單位:新台幣百萬元)



歷年日月光總市值

(單位:新台幣百萬元)



九十九年度年報

目錄 九十九年度年報

壹、致股東報告書及經營摘要	
貳、公司簡介	2
參、公司治理報告	5
一、組織系統	5
二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料	6
三、公司治理運作情形	16
四、會計師公費資訊	22
五、更換會計師資訊	22
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者之情形	23
七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形	23
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊	24
九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數	24
肆、募資情形	25
一、資本及股份	25
二、公司債辦理情形	31
三、特別股辦理情形	31
四、海外存託憑證辦理情形	31
五、員工認股權憑證辦理情形	31
六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形	33
七、資金運用計畫執行情形	33
伍、營運概況	34
一、業務內容	34
二、市場及產銷概況	40
三、從業員工資料	45
四、環保支出資訊	46
五、勞資關係	48
六、重要契約	50
陸、財務概況	51
一、最近五年度簡明資產負債表及損益表	51
二、最近五年度財務分析	52
三、最近年度財務報告之監察人審查報告	54
四、最近年度財務報表	55
五、最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表	131
六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事	139
柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項	140
一、財務狀況	140
二、經營結果	140
三、現金流量	140
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響	140
五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫	141
六、風險事項分析評估	141
七、其他重要事項	144
捌、特別記載事項	145
一、關係企業相關資料	145
二、私募有價證券辦理情形	157
三、子公司持有或處分本公司股票情形	157
四、其他必要補充說明事項	157
玖、其他事項	158

貳、公司簡介

一、設立日期：民國七十三年三月二十三日

二、公司沿革：

本公司之創立係由歸國學人張虔生及張洪本基於工業報國之精神，並配合政府發展高科技政策，以現金及專門技術作價集資所創建，所營事業為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售等。

本公司記事如下：

- 73年03月 公司正式成立。
- 73年07月 工廠開工。
- 73年08月 塑膠立體型積體電路(PDIP)，開始外銷歐美及日本。
- 74年02月 陶瓷立體型積體電路(CDIP)，開始外銷日本及歐美。
- 74年10月 高品質塑膠晶粒承載器積體電路(PLCC)開始外銷美國。
- 76年05月 高品質多腳型針格排列積體電路(PGA)及塑膠多腳型針格排列積體電路(PPGA)開始外銷歐美。
- 78年5-7月 78年5月25日經證期會(78)台財證(一)字第24594號函核准並經台灣證券交易所(78)上字第4461號函核覆股權分散符合標準，並於同年7月19日正式在台灣證券交易所上市掛牌買賣。
- 79年03月 收購台灣福雷電子股份有限公司股權百分之九十九點九，計支付價金新台幣105,006,183元，以併購方式進入半導體測試業務市場。
- 80年03月 轉投資設立日月光電子(馬來西亞)股份有限公司，從事各型積體電路之製造、加工、組合、測試及外銷，另轉投資設立日月光半導體貿易(香港)股份有限公司，以便利轉接海外(馬來西亞)生產基地訂單及服務客戶。
- 80年08月 新產品平面型塑膠晶粒承載器積體電路(EQFP)開始量產。
- 80年11月 本公司產品榮獲MOTOROLA公司頒發品質優良獎(Award of Excellence for Quality)。
- 81年04月 榮獲國際標準組織(ISO 9002)品質認證合格。
- 84年07月 在亞洲、美國及歐洲等地發行海外存託憑證8,600仟單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行43,000仟股，每股面額10元，售價每單位美金15.25元溢價發行，募集資金折合新台幣33.9億元。
- 85年06月 本公司之子公司「ASE Test Limited」在美國NASDAQ證券市場掛牌買賣。
- 86年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 86年11月 通過SAC(Semiconductor Assembly Council)認證。
- 87年01月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)以1,500,000股普通股發行120,000,000單位之台灣存託憑證(TDR)，並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 87年03月 榮獲國際標準組織(QS 9000)品質認證合格。
- 87年09月 榮獲ISO14001環境品質認證合格。
- 88年03月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)第二次以2,500,000股普通股發行台灣存託憑證(TDR)，並於台灣證券交易所掛牌買賣。
- 88年05月 本公司之子公司新加坡福雷電子公司(ASE Test Limited)收購ISE LAB七成股權。
- 88年07月 日月光集團收購摩托羅拉台灣中壢及南韓PAJU兩廠，藉此更能與摩托羅拉公司進行長期之策略聯盟，強化日月光集團垂直整合的力量，並可擴大產品涵蓋範圍。
- 88年2-7月 為提昇日月光集團電子專業代工之領域，進一步增加對客戶之服務項目，進而擴大客戶群，遂於88年度自集中交易市場買入環隆電氣股份有限公司股票，參與經營權，持股比率20.67%。

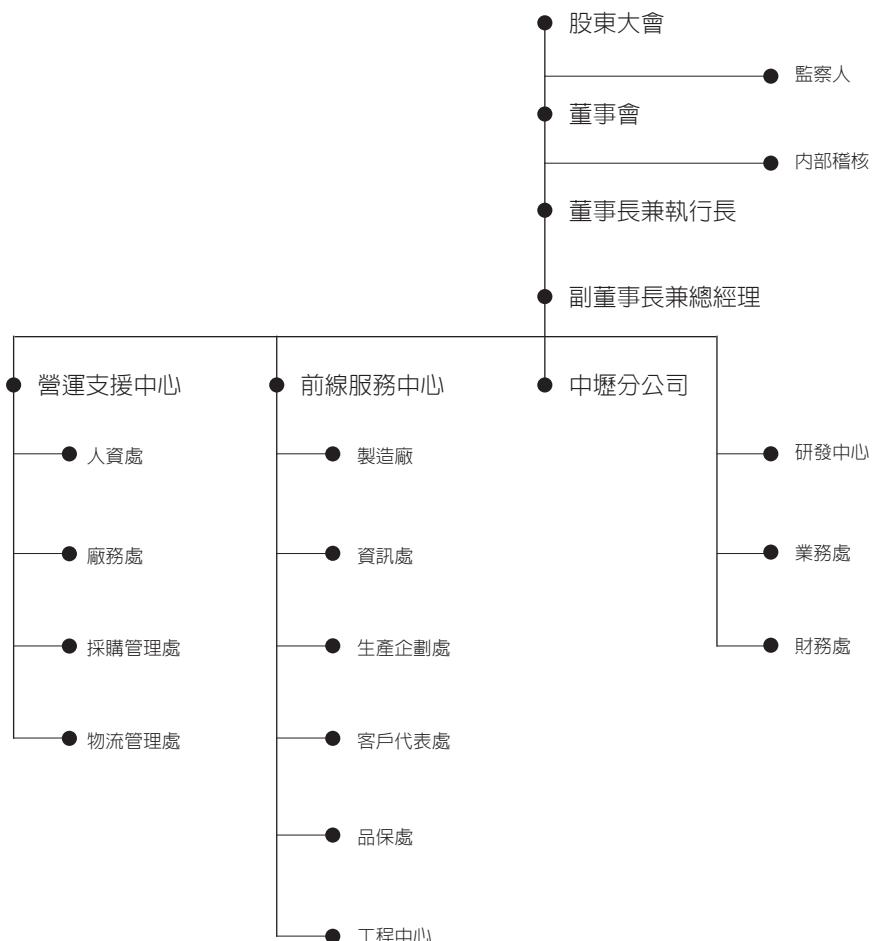
- 89年09月 為提昇本公司於全球半導體市場之競爭力，進而強化公司形象及國際知名度，於美國時間9月25日完成美國存託憑證(ADR)發行作業，本次發行數量計20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股，計發行普通股100,000,000股面額10元，發行價格每單位美金7元，募集資金折合新台幣計43.8億元。
- 91年09月 榮獲「第十屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 92年07月 本公司合併持股100%之子公司日月新投資(股)公司及日月興投資(股)公司。
- 92年09月 本公司發行美金2億元之海外可轉換公司債(Euro Convertible Bond)。
- 92年10月 本公司董事會決議合併子公司日月欣半導體股份有限公司與日月宏科技股份有限公司，換股比率訂為每1股日月欣半導體股份有限公司股份換發本公司股份0.85股，每1股日月宏科技股份有限公司股份換發本公司股份0.5股，本公司預計將發行282,315,437股以進行合併換股事宜。
- 93年02月 日月光集團與NEC簽立股權買賣合約，併購該公司位於山形縣之封裝測試廠。
- 93年07月 本公司於93年6月經董事會決議通過投資設立日月光半導體(昆山)有限公司，投資金額美金壹仟貳佰萬元，並於93年7月23日經投審會核准在案。
- 93年08月 本公司與子公司日月欣半導體股份有限公司及日月宏科技股份有限公司正式辦理合併，以本公司為存續公司，並設立中壢分公司。
本公司概括承受原由子公司日月欣半導體股份有限公司投資Omniquest Industrial Limited在大陸地區設立之日月光半導體(上海)(股)公司，並於93年8月10日經投審會核准在案。
本公司於93年7月經董事會決議通過投資設立日月光電子元器件(上海)有限公司，投資金額美金壹仟貳佰萬元，並於93年8月20日經投審會核准在案。
- 93年11月 本公司於93年9月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於93年11月25日經投審會核准在案。
- 94年06月 本公司於94年5月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於94年6月30日經投審會核准在案。
- 94年10月 榮獲「第十三屆經濟部產業科技發展獎」傑出獎。
- 94年11月 本公司於94年8月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(上海)(股)公司，並於94年11月2日經投審會核准在案。
本公司於94年11月在菲國總統「國際優良廠商頒獎典禮」頒獎之夜獲頒最高獎項「菲律賓總統獎」。
- 94年12月 本公司於94年11月經董事會決議通過投資設立日月光高新科技(上海)有限公司，投資金額美金壹仟伍佰萬元，並於94年12月21日經投審會核准在案。
- 95年03月 本公司以新台幣參仟萬元投資設立「日月光電子股份有限公司」，持股比率為100%。
- 95年05月 本公司經董事會決議通過將材料事業部分割予子公司日月光電子股份有限公司，換股比例為被分割之材料事業部營業價值每新台幣十元換取日月光電子股份有限公司普通股一股。
- 95年08月 本公司正式將材料事業部分割予日月光電子股份有限公司，本公司計取得日月光電子股份有限公司普通股294,929,700股。
本公司於95年6月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光半導體(昆山)有限公司，並於95年8月1日經投審會核准在案。
- 95年09月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股147,500,000股及147,429,700股，分別轉讓予子公司ASE Labuan Inc.及ASE Mauritius Inc.。
- 95年12月 本公司於95年11月經董事會決議通過透過子公司J&R Holding Limited以其自有資金美金陸仟萬元，受讓中國大陸地區之現有事業威宇科技測試封裝有限公司100%股權，並於95年12月29日經投審會核准在案。
為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，本公司之子公司ASE Mauritius Inc.將其持有之日月光電子股份有限公司普通股147,429,700股，轉讓予本公司另一子公司ASE Labuan Inc.。
- 96年06月 本公司為配合集團之全球營運策略及財務規劃之考量，將本公司所持有之日月光電子股份有限公司普通股3,000,000股，轉讓予子公司ASE Labuan Inc.。

- 96年07月 本公司於96年3月經董事會決議以海外自有資金美金21,600,000元，透過子公司J&R Holding Limited購買NXP B.V.所持有中國大陸之恩智浦半導體蘇州有限公司60%股權，並於96年7月2日經投審會核准在案。(另於97年3月7日核准更名為蘇州日月新半導體有限公司)。
- 96年08月 本公司為整合集團名稱，將大陸地區投資事業威宇科技測試封裝有限公司名稱更名為「日月光封裝測試(上海)有限公司」，並於96年8月29日經投審會核准在案。
- 97年02月 本公司於96年10月經董事會決議通過增資金額美金參仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司，並於97年2月20日經投審會核准在案。
本公司於97年01月經董事會決議通過以自有資金美金柒佰萬元，透過子公司J&R Holding Limited受讓中國大陸地區之現有事業威海愛一和一電子有限公司100%股權，並於97年2月15日經投審會核准在案。(另於97年5月22日核准更名為日月光半導體(威海)有限公司)。
- 97年05月 本公司於97年03月經董事會決議通過增資美金玖仟萬元於日月光封裝測試(上海)有限公司，並於97年5月16日經投審會核准在案。
本公司於97年04月經董事會決議通過增資金額美金壹仟參佰萬元於日月光半導體(威海)有限公司，並於97年5月22日經投審會核准在案。
- 97年08月 本公司於97年07月經董事會決議通過增資美金陸佰萬元於日月光電子元器件(昆山)有限公司，並於97年8月7日經投審會核准在案。
- 97年11月 本公司為維護公司信用及股東權益於97年11月經董事會決議通過實施第一次買回本公司普通股股份144,037,000股並辦理銷除。
- 98年01月 本公司為維護公司信用及股東權益於98年01月經董事會決議通過實施第二次買回本公司普通股股份73,937,000股並辦理銷除。
- 98年02月 本公司於97年12月經董事會決議通過增資美金貳仟萬元於日月光半導體(威海)有限公司，並於98年2月4日經投審會核准在案。
- 98年07月 本公司於98年06月經董事會決議通過增資美金參仟貳佰萬元於日月光半導體(昆山)有限公司，並於98年7月31日經投審會核准在案。
- 98年11月 本公司於98年11月經董事會決議通過，以現金及子公司J&R Holding Limited及新加坡福雷電子股份有限公司所分別持有之本公司普通股107,308,600股及199,287,400股合計306,596,000股作為對價，對環隆電氣股份有限公司(下稱環隆電氣)之股份進行公開收購。
- 99年02月 前述共同公開收購案已於99年2月9日完成，本次共收購環隆電氣普通股股份641,669,316股，加計收購前集團原持有普通股股份192,944,213股，完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額78.1%。
- 99年08月 本公司於99年4月經董事會決議通過同意環隆電氣之股票終止上市申請案，同時承諾收購環隆電氣之股票。本公司已於99年8月5日完成該公開收購案，共收購環隆電氣流通在外股份222,243,661股，加計收購前集團原持有環隆電氣股份834,613,529股，完成收購後總計約占環隆電氣已發行有表決權股份總額98.9%。
- 99年11月 本公司為維護公司信用及股東權益於99年11月經董事會決議通過實施第三次買回本公司普通股股份37,000,000股並辦理銷除。
本公司為配合主管機關之政策，於99年11月26日將本公司發行之股票轉換為全面無實體發行。
- 100年01月 本公司為配合集團營運策略之考量，於100年01月經董事會決議通過設立南投分公司以承接子公司環隆電氣之微電子構裝業務。
- 100年03月 本公司於99年11月經董事會決議通過透過子公司ASE(Korea) Inc.以其自有資金美金陸仟萬元增資日月光半導體(威海)有限公司，並於100年3月1日經投審會核准在案。

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織結構：



(二)主要部門所營業務

人資處	人力資源管理及組織發展
廠務處	廠房及行政區環境保護、庶務管理及工安管制
採購管理處	機台、產品投料之採購、管理及控制
物流管理處	倉儲及進出口業務
製造廠	半導體封裝之代工
資訊處	公司資訊系統建構、推動e化經營策略及系統服務
生產企劃處	生產企劃及營運效率管理
客戶代表處	客戶服務及諮詢
品保處	產品品質檢驗及品質確保
工程中心	基板設計及生產技術開發
研發中心	先進技術研究發展
業務處	亞洲、美洲、歐洲等地區業務發展
財務處	財務及會計，包括資金管理、資產管理、成本與管理會計、租稅規劃及股務作業
內部稽核	內部政策、流程及標準稽核

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：

(一)董事及監察人資料(年報刊印日100.02.28)

單位:股

職稱	姓名	選任日期	任期	初次選任日期	選任時持有股份		現在持有股數(註1)		配偶、未成年子女現在持有股份(註1)	
					股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
董事本人	張洪本(副董事長)	98.06.25	三年	73.03.11	73,453,840	1.34%	80,792,217	1.34%	95,612,517	1.59%
董事本人	張能傑	98.06.25	三年	98.06.25	23,622	—	1,305,981	0.02%	—	—
董事本人	香港商微電子國際公司	98.06.25	三年	80.03.30	949,483,271	17.35%	1,044,341,034 (註2)	17.32%	—	—
董事之 法人代表人	張虔生(董事長)									
	吳田玉									
	羅瑞榮									
	董宏思									
	陳昌益									
獨立董事	游勝福	98.06.25	三年	98.06.25	—	—	—	—	—	—
獨立董事	徐大麟	98.06.25	三年	98.06.25	—	—	—	—	—	—
監察人本人	張能超	98.06.25	三年	98.06.25	343,294	0.01%	377,590	0.01%	—	—
監察人本人	台灣福雷電子股份有限公司	98.06.25	三年	95.06.22	986,223	0.02%	1,084,751	0.02%	—	—
監察人之 法人代表人	何弘									
	劉曉明									
	陳天賜									
監察人本人	宏璟建設股份有限公司	98.06.25	三年	98.06.25	61,230,021	1.12%	67,347,182 (註3)	1.12%	—	—
監察人之 法人代表人	曾元一									

職稱	姓名	利用他人名義持有股份(註4)		主要經(學)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務(註4)	具配偶或二親等以內關係之其他主管、 董事或監察人		
		股數	持股比率		職稱	姓名	關係
董事本人	張洪本(副董事長)	—	—	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	董事長 監察人	張虔生 張能超	兄 子
董事本人	張能傑	—	—	美國衛斯理大學(Wesleyan University) 心理系學士	董事長	張虔生	父
董事本人	香港商微電子國際公司	—	—				
董事之 法人代表人	張虔生(董事長)			台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	副董事長 董事	張洪本 張能傑	弟 子
	吳田玉			美國賓州大學應用機械博士	—	—	—
	羅瑞榮			交通大學電子物理系畢	—	—	—
	董宏思			美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	—	—	—
	陳昌益			加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	—	—	—
獨立董事	游勝福	—	—	台灣大學商學系會計組 政大會計研究所碩士	—	—	—
獨立董事	徐大麟	—	—	台灣大學物理學學士 美國紐約州布魯克林理工學院電子物理學碩士 美國加州柏克萊分校電機工程博士	—	—	—
監察人本人	張能超	—	—	美國威廉姆斯大學(Williams)經濟系畢	副董事長	張洪本	父
監察人本人	台灣福雷電子股份有限公司	—	—				
監察人之 法人代表人	何弘			美國愛荷華大學企管碩士 美商花旗銀行經理	—	—	—
	劉曉明			史丹佛大學材料科學博士 英特爾協理 矽統科技總經理	—	—	—
	陳天賜			中原大學工業工程與管理系	—	—	—
監察人本人	宏璟建設股份有限公司	—	—				
監察人之 法人代表人	曾元一			台灣大學土木系畢 亞洲理工學院系統工程碩士 泛亞工程公司董事長 泰國榮泰公司董事長 美國榮工國際公司董事長	—	—	—

註1：截至年報刊印日止實際持有股數。

註2：截至年報刊印日止質押股數為173,288,000股。

註3：截至年報刊印日止質押股數為60,331,000股。

註4：本公司董監事及部份經理人目前兼任本公司及其他公司之職務如下表：

張虔生

日月光半導體製造(股)公司-執行長、董事長及董事(代表人)
日月瑞(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Test Holding, Ltd.-董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Holding Ltd.(Bermuda)-董事
J&R Holding Ltd.(Bermuda)-董事
Innosource Ltd.-董事
日月光半導體(昆山)有限公司-董事
ASE Test Limited (Singapore)-董事長
日月光半導體(上海)(股)公司-董事長及董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事
日月光高新科技(上海)有限公司-董事
日月鴻科技股份有限公司-董事長及董事(代表人)
日月光電子(股)公司-董事長及董事(代表人)
ASE Mauritius Inc.-董事
ASE Corporation -董事
蘇州日月新半導體有限公司-董事長
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事
ASE Labuan Inc.-董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
ASE Singapore Pte. Ltd.-董事
ASE Singapore II Pte. Ltd.-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
環隆電氣股份有限公司-董事(代表人)
環旭上海公司-董事
環鴻深圳II公司-董事

吳田玉

日月光半導體製造(股)公司-集團營運長及董事(代表人)
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Japan Co., Ltd.-董事
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事
GAPT-Cayman-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事
ASE Assembly & Test(HK) Ltd.-董事
蘇州日月新半導體有限公司-董事兼總經理
日月光半導體(威海)有限公司-董事
ASE (U.S.) Inc.-總經理

董宏思

日月光半導體製造(股)公司-財務長及董事(代表人)
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
ASE Japan Co., Ltd.-監察人
台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-監察人
Innosource Ltd. -董事
J&R Holding Ltd. (Bermuda)-董事
ASE Investment (Labuan) Inc.-董事
ASE Holding Ltd. (Bermuda) -董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Holding, Ltd.-董事
ASE Test Finance, Ltd.-董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn. Bhd.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Mauritius Inc.-董事
日月光電子(股)公司-董事(代表人)
ASE Labuan Inc.-董事
ASE Corporation-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
環隆電氣(股)公司-監察人(代表人)
環旭上海公司-監察人
環鴻台灣公司-監察人(代表人)
三朋友電有限公司(香港)-董事
大眾商業銀行-獨立董事

張能傑

日月光半導體製造(股)公司-董事
日月光半導體(上海)(股)公司-董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
環旭上海公司-董事

劉曉明

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
晶鈞科技股份有限公司-董事(代表人)

張洪本

日月光半導體製造(股)公司-總經理及副董事長
日月瑞(股)公司-董事(代表人)
Innosource Ltd.-董事
日月光半導體(上海)(股)公司-董事
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ASE Test Limited (Singapore) -董事
ASE (Korea) Inc.-董事
ASE Electronics (Malaysia) Sdn, Bhd.-董事
ASE Holding Ltd. (Bermuda) -董事
J&R Holding Ltd.(Bermuda) -董事
日月光半導體(昆山)有限公司-董事長及董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事長及董事
日月光高新科技(上海)有限公司-董事長及董事
日月鴻科技股份有限公司-董事(代表人)
GAPT-Cayman-董事
日月光封裝測試(上海)有限公司-董事
ASE Assembly & Test (HK) Ltd.-董事
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事長及董事
ASE Japan Co., Ltd.-董事
日月光半導體(香港)有限公司-董事長及董事
日月光集成電路製造(中國)有限公司-董事
Alto Enterprises Ltd.-董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
環隆電氣(股)公司-董事長及董事(代表人)
RTH公司-董事長及董事
環旭上海公司-董事長及董事
環旭昆山公司-董事長及董事
環勝電子(深圳)公司-董事長及董事
環鴻香港公司-董事長及董事
環鴻深圳公司-董事
環旭香港公司-董事
環鴻台灣公司-董事(代表人)
環誠公司-董事

羅瑞榮

日月光半導體製造(股)公司-高雄廠區總經理及董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)及總經理

游勝福

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事
勝福會計師事務所會計師

徐大麟

日月光半導體製造(股)公司-獨立董事
漢鼎亞太公司總裁暨創辦人

陳昌益

日月光半導體製造(股)公司-副總經理及董事(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(昆山)有限公司-董事
ASE Test Limited (Singapore)-董事
ASE Test Holdings Ltd.-董事
Omniquest Industrial Ltd.-董事
ISE Labs, Inc.-董事
ASE Investment (Labuan) Inc.-董事
日月光電子元器件(上海)有限公司-董事
日月光高新科技(上海)有限公司-董事
上海鼎匯房地產開發有限公司-董事長及董事
日月光電子(股)公司-董事(代表人)
日月光半導體(香港)有限公司-董事
日月光電子元器件(昆山)有限公司-董事
蘇州日月新半導體有限公司-董事
上海鼎威房地產開發有限公司-董事長及董事
上海鼎裕房地產開發有限公司-董事長及董事
Super Zone Holdings Ltd.-董事
環隆電氣(股)公司-董事
展毅投資股份有限公司-董事(代表人)
達基公司-董事(代表人)
HHI公司-董事
聯合創業投資(股)公司-董事(代表人)

陳天賜

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
日月鴻科技股份有限公司-董事(代表人)

張能超

日月光半導體製造(股)公司-監察人
日月光半導體(上海)股份有限公司-董事

何弘

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
 日月光電子(股)公司-監察人(代表人)
 ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.-董事
 ASE Japan Co., Ltd. -董事
 日月鴻科技股份有限公司-監察人
 環隆電氣(股)公司-董事
 展毅公司-董事(代表人)
 達基公司-董事(代表人)
 環隆英國公司-董事
 環隆日本公司-董事
 環旭上海公司-董事
 HHI公司-董事
 RTH公司-董事
 UI公司-董事
 UHI公司-董事
 USI-CA公司-董事
 UEHC公司-董事
 環鴻香港公司-董事
 環旭昆山公司-董事
 環旭香港公司-董事
 環茂控股公司-董事
 環鴻台灣公司-董事(代表人)
 環勝電子(深圳)公司-董事

李智強

台灣福雷電子(股)公司-董事(代表人)
 日月光封裝測試(上海)有限公司-董事兼總經理
 ASE Assembly & Test(HK) Ltd.-董事
 日月光半導體(上海)(股)公司-董事
 GAPT-Cayman-董事
 蘇州日月新半導體有限公司-監察人
 日月光半導體(威海)有限公司-董事
 上海鼎匯房地產開發有限公司-董事
 上海鼎威房地產開發有限公司-董事
 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事

曾元一

日月光半導體製造(股)公司-監察人(代表人)
 宏璟建設(股)公司-董事長
 宏錦光(股)公司-董事(代表人)
 宏璟新(股)公司-董事長及董事(代表人)
 三朋友電有限公司(香港)-董事
 ASE (Korea Inc.)-監察人

俞旭濬

上海鼎匯房地產開發有限公司-董事
 上海鼎威房地產開發有限公司-董事
 上海鼎裕房地產開發有限公司-董事
 環隆電氣股份有限公司-監察人(代表人)
 宏璟建設股份有限公司-監察人
 視元素(股)公司-董事長及董事(代表人)

1.1 董事、監察人為法人股東其主要股東

100年02月28日

法人股東名稱	法人股東之主要股東	持股比例
香港商微電子國際公司	Aintree Limited	100.00%
	日月光半導體製造(股)公司	99.99%
	蔡惠昭	0.01%
	張顏慧琪	0.00%
	朱武彝	0.00%
	楊德榮	0.00%
	潘心蘭	0.00%
	蘇煜嵐	0.00%
	柯照堂	0.00%
	李寶秀	0.00%
	黃桂銀	0.00%
台灣福雷電子股份有限公司	日月光半導體製造(股)公司	26.22%
	張虔生	16.35%
	張洪本	7.20%
	宏璟新股份有限公司	3.16%
	張姚宏影	2.80%
	張迎申	2.56%
	匯豐銀行託管摩根士丹利國際有限公司專戶	2.42%
	萬亞投資股份有限公司	2.21%
	明祥投資股份有限公司	2.11%
	偉東投資股份有限公司	2.03%

另法人股東其主要股東為日月光半導體製造(股)公司者，其主要股東詳本年報第28頁。

1.2 董事、監察人為法人股東其主要股東為法人者其上一層主要股東

100年02月28日

法人名稱	法人之主要股東	持股比例
Aintree Limited	張虔生	100.00%
宏璟新股份有限公司	宏璟建設股份有限公司	100.00%
	鼎昌投資股份有限公司	99.95%
	張洪本	0.01%
	張虔生	0.01%
萬亞投資股份有限公司	張淡榮	0.01%
	馮美玲	0.01%
	馮偉誠	0.01%
	馮偉望	0.00%
	嘉瑩投資股份有限公司	99.95%
	張淡榮	0.01%
明祥投資股份有限公司	張虔生	0.01%
	馮美珍	0.01%
	馮美玲	0.01%
	王永剛	0.01%
	劉小克	0.00%
	嘉慶投資股份有限公司	99.95%
	張虔生	0.01%
偉東投資股份有限公司	張淡榮	0.01%
	馮美珍	0.01%
	馮美玲	0.01%
	王永剛	0.01%
	劉小克	0.00%

1.3 董事及監察人所具專業知識及獨立性之情形

姓名	是否具有五年以上工作經驗及下列專業資格			符合獨立性情形				
	商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上	法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員	商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗	1.非為公司或其關係企業之受僱人	2.非公司或其關係企業之董事、監察人	3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東	4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬	5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人
張虔生			V					
張洪本			V					
吳田玉			V			V	V	V
羅瑞榮			V			V	V	V
董宏思			V				V	V
陳昌益			V			V	V	V
張能傑			V			V		V
游勝福	V	V	V	V	V	V	V	V
徐大麟			V	V	V	V	V	V
何弘			V			V	V	V
劉曉明			V			V	V	V
陳天賜			V			V	V	V
曾元一			V			V	V	V
張能超			V			V		V

姓名	符合獨立性情形					兼任其他公開發行 公司獨立董事家數
	6. 非與公司有財務 或業務往來之特 定公司或機構之 董事(理事)、監 察人(監事)、經 理人或持股百分 之五以上股東	7. 非為公司或關係 企業提供商務、 法務、財務、會 計等服務或諮詢 之專業人士、獨 資、合夥、公司 或機構之企業 主、合夥人、董 事(理事)、監察 人(監事)、經理 人及其配偶	8. 未與其他董事間 具有配偶或二 親等以內之親 屬關係	9. 未有公司法第30 條各款情事之一	10. 未有公司法第 27條規定以政 府、法人或其 代表人當選	
張虔生		V		V		0
張洪本		V		V	V	0
吳田玉	V	V	V	V		0
羅瑞榮	V	V	V	V		0
董宏思		V	V	V		1
陳昌益		V	V	V		0
張能傑	V	V		V	V	0
游勝福	V	V	V	V	V	0
徐大麟	V	V	V	V	V	0
何弘		V	V	V		0
劉曉明		V	V	V		0
陳天賜	V	V	V	V		0
曾元一		V	V	V		0
張能超	V	V		V	V	0

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

單位：股(截至年報刊印日止實際持有股數)

職稱	姓名	就任日期	持有股份		配偶、未成年子女持有股份		利用他人名義持有股份	
			股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率
執行長	張虔生	92.05	63,292,924	1.05%	1,504,000	0.02%	1,127,185,752(註1)	18.70%
總經理	張洪本	92.02	80,792,217	1.34%	95,612,517	1.59%	—	—
集團營運長及 總經理	吳田玉	96.02	2,589,934	0.04%	—	—	—	—
高雄廠區總經理	羅瑞榮	95.04	1,525,519	0.03%	931	—	—	—
總經理	李智強	92.07	90,000	—	—	—	—	—
總經理	唐和明	96.01	1,590,706(註2)	0.03%	—	—	—	—
財務長	董宏思	83.12	2,873,591	0.05%	216,324	—	—	—
副總經理	唐國安	87.02	181,658	—	—	—	—	—
副總經理	俞旭濬	88.08	—	—	—	—	—	—
副總經理	陳昌益	91.05	1,520,671	0.03%	—	—	—	—
副總經理	陳道有	93.01	435,348	0.01%	—	—	—	—
副總經理	李世文	93.01	34,226	—	—	—	—	—
副總經理	林顯堂	93.01	506,038	0.01%	11,310	—	—	—
副總經理	林國堂	93.08	1,114,836	0.02%	2,552	—	—	—
副總經理	莫煥華	93.08	329,420	0.01%	—	—	—	—
副總經理	葉清昆	93.08	71,000	—	—	—	—	—
副總經理	藍詩融	93.08	359,706	0.01%	—	—	—	—
副總經理	曾和帝	95.06	535,986	0.01%	—	—	—	—
副總經理	鄭楨銘	95.07	20,792	—	—	—	—	—
副總經理	洪松井	100.01	181,198	—	—	—	—	—

職稱	姓名	主要學(經)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之經理人		
				職稱	姓名	關係
執行長	張虔生	台灣大學電機工程系畢 美國伊利諾理工學院碩士	請參閱第07頁	副董事長 董事	張洪本 張能傑	弟子
總經理	張洪本	中原大學工業工程學系畢 環隆電氣(股)公司董事長	請參閱第07頁	董事長 監察人	張虔生 張能超	兒子
集團營運長及總經理	吳田玉	美國賓州大學應用機械博士	請參閱第07頁	—	—	—
高雄廠區總經理	羅瑞榮	交通大學電子物理系畢	請參閱第07頁	—	—	—
總經理	李智強	清華大學工業管理系畢 台灣福雷電子製造處副總	請參閱第08頁	—	—	—
總經理	唐和明	美國哥倫比亞大學化工博士	台灣福雷電子(股)公司-監察人(代表人)	—	—	—
財務長	董宏思	美國南加州大學企管碩士 美商花旗銀行企業融資部副總裁	請參閱第07頁	—	—	—
副總經理	唐國安	國立中央大學管理學碩士 矽品精密工業品部副總	無	—	—	—
副總經理	俞旭濬	國立藝專廣播電視科 東森傳播公司副總經理 鑫凱傳播公司總經理	請參閱第08頁	—	—	—
副總經理	陳昌益	加拿大英屬哥倫比亞大學企管碩士 美商信孚銀行台北分行副總裁	請參閱第07頁	—	—	—
副總經理	陳道有	成功大學機械系畢	無	—	—	—
副總經理	李世文	成功大學物理系畢	無	—	—	—
副總經理	林顯堂	中山大學EMBA碩士	無	—	—	—
副總經理	林國堂	崑山工專電子科畢	無	—	—	—
副總經理	莫煥華	伯明罕大學機械工程所	無	—	—	—
副總經理	葉清昆	東吳大學物理系	無	—	—	—
副總經理	藍詩融	休士頓大學企研所	無	—	—	—
副總經理	曾和帝	中原大學工業工程與管理系	無	—	—	—
副總經理	鄭楨銘	淡江大學機械工程系	無	—	—	—
副總經理	洪松井	德州大學機械博士	無	—	—	—

註1：其中設質股數為173,288,000股。

註2：其中設質股數為1,300,000股。

(三)最近年度支付董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

3.1 董事之酬金

99年12月31日

職稱	姓名	兼任員工領取相關酬金								A、B、C、D、E、F及G等七項總額占稅後純益之比例	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金			
		薪資、獎金及特支費等(E)(註3)		退職退休金(F)(註2)		盈餘分配員工紅利(G)(註1)			員工認股權憑證得認購股數(H)					
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司		合併報表內所有公司		本公司	合併報表內所有公司	本公司		
董事本人	張洪本 (副董事長)	134,900	189,977	3,120	4,481	50,430	—	65,830	—	16,100,000股	22,029,600股	2.02%	2.30%	有 (註4)
	張能傑													
	香港商微電子國際公司													
	張虔生 (董事長)													
	吳田玉													
	羅瑞榮													
	董宏思													
	陳昌益													
獨立董事	游勝福													
獨立董事	徐大麟													

註1：本公司董事會於100年3月30日決議，擬訂99年度董監酬勞為新台幣304,200仟元，董事之金額為新台幣177,450仟元，員工紅利新台幣1,523,133仟元(全部以現金發放)，惟截至刊印日止本次員工紅利配發名單尚未決定，茲以去年員工紅利之實際配發比例估算擬議配發數如上，上述盈餘分配內容俟本年度股東會決議通過後才確定。

註2：本公司99年度實際給付退職退休金金額為0元；該欄退職退休金金額全數屬退職退休金費用化之提列(提撥)數。

註3：本欄位含本公司及子公司員工認股權費用化之金額新台幣71,269仟元。

註4：領取來自子公司以外轉投資事業酬金為新台幣708仟元。

酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距	董事姓名					前四項酬金總額(A+B+C+D)	前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G)	本公司	所有轉投資事業J	本公司	所有轉投資事業J						
	本公司		所有轉投資事業I														
	本公司	所有轉投資事業I	本公司	所有轉投資事業J	本公司												
低於2,000,000元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
2,000,000元(含)～5,000,000元	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	游勝福、徐大麟	—	—	—	—	—	—						
5,000,000元(含)～10,000,000元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
10,000,000元(含)～15,000,000元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
15,000,000元(含)～30,000,000元	張虔生、張洪本、吳田玉、羅瑞榮、董宏思、陳昌益、張能傑	張虔生、張洪本、吳田玉、羅瑞榮、董宏思、陳昌益、張能傑	陳昌益、張能傑	張能傑	—	—	—	—	—	—	—						
30,000,000元(含)～50,000,000元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
50,000,000元(含)～100,000,000元	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
100,000,000元以上	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
總計	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						

3.2 監察人之酬金

99年12月31日
單位：新台幣仟元

職稱	姓名	監察人酬金						A、B及C等三項總額占稅後純益之比例	有無領取來自子公司以外轉投資事業酬金		
		報酬(A)		盈餘分配之酬勞(B)(註5)		業務執行費用(C)					
		本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司	本公司	合併報表內所有公司				
監察人本人	張能超	—	—	101,400	101,400	—	—	0.55%	0.53%	有 (註6)	
	台灣福雷電子股份有限公司										
	何弘										
	劉曉明										
	陳天賜										
監察人本人	宏環建設股份有限公司	—	—	25,350	25,350	—	—	0.14%	0.13%	無	
監察人之法人代表人	曾元一	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

註5：本公司董事會於100年3月30日決議，擬訂99年度董監酬勞為新台幣304,200仟元，監察人擬配發之金額為新台幣126,750仟元，俟本年度股東會決議通過後才確定。

註6：領取來自子公司以外轉投資事業酬金為新台幣403仟元。

酬金級距表

給付本公司各個監察人酬金級距	監察人姓名	
	前三項酬金總額(A+B+C)	
	本公司	所有轉投資事業D
低於2,000,000元	—	—
2,000,000元(含)~5,000,000元	—	—
5,000,000元(含)~10,000,000元	—	—
10,000,000元(含)~15,000,000元	—	—
15,000,000元(含)~30,000,000元	曾元一、何弘、劉曉明、陳天賜、張能超	曾元一、何弘、劉曉明、陳天賜、張能超
30,000,000元(含)~50,000,000元	—	—
50,000,000元(含)~100,000,000元	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	—	—

3.3 總經理及副總經理之酬金

99年12月31日
單位：股，新台幣仟元

職稱	姓名	薪資(A)		退職退休金(B)		獎金及特支費等(C)	
		本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司
執行長	張虔生						
總經理	張洪本						
集團營運長及總經理	吳田玉						
高雄廠區總經理	羅瑞榮						
總經理	李智強						
總經理	唐和明						
財務副總	董宏思						
副總經理	唐國安						
副總經理	俞旭濬						
副總經理	陳昌益	162,461	217,976	5,670	7,030	52,112	59,837
副總經理	陳道有						
副總經理	李世文						
副總經理	林顯堂						
副總經理	林國堂						
副總經理	莫煥華						
副總經理	葉清昆						
副總經理	藍詩融						
副總經理	曾和帝						
副總經理	鄭楨銘						
副總經理	洪松井						

職稱	姓名	盈餘分配之員工紅利金額(D)(註)				A、B、C及D等四項總額占稅後純益之比例(%)		取得員工認股權憑證數額		有無領取 來自子公司以外轉 投資事業 酬金	
		本公司		合併報表內 所有公司		本公司	合併報表內 所有公司	本公司	合併報表內 所有公司		
		現金紅 利金額	股票紅 利金額	現金紅 利金額	股票紅 利金額						
執行長	張虔生										
總經理	張洪本										
集團營運長及總經理	吳田玉										
高雄廠區總經理	羅瑞榮										
總經理	李智強										
總經理	唐和明										
財務副總	董宏思										
副總經理	唐國安										
副總經理	俞旭濬										
副總經理	陳昌益										
副總經理	陳道有										
副總經理	李世文										
副總經理	林顯堂										
副總經理	林國堂										
副總經理	莫煥華										
副總經理	葉清昆										
副總經理	藍詩融										
副總經理	曾和帝										
副總經理	鄭楨銘										
副總經理	洪松井										

註：詳第12頁註1之說明。

酬金級距表

給付本公司各個總經理及 副總經理酬金級距	總經理及副總經理姓名	
	本公司	所有轉投資事業
低於2,000,000元	陳昌益	—
2,000,000元(含)～5,000,000元	—	—
5,000,000元(含)～10,000,000元	俞旭濬、陳道有、李世文、林顯堂、林國堂、唐國安、 莫煥華、葉清昆、藍詩融、曾和帝、鄭楨銘	俞旭濬、陳道有、李世文、林顯堂、林國堂、唐國安、 莫煥華、葉清昆、藍詩融、曾和帝、鄭楨銘
10,000,000元(含)～15,000,000元	李智強	—
15,000,000元(含)～30,000,000元	張洪本、羅瑞榮、唐和明、董宏思	羅瑞榮、李智強、唐和明、董宏思、陳昌益
30,000,000元(含)～50,000,000元	張虔生、吳田玉	張虔生、張洪本、吳田玉
50,000,000元(含)～100,000,000元	—	—
100,000,000元以上	—	—
總計	—	—

3.4 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形

99年12月31日
單位：新台幣仟元

	職稱	姓名	股票紅利金額(註1)	現金紅利金額(註1)	總計	總額占稅後純益之比例%
經理人	執行長	張虔生	—	86,760	86,760	0.47%
	總經理	張洪本				
	集團營運長及總經理	吳田玉				
	高雄廠區總經理	羅瑞榮				
	總經理	李智強				
	總經理	唐和明				
	財務副總	董宏思				
	副總經理	唐國安				
	副總經理	俞旭濬				
	副總經理	陳昌益				
	副總經理	陳道有				
	副總經理	李世文				
	副總經理	林顯堂				
	副總經理	林國堂				
	副總經理	莫煥華				
	副總經理	葉清昆				
	副總經理	藍詩融				
	副總經理	曾和帝				
	副總經理	鄭慎銘				
	副總經理	洪松井				

註1：詳第12頁註1之說明。

(四) 分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

占稅後損益比例	年度	九十九年度		九十八年度	
		項目	本公司	合併報表內所有公司	本公司
董事、監察人酬金總額(註2)		2.32%	2.59%	3.20%	3.44%
總經理及副總經理酬金總額(註2)		1.26%	1.62%	2.38%	2.63%

本公司執行長及總經理之薪資係經本公司董事會決議通過，另副總經理之酬金則參照同業水準訂定支付之，每年定期檢視與同業人才競爭廠商比較，確保薪酬的競爭性，其獎金之給付則視本公司盈餘多寡、個人經營績效優劣以達求才與留才之目的。

董事、監察人酬勞之擬訂，係依有純益年度之分配順序，將酬勞明訂於本公司章程中。

註2：本公司董事會於100年3月30日決議，擬訂99年度提撥員工紅利新台幣1,523,133仟元，全部以現金發放，惟截至刊印日止本次員工紅利配發名單尚未決定，故酬金總額之計算員工紅利金額係以去年實際配發比例估算擬議配發數。

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形：

董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會15(A)次，董事出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數B	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A) (註1)	備註
董事本人	張洪本(副董事長)	5	9	33%	
董事本人	張能傑	3	2	20%	
	張虔生(董事長)	8	7	53%	
	吳田玉	8	4	53%	
董事之法人(香港商微電子國際公司) 代表人	羅瑞榮	14	0	93%	
	董宏思	14	0	93%	
	陳昌益	1	1	7%	
獨立董事	游勝福	15	0	100%	
獨立董事	徐大麟	5	10	33%	

其他應記載事項：無。

註1：實際出席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際出席次數計算之。

(二)審計委員會運作情形或監察人參與董事會運作情形：

審計委員會運作情形資訊：本公司依臺灣之證交法尚無需設置審計委員會，惟為配合ADR上市之相關規定，本公司業已依美國沙氏法案設置符合其規定之審計委員會。

監察人參與董事會運作情形資訊

最近年度截至年報刊印日止董事會開會15次(A)，列席情形如下：

職稱	姓名	實際出列席次數B	實際列席率(%) (B/A) (註2)	備註
監察人本人	張能超	0	0%	
	何弘	7	47%	
監察人之法人(台灣福雷電子股份有限公司)代表人	劉曉明	0	0%	
	陳天賜	1	7%	
監察人之法人(宏璟建設股份有限公司)代表人	曾元一	5	33%	

其他應記載事項：

一、監察人之組成及職責：本公司並無設置審計委員會(由全體獨立董事組成)以代替監察人之情事。

1.監察人與公司員工及股東之溝通情形(如溝通管道、方式等)：目前公司之員工及股東均直接與本公司溝通。

2.監察人與內部稽核主管及會計師之溝通情形(如就公司財務、業務狀況進行溝通之方式、事項及結果等)：每季度結束後，內部稽核主管會彙總上一季度所查核的稽核事項及缺失，於定期董事會中報告，並於會後將相關資料併同董事會議紀錄e-mail予全體董監事參閱。根據公司法第219條監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊應予查核，本公司監察人若對於財務報表有疑問會直接與會計師聯繫並溝通。

二、監察人列席董事會如有陳述意見，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對監察人陳述意見之處理：

董事會日期期別	議案內容	董事會決議結果	公司對監察人陳述意見之處理
99.12.10 99年度第14次董事會議	訂定本公司一〇〇年度稽核計畫 監察人發言摘要：確實現在美國公司對整個稽核業務都在加強，故請稽核主管在 下一次董事會補充報告，將有助於董監事了解公司加強了那些稽核內容。	經主席徵詢出席董事全體 無異議照案通過。	公司已於下一次(100年1月12日)之董事會議中 補充報告本公司一〇〇年度稽核計畫之稽核範 圍及稽核內容

註2：實際列席率(%)則以其在職期間董事會開會次數及其實際列席次數計算之。

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、公司股權結構及股東權益		
(一)公司處理股東建議或糾紛等問題之方式。	本公司有專人負責法人關係、公共關係、法務等相關部門處理股務相關事宜。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二)公司掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單之情形。	本公司每月均經由董監事及持股10%以上大股東之持股變動申報書，以確實掌握實際控制公司之主要股東之名單，並經由與主要股東保持密切聯繫，以掌握其最終控制者之名單。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(三)公司建立與關係企業風險控管機制及防火牆之方式。	透過內部控制制度及相關辦法之制定及落實，稽核單位並定期監督執行情形。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
二、董事會之組成及職責		
(一)公司設置獨立董事之情形。	本公司於民國98年股東常會已選任獨立董事二位。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二)定期評估簽證會計師獨立性之情形。	本公司均定期評估簽證會計師的獨立性，目前本公司之簽證會計師與公司、董事及監察人均非關係人，獨立性並無疑慮。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
三、建立與利害關係人溝通管道之情形	本公司責成相關單位專責處理債權人、客戶及供應商等利害關係人之溝通事宜，員工亦設有工會定期與公司溝通。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
四、資訊公開		
(一)公司架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊之情形。	本公司已架設網站，並責成相關部門專責維護並隨時揭露公司財務業務情形，網址為 http://www.aseglobal.com	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
(二)公司採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）。	本公司指定專人負責定期及不定期於公開資訊觀測站申報各項財務、業務資訊並依相關規定發佈重大訊息。 本公司設有發言人及代理發言人制度，並於本公司之網站上揭露相關資訊。	與上市上櫃公司治理實務守則無重大差異。
五、公司設置提名、薪酬或其他各類功能性委員會之運作情形	本公司目前依沙氏法案已設置審計委員會。 為配合美國證管會之規定，由董事會指派符合1934年美國證交法規則10A-3規定之獨立董事擔任本公司審計委員會之委員。	屬符合臺灣證交法之審計委員會尚在評估規劃中。另薪酬委員會則依證交法預計於100年9月底前設置完成。
六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者，請敘明其運作與所訂公司治理實務守則之差異情形：本公司目前係遵照相關法令執行相關作業並依公司治理守則之精神改善中，未來將考量實際運作情形及內外部環境之評估作為訂定公司治理實務守則之依據。		
七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)。		
<ul style="list-style-type: none"> • 本公司以妥善照顧員工與善盡社會責任自期，承諾將提供並保持一個符合社會責任規範及保障員工福利權益的管理制度，並營造一個安全舒適的工作環境。 • 因應國際碳揭露趨勢，導入溫室氣體管理系統，持續進行溫室氣體盤查及減量，並已完成Y2007,Y2008,Y2009溫室氣體盤查，盤查資訊並通過第三公證單位查證。 • 恪遵環保、安全、綠色產品與社會責任等永續發展相關之法令規章或要求，並尊重國際條例及其解釋。 • 在勞動權益上，持續改善就業環境與安全衛生管理制度，以保障員工就業自由、職場平等及預防傷害事故與職業疾病的發生。 • 在資訊保密上，尊重、保護國際上與客戶之任何技術、專門技能、文件與資料，要求員工或供應商遵守相關保密協定，並落實保全管理，以確保公司與客戶資料之機密安全。 • 在環境管理上，導入綠色設計、綠色材料與綠色製程及製造，有效降低產品對環境的衝擊。並持續推動能源節約、污染預防與資源再利用，以強化管理成效。 • 妥善運用教育訓練資源，提昇員工對環保、安全、綠色產品與社會責任等永續發展各面向的意識與職能，並定期與員工及其代表溝通與諮詢，以確保管理系統持續運作。 • 持續改善永續發展管理機制以成就管理績效，並且確信所有問題均可經由完善管理系統的運作達到控制，進而保障利害關係人的權益。 • 機構辦理與參與公開活動，主動對利害關係人傳達我們積極邁向永續發展的決心，並透過輔導、溝通與宣導，鼓勵產業鏈上下游共同推動永續發展各管理系統，以促進產業鏈之永續經營。 • 本公司會與供應商簽訂供應商保密條款/GP Warranty Letter/稀土與衝突礦產聲明書/供應與承攬商社會責任承諾書，採購合約中明定具法律效力的權利與義務，且明定供應商遴選制度，確保供應商能符合本公司的品質政策、環境政策，並訂定供應商稽核制度以確保執行。為此本公司體認與社會上利害關係各方進行長期對話之必要性。此方式能增進企業對社會的瞭解，做出最佳決策，還能減少企業與社會之衝突。 • 董事及監察人進修之情形：本公司之董事及監察人均依其個人需求自行進修。 • 公司為董事及監察人購買責任保險之情形：本公司已為董事及監察人購買責任保險(99年保險金額約為7億3仟萬元)。 • 本公司業已依法訂定各種內部規章，進行各種風險管理及評估。 		
八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者，應敘明其自評(或委外評鑑)結果、主要缺失(或建議)事項及改善情形：本公司無公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告。		

(四)薪酬委員會其組成、職責及運作情形：本公司依證交法預計於100年9月底前設置薪酬委員會。

(五)履行社會責任情形：(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履行情形。)

項目	運作情形	與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
一、落實推動公司治理		
(一)公司訂定企業社會責任政策或制度，以及檢討實施成效之情形。	本公司有專人負責訂定公司永續發展政策等相關事宜。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二)公司設置推動企業社會責任專(兼)職單位之運作情形。	本公司設有永續發展管理委員會。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三)公司定期舉辦董事、監察人與員工之企業倫理教育訓練及宣導事項，並將其與員工績效考核系統結合，設立明確有效之獎勵及懲戒制度之情形。	本公司定期召開永續發展管理委員會議。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
二、發展永續環境		
(一)公司致力於提升各項資源之利用效率，並使用對環境負荷衝擊低之再生物料之情形。	本公司規劃了電力、水資源與耗用材料的管理機制，並持續進行供應設施效率提升或模組最佳化的改善，以達到減少用電的目標，包含：空調節能、照明節能、製程節能…等節能作為。 本公司有計劃的執行各項資源使用管理，對於能、水資源做最佳化使用與持續改善。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二)公司依其產業特性建立合適之環境管理制度之情形。	本公司在環境保護業務上的執行，除了符合法律及相關規範的規定外，同時建立ISO 14001環境管理系統。建立ISO 14001環境管理系統，除定期查核符合法令要求外，每年訂定污染防治與設備改善計劃，有效降低污染排放與環境管理。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三)設立環境管理專責單位或人員，以維護環境之情形。	本公司設立環境管理專責單位，更配合最佳可行性控制技術(BACT)的選用、污染防治設備正常運作的確保與廢棄物資源化的主動作為，有效降低對環境的衝擊。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(四)公司注意氣候變遷對營運活動之影響，制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略之情形。	本公司注意氣候變遷對營運活動之影響，除推行ISO 14064溫室氣體管理系統，每年均進行溫室氣體盤查外，並訂定溫室氣體減量目標，進行溫室氣體減量。為回應客戶及全球消費大眾對低碳產品的期待，導入PAS 2050產品碳足跡盤查，並以減少產品碳足跡為目標。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
三、維護社會公益		
(一)公司遵守相關勞動法規，保障員工之合法權益，建立適當之管理方法與程序之情形。	本公司依政府法令規範指導員工及各級主管成員，遵守政府勞動法規相關規定。導入SA 8000社會責任管理制度、訂定相關政策，並取得驗證單位證書，明確規範並保障員工工作環境、健康安全、性別歧視等權益事項。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二)公司提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育之情形。	本公司有日月光安全衛生業務的執行，除了符合法律及相關規範的規定，也導入OHSAS 18001職業安全衛生管理系統與TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統，提供員工一個符合安衛法規、安全且健康的最佳作業場所。提供符合安全衛生規定的工作場所，定期舉辦員工工作安全衛生教育訓練與健康促進活動。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(三)公司制定並公開其消費者權益政策，以及對其產品與服務提供透明且有效之消費者申訴程序之情形。	本公司設有客戶服務專業專責團隊，定期檢視客戶的滿意度，提供相關客戶的意見反應與溝通服務。並以網際網路為基礎，建置客戶線上服務平台，整合客戶簡易的服務網路，提供完整的線上供應鏈資訊，致力於提供客戶最好的服務，提供高效率服務。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(四)公司與供應商合作，共同致力提升企業社會責任之情形。	本公司視供應商/承攬商為重要合作夥伴，不論是當地或是全球各地的供應商，依據當地法令公平對待其員工。且不定期舉辦供應商永續發展相關教育訓練課程，除宣導及溝通我們的政策及作法，以及供應商應配合達成的事項，也能與供應商凝聚永續發展的共識。期望與供應商一同成長，創造共存共榮的夥伴關係，建構完整綠色半導體供應鏈群聚，促進整個產業的永續經營發展。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(五)公司藉由商業活動、實物捐贈、企業志工服務或其他免費專業服務，參與社區發展及慈善公益團體相關活動之情形。	本公司長期透過「日月之光慈善事業及日月光文教基金會」關懷活動，致力投入社區發展及參與各項社會公益活動，長期致力於回饋社會，深化社區參與行動，並結合慈善團體回饋社會。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
四、加強資訊揭露		
(一)公司揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊之方式。	本公司為讓社會大眾與所有關注日月光的讀者，瞭解日月光在因應永續發展趨勢的思維與承諾，以及我們在各項永續的相關議題上的努力與堅持，公開發行永續報告書。本報告書符合GRI G3 A+ 應用等級，並取得BSI外部第三方查證聲明書。日月光集團於2010年發行企業永續報導書，對外有效揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。
(二)公司編製企業社會責任報告書，揭露推動企業社會責任之情形。	本公司有編製企業永續報告書，揭露推動企業社會責任之情形。並發行中、英文版本，提供PDF檔刊載於日月光網站(http://www.aseglobal.com)。	與上市上櫃公司企業社會責任實務守則無重大差異。

五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者，請敘明其運作與所訂守則之差異情形：本公司目前係遵照相關法令執行相關作業並依公司社會責任實務守則之精神改善中，未來將考量實際運作情形及內部環境之評估作為訂定公司社會責任實務守則之依據。

六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊：

- 日月光其他企業社會責任運作情形之資訊，請詳日月光永續報告書（<http://www.aseglobal.com>）。
- 目標：經營社會企業、推動志工活動並幫助更多社會的弱勢族群。我們的員工慷慨地奉獻出時間、善款及專業技能，協助解決急難救助、學童教育等問題，是我們履行社會參與承諾的最大支柱。我們期望與廠區週邊的鄰居及社會大眾，藉由長期的合作及溝通，產生信任、互助及融洽的關係，創造積極正面並對社會有益的商業環境。
- 創造就業機會。
- 積極回饋地方：1.不定期捐款回饋政府及地方團體。2.與大專院校合作進行「產學合作」。3.捐贈機台給大專院校。4.設立南區菁英獎學金。(99年度捐贈的政府及地方團體有中華民國對外貿易發展協會、財團法人財經立法促進院籌備處、財團法人余紀忠文教基金會、美商國際半導體產業有限公司台灣分公司、財團法人華聚產業共同標準推動基金會、台灣電路板協會、中華民國工商協進會、中華民國三三企業交流會、高雄市立後勁國民小學、中華民國科技管理學會、財團法人台灣企業重建協會、中國青年救國團等贊助金額約為新台幣2,400萬元)。
- 成立日月光文教基金會積極參與全國性之公益活動(台中榮總教育訓練大樓興建及兩岸城市藝術節—台北文化週(明華園)等贊助金額約為新台幣545萬元)。
- 成立高雄市日月之光慈善會參與地區性公益活動(99年度舉辦的活動經費總計約為新台幣476萬元)條列主要活動如下：
 1. 清寒學子脫貧計畫—獎助學金(對象：鄰近廠區國小及國、高中清寒學生共計751人次)經費新台幣146餘萬元。
 2. 日月之光課後照顧中心—寶貝熊(對象：國小一年級~六年級鄰近廠區貧困、單親、隔代教養原眷民等弱勢家庭學童)經費近新台幣145萬元。
 3. 關懷弱勢團體及急難救助慰問金(對象：永安兒童之家、聖心教養院、突逢變故之家庭及個案)經費約新台幣110餘萬元。
 4. 營養午餐補助計畫經費近新台幣35萬元。
 5. 品格教育希望工程、親子講座、夏令營(對象：快樂熊、寶貝熊課輔班學生與家長)經費近新台幣24萬元。
 6. 其他如「2010弱勢家庭兒童生活體驗營—循規蹈矩、有禮真行」、捐血活動、志工培訓、志工會議及聯誼活動及捐血活動等經費近新台幣16萬元。

七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準，應加以敘明：日月光集團於2010年發行企業永續報告書，對外有效揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊，本報告書符合GRI G3 A+ 應用等級，並通過查證取得BSI外部第三方查證聲明書。

八、揭露溫室氣體排放及減量資訊：本公司編製公開揭露溫室氣體排放及減量資訊於日月光集團永續報告書中，請詳日月光網站 <http://www.aseglobal.com>.

(六)公司履行誠信經營情形及採行措施：

- 本公司之董事、監察人、經理人及受僱人等，秉持高度自律於從事商業行為之過程中，不直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，以求獲得或維持利益。
- 本公司一向正派經營，並遵守公司法、證券交易法、商業會計法、上市上櫃相關規章或其他商業行為等有關法令。法令遵循為企業經營之基本原則，本公司恪遵相關之法令規章或要求，以作為落實誠信經營之基本前提。
- 本公司於商業往來之前，考量代理商、供應商、客戶或其他商業往來交易對象之合法性及是否有不誠信行為紀錄，避免與有不誠信行為紀錄者進行交易。與他人簽訂契約，交易相對人如涉及不誠信行為，得隨時終止或解除契約。本公司與供應商簽訂供應商保密條款/供應與承攬商社會責任承諾書，採購合約中明定具法律效力的權利與義務，且明定供應商遴選制度，確保供應商能符合本公司的品質政策、環境政策，並訂定供應商稽核制度以確保執行。在資訊保密上，尊重、保護國際上與客戶之任何技術、專門技能、文件與資料，要求員工或供應商遵守相關保密協定，並落實保全管理，以確保公司與客戶資料之機密安全且以公平與透明之方式進行商業活動。
- 本公司於員工須知3.2.工作紀律倫理中有訂定「道德規範」，在公司所有營業活動上應遵循最高道德標準之承諾。於執行業務時，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何形式之不正當利益，包括回扣、佣金、疏通費或透過其他途徑向客戶、代理商、承包商、供應商、公職人員或其他利害關係人提供或收受不正當利益。並於員工須知中訂定違反道德規範之行為：1.受雇於本公司之競爭者、客戶或者供應商。2.自競爭者、客戶或供應商處收受過高價值的禮品、私人折扣或收受其他利益。3.在採購或銷售資產、產品、服務或其他利益上與公司競爭。4.在公司與競爭者、客戶或供應商之交易中享有利益。5.基於在公司的職位接受某項債權或者保證事項。6.主導公司與自己擁有或管理，或親戚朋友經營之供應商進行交易。7.假借公司名義及工作之便辦理私人事務或利用職務之便營私舞弊。
- 本公司及董事、監察人、經理人及受僱人等，對於慈善捐贈或贊助，皆符合相關法令及內部作業程序，不為變相行賄。本公司設有「財團法人日月之光慈善事業基金會」與「日月光文教基金會」，投入社區及參與各項社會公益活動。我們的員工慷慨地奉獻出時間、善款及專業技能，協助解決急難救助、學童教育等問題，是我們履行社會參與承諾的最大支柱。
- 本公司之董事會盡善良管理人之注意義務，督促公司防止不誠信行為，確保誠信經營政策之落實。
- 本公司設有健全之會計制度及內部控制制度，不允許有外帳或保留秘密帳戶，為確保該制度之設計及執行持續有效，本公司內部稽核人員不定期查核前項制度遵循情形。
- 本公司對於違反規定之懲戒與申訴，將公佈於公司內部網站並揭露違反人員之職稱、姓名、違反日期、違反內容及處理情形等資訊。

(七)公司如有訂定公司治理守則及相關規章者，應揭露其查詢方式：本公司並未訂定公司治理實務守則。

(八)其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要資訊：無。

(九)內部控制制度執行狀況

1. 內部控制聲明書



日期：一〇〇年三月三十日

本公司民國九十九年度之內部控制制度，依據自行檢查的結果，謹聲明如下：

- 一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率(含獲利、績效及保障資產安全等)、財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
- 二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
- 三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」)規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估及回應，3.控制作業，4.資訊及溝通，及5.監督。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
- 四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，檢查內部控制制度之設計及執行的有效性。
- 五、本公司基於前項檢查結果，認為本公司於民國九十九年十二月三十一日的內部控制制度(含對子公司之監督與管理)，包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
- 六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、本聲明書業經本公司民國一〇〇年三月三十日董事會通過，出席董事七人中，無人持反對意見，均同意本聲明書之內容，併此聲明。

日月光半導體製造股份有限公司

董事長：張虔生 簽章



總經理：張洪本 簽章



- 2. 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。

(十)最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形：無。

(十一)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議：

股東會之重要決議

召開日期	重要決議	執行情形
99.06.14 召開99年股東常會	1. 承認本公司九十八年度決算表冊案。	1. 不適用。
	2. 承認本公司九十八年度盈餘分派案。	2. 已依通過後內容執行。
	3. 本公司擬以盈餘及資本公積轉增資發行新股案。	3. 已依通過後內容辦理相關程序。
	4. 提請股東會授權董事會於適當時機選擇以現金增資參與發行海外存託憑證、或於國內辦理現金增資、或發行國內外可轉換公司債募集資金案。	4. 尚未募集發行。
	5. 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。	5. 已依修訂後運作。
	6. 修訂本公司「背書保證作業程序」案。	6. 已依修訂後運作。
	7. 修訂本公司「公司章程」案。	7. 已依修訂後運作。

董事會之重要決議

開會日期	重要決議
99.03.26	1. 決議通過承認本公司截至民國九十八年十二月三十一日止之背書保證總額及資金貸與他人金額，並提報民國九十九年股東常會報告。 2. 決議通過承認本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表，提請監察人查核，並提報民國九十九年股東常會。 3. 決議通過承認本公司民國九十八年度盈餘分派議案，提請監察人查核，並提報民國九十九年股東常會。 4. 決議通過承認本公司以盈餘及資本公積轉增資發行新股。 5. 決議通過本公司為支應未來產能擴充計畫、充實營運資金、償還銀行借款或其他因應本公司長期發展之資金需求，並使資金募集管道更形多元化及彈性化，提請股東會授權董事會視市場狀況及公司資金需求狀況，於適當時機依公司章程，相關法令規定及以下說明之各項辦理原則，選擇以現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證、或於國內辦理現金增資、或發行國內外可轉換公司債等方式籌措資金，並提請民國九十九年股東常會討論。 6. 決議通過修訂本公司「公司章程」，並提請民國九九年股東常會討論。 7. 決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」，並依法送交各監察人及提請查核民國九九年股東常會討論。 8. 決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」，並依法送交各監察人及提請查核民國九九年股東常會討論。 9. 決議通過本公司民國九十九年股東常會召開之日期、地點及議程。 10. 決議通過本公司以美金2,150萬元將間接持有之大陸地區投資事業日月光半導體(威海)有限公司100%股權轉讓予另一100%間接持有之子公司ASE (Korea) Inc.。
99.04.09	追認本公司於99年3月26日參與投資認購元隆電子股份有限公司99年度第2次私募普通股2,032,370股，投資總金額為新台幣17,580,000元整。
99.04.19	決議通過授權由本公司指派擔任環隆電氣股份有限公司之法人董事代表同意環隆電氣股份有限公司申請股票終止上市案。
99.05.04	1. 決議通過本公司民國九十九年度第一次員工認股權憑證之發行數量及認股權人名冊。 2. 追認本公司為配合未來營運成長之業務發展需要並爭取時效，業於99年4月29日與楠梓電子股份有限公司簽訂買賣契約書，以購入廠辦大樓。
99.05.20	決議通過出具「減少並規範關聯交易承諾函」及「避免同業競爭承諾函」，以配合子公司環旭電子股份有限公司擬於中國申請上市之需要。
99.06.15	1. 決議通過本公司為履行同意環隆電氣股份有限公司申請股票終止上市案所為之承諾，擬公開收購環隆電氣之股份。 2. 決議通過轉讓本公司所持有之日月鴻科技股份有限公司股份900,000股予日月鴻科技股份有限公司之輔導推薦證券商，以配合子公司日月鴻科技股份有限公司申請興櫃之需要。
99.09.23	決議通過本公司發行之股票擬轉換為全面無實體發行，並訂定中華民國99年11月26日為本公司股票轉換為全面無實體發行之換發基準日。
99.11.12	決議通過本公司擬經由子公司ASE (Korea) Inc.以其自有資金增加間接轉投資中國大陸地區美金6,000萬元，以增資日月光半導體(威海)有限公司。
99.11.29	決議通過本公司為維護公司信用及股東權益擬依相關法令規定買回本公司股份並辦理銷除。
100.01.12	1. 決議通過修訂本公司「會計制度」。 2. 決議通過訂定本公司庫藏股註銷股本之減資基準日：100年1月12日。 3. 決議通過本公司擬於南投縣草屯鎮太平路一段351巷135號設立南投分公司，以從事微電子構裝業務，並委任洪松井先生為南投分公司經理人。

(十二)最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者，其主要內容：無。

(十三)最近年度及截至年報刊印日止，與財務報告有關人士(包括董事長、總經理、會計主管及內部稽核主管等)辭職解任情形之彙總：無。

四、會計師公費資訊：

會計師公費資訊級距表

會計師事務所名稱	會計師姓名		查核期間	備註
勤業衆信聯合會計師事務所	龔俊吉	邱慧吟	99.01.01~99.12.31	

單位：新台幣仟元

金額級距	公費項目	審計公費		非審計公費	合計
1 低於2,000千元		—	—	—	—
2 2,000千元(含)~4,000千元		—	—	—	—
3 4,000千元(含)~6,000千元		—	—	—	—
4 6,000千元(含)~8,000千元		—	—	—	—
5 8,000千元(含)~10,000千元		—	—	—	—
6 10,000千元(含)以上		\$34,956		\$29,308	\$64,264

(一) 紿付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分之一以上者，應揭露審計與非審計公費金額及非審計服務內容。

單位：新台幣仟元

會計師事務所名稱	會計師姓名	審計公費	非審計公費					會計師查核期間	備註
			制度設計	工商登記	人力資源	其他(註)	小計		
勤業衆信聯合會計師事務所	龔俊吉 邱慧吟	\$34,956	—	\$245	—	\$29,063	\$29,308	99.01.01 至 99.12.31	非審計公費之其他服務內容，包括導入IFRS、稅務諮詢及其他等。

註：非審計公費按服務項目分別列示，若非審計公費之「其他」達非審計公費合計金額25%者，應於備註欄列示其服務內容。

(二) 更換會計師事務所且更換年度所支付之審計公費較更換前一年度之審計公費減少者，應揭露更換前後審計公費減少金額及原因：不適用。

(三) 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上者，應揭露審計公費減少金額、比例及原因：不適用。

五、更換會計師資訊：

(一) 關於前任會計師

更換日期	九十八年三月六日		
更換原因及說明	本公司簽證會計師原委由勤業衆信聯合會計師事務所龔俊吉及郭麗園兩位會計師為之，因該事務所內部業務調整，故改委由該所之龔俊吉及邱慧吟兩位會計師續為之		
說明係委任人或會計師終止或不接受委任	情況	當事人	會計師 委任人
	主動終止委任		不適用
	不再接受(繼續)委任		
最近兩年内簽發無保留意見以外之查核報告書意見及原因		無	
與發行人有無不同意見	有		會計原則或實務
			財務報告之揭露
			查核範圍或步驟
	無		其他
說明：不適用			
其他揭露事項 (依公開發行公司年報應行記載事項準則第十條第五款第一目第四點應加以揭露者)		無	

(二)關於繼任會計師

事務所名稱	勤業衆信聯合會計師事務所
會計師姓名	龔俊吉、邱慧吟
委任之日期	九十八年三月六日
委任前就特定交易之會計處理方法或會計原則及對財務報告可能簽發之意見諮詢事項及結果	無
繼任會計師對前任會計師不同意見事項之書面意見	無

(三)前任會計師對本準則第10條第5款第1目及第2目之3事項復函：無。

六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間：不適用。

七、董事、監察人、經理人及持股比例超過10%之股東股權移轉及股權質押變動情形。

1. 持股及設質股數變動情形

職稱	姓名	九十九年底止		一〇〇年截至二月底止	
		持有股數增(減)數	質押股數增(減)數	持有股數增(減)數	質押股數增(減)數
董事本人及大股東	香港商微電子國際公司	94,857,763	—	—	173,288,000
董事本人	張洪本(副董事長兼總經理)	7,338,377	—	—	—
董事本人	張能傑	2,359	—	1,280,000	—
董事之法人代表人	張虔生(董事長及執行長)	5,748,912	—	—	—
	吳田玉(集團營運長及總經理)	617,078	—	—	—
	羅瑞榮(高雄廠區總經理)	793,061	—	(600,000)	—
	董宏思(財務長)	261,009	—	—	—
	陳昌益(副總經理)	592,707	—	—	—
獨立董事	游勝福	—	—	—	—
獨立董事	徐大麟	—	—	—	—
監察人本人	張能超	34,296	—	—	—
監察人本人	台灣福雷電子(股)公司	98,528	—	—	—
監察人之法人代表人	何弘	928,527	—	—	—
	劉曉明	227,462	—	(50,000)	—
	陳天賜	805,438	—	—	—
監察人本人	宏璟建設(股)公司	6,117,161	5,220,000	—	—
監察人之法人代表人	曾元一	12,340	—	(27,000)	—
總經理	李智強	90,000	—	—	—
總經理	唐和明	280,859	—	—	—
副總經理	唐國安	91,677	—	(35,000)	—
副總經理	俞旭濬	5,094	—	(176,989)	—
副總經理	陳道有	221,376	—	—	—
副總經理	李世文	(360,560)	—	—	—
副總經理	林顯堂	175,963	—	—	—
副總經理	林國堂	301,260	—	—	—
副總經理	莫煥華	(31,359)	—	(26,000)	—
副總經理	葉清昆	71,000	—	—	—
副總經理	藍詩融	32,672	—	—	—
副總經理	曾和帝	139,600	—	100,000	—
副總經理	鄭楨銘	11,872	—	(200,000)	—
副總經理	洪松井(註)	—	—	—	—

註：係100年1月新上任之經理人。

2. 股權移轉之相對人為關係人資訊：無。

3. 股權質押之相對人為關係人資訊：無。

八、持股比例占前十名之股東，其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：

持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料

100年1月19日(註) 單位：股：%

姓名	本人持有股份		配偶、未成年子女 持有股份		利用他人名義 合計持有股份		前十大股東相互間具 有財務會計準則公報 第六號關係人或為配 偶、二親等以內之親 屬關係者，其名稱或 姓名及關係。	備註
	股數	持股 比率	股數	持股 比率	股數	持股 比率		
香港商微電子國際公司	1,044,341,034	17.322	—	—	—	—	—	—
大通銀行託管歐洲太平洋成長基金專戶	301,043,893	4.993	—	—	—	—	—	—
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證	261,916,239	4.344	—	—	—	—	—	—
德銀保管雷查德之雷拉新興市場組合投資專戶	131,781,069	2.186	—	—	—	—	—	—
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶	120,405,656	1.997	—	—	—	—	—	—
公務人員退休撫卹基金管理委員會	102,441,113	1.699	—	—	—	—	—	—
匯豐銀行託管BNP百利私人銀行香港分行	99,986,790	1.658	—	—	—	—	—	—
馮美珍	95,612,517	1.586	80,792,217	1.340	—	—	張洪本	配偶
張洪本	80,792,217	1.340	95,612,517	1.586	—	—	馮美珍	配偶
匯豐銀行託管新加坡私人有限公司—新加坡	80,192,373	1.330	—	—	—	—	—	—

註：總股數之基礎係依本公司員工截至99年12月31日止因行使員工認股權增加之股數及註銷3rd買回之庫藏股而於100年1月19日辦理變更登記後之流動在外股數。

**九、公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數
綜合持股比例**

99年12月31日 單位：股：%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資	
	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
J&R Holding Limited (Bermuda)	435,128	100.00%	—	—	435,128	100.00%
台灣福雷電子(股)公司	361,409,622	99.99%	—	—	361,409,622	99.99%
ASE Holding Ltd.(Bermuda)	243,966	100.00%	—	—	243,966	100.00%
環隆電氣(股)公司	791,039,874	74.15%	265,817,316	24.92%	1,056,857,190	99.07%
ASE MS Japan Co., Limited	1,200	100.00%	—	—	1,200	100.00%
宏璟建設(股)公司	68,629,782	26.22%	63,686,323	23.56%	132,316,105	49.78%
宏錦光(股)公司	39,047,000	27.31%	—	—	39,047,000	27.31%
Omniquest Industrial Limited	250,504,067	70.63%	104,200,000	29.37%	354,704,067	100.00%
Innosource Limited	86,000,000	100.00%	—	—	86,000,000	100.00%
日月鴻科技(股)公司	135,688,085	55.75%	8,115,558	3.33%	143,803,643	59.08%
晶鍛科技(股)公司	6,000,000	33.33%	—	—	6,000,000	33.33%

註：係公司之長期投資。

肆、募資情形

一、資本及股份

股份種類

股份種類	核定股本					轉換公司債可轉換 股份總數	保留員工認股權 憑證總數		
	流通在外股份			未發行股份	合計				
	已上市	未上市	合計						
普通股	6,029,118,452股	0股	6,029,118,452股	1,970,881,548股	8,000,000,000股	600,000,000股	800,000,000股		

(一) 股本來源

單位:股/新台幣元

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
73.03	—	17,200,000	172,000,000	10,000,000	100,000,000	設立(現金)	無	民國73年3月23日 經加處(73)設字第414號
73.05	—	20,000,000	200,000,000	20,000,000	200,000,000	現金增資100,000,000	無	民國73年5月29日 經加處(73)資字第4585號
73.06	—	23,520,000	235,200,000	23,520,000	235,200,000	現金增資35,200,000	技術股 35,200,000	民國73年7月17日 經加處(73)商字第6266號
75.08	—	33,121,625	331,216,250	33,121,625	331,216,250	現金增資96,016,250	無	民國75年4月2日 經加處(75)資字第2926號
76.11	—	39,495,000	394,950,000	39,495,000	394,950,000	盈餘增資63,733,750	無	民國76年11月25日 經加處(76)資字第11447號
77.06	—	50,000,000	500,000,000	50,000,000	500,000,000	盈餘增資105,050,000	無	民國77年6月9日 經加處(77)資字第11447號
78.12	—	62,000,000	620,000,000	62,000,000	620,000,000	盈餘增資120,000,000	無	民國78年12月24日 經加處(78)資字第3328號
79.11	—	75,024,000	750,240,000	75,024,000	750,240,000	盈餘及員工紅利增資117,840,000 資本公積轉增資12,400,000	無	民國79年11月28日 經加處(79)資字第4696號
80.08	—	125,000,000	1,250,000,000	105,607,373	1,056,073,730	盈餘及員工紅利增資80,761,730 資本公積轉增資225,072,000	無	民國80年4月29日 經加處(80)資字第003001號
80.12	38	125,000,000	1,250,000,000	125,000,000	1,250,000,000	現金增資193,926,270	無	民國80年12月23日 經加處(80)資字第010557號
81.05	—	150,600,000	1,506,000,000	150,600,000	1,506,000,000	盈餘及員工紅利增資68,500,000 資本公積轉增資187,500,000	無	民國81年5月25日 經加處(81)資字第004304號
82.05	—	165,660,000	1,656,600,000	165,660,000	1,656,600,000	資本公積轉增資150,600,000	無	民國82年6月4日 經加處(82)資字第004229號
83.03	—	260,000,000	2,600,000,000	233,824,000	2,338,240,000	盈餘及員工紅利增資491,131,000 資本公積轉增資190,509,000	無	民國83年3月25日 經加處(83)資字第002514號
84.01	60	260,000,000	2,600,000,000	260,000,000	2,600,000,000	現金增資261,760,000	無	民國83年9月24日 經加處(83)資字第008500號
84.05	—	500,000,000	5,000,000,000	356,800,000	3,568,000,000	盈餘及員工紅利增資760,000,000 資本公積轉增資208,000,000	無	民國84年3月27日 經加處(84)資字第002471號
84.07	79.7	500,000,000	5,000,000,000	399,800,000	3,998,000,000	現金增資430,000,000	無	民國84年7月29日 經加處(84)商字第00671號
85.05	—	1,000,000,000	10,000,000,000	729,000,000	7,290,000,000	盈餘及員工紅利增資2,092,600,000 資本公積轉增資1,199,400,000	無	民國85年4月17日 經加處(85)資字第003679號
86.05	—	1,400,000,000	14,000,000,000	1,017,000,000	10,170,000,000	盈餘及員工紅利增資1,640,700,000 資本公積轉增資1,239,300,000	無	民國86年5月1日 經加處(86)資字第004063號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
87.04	—	2,200,000,000	22,000,000,000	1,780,000,000	17,800,000,000	盈餘及員工紅利增資6,409,600,000 資本公積轉增資1,220,400,000	無	民國87年4月4日 經加處(87)資字第003051號
88.07	—	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,000,000	19,800,000,000	盈餘及員工紅利增資 2,000,000,000	無	民國88年10月29日 經加處(88)三資字第011765號
89.06	—	2,400,000,000	24,000,000,000	1,980,355,086	19,803,550,860	海外可轉換公司債轉換普通股本 3,550,860	無	民國89年6月5日 經加處(89)三商字第005552號
89.09	—	3,200,000,000	32,000,000,000	2,652,000,000	26,520,000,000	盈餘及員工紅利增資 6,716,449,140	無	民國89年9月5日 經加處(89)三資字第009686號
89.10	43.81	3,200,000,000	32,000,000,000	2,752,000,000	27,520,000,000	現金增資發行海外存託憑證 1,000,000,000	無	民國89年10月23日 經加處(89)三商字第011577號
90.08	—	4,150,000,000	41,500,000,000	3,254,800,000	32,548,000,000	盈餘及員工紅利增資 5,028,000,000	無	民國90年6月26日 經加三資字第0900005692號
92.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	3,580,280,000	35,802,800,000	盈餘轉增資97,644,000 資本公積轉增資3,157,156,000	無	民國92年9月18日 經加三商字第09200088290號
93.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	3,862,595,437	38,625,954,370	合併增資2,823,154,370	無	民國93年9月3日 經加三商字第09301027080號
93.09	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,000,000	41,000,000,000	盈餘轉增資2,219,773,600 員工紅利轉增資154,272,030	無	民國93年9月15日 經加三商字第09300078780號
94.01	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,100,660,600	41,006,606,000	員工認股權憑證轉換6,606,000	無	民國94年1月31日 經加三商字第09400004370號
94.04	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,111,728,800	41,117,288,000	員工認股權憑證轉換110,682,000	無	民國94年4月21日 經加三商字第09400032410號
94.07	—	5,150,000,000	51,500,000,000	4,113,744,200	41,137,442,000	員工認股權憑證轉換20,154,000	無	民國94年7月21日 經加三商字第09400059920號
94.09	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,550,532,800	45,505,328,000	盈餘轉增資2,878,547,980 員工紅利轉增資255,674,600 資本公積轉增資1,233,663,420	無	民國94年9月29日 經加三商字第09400084400號
94.10	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,557,372,300	45,573,723,000	員工認股權憑證轉換68,395,000	無	民國94年10月21日 經加三商字第09400091660號
95.01	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,563,877,540	45,638,775,400	員工認股權憑證轉換65,052,400	無	民國95年01月19日 經加三商字第09500005220號
95.04	—	6,300,000,000	63,000,000,000	4,573,895,020	45,738,950,200	員工認股權憑證轉換100,174,800	無	民國95年04月24日 經加三商字第09500030630號
95.07	—	7,000,000,000	70,000,000,000	4,577,568,780	45,775,687,800	員工認股權憑證轉換36,737,600	無	民國95年07月19日 經加三商字第09500059250號
95.10	—	7,000,000,000	70,000,000,000	4,592,508,620	45,925,086,200	員工認股權憑證轉換149,398,400	無	民國95年10月17日 經加三商字第09500088730號
96.01	—	7,000,000,000	70,000,000,000	4,611,311,450	46,113,114,500	員工認股權憑證轉換188,028,300	無	民國96年01月18日 經加三商字第09600005130號
96.04	—	7,000,000,000	70,000,000,000	4,629,639,544	46,296,395,440	海外無擔保可轉換公司債轉換 39,956,440及員工認股權憑證 轉換143,324,500	無	民國96年04月20日 經加三商字第09600034690號
96.07	—	7,000,000,000	70,000,000,000	4,645,295,431	46,452,954,310	海外無擔保可轉換公司債轉換 85,688,270及員工認股權憑證 轉換70,870,600	無	民國96年07月23日 經加三商字第09600063120號
96.09	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,392,899,352	53,928,993,520	盈餘轉增資6,941,010,710 員工紅利轉增資535,028,500	無	民國96年09月12日 經加三商字第09600079950號
96.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,447,558,879	54,475,588,790	海外無擔保可轉換公司債轉換 251,542,070及員工認股權憑證 轉換295,053,200	無	民國96年10月23日 經加三商字第09600090450號

年月	發行價格	核定股本		實收股本		備註		
		股數	金額	股數	金額	股本來源	以現金以外財產抵充股款者	核准日期與文號
97.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,466,030,849	54,660,308,490	海外無擔保可轉換公司債轉換145,603,600及員工認股權憑證轉換39,116,100	無	民國97年01月22日 經加三商字第09700004950號
97.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,476,949,209	54,769,492,090	海外無擔保可轉換公司債轉換19,863,200及員工認股權憑證轉換89,320,400	無	民國97年04月22日 經加三商字第09700033570號
97.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,484,848,118	54,848,481,180	海外無擔保可轉換公司債轉換61,524,590及員工認股權憑證轉換17,464,500	無	民國97年07月24日 經加三商字第09700063360號
97.08	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,681,934,764	56,819,347,640	資本公積轉增資1,094,938,940 員工紅利轉增資383,205,000及盈餘轉增資492,722,520	無	民國97年08月28日 經加三商字第09700077400號
97.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,427,734	56,904,277,340	海外無擔保可轉換公司債轉換32,763,800及員工認股權憑證轉換52,165,900	無	民國97年10月21日 經加三商字第09700094250號
98.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,690,742,134	56,907,421,340	員工認股權憑證轉換3,144,000	無	民國98年01月19日 經加三商字第09800005500號
98.03	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,546,705,134	55,467,051,340	註銷庫藏股1,440,370,000	無	民國98年03月16日 經加三商字第09800023510號
98.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,547,064,694	55,470,646,940	員工認股權憑證轉換3,595,600	無	民國98年04月22日 經加三商字第09800037010號
98.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,127,694	54,731,276,940	註銷庫藏股739,370,000	無	民國98年07月14日 經加三商字第09800065960號
98.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,473,529,914	54,735,299,140	員工認股權憑證轉換4,022,200	無	民國98年07月21日 經加三商字第09800068350號
98.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,479,878,254	54,798,782,540	員工認股權憑證轉換63,483,400	無	民國98年10月20日 經加三商字第09800103260號
99.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,488,458,214	54,884,582,140	員工認股權憑證轉換85,799,600	無	民國99年01月25日 經加三商字第09900005410號
99.04	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,495,212,494	54,952,124,940	員工認股權憑證轉換67,542,800	無	民國99年04月23日 經加三商字第09900039480號
99.07	—	8,000,000,000	80,000,000,000	5,499,659,994	54,996,599,940	員工認股權憑證轉換44,475,000	無	民國99年07月19日 經加三商字第09900075180號
99.08	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,049,157,072	60,491,570,720	資本公積轉增資879,195,320 股東股息紅利轉增資4,615,775,460	無	民國99年08月09日 經加三商字第09900084320號
99.10	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,051,987,182	60,519,871,820	員工認股權憑證轉換28,301,100	無	民國99年10月22日 經加三商字第09900113120號
100.01	—	8,000,000,000	80,000,000,000	6,029,118,452	60,291,184,520	員工認股權憑證轉換141,312,700 註銷庫藏股370,000,000	無	民國100年01月19日 經加三商字第10000006520號

(二) 股東結構

100年01月19日(註1)

股東結構 數量	政府機構	金融機構	其他法人	個人	外國機構及外人	合計(註2)
人數(人)	5	1	368	201,249	825	202,448
持有股數(股)	245,548,773	24,579,172	548,803,072	1,500,128,624	3,747,058,811	6,066,118,452
持股比例(%)	4.048	0.405	9.047	24.730	(註3) 61.770	100.000

註1：係股務代理公司所提供之近期期之資料。

註2：包含九十九年十二月三十一日止，因員工行使認股權於一〇〇年一月十九日辦理變更登記後所發行之股數，但未扣除第三次買回庫藏股之註銷股數37,000,000股。

註3：其中陸資持股比例為0.009%。

(三) 股權分散情形

1. 普通股股權分散情形

每股面額十元：100年01月19日(註1)

持股分級	股東人數	持有股數	持股比例
1~999	63,209	19,881,354	0.328
1,000~5,000	83,793	191,832,545	3.162
5,001~10,000	26,049	173,156,957	2.854
10,001~15,000	12,617	149,517,118	2.465
15,001~20,000	4,073	69,941,235	1.153
20,001~30,000	5,190	124,938,348	2.060
30,001~40,000	2,244	77,324,695	1.275
40,001~50,000	1,092	48,951,187	0.807
50,001~100,000	2,286	153,108,972	2.524
100,001~200,000	929	124,689,673	2.055
200,001~400,000	377	103,406,694	1.705
400,001~600,000	149	73,926,967	1.219
600,001~800,000	76	52,363,483	0.863
800,001~1,000,000	37	33,349,189	0.550
1,000,001以上	327	4,669,730,035	76.980
合計	202,448	6,066,118,452 (註2)	100.000

2. 特別股股權分散情形：不適用。

(四) 主要股東名單

100年01月19日(註4)

主要股東名稱	股份	持有股數	持股比例
香港商微電子國際公司		1,044,341,034	17.322
大通銀行託管歐洲太平洋基金專戶		301,043,893	4.993
花旗台灣商銀保管日月光存託憑證		261,916,239	4.344
德銀保管雷查德之雷拉新興市場組合投資專戶		131,781,069	2.186
大通託管沙烏地阿拉伯中央銀行投資專戶		120,405,656	1.997
公務人員退休撫卹基金管理委員會		102,441,113	1.699
匯豐銀行託管BNP百利私人銀行香港分行		99,986,790	1.658
馮美珍		95,612,517	1.586
張洪本		80,792,217	1.340
匯豐銀行託管新加坡私人有限公司－新加坡		80,192,373	1.330

註4：總股數之基礎係依本公司員工截至99年12月31日止因行使員工認股權增加之股數及註銷3rd買回之庫藏股而於100年1月19日辦理變更登記後之流動在外股數。

(五) 每股市價、淨值、盈餘及股利資料

單位：新台幣元

項目	年度		九十八年度	九十九年度	九十九年截至年報刊印日止
每股市價	追溯前	最高	29.65	35.50	37.80
		最低	10.20	21.80	31.25
	追溯後	最高	29.65	35.50	註1
		最低	9.27	21.80	註1
平均		20.29	27.51	34.93	
每股淨值	分配前		13.86	14.97	註5
	分配後		13.48	註1	註5
每股盈餘	加權平均股數		5,727,876,248股	5,981,774,926股	6,091,311,415股
	每股盈餘 (稀釋)	追溯前	1.29	3.04	註5
		追溯後	1.17	註1	註5
每股股利	現金股利		0.35965662	註1	—
	無償配股	盈餘配股	0.839198792	註1	—
		資本公積配股	0.159847388	註1	—
累積未付股利		—	—	—	—
投資報酬分析	本益比(註2)		16.19	9.04	註5
	本利比(註3)		58.08	註1	—
	現金股利殖利率(註4)		0.02	註1	—

註1：俟股東會決議後定案。

註2：本益比=當年度平均收盤價/每股盈餘

註3：本利比=當年度每股平均收盤價/每股現金股利。

註4：現金股利殖利率=每股現金股利/當年度每股平均收盤價。

註5：尚未完成盈餘結算。

(六) 公司股利政策及執行狀況

1. 公司之股利政策：

本公司於民國九十八年六月二十五日經股東會通過修訂之股利政策如下：

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分派案，經股東會決議後辦理。

2. 本次股東會擬議股利分配之情形：

(1)本公司董事會於100年3月30日提議本次分派股東紅利新台幣10,889,775,552元，每股配發1.8元，其中新台幣3,932,418,952元以現金方式發放(每股配發現金股利0.65元)，其餘新台幣6,957,356,600元以股票方式發放(每1000股無償配發盈餘轉增資股票股利115股)。有關上項股東股利之配息率及配股率係依據本公司100年3月21日之股東名簿所記載之股數6,049,875,312股計算，嗣後如因本公司發行海外可轉換公司債之債權人行使轉換、或因員工執行員工認股權憑證認購本公司新股、或因本公司辦理現金增資發行新股、或因買回本公司股份、或因本公司將庫藏股轉讓或註銷等因素，影響本公司可參與分配股利之股數，致股東之配息率及配股率發生變動而需修正時，擬提請股東會授權董事會全權處理並調整之。

(2)本次股東會擬議股利分配之情形俟股東常會通過並報請主管機關核准增資後，授權由董事會另訂除權配股基準日，新股之權利義務與原發行之股份相同，屆時將另行公告。

(3)為配合兩稅合一實施，本次盈餘分派案優先分配最近年度盈餘。

3. 預期股利政策將有重大變動時，應加以說明分配之情形：不適用。

(七) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：

不適用。(依「公開發行公司公開財務預測資訊處理準則」規定，本公司無需公開民國一〇〇年度財務預測資訊。)

(八) 員工分紅及董事、監察人酬勞

1. 本公司公司章程於民國九十七年六月十九日股東會後所載員工分紅及董事、監察人酬勞之成數或範圍如下：

依本公司章程第二十三條規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

- (1)彌補虧損。
- (2)提存10%為法定盈餘公積。
- (3)依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。

(4)長期投資依權益法計算之投資收益內屬現金股利以外未實現部分，得就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

如尚有盈餘分派如下：

(5)董事、監察人酬勞金就依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥2%(含)以下。

(6)員工紅利係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥7%(含)以上，10%(含)以下，其中7%部份按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其超過7%部份則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。

(7)其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總額比例分派之。

上開第(6)款所稱之員工，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

2. 本期估列員工紅利及董事、監察人酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發金額若與估列數有差異時之會計處理。

九十九年度應付員工紅利及董事監察人酬勞之估列金額分別為新台幣1,523,133,281元及304,626,656元，分別按稅後淨利(已扣除員工紅利及董監酬勞之金額)之10%及2%計算。董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊：

本公司100年3月30日董事會通過99年度盈餘分派案如下：

- (1)擬議配發員工現金紅利新台幣1,523,133,000元及董事監察人酬勞金額新台幣304,200,000元。上述擬配發金額與原已費用化之員工紅利1,523,133,281元及董事監察人酬勞304,626,656元，差異數共計426,937元。差異原因係會計估計取整數之差異，差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若股東會決議日時，金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。
- (2)擬議配發員工股票紅利金額0元，占本期稅後純益及員工紅利合計數之比例0%。
- (3)考慮擬議配發員工紅利及董事、監察人酬勞後之設算每股盈餘為3.04元。

4. 前一年度員工分紅及董事、監察人酬勞之實際配發情形(包括配發股數、金額及股價)、其與認列員工分紅及董事、監察人酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形。

本公司99年6月14日股東常會通過98年度盈餘分派案及實際配發情形：

(1)實際配發員工紅利新台幣607,009,000元及董事監察人酬勞金額新台幣120,000,000元。

(2)上述實際分派金額與原已費用化之員工紅利607,009,081元，董事監察人酬勞121,401,817元，差異數共計1,401,898元。差異原因：係會計估計取整數之差異。

處理情形：差異金額已於董事會通過擬議時以會計估計變動認列。若股東會決議日時金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。

(九)公司買回本公司股份情形：**公司買回本公司股份情形**

99年12月31日

買回期次	第一次	第二次	第三次
買回目的	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益	維護公司信用及股東權益
買回期間(實際)	97/11/18~98/01/17	98/02/02~98/03/03	99/11/30~99/12/06
買回區間價格	新台幣8~18元	新台幣8~17元	新台幣25~41元
已買回股份種類及數量	普通股144,037,000股	普通股73,937,000股	普通股37,000,000股
已買回股份金額	新台幣1,518,915,314元	新台幣895,346,137元	新台幣1,185,204,932元
已辦理銷除及轉讓之股份數量(註)	144,037,000股	73,937,000股	37,000,000股
累積持有本公司股份數量(註)	普通股0股	普通股0股	普通股0股
累積持有本公司股份數量占買回當時已發行股份總數比率(%)	0%	0%	0%

註：本公司分別於98年3月16日、98年7月14日及100年1月19日完成第一次、第二次及第三次買回股份註銷登記。

二、公司債辦理情形：無。**三、特別股辦理情形：無。****四、海外存託憑證辦理情形：**

100年截至年報刊印日止 單位：美金元

項目	發行(辦理)日期	89年9月	92年6月
發行(辦理)日期	民國89年9月	民國92年6月	
發行及交易地點	美國紐約證券交易所	美國紐約證券交易所	
發行總金額	美金140,000仟元	美金86,808仟元	
單位發行價格	每單位美金7元	每單位美金2.65元	
發行單位總數	20,000,000單位，每單位表彰本公司普通股5股	32,757,600單位，每單位表彰本公司普通股5股	
表彰有價證券之來源	本公司現金增資發行之普通股	本公司股東所持有本公司已發行之普通股	
表彰有價證券之數額	本公司普通股100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整	本公司普通股163,788,000股，每股面額新台幣壹拾元整	
存託憑證持有人之權利與義務	享有與本公司普通股股東相同之權利義務		
受託人	無		
存託機構	花旗銀行		
保管機構	花旗銀行台北分行		
未兌回餘額	迄年報刊印日止，海外存託憑證流通在外餘額為53,794,843單位，表彰本公司普通股268,974,269股。		
發行及存續期間相關費用之分攤方式	無		
存託契約及保管契約之重要約定事項	無		
每單位市價	99年度	最高	5.97
		最低	3.33
		平均	4.30
	100年截至年報刊印日止	最高	6.66
		最低	5.43
		平均	5.92

五、員工認股權憑證辦理情形：

本公司為吸引並留住公司所需之專業人才，激勵員工及提昇員工向心力，業經主管機關分別於九十一年八月、九十三年五月、九十六年十一月及九九年四月核准發行第一次員工認股權憑證160,000,000單位、第二次員工認股權憑證140,000,000單位、第三次員工認股權憑證200,000,000單位及第四次員工認股權憑證200,000,000單位，每單位得認購本公司普通股一股，並以發行日當日之普通股股票收盤價為認股價格。

(一) 員工認股權憑證辦理情形

100年01月19日

員工認股權證種類	第一次員工認股權憑證		第二次員工認股權憑證		第三次員工 認股權憑證	第四次員工 認股權憑證
	第一次發行	第二次發行	第一次發行	第二次發行		
主管機關核准日期	91/8/28		93/5/27		96/11/22	99/04/20
發行(辦理)日期	91/12/24	92/08/22	93/6/30	94/5/23	96/12/19	99/05/06
董事會決定發行單位數	145,990,000單位	14,010,000單位	125,000,000單位	15,000,000單位	200,000,000單位	200,000,000單位
發行得認購股數占發行時 已發行股份總數比率	4.49%	0.39%	3.49%	0.36%	3.66%	3.41%
認股存續期間	本認股權憑證之存續期間為十年，不得轉讓，但因繼承者不在此限。存續期間屆滿後，未行使之認股權視同棄權，認股權人不得再行主張其認股權利。					
履約方式	由本公司發行普通股新股交付。					
限制認股期間及比率(%)	認股權人自被授予員工認股權憑證屆滿二年後，可按下列時程及比例行使認股。					
	認股權憑證授予期間		累積最高可行使認股比例			
	屆滿2年		40%			
	屆滿2.5年		50%			
	屆滿3年		60%			
	屆滿3.5年		70%			
	屆滿4年		80%			
	屆滿4.5年		90%			
屆滿5年		100%				
已執行取得股數	104,789,300股	5,488,360股	66,090,550股	6,730,500股	6,323,300股	0股
已執行認股金額	1,584,222,880元	100,012,389元	1,392,089,670元	118,054,600元	170,544,970元	0元
未執行認股數量	41,199,700股	8,521,640股	58,909,450股	8,269,500股	179,482,700股	187,719,500股
未執行認股者其每股認購價格 (目前執行價格)	新台幣8.5元	新台幣12.1元	新台幣17.2元	新台幣14.0元	新台幣26.9元	新台幣26.0元
未執行認股數量占年報刊印 日已發行股份總數比率(%)	0.68%	0.14%	0.98%	0.14%	2.98%	3.11%
對股東權益影響	本認股權憑證於發行日屆滿二年後，分三年執行，對原股東權益逐年稀釋，其稀釋效果尚屬有限。					

(二)取得員工認股權憑證之經理人及取得認股權憑證可認股數前十大且得認購金額達新臺幣三仟萬元以上員工之姓名、取得及認購情形

100年02月28日

六、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：

- (一)最近年度及截至年報刊印日止已完成併購或受讓他公司股份發行新股：無。
- (二)最近年度及截至年報刊印日止已經董事會決議通過併購或受讓他公司股份發行新股者：無。

七、資金運用計畫執行情形：

截至年報刊印日之前一季止已募集完成但尚未執行完畢之計劃：無。

伍、營運概況

一、業務內容

(一) 業務範圍

從事各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

1. 主要業務：本公司以先進半導體封裝測試技術與製程研發為核心競爭能力，提供全球半導體廠商先進封裝及測試服務。
2. 目前商品種類及其比重：

單位：新台幣仟元

主要產品項目	九九年度	
	營收金額	營業比重
先進基板或導線架型積體電路(FlipChip BGA, QFN, QFP, BCC,WLCSP)	54,707,808	81.2%
傳統導線架型積體電路(SO,PLCC)	990,795	1.5%
其他	11,640,803	17.3%
總計	67,339,406	100.0%

(二) 產業概況

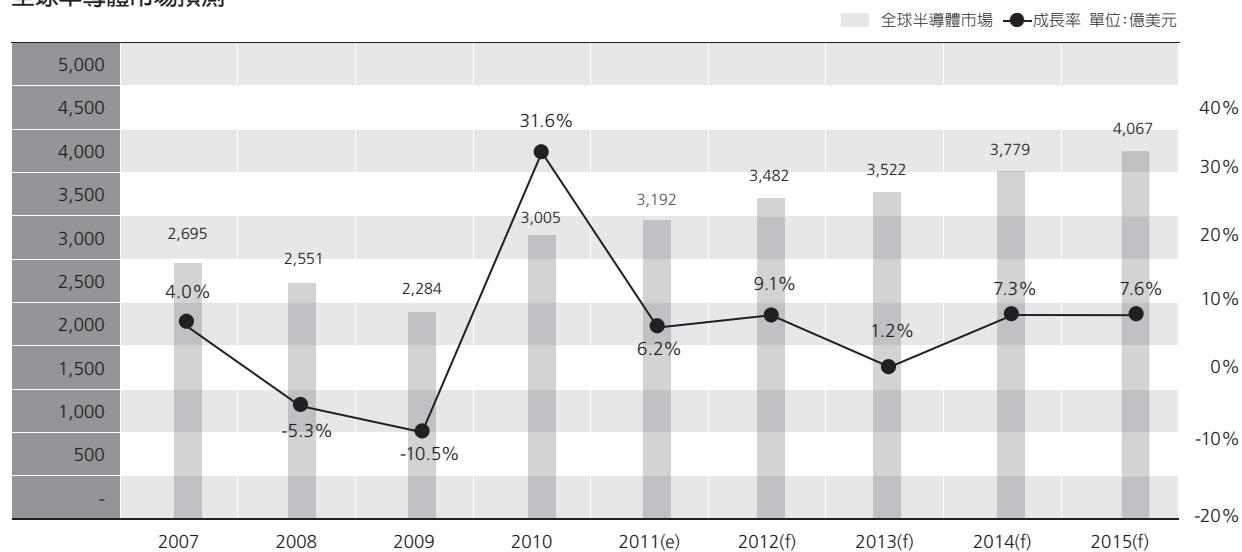
1. 產業之現況與發展

在全球政府振興經濟方案之刺激、供給面的產能縮減以及廠商快速調整庫存之情況下，全球半導體景氣已於2009年落底，並於2010年呈現觸底復甦強勁力道。2010年半導體市場營收達到3,005億美元，產業成長率將達到31.6%。

2010年全球半導體市場成長率為正成長31.6%，由2009年的2,284億美元升至3,005億美元。導因於其下列應用市場：筆記型電腦(Mobile PC)與智慧型手機(Smartphone)仍為半導體殺手級應用，而平板機(Tablet Device)的需求繼Apple iPad於2010年一月推出後，也持續增溫，已成為另一股熱門的新興應用。半導體市場中約有25%的晶片流到通訊性電子產品市場；17%的晶片流到消費性電子產品市場；42%的晶片貢獻給資訊電子產品，此三種應用市場皆顯著帶動半導體產業產值。

在資本支出方面，因景氣復甦力道強勁，隨著晶圓代工廠、邏輯元件以及記憶體製程提升需求，故2010年全球半導體產業資本支出較2009年大幅增加108.9%，達到541億美元。預期2011年的資本支出成長幅度放緩，較2010年衰退3.8%。

全球半導體市場預測



資料來源：Gartner (2011/03)

台灣半導體產業景氣之動向：台灣半導體產業產值表現，2010年我國IC總體產業產值(含設計、製造、封測)為新台幣17,686億元，較2009年增加41.5%。其中設計業產值為新台幣4,548億元，較2009年增加17.9%；製造業為新台幣8,841億元，較2009年增加53.3%；封測業為新台幣4,297億元，較2009年增加49.6% (封裝業為新台幣2,970億元，較2009年增加48.8%；測試業為新台幣1,327億元，較2009年增加51.5%)。以下係2010年我國IC設計、製造、封測業及2011年預估營運表現，表列如下：

2011年台灣半導體產業產值預估

單位：新台幣億元

	2006	2007	2008	2009	2010	2011(e)
IC產業產值	13,933	14,574	13,743	12,497	17,686	19,225
IC設計業	3,234	3,997	3,749	3,859	4,548	4,847
IC製造業	7,667	7,274	6,542	5,766	8,841	9,627
IC封測業	3,032	3,303	3,182	2,872	4,297	4,751

資料來源：工研院IEK (2011/02)

2010年全年台灣IC製造業較2009年成長53.3%，達到新台幣8,841億元。回顧並展望明年，整體而言，台灣IC製造產業的兩大支柱—晶圓代工產業及記憶體製造業及封測業等，在在顯示2010年封測業穩健、2011年晶圓代工樂觀、記憶體多變。

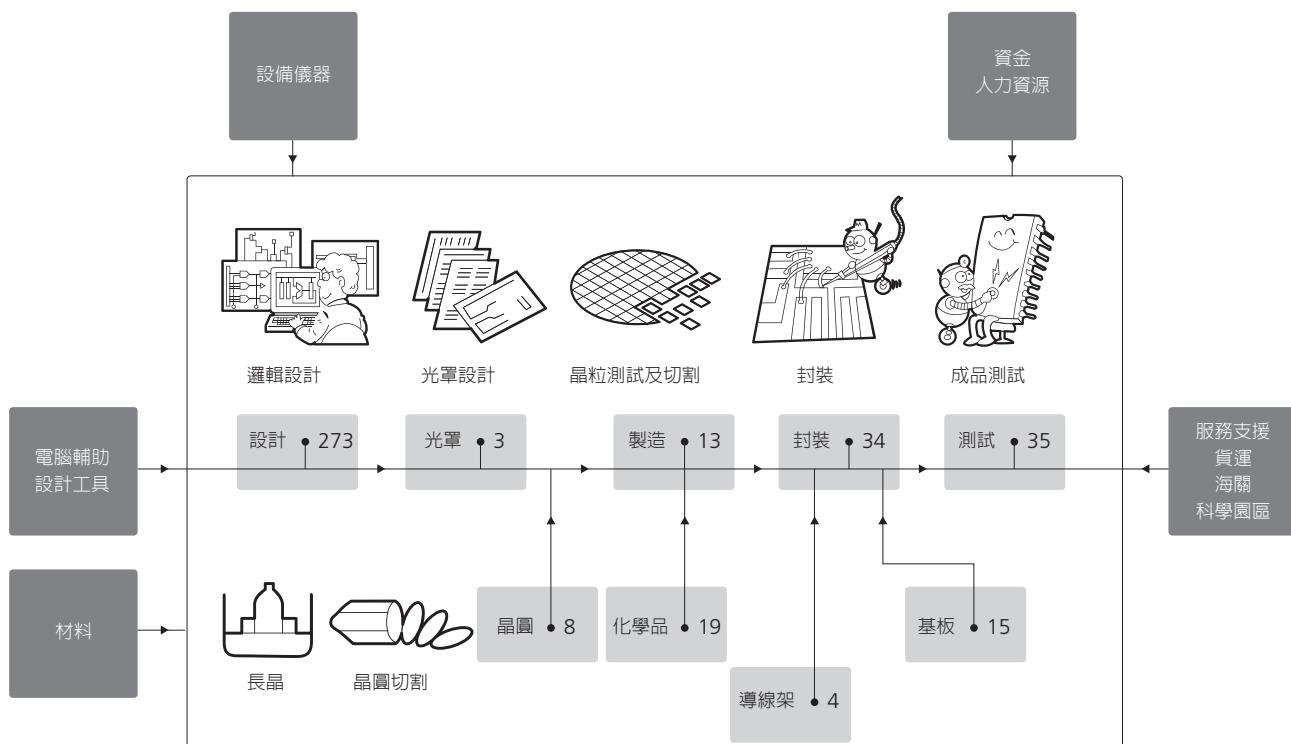
台灣IC製造業也逐漸遠離2009年的金融風暴，廠商競爭情事受到此次風暴衝擊下，相關的併購及策略聯盟活動也逐漸明朗化。而受到2009年景氣趨緩的影響，連帶產能及新製程設備投資保守，但隨著2010年景氣復甦及需求增加，使得主要大廠在2010年都增加資本支出規模，年成長率由負轉正。

2. 產業上、中、下游之關連性

在整個半導體供應鏈中，本公司之業務主要負責中游之封裝測試和下游之封裝材料供應。

本公司提供客戶晶片封裝及測試之半導體製造服務，主要晶圓大都為國際知名半導體公司所提供之半導體製造服務，長期與本公司保持良好的業務關係。本公司並透過策略聯盟與合作伙伴藉由垂直分工，進而提昇彼此的競爭實力。

我國半導體產業結構圖



資料來源：工研院經資中心ITIS計劃/IEK產業情報網(註：圖中數字代表公司家數)

3. 產品之發展趨勢

由於科技的發展下，數位化革命牽動晶片高速化、大容量化，同時還促成邏輯IC、記憶IC被整合成SoC，其結果造成各種電子產品可以實現小型化、高功能、高密度封裝的目標。而在IC封裝技術方面，為了因應消費者對於外型小，功能強的可攜式產品需求強烈，此使得市場投入研究系統整合型封裝(SiP)的發展，SiP的解決方案包括兩大模組：多重晶片模組(MCM BGA)以及堆疊式封裝(Stacked Die Package)而本公司近年來也積極發展三度空間(3D)堆疊及TSV等技術，成為下一波主流技術，包含CMOS Sensor及記憶體等皆已在採用TSV技術，並預期未來基頻、RF及CPU等應用趨勢會愈來愈明顯。我們也預估TSV在以後可望放量。

4. 競爭情形

近年來全球半導體封裝測試業經營方向已從過去的「量變」轉向「質變」，記取2000年教訓，近年來已不再肆意投資，而是謹慎控制產能，並積極改善財務結構，低負債經營成為業界共識；封測業的改變不單如此，連整合元件(IDM)大廠也加快釋出委外訂單，已為封測業者創造出更多商機。綜合上述，封測業正進入低負債經營、IDM廠加速委外、市場轉向大陸等「質變」階段。隨著2010年景氣復甦，封測業者挾著質變優勢，成長性超越整體半導體及晶圓代工產業。鑑此本公司積極地研發未來新市場所需的新技術，並且減少成本降低支出；在目前現有技術及製程能力方面也不斷加強與客戶的溝通以達到或是超越顧客所要求的品質水準，並提供完整的半導體後段製造服務。另外也可藉由合資來增強市場競爭力、降低新產品研發風險及以具備完整產品線，取得市場領導地位。

(三) 技術及研發概況

1. 最近年度投入之研發費用：

單位：新台幣仟元

項目	年度	98年度	99年度	100年截至2月底
營業收入		46,134,314	67,339,406	10,729,223
研發支出金額		2,036,633	2,775,607	440,553
研發支出佔營業收入之比率		4.41%	4.12%	4.11%

2. 所營業務之技術層次：

封裝技術

本公司為配合客戶需求及引導符合市場需求之主流產品及技術，除現有成熟封裝技術服務諸如BGA、QFP外積極開發提供具低成本優勢、高效能封裝服務包括aQFN, aWLP, afcCSP, Cu wire package, aMaP PoP並同步提供高效能先進封裝服務，包括45/32奈米銅導線(超)低介電材質晶圓之高階打線、覆晶封裝、150/200/300mm晶圓凸塊封裝技術與測試能力、200/300 mm基頻晶片(Baseband)與微機電(MEMS)晶圓穿導孔技術、內外引腳式晶圓級封裝技術(Fan-in and Fan-out WLP)、光電封裝技術(Optoelectronics package)、三維晶片及晶片、晶圓堆疊(3D IC)和系統整合型封裝技術SiP(System in a Package)、40微米微間距銅柱凸塊技術(40 um Pitch Cu Pillar Bumping)、矽材基板內埋主動元件(Embedded Chip in Si Substrate)。此外我們擁有全球最大規模的300mm晶圓後段整合服務，並提供綠色環保封裝解決方案之服務。

測試技術

本公司提供頂尖先進測試技術，包括六吋/八吋/十二吋矽晶圓針測與凸塊晶圓針測技術與後段測試能力、IC成品外觀、3D檢驗和捲帶包裝技術。此外，我們擁有獨步全球的十二吋晶圓後段整合服務，並能提供綠色環保測試解決方案之服務。

3. 所營業務之研究發展：

本公司有效的運用專業半導體製造服務，將可協助客戶以最精簡的成本獲得最佳商業收益。面對激烈之競爭環境，本公司研發成果及未來研發方向如下：

(1) 未來研究發展技術

封裝技術

New Package	
先進封裝 (APT)	1. 晶片-晶片, 晶片-晶圓堆疊技術 (Die-to-Die, Die-to-Wafer Stacking) 2. 微間距銅柱覆晶封裝技術 (Fine Pitch Cu Pillar FC Solution) 3. 砂材基板系統封裝技術 (Si Interposer SiP Technology) 4. 熱壓融接技術 (Thermo-compression Bonding Technology) 5. 晶圓級微機電封裝 (Wafer Level MEMS Packaging) 6. DDR3, DDR4封裝測試方案 (DDR3, DDR4 Assembly and Test Solution)
光電封裝 (OEP)	1. 高功率、高亮度LED封裝方案 (High Power/High Brightness LED Packaging Solution) 2. 晶圓級白光LED封裝方案 (Wafer Level White Light LED Packaging Solution) 3. 光感測元件透明封膠技術 (ALS Clear Compound Packaging Solution)
晶圓級封裝 (WLP)	1. 晶圓穿導孔技術 (Through Silicon Via) 2. 砂基板封裝技術 (Silicon Substrate Technology) 3. 豐層晶圓之薄化技術 (Bonded Wafer Thinning Technology) 4. 雙層PI晶圓RDL電鍍銅技術 (2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology) 5. 300 mm二維外引腳式晶圓級封裝 (300 mm Wafer 2D Fan-out WLP) 6. 200 mm 三維外引腳式晶圓級封裝 (200 mm Wafer 3D Fan-out WLP)
覆晶封裝 (Flip Chip)	1. 綠色環保覆晶封裝 (Flip Chip Green Package Solution) 2. 無核心層機板之覆晶封裝 (Coreless Flip Chip Package) 3. 45/40奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝 (45/40 nm Cu/ELK Lead-free FC Solution) 4. 32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝 (32/28 nm ELK Wafer Lead-free FC) 5. 300mm晶圓50微米厚度研磨技術 (300 mm Wafer 50um Backgrind Technology) 6. 300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術 (300 mm TSV Wafer 50um CMP Technology) 7. 銅製程/超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術 (SD Laser Technology on Thin ELK Wafer) 8. 微間距非導電覆晶薄膜底材 (Fine Pitch NCF Underfill Technology) 9. 壓合式晶圓級覆晶封技術 (Laminated FC CSP)
系統封裝 (SiP)	1. 引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-in Map PoP Technology) 2. 外引腳式Map PoP堆疊技術PoP (Fan-out Map PoP Technology) 3. 薄基板核層覆晶PoP堆疊技術 (Thin Core FC PoP Technology) 4. 整合被動元件封裝技術 (Integrated Passive Device) 5. 整合電阻動元件封裝技術 (Integrated Passive Resistor Device) 6. 有機基板內埋被動元件技術 (Embedded Passives Laminate Substrate) 7. 砂材基板內埋被動元件技術 (Embedded Passive Si Substrate) 8. 砂材基板內埋主動元件技術 (Embedded Active Si Substrate) 9. 異質晶片整合系統封裝 (Heterogeneous Chip Integration SiP) 10. 微間距面對面堆疊系統封裝 (Fine Pitch CoC SiP Solution)
射頻模組 (RF Module)	1. Blue Tooth模組完整方案 (BT Module Total Solution) 2. Wi-Fi模組完整方案 (Wi-Fi Module Total Solution) 3. GPS模組完整方案 (GPS Module Total Solution) 4. Conformal/Compartment式電磁干擾遮敝方案 (Conformal/Compartment EMI Shielding Solution) 5. 有機基板內埋被動元件通訊模組 (Embedded Substrate Wireless Module)
鍚線封裝 (Wire Bond Package)	1. 28/22奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鍚線封裝 (28/22 nm Cu/ELK Wafer Wire Bond Solution) 2. 18微米銅線製程開發 (18 um Cu Wire Bond Technology Development) 3. 32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銅鍚線封裝 (32/28 nm Cu/ELK Wafer Cu Wire Bond) 4. 雷射晶圓切割技術 (Wafer Laser Grooving Technology) 5. 低成本、高效能aQFN封裝方案 (Low Cost, High Performance aQFN Packaging Solution)

Bumping	
印刷製程(Printing)	1. 晶圓PI凸塊技術 (Wafer Bumping Technology with PI Bump)
	2. 無助焊劑晶圓凸塊技術 (Fluxless Wafer Bumping Technology)
	3. 多層PI晶圓凸塊技術 (Wafer Bumping Technology with Multi-PI-Layers)
	4. 300mm凸塊晶圓 75微米厚度研磨技術 (300mm Bumped Wafer 75 um Backgrind Technology)
電鍍製程(Plating)	1. 錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術 (Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)
	2. 40微米微間距銅柱凸塊晶圓電鍍技術開發 (40 um Fine Pitch Cu Pillar Wafer Bumping)
	3. 高深寬比銅柱電鍍凸塊技術 (High Aspect Ratio Cu Pillar Plating Technology)
	4. 高長寬比銅柱凸塊技術 (Non-circular High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping)

測試技術

New Package	
晶圓測試(Wafer probing)	8/12吋凸塊晶圓測試技術(8/12Inchs Bumping Wafer probing Technology)
後段測試(Final testing)	1. 射頻(2.4~6GHZ)元件測試技術(RF 2.4~6 GHZ Device testing Technology)
	2. 條狀元件測試技術(Strip Device Testing Technology)
	3. 綠色環保產品測試方案(Green Package Product Testing Solution)
	4. 系統整合元件測試方案(SOC Device Testing Solution)

(2) 開發成功之技術或產品 :

A. 開發成功之新產品

封裝技術

New Package	
系統封裝(SiP)	1. Panel Level覆晶PoP(aMaP Flip Chip PoP)
	2. Panel Level Wire Bond PoP(aMaP PoP)
	3. 整合電阻動元件QFN封裝(Integrated Passive Resistor Device on QFN Package)
	4. 基板內埋主被動元件技術(Embedded Active/Passive Laminate Substrate)
	5. 微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
光電封裝(OEP)	1. 晶圓級微機電/影像感測器封裝(Wafer Level MEMS/CIS Package)
	2. 裸晶封膠之指紋感應器封裝技術(Exposed Die Molding Solution for Finger Print Sensor)
	3. 微光機電微顯示器封裝(Optical MEMS Microdisplay Package)
晶圓級封裝(WLP)	1. 硅晶圓間層封裝(Si Interposer Package)
	2. 200mm外引腳式二維WLP(200 mm 2D Fan-out WLP)
	3. 整合電阻被動元件技術(Integrated Passive Resistor Device)
覆晶封裝(Flip Chip)	1.40奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(40 nm Cu/ELK Lead Free FC Solution)
	2.40微米微間距覆晶及鋅線混合堆疊(40 um Pitch Hybrid Stacked CoC Package)
鋅線封裝(Wire Bond Package)	1.32奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鋅線封裝(32 nm Cu/Ultra Low K Wafer Wire Bond Package)
	2. 銅線BGA封裝開發(Cu Wire Bond BGA Package)
	3. 金線凸塊DDR2 800封裝測試方案(Au Stud Bump DDR2 800 Assembly and Test Solution)
	4. 低成本、高效能aQFN封裝方案(Low Cost, High Performance aQFN Packaging Solution)
無線射頻模組(Wireless Module)	1. BT+FM系統模組完整方案(BT+FM SiP Module Total Solution)
	2. Wi-Fi+BT+FM系統模組完整方案(Wi-Fi+BT+FM Combo SiP Module Total Solution)
	3. 通訊模組Conformal電磁遮避技術(Wireless Module Conformal Shielding)

Bumping

印刷製程(Printing)	200厘米/300厘米晶圓無鉛印刷技術(200mm/300 mm Lead-Free Wafer Printing Process)
電鍍製程(Plating)	40微米微間距銅柱凸塊技術開發(40 um Fine Pitch Cu Pillar Wafer Bumping)

測試技術

New Package	
	1. 無線通訊產品(GSM/CDMA Wireless Product)
後段測試(Final testing)	2. 寬頻網路元件測試方案(ADSL/XDSL Device Testing Solution)
	3. 藍芽(2.5GHZ)元件測試方案(BlueTooth 2.5GHZ Device Testing Solution)
	4. 觸控元件測試方案(Touch Panel Device Testing Solution)
	5. 電視解調晶片測試方案(TV Tuner Device Testing Solution)
	6. Low cost power management元件測試方案

B. 開發成功之新技術

封裝技術

New Technology	
光電封裝(OEP)	微型投影機顯示器功能驗證(Pico Projector Microdisplay Function Pass)
系統封裝(SiP)	1.FC PoP雷射燒結技術(FC Fan-out Map PoP w/Laser Ablation Technology) 2.薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology) 3.微間距晶片-晶圓堆疊系統技術(Fine Pitch Die-to-Wafer Stacking Technology)
晶圓級封裝(WLP)	1.65奈米SRAM晶圓穿孔功能驗證(65 nm SRAM TSV Function Pass) 2.雙面RDL電鍍厚銅技術(Double-sided Cu-Plated RDL Technology) 3.矽材基板內埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate) 4.200mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(200 mm TSV Wafer 50um CMP Technology) 5.200mm穿導孔晶圓50微米厚分離載具技術(200 mm TSV Wafer Carrier Release Technology)
覆晶封裝(Flip Chip)	1.300mm 凸塊晶圓75微米厚度研磨技術(75 um Wafer Grind Technology on 300 mm Bumped Wafer) 2.助焊劑噴塗技術(Flux Jetting Technology) 3.微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Underfill Technology) 4.28奈米超低介電係數晶圓，40 um bump pitch之覆晶封裝(40 um Pitch FC Solution on 28 nm ELK Wafer) 5.40微米銅柱凸塊間距之覆晶晶片堆疊封裝(40um Pitch Cu Pillar Bump FC Stack) 6.銅製程/超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
鍍線封裝(Wire Bond Package)	1.50微米晶圓厚度研磨技術(50um Wafer Grinding Technology) 2.18微米線徑銅鍍線封裝技術(18 um Cu Wire Bond Technology) 3.銅鍍線封裝技術(Cu Wire Bond Packaging Technology)
綠色封裝(Green Package)	1.QC080000綠色環保系統認證(QC080000 Green System Certification) 2.化學實驗室通過TAF認證(RoHS Certification on Chemical Lab)
Bumping	
電鍍製程	1.40微微米間距銅柱凸塊技術開發(40 um Fine Pitch Cu Pillar Wafer Bumping) 2.高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Plating Technology)

(四)長、短期業務發展計畫

1. 短期計畫

- 鞏固既有客戶，並爭取更多IDM客戶
- 落實集團生產策略，取得最具優勢之配置
- 爭取高階封裝訂單，提昇實質獲利
- 提昇資源運用率並減少資源耗用與浪費
- 提昇環保產品之生產技術，加速產品轉換速度，以提昇市場機會
- 藉由試製開發達到量產

2. 長期計畫

- 整合集團資源，提供客戶更趨完整之服務
- 改善成本結構，提供客戶更具競爭力之價格
- 落實客戶區隔，強化客戶滿意擴大整體生產規模，追求成本優勢，讓價格更具競爭力
- 確保技術領先以提高市佔率

二、市場及產銷概況

(一)市場分析

1. 九十九年度本公司主要商品之銷售地區

單位:新台幣仟元

銷售地區	銷售金額	%
美洲	32,384,983	48.09
歐洲	9,752,815	14.48
台灣	18,665,814	27.72
亞洲及其他	6,535,794	9.71
合計	67,339,406	100.00

2. 市場佔有率

主要封測廠營收比率統計表

Year	ASE	Amkor	SPIIL	STATS ChipPAC	Powertech
2006	31.5%	28.4%	18.0%	16.8%	5.4%
2007	30.3%	27.0%	19.4%	16.1%	7.3%
2008	29.0%	26.1%	18.8%	16.3%	9.8%
2009	29.5%	24.7%	19.6%	15.1%	11.2%
2010	33.4%	24.5%	18.4%	13.5%	10.2%

資料來源: Gartner (2011/02) 及本公司資料彙整

2010年全球主要封測廠營收比例中，日月光營收大幅成長佔33.4%，位居於龍頭地位，Amkor市佔下滑至24.5%，位於第二，矽品佔18.4%，位居第三，STATS ChipPAC及力成分別為13.5%及10.2%，各居全球四、五名，排名及比例上變化甚小。日月光在2003年正式超越最大競爭對手Amkor，成為全球最大之專業封測大廠，2005~2010年更大幅拉大與競爭者的差距。近年來，封裝技術發展趨勢主要配合電子元件朝高密度、高I/O數、低操作功率、表面元件模組化、複合結構化等方向發展，使封裝技術朝高集成度化、多腳/細微化、薄型化、多晶模組封裝化及低成本方向進行，包括因應腳數增加的細間距銲線技術、覆晶封裝、3D堆疊式封裝、晶圓級構裝、多晶模組(Multi-chip Module, MCM)、系統整合型封裝(SiP)技術、銅製程以及晶圓穿導孔(TSV)技術等。有鑑於產業對高階封測產能的需求不斷成長，日月光集團過去在技術與產能的投資已為這成長趨勢作好準備。展望未來，我們將持續製程的精進，同時致力於提昇獲利率。

3. 市場現況

無論從整體產業或熱門應用產品的趨勢來分析，我們都可感受到整體景氣已明顯提升，展望2011年發展將呈現上升的走勢，而且整體產業景氣也正在大幅成長，然而完全復甦的時程恐需視大環境而定。而受到IC產品功能多樣化及複雜化發展的影響，半導體製程將更趨微縮精密，加上IC產品生命週期快速縮短，新產品變化速度加快，加速半導體製程的演進，機台設備因而必須跟進汰舊換新，造成設備投資的資本支出更加擴大，致使許多國際性IDM大廠經營績效及競爭力逐漸受其製造部門拖累，為鞏固其核心優勢，進而增加委外製造代工比重，故無論是晶圓製造及後段封測，其委外比重都逐年增加。台灣半導體大廠在全球半導體正朝向專業分工的發展趨勢下，晶圓代工部分的晶圓雙雄台積電及聯電與封測第一大廠的日月光都將是未來趨勢下的最大受惠者。

4. 市場未來之供需狀況與成長性

根據Gartner統計，封裝及測試市場整體規模2010年達49,331百萬美元，因金融危機狀況已受到控制，預估2011年將升至53,669百萬美元，預測2015年將提升至67,482百萬美元。其中，IDM封裝及測試整體規模2010年達25,375百萬美元，佔封裝及測試市場整體規模比例為51.4%，預估2011年上升至26,994百萬美元，預測2015年將提升至31,994百萬美元，佔市場整體規模比例降為47.4%；專業代工封裝及測試市場規模(SATS)方面，封裝及測試市場整體規模2010年達23,956百萬美元，佔封裝及測試市場整體規模比例為48.6%，預估2011年將上升為26,675百萬美元，預測2015年將提升至35,488百萬美元，佔市場整體規模比例將高達52.6%。由此數據顯示，封裝及測試委外代工的比率逐年增加。主要影響因素為消費性電子化所帶來的產品多樣化，使得客製化的封測設計越來越複雜；系統電路板微縮的速度無法與越來越精細的製程同步，而兩者之間僅能靠封裝技術做為橋樑；再加上封裝與測試技術成本越來越高，促使封測研發費用隨著上升，因此晶片製造商為了降低成本，更加使得封測外包需求逐漸增加。同時也突顯出IDM大廠越來越不可能自行投入高階封測設備，委外代工趨勢勢必越來越明顯。

2010~2015年半導體封裝及測試市場成長情形

(單位：百萬元美金)	2010	2011	2012	2013	2014	2015
IDM封裝及測試市場規模	25,375	26,994	28,280	29,007	30,085	31,994
IDM封裝市場規模	19,997	21,292	22,423	23,032	23,888	25,403
IDM測試市場規模	5,378	5,702	5,857	5,975	6,198	6,591
專業代工封測市場規模(SATS)	23,956	26,675	29,472	30,680	33,135	35,488
專業代工封裝市場規模	18,394	20,155	22,268	23,058	24,828	26,591
專業代工測試市場規模	5,562	6,519	7,204	7,623	8,306	8,896
封裝及測試市場整體規模	49,331	53,669	57,752	59,687	63,220	67,482
封裝及測試市場整體規模成長率	30.0%	8.8%	7.6%	3.4%	5.9%	6.7%
封裝市場整體規模	38,391	41,447	44,691	46,089	48,716	51,994
專業代工比率(封裝)	47.9%	48.6%	49.8%	50.0%	51.0%	51.1%
測試市場整體規模	10,940	12,222	13,061	13,598	14,504	15,487
專業代工比率(測試)	50.8%	53.3%	55.2%	56.1%	57.3%	57.4%
專業代工比率(封裝及測試)	48.6%	49.7%	51.0%	51.4%	52.4%	52.6%
專業代工市場成長率	39.7%	11.3%	10.5%	4.1%	8.0%	7.1%

資料來源：Gartner (2011/1Q)

5. 競爭利基

2011年整體市場仍呈現正成長趨勢，日月光集團也更重視內部營運機制，提升技術開發能力，期許在千變萬化環境下再創佳績，我們所依賴之各項競爭優勢分析如下：

A.持續技術研發，高階產品技術及品質居領導地位

隨著半導體專業代工產業鏈模式，日月光也跟著台積電、聯電等主要晶圓代工不斷往高階產品研發，在技術上能夠自我提升，創造雙贏之局面。日月光在高階封測技術SiP、CSP、Flip Chip、Bumping及WLP等領域研究多有著墨，主要是產品應用的功能越趨繁多、尺寸越來越小及散熱需求以滿足市場需求。

再者，日月光集團每年提撥4~5%的營收比例金額投入在技術研發上，每年獲得超過百項專利，期許保持產業之領先地位及競爭優勢，除了在市佔率領先業界，也必須在技術研發上超越同業。

B.積極佈局，適時掌握IDM大廠委外代工之商機

為維持半導體經營之效率，降低成本，IDM大廠必須朝向Fab Lite型態發展，而擴充委外代工比例已是近年來的趨勢。日月光集團為迎合不斷升溫的半導體委外代工趨勢，多年來的營運策略更為積極，西進大陸佈局，接近客戶，接近市場，以爭取潛在商機。所有的國際大廠都想在中國大陸佔有一席之地，又無法找到較具規模的合作夥伴，如今日月光的佈局，將可能使其陸續將封測業務外包，不僅不會影響到台灣的基礎，還帶進更多的商機。

6. 發展遠景之有利/不利因素與因應對策

(1)有利因素

- IDM廠商的經營趨勢，持續釋出封測訂單，未來將持續帶給IC封裝測試產業更大的發揮空間與更多商機。
- 市場對新產品、新技術的需求逐漸增加，對一向在研發創新具備優勢的日月光而言是一大利多機會。
- 身為台灣擁有基板產線的封測廠，擁有高階基板穩健的自供能力，不但可掌握高階封裝材料之關鍵，更可有效降低IC的整體製造成本，提高獲利能力。
- 除傳統之BGA、QFP、QFN封裝產品外，更多高階產品如晶片組、繪圖晶片、光電產品等相關晶片，以及潛在顧客等皆具有更大更深之市場可供開發。
- 未來幾年中國大陸對積體電路的需求仍會有大幅成長，基於群聚效應、供應鏈原則，日月光已在地理位置及資源運用方面之佈局作好準備，迎接這波成長及搶先商機。

(2) 不利因素

- 本土同業競爭者對爭取日月光的客戶相當積極；另外，競爭者的聯盟機制亦有可能對日月光產生影響。
- 新技術的門檻逐漸下降，競爭者的模仿能力逐漸提升且產品的獲利週期逐漸縮短，對一向以技術取得優勢的日月光是一項外在威脅；由於新技術的研發需投入大量的資金與人力，因此在後續價格上，日月光在價格上的變動彈性相對較弱，在微利時代下，實為一項挑戰。
- 客戶端對於IC後段封、測之要求水準日益嚴苛，日月光業務成長如要有顯著的表現就必須超越競爭對手及IDM客戶的期待。
- 半導體後段的封裝、測試屬高資本密集產業，因而受到半導體市場景氣影響甚劇，營運的優劣多受景氣所引導；IC封裝與測試產業需審慎評估投資計畫及人員、機台、資金與技術的規劃，以彈性因應景氣繁榮時所帶來大量的訂單以及不景氣時訂單減少的衝擊。

(3) 因應對策

- 利用整合優勢以提供一元化服務、整合集團資源、技術互享以創造更多附加價值及更大的經濟效益，強化競爭優勢以爭取未來市場蓬勃時更多商機。
- 藉由日月光特有的先進製程與彈性產能以及多元的生產線，提供與滿足客戶更多新產品、新技術以及大量、即時的需求。
- 穩健的財務結構對於發展新技術、新產品所需的資金提供穩定及充足的資源。
- 利用技術優勢改進設計缺失，建立最佳化製程，提升製程穩定性，強化日月光在成本和品質方面的競爭力，爭取最大的市場契機。
- 憑藉日月光先進技術的優勢、資本優勢、資源整合優勢來深耕現有客戶以及爭取更多潛在客源，擴大業務版圖。
- 確切發揮跨廠區先進技術交流及跨部門協調之功能，提高綜效。
- 日月光在材料、封裝、測試及系統方面的垂直整合及橫向鏈結合作，除可鞏固競爭力、提供更完善的服務外，更具備最佳彈性以隨時調整與迎接外在多變的挑戰。
- 持續強化技術優勢，依客戶不同特性提供與滿足客戶多元的需求，提升服務品質的競爭力，同時建立專利防護網，削減其他業者的模仿速度。
- 提升客戶對日月光一元化服務的訂單比例，加快整合速度，以最完整的架構提供客戶最快速與滿意的服務。

(二)主要產品之重要用途及產製過程

1. 主要產品之重要用途：

封裝技術

主要產品	重要用途
<ul style="list-style-type: none"> 塑膠立體型積體電路 (PDIP) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在於家電用品、通訊設備、汽車元件、飛機、武器和太空梭等電腦遙控資訊系統、導航設備。
<ul style="list-style-type: none"> 塑膠晶粒承載器積體電路 (PLCC) 平面型塑膠晶粒承載器積體電路(QFP) 凸塊晶片承載器積體電路(BCC) 覆晶(Flip Chip)封裝技術 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路 (LQFP、TQFP) 球型陣格承載器積體電路 (BGA、FBGA、LBGA) 覆晶式球型陣格承載器積體電路 (FC BGA, HFC BGA) 散熱增益球型陣格承載器積體電路 (TE BGA) 超薄球型陣格承載器積體電路 (VF BGA) 無引腳型陣格承載器積體電路 (LGA) 外露晶片四邊平面形積體電路 (Exposed Pad QFP) 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路 (HSBGA) 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路 (QFN) 覆晶式晶片尺寸封裝 (Flip Chip CSP) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、大哥大等。 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 個人電腦與筆記型電腦等。 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 電腦一繪圖/晶片卡、伺服器、PCS&伺服器微處理器、電壓調節器、快速記憶卡、硬碟等週邊產品。 通訊產品—網路產品(LAN)、轉換器、交換器、蜂巢式基地台。 消費性產品—攝錄影機、數位相機、DVD等、電視遊樂器、機上盒等、PDA、MID。 其他產品—自動汽車元件。
<ul style="list-style-type: none"> 小型晶粒承載器積體電路 (SOP、SOJ) 超薄小型晶粒承載器積體電路 (TSOP) 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路 (SCSP) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在於記憶體積體電路。 個人電腦與週邊裝備等。 主要用途在於記憶體積體電路。
<ul style="list-style-type: none"> 立體式晶片模組承載器積體電路 (3D Package) 晶片堆疊式球狀陣格承載器積體電路 (Stacked BGA) 多晶片模組球狀陣格承載器積體電路 (MCM BGA) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在於各種可移動式的資訊產品，例如：手機、PDA、數位相機等。 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。 筆記型電腦與個人電腦之硬碟等。
<ul style="list-style-type: none"> 晶圓級晶片尺寸封裝 (Wafer Level CSP) 覆晶式晶片尺寸封裝(Flip Chip CSP) 晶圓穿導孔技術 (TSV Technology) 整合被動元件 (IPD) 矽質基板 (Si Interposer) 微間距晶片堆疊系統技術 (Fine Pitch 3D Chip Stacking Technology) 異質晶片整合系統封裝 (Heterogeneous Chip Integration SiP) 微間距面對面堆疊系統封裝 (Fine Pitch CoC SiP Solution) 基板內埋主、被動元件技術 (Embedded Active/Passive Substrate) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要應用手機、PDA、數位相機等。 主要應用手機、NB、數位相機等。 主要應用手機、NB/Network、數位相機等。 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在手機、NB、Network Sever。 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在NB、Sever、生醫照護。 主要應用在手機、Game Console遊戲機。 主要應用在主要應用在可攜式消費電子。
<ul style="list-style-type: none"> 微機電型微顯示器 (MEMS-based Micro display) 指紋辨識器 (Finger Print Sensor) DDR2 800記憶體 (DDR2 800 Memory) 外引腳式Map PoP堆疊技術 (Fan-out Map PoP Technology) 外引腳式WLP (Fan-out WLP) 無線通訊模組 (Wireless Connectivity SiP Module) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要應用在投影機(Projector)、高解析數位電視(HDTV)。 主要應用在個人電腦、筆記型電腦、網路商業等安全辨識裝置。 主要應用在3C產品之記憶體。 主要應用在3C產品之系統封裝產品 (ASIC + MCP Memory, DBB+SDRAM)。 主要應用在可攜式消費電子。 主要應用在3C產品之無線通訊模組包括BT, WiFi, GPS, DVB-H/T。

測試技術

主要產品	重要用途
<ul style="list-style-type: none"> 平面型塑膠晶粒承載器積體電路 (QFP) 凸塊晶片承載器積體電路 (BCC) 覆晶 (Flip Chip) 封裝技術 超薄平面型塑膠晶粒承載器積體電路 (LQFP、TQFP) 球型陣格承載器積體電路 (BGA、FBGA、LBGA) 覆晶式球型陣格承載器積體電路 (FC BGA、HFC BGA) 散熱增益球型陣格承載器積體電路 (TE BGA) 超薄球型陣格承載器積體電路 (VF BGA) 無引腳型陣格承載器積體電路 (LGA) 外露晶片四邊平面形積體電路 (Exposed Pad QFP) 散熱增益球型閘陣列承載器積體電路 (HSBGA) 扁平式無引腳型陣格承載器積體電路 (QFN) 進階陣格扁平式無引腳型陣格承載器積體電路 (aQFN) 單層基板 (Advance Single Sided Substrate) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在微處理機、通訊設備、自動汽車元件、個人電腦、大哥大、晶片組等。 無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電、液晶電視與大哥大等。個人電腦與筆記型電腦等。 電視遊樂器、DVD、機上盒等。 個人電腦、筆記型電腦、無線通訊網路、PDA、數位相機、資訊家電與大哥大等。 手機晶片組、MP3 Processor。
<ul style="list-style-type: none"> 小型晶粒承載器積體電路 (SOP、SOJ) 超薄小型晶粒承載器積體電路 (TSOP) 晶片尺寸堆疊式球型陣格承載器積體電路 (SCSP) 	<ul style="list-style-type: none"> 主要用途在於記憶體積體電路。 個人電腦與週邊裝備等。 Power management IC。

2. 產製過程：

封裝技術

• 釘架類產品：

晶圓切割 → 粘晶粒 → 打金線 → 封模 → 正印 → 外腳成型 → 外觀檢驗 → 包裝

• 球陣列類產品：

晶圓切割 → 粘晶粒 → 打金線 → 封模 → 正印 → 植錫球 → 切割成型 → 外觀檢驗 → 包裝

• 覆晶類產品：

晶圓凸塊 → 晶圓切割 → 覆晶式粘晶粒 → 底膠充填 → 正印 → 植錫球 → 外觀檢驗 → 包裝

• 晶圓穿導孔類產品：

晶圓穿導孔 → 穿導孔絕緣層 → 穿導孔銅電鍍充填 → 穿孔晶圓薄化 → 雙面佈銅導線 → 植錫球

測試技術

• 釘架類產品/球陣列類產品：

IC測試 → 產品老化測試(依客戶需求) → 烘烤 → 產品外觀檢驗 → 捲帶包裝 → 成品包裝

(三) 主要原料之供應狀況

本公司係代客封裝之半導體製造業，主要晶圓由客戶提供，客戶大都為國際知名半導體公司，長期與本公司保持良好的業務關係。

主要封裝材料如：釘架、基板、金線、膠餅等，供應商皆為本公司品管審查合格之績優廠商，尤其基板的主要供應來源為子公司日月光半導體(上海)股份有限公司 (ASESH)、日月光半導體(香港)有限公司 (ASEHK) 及日月光電子(股)公司 (ASEE)，使得材料的取得可完全掌握。

主要原物料名稱	供應來源	市場狀況	採購策略
基板 Substrate	ASESH/ASEHK/ASEE/A公司/B公司	供需平衡	朝80%自製目標
釘架 Lead Frame	C公司/D公司	供需平衡	長期配合廠商
金線 Gold Wire	E公司/C公司/F公司/G公司	供需平衡	長期配合廠商
膠餅 Compound	C公司/H公司	供需平衡	長期配合廠商

(四)最近二年度任一年度曾佔進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例**1. 佔銷貨百分之十以上之客戶名稱**

本公司最近兩年度並無佔銷貨百分之十之客戶。

2. 佔進貨百分之十以上之進貨廠商

排名	99年度			98年度			
	名稱	金額	佔全年進貨淨額比率(%)	與發行人之關係	名稱	金額	佔全年進貨淨額比率(%)
1	E公司	3,349,185	11.7	無	日月光香港	3,353,778	17.4
2	G公司	3,072,280	10.8	無	G公司	2,108,211	10.9
	其他	22,131,063	77.5		其他	13,797,413	71.7
	進貨淨額	28,552,528	100.0		進貨淨額	19,259,402	100.0

(五)最近二年度生產量值表

單位：仟個/新台幣仟元

主要商品	年度 生產量值	99年度			98年度		
		產能	產量	產值	產能	產量	產值
先進基板或導線架型積體電路 (FlipChip, BGA, QFN, QFP, BCC)		10,199,387	5,078,213	47,896,611	3,789,763	3,160,302	28,888,328
傳統導線架型積體電路(PDIP, SO, PLCC)		2,133,025	502,690	857,511	1,544,160	439,796	791,387
其他		—	—	1,879,493	—	—	6,044,604
合計		12,332,412	5,580,903	50,633,615	5,333,923	3,600,098	35,724,319

(六)最近二年度銷售量值表

單位：仟個/新台幣仟元

主要商品	年度 銷售量值	99年度				98年度			
		內銷		外銷		內銷		外銷	
		量	值	量	值	量	值	量	值
先進基板或導線架型積體電路 (FlipChip, BGA, QFN, QFP, BCC)		1,998,375	19,795,095	3,079,838	34,912,713	1,371,909	12,020,390	1,788,393	26,448,614
傳統導線架型積體電路(PDIP, SO, PLCC)		111,453	218,116	391,237	772,679	110,421	195,667	329,375	696,447
其他		—	3,104,299	—	8,536,504	—	1,522,701	—	5,250,495
合計		2,109,828	23,117,510	3,471,075	44,221,896	1,482,330	13,738,758	2,117,768	32,395,556

三、從業員工資料**(一)組織**

本公司基於能維持有利的競爭市場，培育優秀的工程人力資源，健全公司組織職能制度、確定組織功能及培養職務生涯等是刻不容緩的首要策略。

(二)最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料：

年度		98年度	99年度	100年2月28日
員工人數	技術職人員	3,807	4,305	4,355
	管理職人員	624	777	786
	事務職人員	1,216	1,302	1,328
	作業員	8,224	9,954	10,138
	合計	13,871	16,338	16,667
平均年歲		32.4	32.0	32.1
平均服務年資		5.30	4.90	4.85

年度		98年度	99年度	100年2月28日
學歷分布比率	博士	0.2	0.2	0.2
	碩士	6.0	6.3	6.3
	大專	55.2	55.5	56.0
	高中	33.9	33.5	33.1
	高中以下	4.7	4.5	4.4

四、環保支出資訊

(一) 說明最近年度及截至年報刊印日止，公司因污染環境所受損失(包括賠償)、處分之總額、未來因應對策及可能之支出。

- 100年度：截至年報刊印日止，無重大環境污染事件發生。
- 99年度：無重大環境污染事件發生。

(二) 說明目前污染狀況及其改善對公司盈餘、競爭地位及資本支出之影響及其未來年度預計之重大環保資本支出。

項目	一〇〇年度	一〇一年度
擬採行改善措施部分		
(1)改善計劃	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 3. 持續推行環境會計系統 4. 發表本公司企業永續發展報告書 5. 導入ISO50001能源管理系統 6. 推行產品碳足跡盤查及查證 7. 結合台灣永續創新論壇，持續致力推動本公司永續發展 8. 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO ₂ 減量 9. 節能產品導入與節能工程改善 10. 廢水防治設備清理與改善、汙泥脫水機濾布更換並強化廢水回收量與效益 11. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 12. 高效率汙染防制設施建置 13. 集塵設備濾材更換 14. 廢氣防制設備及廢氣洗滌塔、活性碳吸附設備之填充料更換與VOC減量 15. 事業廢棄物減廢、減量與回收再利用 16. 廢水處理污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 17. 化學品使用量減量 18. 周界臭味防範 19. 緊急應變訓練與演練 20. 噪音防制強化 21. 研磨廢水回收系統薄膜保養 22. 2011年工安環保月活動	1. ISO14001環境管理系統持續驗證 2. 持續配合ISO14064溫室氣體管理系統運作，進行溫室氣體減量 3. 推動本公司產品生態化設計 (eco-design) 4. 導入ISO14064-2溫室氣體減量查證，為碳交易預作準備。 5. 持續推行ISO50001能源管理系統 6. 推行產品碳足跡盤查及查證 7. 結合台灣永續創新論壇，持續致力推動本公司永續發展 8. 持續推動搭乘大眾捷運系統減少耗能與CO ₂ 減量 9. 節能產品導入與節能工程改善 10. 廢水防治設備清理與改善、汙泥脫水機濾布更換並強化廢水回收量與效益 11. 廢水處理砂塔、活性碳塔濾料更換 12. 高效率汙染防制設施建置 13. 新設集塵機及既設集塵設備濾材更換 14. 廢氣防制設備新設、既設廢氣洗滌塔填充料更換與VOC減量 15. 事業廢棄物減廢、減量與回收再利用 16. 廢水處理污泥減重、減量與金屬成份回收再利用 17. 化學品使用量減量 18. 周界臭味防範 19. 緊急應變訓練與演練 20. 噪音防制強化 21. 新設製程廢水回收系統 22. 研磨廢水回收系統薄膜保養 23. 能源節約工程改善 24. 包裝材料重複使用 25. 2012年工安環保月活動

項目	一〇〇年度	一〇一年度
(2)未來二年預計環保資本支出擬購置之污染設備或支出內容	1. 各部門自發性改善方案推動 2. 降低污泥含水率 3. 周界噪音防制工程 4. 廢水廢氣防治設備改善 5. 低頻噪音防制工程 6. 環保設備汰換 7. 推動廢水處理廠合併 8. 使用省電燈具 9. 推動廢液減量/回收 10. 配合管理處導入再生水專案 11. 週遭環境美化 12. 廢氣洗滌塔 13. 活性碳吸附設備 14. 集塵機 15. 廢水回收設備	1. 各部門自發性改善方案推動 2. 廢水廢氣防治設備改善 3. 低頻噪音防制工程 4. 環保設備汰換 5. 推動廢水處理廠合併 6. 週遭環境美化 7. 廢棄物減量回收推動 8. 周界噪音防制工程 9. 使用省電燈具 10. 廢氣洗滌塔 11. 活性碳吸附設備 12. 集塵機 13. 廢水回收設備 14. 污泥乾燥設備
預計改善情形	1. 減少耗能與CO ₂ 減量 2. 防範周界臭味 3. 延長設備使用壽命 4. 減廢/減量/資源回收 5. 降低周界噪音 6. 降低VOC排放量 7. 減少能源耗用	1. 減少耗能與CO ₂ 減量 2. 防範周界臭味 3. 延長設備使用壽命 4. 減廢/減量/資源回收 5. 降低周界噪音 6. 減少能源耗用 7. 提昇作業環境舒適度 8. 污染防治
支出金額	NT\$169,322仟元	NT\$183,960仟元
(3)改善後之影響		
對淨利之影響	約增加NT\$70,150仟元	約增加NT\$83,930仟元
對競爭地位之影響	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。	企業社會責任與永續發展。對環境友善的環保政策提昇公司之企業形象，符合廣大投資人對於公司永續發展的目標。
未採取因應對策部分	不適用	不適用

(三)環境與綠色產品政策

環境保護是我們責無旁貸的重要責任，本公司承諾做好環境污染預防、綠色產品設計與製造及持續改善之工作，以響應全球環保運動。

本公司環境政策如下：

- 符合政府環保法規及綠色產品相關法規規定。
- 教育員工，提昇全體員工環境保護及綠色產品意識。
- 在環境保護上，加強廢水、廢氣、廢棄物、噪音、毒化物等對環境的衝擊污染控制、改善，並注重污染預防工作。在綠色產品上，逐步採用綠色設計、綠色材料、綠色製程與生產，減少產品對環境的衝擊，提昇客戶滿意度。
- 節約能源及資源，進行資源回收。
- 在環境保護的相關議題上與大眾及相關團體做密切的溝通與合作。
- 承諾持續改善，確保永續經營。
- 傳達本政策，使大眾和相關團體了解日月光集團於環境保護與綠色產品管理上的企圖心。

(四)安全衛生政策

本公司承諾提供員工一個符合安衛法規的最佳作業場所。

本公司的承諾如下：

- 致力符合適用之安衛法令及公司所簽訂關於安衛危害之其他規章或要求事項。
- 持續改善安衛管理與績效，預防傷害事故與疾病的發生，並且確信災害的損失可經由完善管理系統的運作達到控制。
- 提供完整的教育訓練，以提昇員工的安全知能，並與員工及其代表進行諮詢，以確保安衛管理系統所有的活動可以成功地運作。
- 分級輔導供應商與承攬商符合安衛法令及相關要求。
- 對所有為組織或代表組織工作的人、大眾及相關團體傳達我們致力於工作環境安全衛生改善的決心。

五、勞資關係

(一)員工福利措施

本公司體認勞資一體的關係，於民國九十七年股東會中決議，除自每年所得盈餘中提撥7%~10%作為員工紅利外，復全面改善福利文康設施，舉凡圖書館、社團活動、年度旅遊、文康競賽等，使得全廠員工均有調劑身心的機會，並加強有關員工福利及勞資關係的措施如下：

- 免費提供員工及眷屬團體醫療保險。
- 全面改善廠房的安全衛生以保持清潔舒適的環境。
- 定期或不定期勞資溝通會議。
- 成立勞工安全衛生督導委員會。
- 成立福利委員會辦理各項員工福利。
- 自助餐廳及福利社。
- 結婚禮金、喪葬津貼、住院慰問金及獎助學金。
- 完善的退休制度。
- 員工健康檢查。
- 股票及現金紅利。
- 三節福利金發放。
- 員工旅遊及多元商品選購。
- 因公出差員工享有旅行平安保險1,500萬元。
- 假日安親措施。
- 假日免費供餐。
- 設有職工休閒健身中心。
- 設有員工健康診所及健檢中心。
- 員工認股權憑證。

(二)員工進修及其實施情形

- 員工在職進修取得相關科系學歷者，可參加學歷升級考試，並予以實質調薪鼓勵。
- 提供員工建教合作學校管道，辦理「職訓局」台德菁英計劃。

(三)員工訓練及其實施情形

- 提供新進員工職前引導訓練、專業訓練及新人評鑑。
- 設計與執行主管管理技能訓練與職能發展。
- 設計與執行工程師專業技術訓練。
- 提供在職人員專業技能與第二專長訓練(OJT)。
- 培育公司內部專業講師與訓練師。
- 設計與執行工安環保相關訓練。
- 提供員工參與外訓或研討會。
- 為有效整合公司資源，本公司訂定「外訓暨證照補助管理辦法」，此辦法分為兩大項目：外訓(部門派外受訓)以及證照補助(個人自主學習補助)。為提高員工素質且鼓勵員工自主學習，工作之餘進修培養專業技術，強化個人專業職能，充實業務相關技能，利用外部訓練培養專業技術以彌補企業內訓之不足，並設立公司統一審核與課後回饋機制，以利公司外訓制度之推行，結合外訓與出差電子系統以利主管管控。
- 自主學習補助每人每次補助總訓練費用50%，以壹萬元為上限，採課後補助原則，由員工先行自費報名，於課程結束取得證照後三個月內，檢具附件向訓練部門進行補助申請。
- 本公司九十九年度員工訓練費用合計新台幣7,567,935元。
- 本公司與財務資訊透明有關人員，其取得主管機關指明之相關證照情形如下：本公司內部稽核人員取得國際內部稽核師協會所核發之國際內部稽核師證書者計有三人。

(四)退休制度及實施情形

- 本公司自民國七十五年十一月起即遵照勞動基準法訂定勞工退休辦法，並設立勞工退休準備金監督委員會，按月提撥勞工退休準備金存入台灣銀行，勞工退休時可請領退休金。
- 本公司自民國九十四年七月起即遵照勞工退休金條例訂定之勞工新制退休辦法，每月提撥薪資之6%存入勞保局退休金專戶，勞工於年滿60歲即可於個人退休金專戶請領退休金。
- 優惠退休條件：工作滿十四年以上，年齡與工作年資合計滿六十八以上者，或工作滿十年以上且年齡滿六十歲者，得自請退休。

(五)勞資協議情形

- 本公司設有書面及電子化員工溝通管道，且各廠均定期召開員工座談會，溝通良好，無重大勞資糾紛之情事。

(六)各項員工權益維護措施

- 依勞動基準法，保障員工權益。
- 依性別工作平等法，提供一兩性平權及無性騷擾的工作環境。

(七)工作環境與員工人身安全之保護措施(本公司為保護員工免於受職業傷害所做之措施)

- OHSAS 18001及TOSHMS台灣職安衛管理系統持續驗證。
- 持續運作廠區安全衛生績效評核，辦理年度安全衛生優良廠區頒獎。
- 持續強化承攬商協議組織會議運作，結合承攬商安全衛生評核機制，辦理年度安全衛生優良承攬商頒獎。
- 持續推動廠區安全衛生績效評核機制，辦理年度安全衛生優良廠區頒獎。
- 強化承攬商協議組織會議運作，結合承攬商安全衛生評核機制，辦理年度安全衛生優良承攬商頒獎。
- 舉辦2010年工安環保月活動。
- 落實各部門危害鑑別與風險評估及強化各部門安全衛生改善方案。
- 機台安全防護改善持續推動。
- 廠區緊急應變最佳化模式建立。
- 新建廠消防系統設計導入NFPA (National Fire Protection Association，美國國家防火協會) 規定，強化消防安全設施。
- 承攬商監工人員管理與訓練驗證制度建置。
- 導入廠區夜間/無人區域緊急應變編組模式。
- 輔導主要承攬商建立自主安全衛生管理系統。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之國家工安獎選拔。
- 參與行政院勞工委員會舉辦之全國勞工安全衛生優良單位選拔。
- 廠區高風險區域現場指揮官應變演練。
- 廠區機台及加藥系統作業安全防護強化。
- 進行廠區週界風險評估及改善，強化廠區消防安全。
- 導入EICC電子電機產業社會行為準則管理規範並完成查證。
- 持續推動廠區安全文化評量系統，強化提升廠區安全文化水平。

(八)各項員工工作守則及倫理原則

- 與主管有不同看法時，以『對事不對人』的態度，選擇適當時間、地點，與主管誠懇的溝通，勿在訪客或他人面前強烈的表示不同的意見。
- 會議須準時參加，不克出席應事先請代理人出席，並說明需準備之文件資料，並同時知會會議主持人。
- 與廠商開會若有跨越中晚餐時間，可以幫廠商代訂便當，再向公司報帳，勿與廠商外出交際應酬。
- 嚴禁私自攜帶公司產品、零件、貨品出加工區，出廠區物品務須配合保稅放行單，未依規定辦理者，經查獲，依相關法令處理。
- 尊重公司名譽，凡涉及公司任何事項，未經許可，不得擅自對外發佈個人意見。
- 培養誠實與負責任的文化。在公司所有的營業活動上應遵循最高道德標準的承諾。

(九)最近二年度及截至年報刊印日止公司因勞資糾紛所遭受之損失(包括目前及未來可能發生之估計金額及因應措施)：無。

六、重要契約

契約性質	當事人	契約起訖日期或訂約日期	主要內容	限制條款
業務契約	ASE (U.S.) Inc.	2011.01.01-2011.12.31	業務代理	
業務契約	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	2011.01.01-2011.12.31	業務代理	
土地租約	經濟部加工出口區管理處	2002.01-2020.06	土地租賃	於租約有效期間內，不得轉與業務不相關之用，且依約執行付款
聯貸契約	花旗銀行等29家銀行	2008.03-2013.03	台幣長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等12家銀行	2008.05-2011.05	美金長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等20家銀行	2009.06-2014.06	台幣長借契約	財務比率限制等
聯貸契約	花旗銀行等25家銀行	2010.6-2015.06	台幣及美金長借契約	財務比率限制等
共同投資契約	POWERCHIP SEMICONDUCTOR	2006.07.14	共同投資成立 POWER ASE TECHNOLOGY	不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Freescale	1994.01.25-2010.12.31	專利授權(2nd amendment)	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	FUJITSU LIMITED	1998.04.13-2010.12.31	專利授權	於合約終止或取消五年內，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (FOC/RDL)	2008.03.07-2024.03.14	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	TESSERA U.S.A.	1998.01-2016.10	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	FLIP CHIP INTERNATIONAL, LLC. (ULCSP)	2000.12.26-2010.12.25	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Mitsui High-tec, Inc.	2007.06.25-2012.06.24	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)
專利契約	Infineon Technologies AG	2007.11.06-2017.11.05	專利授權	於合約期滿前，不得洩露本合約條款和條件予第三者(保密條款)

註：係為截至年報刊印日止之資料。

陸、財務概況

一、最近五年度簡明資產負債表及損益表

(一) 簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註1)				
		九十九年底	九十八年底	九十七年底	九十六年底	九十五年底
流動資產		16,752,587	17,591,613	11,426,119	23,650,598	23,022,894
基金及投資		101,583,798	80,340,959	77,506,660	41,402,013	37,263,526
固定資產		38,809,576	30,383,071	29,296,724	30,781,603	33,635,138
無形資產		1,044,022	1,069,754	1,095,651	997,267	961,248
其他資產		3,436,477	3,887,601	4,606,092	5,213,901	5,969,234
資產總額		161,626,460	133,272,998	123,931,246	102,045,382	100,852,040
流動負債	分配前	24,443,453	18,104,951	8,550,167	13,339,588	17,576,153
	分配後	24,443,453 (註2)	20,083,141	11,286,735	23,300,521	25,352,192
長期負債		47,373,743	42,479,131	44,707,225	12,827,848	16,630,916
其他負債		1,252,895	1,072,890	1,001,860	704,585	625,072
負債總額	分配前	73,070,091	61,656,972	54,259,252	26,872,021	34,832,141
	分配後	73,070,091 (註2)	63,635,162	56,995,820	36,832,954	42,608,180
股本		60,819,570	54,933,988	56,907,665	54,967,472	46,309,514
資本公積		7,180,585	6,333,755	6,373,287	6,394,834	3,805,768
保留盈餘	分配前	24,972,944	13,229,409	9,221,404	13,898,213	16,985,043
	分配後	24,972,944 (註2)	6,635,443	6,484,836	3,061,352	1,732,964
金融商品未實現(損)益		246,303	25,498	(439,438)	402,518	416,400
累積換算調整數		(1,120,618)	3,276,508	4,873,957	2,179,808	1,330,651
未認列為退休金成本之淨損失		(398,103)	(248,641)	(230,401)	(6,516)	(19,041)
股東權益總額	分配前	88,556,369	71,616,026	69,671,994	75,173,361	66,019,899
	分配後	88,556,369 (註2)	69,637,836	66,935,426	65,212,428	58,243,860

註1：(1) 最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

(2) 最近五年度均未曾辦理資產重估。

註2：截至年報刊印日止，本公司一〇〇年股東常會尚未召開，是以分配後金額暫以分配前金額列示。

(二) 簡明損益表

單位：新台幣仟元

項目	年度	最近五年度財務資料(註3)				
		九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度	九十五年度
營業收入		67,339,406	46,134,314	48,451,017	55,543,272	63,065,652
營業毛利		16,705,791	10,579,841	10,538,763	15,280,616	16,812,662
營業淨利		10,361,203	5,818,771	5,487,648	10,680,296	12,577,064
營業外收入及利益		11,237,285	4,052,832	4,059,355	4,391,045	8,129,931
營業外費用及損失		2,565,899	2,203,912	2,205,500	1,341,541	2,613,315
繼續營業部門稅前利益		19,032,589	7,667,691	7,341,503	13,729,800	18,093,680
繼續營業部門利益		18,337,500	6,744,546	6,160,052	12,165,249	16,902,052
停業(分割)部門利益		—	—	—	—	857,105
會計原則變動之累積影響數		—	—	—	—	(343,006)
本期淨利		18,337,500	6,744,546	6,160,052	12,165,249	17,416,151
每股盈餘(元/股)(追溯調整後)						
基本每股盈餘		3.10	1.19	1.04	2.05	2.99
稀釋每股盈餘		3.04	1.17	1.02	1.98	2.85

註3：(1) 最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

(2) 最近五年度均未曾辦理資產重估。

(3)各年度利息資本化金額如下：

九十九年度	43,533仟元
九十八年度	22,603仟元
九十七年度	55,051仟元
九十六年度	25,909仟元
九十五年度	57,081仟元

(三) 最近五年度會計師查核意見

年度	會計師姓名	會計師姓名	查核意見
九十九	龔俊吉	邱慧吟	修正式無保留意見
九十八	龔俊吉	邱慧吟	修正式無保留意見
九十七	龔俊吉	郭麗園	修正式無保留意見
九十六	江佳玲	龔俊吉	無保留意見
九十五	江佳玲	曾光敏	修正式無保留意見

二、最近五年度財務分析

分析項目	年度	最近五年度財務分析(註1)				
		九十九年度	九十八年度	九十七年度	九十六年度	九十五年度
財務結構	負債占資產比率(%)	45.21	46.29	43.78	26.33	34.54
	長期資金占固定資產比率(%)	350.25	375.75	390.42	285.89	245.73
償債能力	流動比率(%)	68.54	97.16	133.64	177.30	130.99
	速動比率(%)	54.26	80.43	105.10	147.90	102.44
經營能力	利息保障倍數(%)	18.95	8.16	9.62	31.19	26.51
	應收款項週轉率(次)	7.08	6.51	6.64	7.09	8.47
	平均收現日數	52	56	55	51	43
	存貨週轉率(次)	20.27	19.81	19.73	14.41	10.15
	應付款項週轉率(次)	7.43	7.23	7.52	6.73	6.59
	平均銷貨日數	18	18	18	25	36
	固定資產週轉率(次)	1.74	1.52	1.65	1.80	1.90
	總資產週轉率(次)	0.42	0.35	0.39	0.54	0.63
獲利能力	資產報酬率(%)	13.03	5.87	6.02	12.33	18.10
	股東權益報酬率(%)	22.90	9.55	8.51	17.23	30.80
	占實收資本比率(%)	營業利益	17.04	10.28	10.46	19.43
		稅前純益	31.29	13.96	12.90	24.98
	純益率(%)	27.23	14.62	12.71	21.90	27.22
	每股盈餘(純損)元/股 (追溯調整後)	基本	3.10	1.19	1.04	2.05
		稀釋	3.04	1.17	1.02	1.98
現金流量	現金流量比率(%)	80.59	57.85	185.34	109.05	118.12
	現金流量允當比率(%)	131.81	145.21	124.31	121.55	117.14
槓桿度	現金再投資比率(%)	9.54	4.76	4.10	5.98	17.57
	營運槓桿度	3.04	3.95	4.50	2.52	2.32
	財務槓桿度	1.11	1.23	1.17	1.04	1.06

說明最近二年度各項財務比率變動原因：

- 本公司流動比率及速動比率降低，主要係擴充購置固定資產增加及併購環電，是以向子公司融通資金致其他應付款項增加所致。
- 本公司資產報酬率及股東權益報酬率增加，主要係營運成長獲利能力提升所致。
- 本公司現金流量比率增加，主係本期因營運成長致營業活動淨現金流量增加所致。

註1：最近五年度財務報表均由會計師查核簽證。

註2：財務分析項目之計算公式如下：

計算公式：

1. 財務結構

- (1)負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額。
- (2)長期資金占固定資產比率 = (股東權益淨額 + 長期負債) / 固定資產淨額。

2. 債債能力

- (1)流動比率 = 流動資產 / 流動負債。
- (2)速動比率 = (流動資產 - 存貨 - 預付費用) / 流動負債。

(3)利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出。

3. 經營能力

(1)應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項(包括應收帳款與因營業而產生之應收票據)餘額。

(2)平均收現日數 = 365 / 應收款項週轉率。

(3)存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額。

(4)應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項(包括應付帳款與因營業而產生之應付票據)餘額。

(5)平均銷貨日數 = 365 / 存貨週轉率。

(6)固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額。

(7)總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額。

4. 獲利能力

(1)資產報酬率 = (稅後損益 + 利息費用 × (1 - 稅率)) / 平均資產總額。

(2)股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額。

(3)純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額。

(4)每股盈餘 = (稅後淨利 - 特別股利) / 加權平均已發行股數。(註3)

5. 現金流量

(1)現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債。

(2)淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度(資本支出 + 存貨增加額 + 現金股利)。

(3)現金再投資比率 = (營業活動淨現金流量 - 現金股利) / (固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資金)。(註4)

6. 檢桿度：

(1)營運槓桿度 = (營業收入淨額 - 變動營業成本及費用) / 營業利益(註5)。

(2)財務槓桿度 = 營業利益 / (營業利益 - 利息費用)。

註3：每股盈餘之計算公式：

1.以加權平均普通股股數為準，而非以年底已發行股數為基礎。

2.凡有現金增資或庫藏股交易者，應考慮其流通期間，計算加權平均股數。

3.凡有盈餘轉增資或資本公積轉增資者，在計算以往年度及半年度之每股盈餘時，應按增資比例追溯調整，無庸考慮該增資之發行期間。

4.若特別股為不可轉換之累積特別股，其當年度股利(不論是否發放)應自稅後淨利減除或增加稅後淨損。特別股若為非累積性質，在有稅後淨利之情況，特別股股利應自稅後淨利減除；如為虧損，則不必調整。

註4：現金流量分析：

1.營業活動淨現金流量係指現金流量表中營業活動淨現金流入數。

2.資本支出係指每年資本投資之現金流出數。

3.存貨增加數僅在期末餘額大於期初餘額時方予計入，若年底存貨減少，則以零計算。

4.現金股利包括普通股及特別股之現金股利。

5.固定資產毛額係指扣除累計折舊前之固定資產總額。

註5：各項營業成本及營業費用依性質區分為固定及變動。

三、最近年度財務報告之監察人審查報告

董事會造送本公司九十九年度財務報表，業經勤業衆信聯合會計師事務所龔俊吉會計師及邱慧吟會計師查核簽證，連同營業報告書、盈餘分配議案等表冊，移由本監察人等審查完竣，認為尚無不合，爰依公司法第二一九條之規定，備具報告書，敬請 鑒察為荷。

此致

本公司民國一〇〇年股東常會

日月光半導體製造股份有限公司

監察人：曾元一

何弘

劉曉明

陳天賜

張能超



中華民國一〇〇年四月十二日

四、最近年度財務報表，含會計師查核報告、兩年對照之資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流量表及附註或附表：

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司(日月光公司)民國九十九年及九十八年十二月三十一日之資產負債表，暨民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日之損益表、股東權益變動表及現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法及商業會計處理準則中與財務會計準則相關之規定暨一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之經營成果與現金流量。

如財務報表附註九所述，日月光公司及其子公司分別於民國九十九年二月及八月公開收購環隆電氣股份有限公司(環電)之股權，收購完成後對環電之持股比例提高為98.9%。

如財務報表附註三所述，日月光公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

日月光公司已編製其與子公司民國九十九及九十八年度之合併財務報表，經本會計師查核並出具修正式無保留意見之查核報告，備供參考。

隨附日月光公司民國九十九年度財務報表重要會計科目明細表，主要供補充分析，亦經本會計師執行第二段所述之查核程序。據本會計師之意見，該等科目明細表在所有重大方面與第一段所述之財務報表相關資訊一致。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 龔俊吉

龔俊吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 邱慧吟

邱慧吟



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中華民國一〇〇年三月十七日



日月光半導體製造股份有限公司
資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

代碼	資產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100	現金(附註四)	\$ 1,632,102	1	\$ 4,079,270	3
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 －流動(附註二及五)	72,586	—	15,747	—
1140	應收帳款淨額(附註二及六)	9,587,062	6	9,279,406	7
1153	應收帳款－關係人(附註二及二一)	99,534	—	52,032	—
1164	應收退稅款	—	—	99,330	—
1178	其他應收款	714,388	—	873,015	1
1180	其他應收款－關係人(附註九及二一)	1,080,395	1	163,854	—
120X	存貨(附註二及七)	2,910,324	2	2,086,376	2
1286	遞延所得稅資產－流動(附註二及十七)	461,417	—	700,357	—
1298	其他流動資產	194,779	—	242,226	—
11XX	流動資產合計	16,752,587	10	17,591,613	13
基金及投資					
1450	備供出售金融資產－非流動(附註二及八)	102,790	—	—	—
1480	以成本衡量之金融資產－非流動(附註二及八)	364,551	—	467,468	—
1421	採權益法之長期股權投資(附註二及九)	101,116,457	63	79,873,491	60
14XX	基金及投資合計	101,583,798	63	80,340,959	60
固定資產(附註二、十、二一、二二及二三)					
1501	土地	1,558,201	1	1,558,201	1
1521	建築物及附屬設備	20,100,741	12	18,278,699	14
1531	機器設備	63,587,917	39	54,595,445	41
1551	運輸設備	63,102	—	66,613	—
1561	辦公設備	846,113	1	968,773	1
1611	租賃資產	17,221	—	39,825	—
15X1	成本合計	86,173,295	53	75,507,556	57
15X9	減：累計折舊	49,468,469	30	48,492,479	37
1599	累計減損	64,072	—	—	—
		36,640,754	23	27,015,077	20
1671	未完工程	465,003	—	128,315	—
1672	在途機器及預付設備款	1,703,819	1	3,239,679	3
15XX	固定資產合計	38,809,576	24	30,383,071	23
無形資產(附註二)					
1720	專利使用權	42,831	—	62,194	—
1760	商譽	957,167	1	957,167	1
1770	遞延退休金成本	44,024	—	50,393	—
17XX	無形資產合計	1,044,022	1	1,069,754	1
其他資產					
1800	出租資產(附註二及十一)	1,806,424	1	2,439,452	2
1810	閒置資產(附註二)	4,744	—	86,062	—
1820	存出保證金	12,950	—	12,193	—
1830	遞延費用(附註二)	621,772	—	570,778	—
1860	遞延所得稅資產－非流動(附註二及十七)	841,140	1	694,669	1
1887	受限制資產(附註二二)	149,447	—	84,447	—
18XX	其他資產合計	3,436,477	2	3,887,601	3
1XXX	資產總計	\$ 161,626,460	100	\$ 133,272,998	100

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代碼	負債及股東權益	九十九十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
	流動負債				
2180	公平價值變動列入損益之金融負債－流動 (附註二及五)	\$ 488,769	-	\$ 61,195	-
2200	避險之衍生性金融負債－流動(附註二及二十)	457,494	-	122,495	-
2140	應付帳款	6,231,596	4	5,253,226	4
2150	應付帳款－關係人(附註二一)	1,090,674	1	1,061,115	1
2160	應付所得稅	744,222	-	808,739	1
2170	應付費用(附註十二)	4,287,655	3	2,574,102	2
2190	其他應付款－關係人(附註二一)	9,348,575	6	5,875,663	4
2224	應付設備款	1,244,836	1	1,755,397	1
2228	其他應付款	383,581	-	291,588	-
2288	應付租賃款－流動(附註二)	1,504	-	9,048	-
2298	其他流動負債	164,547	-	292,383	-
21XX	流動負債合計	24,443,453	15	18,104,951	13
	長期負債				
2430	避險之衍生性金融負債－非流動(附註二及二十)	159,279	-	311,778	-
2420	長期借款(附註十三及二二)	47,214,226	29	42,165,604	32
2446	應付租賃款－非流動(附註二)	238	-	1,749	-
24XX	長期負債合計	47,373,743	29	42,479,131	32
	其他負債				
2810	應計退休金負債(附註十四)	1,251,957	1	1,072,012	1
2820	存入保證金	938	-	878	-
28XX	其他負債合計	1,252,895	1	1,072,890	1
2XXX	負債合計	73,070,091	45	61,656,972	46
	股本(附註十五)				
3110	普通股股本－每股面額10元，額定股數為8,000,000千股： 發行股數九十九年及九十八年十二月三十一日分別為 6,051,987千股及5,479,878千股	60,519,872	38	54,798,783	41
3140	預收股本	299,698	-	135,205	-
31XX	股本合計	60,819,570	38	54,933,988	41
	資本公積(附註二、十五及十六)				
3210	發行股票溢價	1,197,845	1	1,311,421	1
3220	庫藏股票交易	2,136,353	1	827,285	1
3260	長期投資	3,527,240	2	3,538,222	3
3271	員工認股權	319,147	-	-	-
3281	轉換公司債應付利息補償金	-	-	656,827	-
32XX	資本公積合計	7,180,585	4	6,333,755	5
33XX	保留盈餘(附註十五)	24,972,944	16	13,229,409	10
	股東權益其他項目(附註二及十五)				
3450	金融商品未實現損益	246,303	-	25,498	-
3420	累積換算調整數	(1,120,618)	(1)	3,276,508	2
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(398,103)	-	(248,641)	-
3480	庫藏股票－九十九年及九十八年十二月三十一日 分別為151,792千股及322,532千股	(3,144,312)	(2)	(5,934,491)	(4)
34XX	股東權益其他項目淨額	(4,416,730)	(3)	(2,881,126)	(2)
3XXX	股東權益合計	88,556,369	55	71,616,026	54
	負債及股東權益總計	\$ 161,626,460	100	\$ 133,272,998	100

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司
損益表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼	九十九年度		九十八年度	
	金額	%	金額	%
營業收入(附註二)				
4110 銷貨收入	\$ 68,005,684	101	\$ 46,805,576	101
4190 減：銷貨退回及折讓	666,278	1	671,262	1
4000 營業收入淨額	67,339,406	100	46,134,314	100
5000 營業成本(附註三、七、十八及二一)	50,633,615	75	35,554,473	77
5910 營業毛利	16,705,791	25	10,579,841	23
營業費用(附註十八及二一)				
6300 研究發展費用	2,775,607	4	2,036,633	4
6100 推銷費用	745,295	1	783,222	2
6200 管理及總務費用	2,823,686	5	1,941,215	4
6000 合計	6,344,588	10	4,761,070	10
6900 營業淨利	10,361,203	15	5,818,771	13
營業外收入及利益				
7110 利息收入	10,559	—	19,363	—
7310 金融資產評價利益－淨額(附註二及五)	455,097	1	808,585	2
7121 權益法認列之投資收益(附註二及九)	9,918,123	15	2,762,236	6
7160 兌換利益－淨額(附註二)	457,124	1	—	—
7480 其他(附註十一)	396,382	—	462,648	1
7100 合計	11,237,285	17	4,052,832	9
營業外費用及損失				
7510 利息費用(附註二及十)	1,060,346	2	1,070,718	3
7650 金融負債評價損失－淨額(附註二及五)	872,900	1	572,952	1
7560 兌換損失－淨額(附註二)	—	—	3,631	—
7630 減損損失(附註九及十一)	161,024	—	—	—
7880 其他	471,629	1	556,611	1
7500 合計	2,565,899	4	2,203,912	5
7900 稅前淨利	19,032,589	28	7,667,691	17
8110 所得稅費用(附註二及十七)	695,089	1	923,145	2
9600 本期淨利	\$ 18,337,500	27	\$ 6,744,546	15
代碼	九十九年度		九十八年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
每股盈餘(附註十九)				
9750 基本每股盈餘	\$ 3.22	\$ 3.10	\$ 1.35	\$ 1.19
9850 稀釋每股盈餘	3.16	3.04	1.33	1.17

假設子公司持有本公司股票不視為庫藏股票而作為備供出售金融資產時之擬制性資料（稅後金額）：

	九十九年度	九十八年度
計算基本每股盈餘之淨利	<u>\$ 19,646,568</u>	<u>\$ 6,905,441</u>
計算稀釋每股盈餘之淨利	<u>\$ 19,502,171</u>	<u>\$ 6,878,969</u>
基本每股盈餘，九十九及九十八年度分別按加權平均股數6,047,098千股 及6,033,477千股計算	<u>\$ 3.25</u>	<u>\$ 1.14</u>
稀釋每股盈餘，九十九及九十八年度分別按加權平均股數6,122,206千股 及6,082,633千股計算	<u>\$ 3.19</u>	<u>\$ 1.13</u>

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司
股東權益變動表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

代碼	股本			資本公積
	普通股股本	預收股本		
A1 九十八年一月一日餘額	\$ 56,904,278	\$ 3,387	\$ 6,373,287	
九十七年度盈餘分配(附註十五)				
N1 提列法定盈餘公積	-	-	-	
P1 普通股現金股利-5.0%	-	-	-	
S5 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	1,369	
J8 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	160,895	
Q7 現金流量避險未實現損益增減	-	-	-	
G1 員工認股權行使	74,245	131,818	32,726	
M1 本期損益	-	-	-	
R5 外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	
R1 未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	
J1 庫藏股買回-109,274千股	-	-	-	
J3 庫藏股註銷-217,974千股	(2,179,740)	-	(234,522)	
Z1 九十八年十二月三十一日餘額	54,798,783	135,205	6,333,755	
九十八年度盈餘分配(附註十五)				
N1 提列法定盈餘公積	-	-	-	
P5 普通股股票股利-8.4%	4,615,775	-	-	
P1 普通股現金股利-3.6%	-	-	-	
E3 資本公積轉增資	879,195	-	(879,195)	
S5 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	(9,510)	
Q5 備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	
J7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	1,271,532	
K5 處分長期股權投資	-	-	(1,472)	
J8 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	37,536	
Q7 現金流量避險未實現損益增減	-	-	-	
L1 員工認股權	-	-	319,147	
G1 員工認股權行使	226,119	164,493	108,792	
M1 本期損益	-	-	-	
R5 外幣財務報表換算所產生兌換差額增減	-	-	-	
R1 未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	
J1 庫藏股買回-37,000千股	-	-	-	
Z1 九十九年十二月三十一日餘額	\$ 60,519,872	\$ 299,698	\$ 7,180,585	

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業眾信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

單位：新台幣千元

股東權益其他項目

保留盈餘			金融商品			累積換算			未認列為退休金		
法定盈餘公積	未分配盈餘	合計	未實現損益	調整數		成本之淨損失		庫藏股票		股東權益合計	
\$ 2,915,029	\$ 6,306,375	\$ 9,221,404	(\$ 439,438)	\$ 4,873,957		(\$ 230,401)		(\$ 7,034,480)		\$ 69,671,994	
616,005	(616,005)	-	-	-		-		-		-	
-	(2,736,568)	(2,736,568)	-	-		-		-	(2,736,568)		
-	27	27	380,464	-		8,793	-	-	390,653		
-	-	-	-	-		-		-	160,895		
-	-	-	84,472	-		-		-	84,472		
-	-	-	-	-		-		-	238,789		
-	6,744,546	6,744,546	-	-		-		-	6,744,546		
-	-	-	-	(1,597,449)		-		-	(1,597,449)		
-	-	-	-	-	(27,033)	-	-	(27,033)			
-	-	-	-	-	-	-	(1,314,273)	(1,314,273)			
-	-	-	-	-	-	-	2,414,262	-	-		
3,531,034	9,698,375	13,229,409	25,498	3,276,508	(248,641)	(5,934,491)			71,616,026		
674,455	(674,455)	-	-	-		-		-	-		
-	(4,615,775)	(4,615,775)	-	-		-		-	-		
-	(1,978,190)	(1,978,190)	-	-		-		-	(1,978,190)		
-	-	-	-	-		-		-	-		
-	-	-	124,744	-	(22,109)	-		-	93,125		
-	-	-	(9,290)	-	-	-		-	(9,290)		
-	-	-	-	-	-	-	3,975,384		5,246,916		
-	-	-	-	-	8	-	-	(1,464)			
-	-	-	-	-	-	-	-	37,536			
-	-	-	105,351	-	-	-	-	105,351			
-	-	-	-	-	-	-	-	319,147			
-	-	-	-	-	-	-	-	499,404			
-	18,337,500	18,337,500	-	-	-	-	-	18,337,500			
-	-	-	-	(4,397,126)	-	-	-	(4,397,126)			
-	-	-	-	-	(127,361)	-	-	(127,361)			
-	-	-	-	-	-	-	(1,185,205)	(1,185,205)			
\$ 4,205,489	\$ 20,767,455	\$ 24,972,944	\$ 246,303	(\$ 1,120,618)	(\$ 398,103)	(\$ 3,144,312)		\$ 88,556,369			

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司
現金流量表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

代碼		九十九年度		九十八年度	
營業活動之現金流量					
A10000	本期淨利	\$	18,337,500	\$	6,744,546
A20000	調整項目				
A20300	折舊費用		6,149,218		5,611,664
A20400	攤銷費用		344,999		349,617
A21200	股份基礎給付酬勞成本		240,108		-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失		76,763		112,025
A23700	金融資產減損損失		41,739		-
A23900	非金融資產減損損失		119,285		-
A22400	權益法認列之投資收益	(9,918,123)	(2,762,236)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利		2,507,350		1,784,475
A24800	遞延所得稅費用		131,490		281,359
A29900	其他調整項目	(290,788)		376,609
A30000	營業資產及負債之淨變動				
A31110	交易目的金融資產增加	(56,839)	(15,747)
A31140	應收帳款增加	(324,032)	(4,464,864)
A31150	應收帳款－關係人增加	(47,502)	(24,692)
A31160	其他應收款(增加)減少	(140,787)		51,931
A31170	其他應收款－關係人增加	(50,497)	(135,897)
A31180	存貨增加	(900,711)	(678,765)
A31211	其他流動資產(增加)減少		45,415		53,902)
A32110	交易目的金融負債增加(減少)		427,574		21,043)
A32140	應付帳款增加		978,370		2,487,122
A32150	應付帳款－關係人增加		29,559		262,494
A32160	應付所得稅增加(減少)	(64,517)		165,995
A32170	應付費用增加		1,713,553		275,091
A32180	其他應付款項增加(減少)		91,993	(64,192)
A32190	其他應付款－關係人增加		384,944		69,561
A32212	其他流動負債增加(減少)	(127,836)	(121,833)
AAAA	營業活動之淨現金流入		19,698,228		10,472,984
投資活動之現金流量					
B00300	取得備供出售金融資產	(1,470,000)	(570,000)
B00400	處分備供出售金融資產價款		1,470,173		570,058
B00600	處分無活絡市場之債券投資價款		-		450,000
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(23,947)	(104,914)
B01101	以成本衡量之金融資產減資退回股款		14,784		-
B01400	增加採權益法之長期股權投資	(13,730,817)	(23,614,725)
B01500	處分採權益法之長期股權投資價款		18,000		20,814,031
B01800	採權益法之被投資公司減資退回股款		3,169		-
B01900	購置固定資產	(15,210,386)	(5,574,392)
B02000	處分固定資產價款		216,522		101,739
B02500	存出保證金減少		1,275		2,768
B02600	遞延費用增加	(372,510)	(256,365)
B02700	其他應收款(增)減		450,000	(450,000)
B02800	受限制資產增加	(65,000)	(300)
BBBB	投資活動之淨現金流出	(28,698,737)	(8,632,100)
融資活動之現金流量					
C01701	其他應付款－關係人增加		3,316,080		4,893,800
C00900	舉借長期借款		29,369,947		27,680,050
C01000	償還長期借款	(23,459,700)	(28,263,090)
C00500	償還公司債		-	(1,375,000)
C01702	應付租賃款減少	(9,055)	(18,413)
C01600	存入保證金增(減)		60	(121)
C02100	發放現金股利	(1,978,190)	(2,736,568)
C02400	員工執行認股權		499,404		238,789

單位：新台幣千元

代碼		九十九年度		九十八年度	
		(\$)	(\$)
C02500	庫藏股票買回成本		1,185,205		1,314,273
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)		6,553,341		894,826
EEEE	本年度現金淨增(減)金額	(2,447,168)		946,058
E00100	年初現金餘額		4,079,270		3,133,212
E00200	年底現金餘額	\$	1,632,102	\$	4,079,270
	現金流量資訊之補充揭露				
F00100	本年度支付利息	\$	1,095,413	\$	1,194,519
F00200	減：資本化利息		43,533		22,603
F00300	不含資本化利息之本年度支付利息	\$	1,051,880	\$	1,171,916
F00400	支付所得稅	\$	519,421	\$	471,854
	同時影響現金及非現金項目之投資活動				
H00300	固定資產增加數	\$	14,598,373	\$	6,838,333
H00500	應付購買設備款減少(增加)		612,013	(1,263,941)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$	15,210,386	\$	5,574,392
H00900	出售固定資產價款	\$	232,404	\$	140,891
H01000	其他應收款增加－出售固定資產	(15,882)	(39,152)
H01100	出售固定資產收取現金數	\$	216,522	\$	101,739
H01200	出售採權益法之長期股權投資價款	\$	18,000	\$	29,608,501
	應收款項轉作預付投資款		-	(8,794,470)
H01400	出售採權益法之長期股權投資收取現金數	\$	18,000	\$	20,814,031
	採權益法之長期股權投資增加數	\$	13,730,817	\$	32,409,195
	以應收款項轉增資		-	(8,794,470)
	支付現金數	\$	13,730,817	\$	23,614,725
	長期股權投資退回款項	\$	904,587	\$	3,169
	其他應收款－關係人增加	(901,418)	(3,169)
	收取現金數	\$	3,169	\$	-
	不影響現金流量之融資活動				
G00200	應付租賃款－流動	\$	1,504	\$	9,048

後附之附註係本財務報表之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思



日月光半導體製造股份有限公司

財務報表附註

民國九十九及九十八年度

(除另註明外，金額以新台幣千元為單位)

一、公司沿革

本公司於七十三年三月設立於高雄楠梓加工出口區，同年七月開始營業，嗣於九十三年八月吸收合併子公司日月欣半導體公司及日月宏科技公司，經核准設立中壢分公司，另於九十五年八月將材料事業部分割讓與日月光電子公司(日月光電子)。本公司所營業務主要為各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售。

本公司股票在台灣證券交易所掛牌上市買賣(股票代碼：2311)，嗣於八十九年九月以增資發行新股方式經中華民國相關主管機關及美國證管會核准在美國首次公開發行美國存託憑證(ADR)，該ADR並在紐約證券交易所掛牌上市，代號為ASX。

截至九十九年及九十八年十二月三十一日止，本公司員工人數(含派遣人力，並扣除借調子公司員工)分別約為16,700人及15,000人。

二、重要會計政策之彙總說明

本財務報表係依照證券發行人財務報告編製準則、商業會計法、商業會計處理準則及一般公認會計原則編製。依照前述準則、法令及原則編製財務報表時，必須使用合理之估計金額。因估計涉及判斷，實際結果可能有所差異。

重要會計政策彙總說明如下：

資產與負債區分流動與非流動之標準

流動資產包括現金，以及主要為交易目的而持有之資產或預期於資產負債表日後十二個月內變現或耗用之資產；固定資產、無形資產及其他不屬於流動資產之資產為非流動資產。流動負債包括主要為交易目的而發生之負債，以及須於資產負債表日後十二個月內清償之負債，負債不屬於流動負債者為非流動負債。

公平價值變動列入損益之金融商品

公平價值變動列入損益之金融商品係交易目的之金融資產或金融負債。本公司成為金融商品合約之一方時，認列金融資產或金融負債；於對合約權利喪失控制時，除列金融資產；於合約規定之義務解除、取消或到期而使金融負債消滅時，除列金融負債。

原始認列時，係以公平價值衡量，交易成本列為當年度費用；續後評價時，以公平價值衡量且公平價值變動認列為當年度損益。金融商品除列時，出售所得價款或支付金額與帳面價值之差額，計入當年度損益。

衍生性商品未能符合避險會計者，係分類為交易目的之金融資產或金融負債。公平價值為正值時，列為金融資產；公平價值為負值時，列為金融負債。

無活絡市場之金融商品，以評價方法估計其公平價值。

備供出售金融資產

備供出售金融資產於原始認列時，以公平價值衡量，並加計取得之交易成本；續後評價以公平價值衡量，且其價值變動列為股東權益調整項目，累積之利益或損失於金融資產除列時，列入當年度損益。依交易慣例購買或出售金融資產時，採用交割日會計處理。

備供出售金融資產之認列或除列時點與公平價值變動列入損益之金融商品相同。

開放型基金受益憑證以資產負債表日之淨資產價值為公平價值。

收入認列、備抵呆帳及備抵銷貨折讓

半導體封裝收入於完成封裝或交運時認列，半導體測試收入於測試服務完成時認列，其他營業收入通常於勞務完成或商品交付客戶時認列，因其獲利過程大部分已完成，且已實現或可實現。備抵銷貨折讓係按估計可能發生之折讓金額提列。

銷貨收入係按本公司與客戶所協議交易對價(考量商業折扣及數量折扣後)之公平價值衡量；惟銷貨收入之對價為一年期以內之應收款時，其公平價值與到期值差異不大且交易量頻繁，則不按設算利率計算公平價值。

備抵呆帳係按應收款項收回可能性評估提列。本公司係依據應收帳款之帳齡分析及經濟環境等因素，定期評估應收帳款之收回可能性。

存貨

存貨包括原料(不包括受託加工之晶圓)、物料、在製品、製成品及在途原物料。存貨係以成本與淨變現價值孰低衡量，比較成本與淨變現價值係以個別項目為基礎。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及銷售費用後之餘額。原料及物料成本按移動平均法計價，在製品及製成品成本平時按標準成本計價，結帳日再予調整使其接近按加權平均法計算之成本。

以成本衡量之金融資產

無法可靠衡量公平價值之權益商品投資以原始認列之成本衡量。現金股利於除息日認列收益；股票股利不認列為投資收益，僅於除權日註記股數增加，並按增加後之總股數重新計算每股成本。若有減損之客觀證據，則認列減損損失，此減損金額不得迴轉。

採權益法之長期股權投資

本公司持有被投資公司有表決權股份達百分之二十以上或具有重大影響力者，採用權益法評價。惟子公司持有母公司股票視同庫藏股票，子公司收取本公司發放之現金股利收入不認列投資收益，係調整資本公積—庫藏股票交易。

取得股權、首次採用權益法或從子公司之少數股東取得股份時，先將投資成本予以分析處理，投資成本超過可辨認淨資產公平價值部分列為商譽，商譽不予攤銷。若可辨認淨資產公平價值超過投資成本，則其差額就各非流動資產(非採權益法評價之金融資產及遞延所得稅資產除外)公平價值等比例減少之，仍有差額時列為非常利益。

被投資公司發行新股時，若未按持股比例認購，致使持股比例發生變動，並因而使投資之股權淨值發生增減時，其增減數調整資本公積及長期投資；此項調整如應調減資本公積，而長期投資所產生之資本公積餘額不足時，其差額則調減保留盈餘。

組織重組之股權交易，係按原投資公司之長期股權投資帳面價值入帳，與收付價款之差額均調整發行溢價所產生之資本公積，另原投資公司所產生之投資成本與股權淨值間差額之餘額，由受讓公司繼續處理。

本公司與採權益法評價之被投資公司間之順、逆流交易，及採權益法評價之被投資公司間發生之側流交易，其未實現損益均已銷除。

固定資產、出租資產及閒置資產

土地以成本計價，土地以外之固定資產及出租資產則以成本減累計折舊計價。固定資產購建期間為是項資產所支出款項而負擔之利息，予以資本化列為固定資產之成本。重大之更新及改良作為資本支出；修理及維護支出則作為當年度費用。

資本租賃係以各期租金給付額之現值總額或租賃開始日租賃資產公平價值較低者作為成本入帳，並同時認列應付租賃款負債。每期所支付租賃款中之隱含利息列為當年度之利息費用。

折舊採直線法依下列耐用年數計提：建築物及附屬設備，二至五十五年；機器設備，二至五年；運輸設備，四至五年；辦公設備，二至八年；租賃資產，三至五年。耐用年限屆滿仍繼續使用者，則就其殘值按重行估計可使用年數繼續提列折舊。

閒置資產係按淨公平價值或帳面價值較低者評價，並認列減損損失，另帳面價值再按直線法繼續攤提折舊。

固定資產、出租資產及閒置資產出售或報廢時，其相關成本及累計折舊均自帳上減除。處分利益或損失列為當年度營業外利益或損失。

無形資產

專利使用權以取得成本為入帳基礎，採直線法依其效益年限攤銷。因併購所產生之商譽原按十年攤銷，惟自九十五年一月一日起，依新修訂財務會計準則公報之規定，不再攤銷，而係每年定期進行減損測試。

資產減損

倘資產(主要為固定資產、專利使用權、商譽、出租資產與採權益法之長期股權投資)以其相關可回收金額衡量帳面價值有重大減損時，就其減損部分認列損失。嗣後若資產(商譽除外)可回收金額增加時，將減損損失之迴轉認列為利益，惟資產於減損損失迴轉後之帳面價值，不得超過該項資產在未認列減損損失之情況下，減除應提列折舊或攤銷後之帳面價值。

遞延費用

遞延費用包括模具及系統軟體費用等，採直線法按二至五年攤銷。

員工認股權

發行酬勞性員工認股權憑證，其給與日在九十七年一月一日(含)以後者，係依照財務會計準則公報第三十九號「股份基礎給付之會計處理準則」處理。按預期既得認股權之最佳估計數量及給與日公平價值計算之認股權價值，於既得期間以直線法逐期認列為費用，並同時調整資本公積—員工認股權。後續資訊顯示預期既得之認股權數量與估計不同時，則修正原估計數。

發行酬勞性員工認股權憑證，其給與日在九十六年十二月三十一日以前者，係適用財團法人中華民國會計研究發展基金會相關解釋函，本公司選擇採用內含價值法處理，酬勞成本於符合認股權計畫所規定之員工服務年限內逐期認列為費用。

退休金

屬確定給付退休辦法之退休金成本係按精算結果認列；屬確定提撥退休辦法之退休金成本，係於員工任職服務期間，按應提撥之退休金金額認列。

庫藏股票

本公司買回已發行股票作為庫藏股票時，將所支付之成本列記庫藏股票，列為股東權益之減項。註銷庫藏股票時，轉銷帳列庫藏股票，並按股權比例減列股本及與股票發行溢價相關之資本公積。庫藏股票之帳面價值高於面值與股票發行溢價合計數之差額應沖銷同種類庫藏股票所產生之資本公積，如有不足，再減列保留盈餘。處分庫藏股票時，除轉銷庫藏股票外，若處分價格高於帳面價值，其差額貸記庫藏股票產生之資本公積。

子公司持有母公司股票視同庫藏股票處理，自長期投資重分類為庫藏股票。

所得稅

所得稅作同期間及跨期間之分攤，即將(一)直接調整股東權益之項目及(二)可減除暫時性差異及未使用投資抵減之所得稅影響數認列為遞延所得稅資產，並評估其可實現性，認列備抵評價金額；應課稅暫時性差異之所得稅影響數則認列為遞延所得稅負債。遞延所得稅資產或負債依其相關資產或負債之分類劃分為流動或非流動項目，無相關之資產或負債者，依預期迴轉期間劃分為流動或非流動項目。

投資國外子公司之長期股權投資帳面價值與課稅基礎間產生之應課稅暫時性差異，因本公司可控制該暫時性差異迴轉之時間，且於可預見之未來不會迴轉，其實質上係長久存在者，則不予認列相關遞延所得稅負債。

購置機器設備及研究發展等支出所產生之所得稅抵減，採當期認列法處理。

以前年度應付所得稅之調整，列入當年度之所得稅。

依所得稅法規定計算之未分配盈餘課徵百分之十所得稅，列為股東會決議年度之所得稅費用。

外幣交易

非衍生性商品之外幣交易所產生之各項外幣資產、負債、收入或費用，按交易發生時之匯率折算新台幣金額入帳。外幣資產及負債於實際收付結清時所產生之兌換差額，作為當年度損益。

資產負債表日之外幣貨幣性資產或負債，按該日即期匯率予以調整，兌換差額列為當年度損益。

資產負債表日之外幣非貨幣性資產或負債(例如權益商品)，依公平價值衡量者，按該日即期匯率調整，所產生之兌換差額，屬公平價值變動認列為股東權益調整項目者，列為股東權益調整項目；屬公平價值變動認列為損益者，列為當年度損益。以成本衡量者，則按交易日之歷史匯率衡量。

外幣長期投資採權益法評價者，以被投資公司之外幣財務報表換算後所得之股東權益為依據，兌換差額列入累積換算調整數，作為股東權益之調整項目。

避險之衍生性金融商品

係以公平價值評價，且其公平價值變動依所規避之風險列為當年度損益或股東權益調整項目。

避險會計

符合適用避險會計之所有條件時，以互抵方式認列避險工具及被避險項目之公平價值變動所產生之損益影響數，其會計處理方式如下：

(一)公平價值避險

避險工具因公平價值變動而產生之損益及被避險項目因所規避之風險而產生之損益，立即認列為當年度損益。

(二) 現金流量避險

避險工具之利益或損失屬有效避險部分，扣除相關所得稅影響數後認列為股東權益調整項目，並於被避險之預期交易或該預期交易產生之資產或負債影響淨損益時，轉列為當年度損益。但認列為股東權益調整項目之淨損失預期無法收回之金額，立即轉列當年度損失。

重分類

九十八年度財務報表若干項目經予重分類，以配合九十九年度財務報表之表達。

三、會計變動之理由及其影響**存貨之會計處理準則**

本公司自九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。主要之修訂包括(一)存貨以成本與淨變現價值孰低衡量，且採逐項比較之；(二)未分攤固定製造費用於發生當期認列為營業成本；及(三)異常製造成本及存貨跌價損失(或回升利益)應分類為營業成本。此項會計變動，對本公司九十八年度財務報表並無重大影響。

四、現金

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
庫存現金	\$ 1,194	\$ 867
銀行支票及活期存款	1,543,488	4,078,403
銀行定期存款	87,420	-
	<hr/> <u>\$ 1,632,102</u>	<hr/> <u>\$ 4,079,270</u>

五、公平價值變動列入損益之金融商品－流動

本公司分類為交易目的之金融商品相關資訊如下：

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
交易目的之金融資產－流動		
遠期外匯合約	\$ 30,188	\$ 14,723
換匯合約	<u>42,398</u>	<u>1,024</u>
	<u>\$ 72,586</u>	<u>\$ 15,747</u>
交易目的之金融負債－流動		
遠期外匯合約	\$ 13,708	\$ 10,727
換匯換利合約	80,314	-
換匯合約	<u>394,747</u>	<u>50,468</u>
	<u>\$ 488,769</u>	<u>\$ 61,195</u>

本公司九十九及九十八年度從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避因匯率及利率波動所產生之風險。除附註二十(八)所述外，餘為不符有效避險條件，是以不適用避險會計。

(一)本公司於九九年及九八年十二月三十一日尚未到期之遠期外匯合約如下：

幣別	到期期間	合約金額 (千元)
九九年十二月三十一日		
新台幣兌美金	100.01.20	NTD595,600 USD20,000
美金兌新台幣	100.01.05~100.01.14	USD58,250 NTD1,715,329
美金兌日幣	100.01.06~100.01.27	USD17,100 JPY1,421,984
美金兌歐元	100.01.07	USD1,325 EUR1,000
九八年十二月三十一日		
新台幣兌美金	99.01.06~99.01.15	NTD2,568,060 USD80,000
美金兌新台幣	99.01.07~99.01.19	USD84,500 NTD2,720,558

(二)本公司於九九年及九八年十二月三十一日尚未到期之換匯合約如下：

幣別	到期期間	合約金額 (千元)
九九年十二月三十一日		
新台幣兌美金	100.01.03~100.12.23	NTD10,829,198 USD361,000
美金兌新台幣	100.01.07~100.02.24	USD35,300 NTD1,069,985
九八年十二月三十一日		
新台幣兌美金	99.01.06~99.01.20	NTD6,258,897 USD194,000
美金兌新台幣	99.01.07~99.01.08	USD9,000 NTD289,075

(三)本公司於九九年十二月三十一日尚未到期之換匯換利合約之名目本金為新台幣953,940千元兌美金30,000千元，僅按約定利率收取利息，到期日為一〇〇年九月。

九十九及九十八年度，交易目的之金融資產分別產生淨利益455,097千元及808,585千元；交易目的之金融負債則分別產生淨損失872,900千元及572,952千元。

六、應收帳款淨額

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
應收帳款	\$ 9,715,182	\$ 9,391,150
減：備抵呆帳	22,921	22,921
備抵銷貨折讓	<u>105,199</u>	<u>88,823</u>
	<u>\$ 9,587,062</u>	<u>\$ 9,279,406</u>

本公司於九九年六月與花旗銀行簽訂無追索權之應收帳款讓售合約，可循環使用額度為美金108,000千元。九十九年度本公司讓售並除列之金額為新台幣2,028,208千元及美金57,887千元，該讓售應收帳款已收現金額分別為新台幣1,621,146千元及美金29,447千元。截至九九年十二月三十一日止，本公司已預支金額為新台幣407,062千元及美金28,440千元，年利率分別為1.35%及1.01%。

依讓售合約之規定，因商業糾紛(如銷貨退回或折讓等)而產生之損失由本公司承擔，因信用風險而產生之損失則由該銀行承擔。本公司於九九年十二月三十一日已提供本票美金28,000千元作為擔保品。

七、存貨

	九九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
製成品	\$ 177,812	\$ 208,754
在製品	176,755	190,678
原料	2,320,365	1,418,849
物料	145,428	157,728
在途原物料	<u>89,964</u>	<u>110,367</u>
	<u>\$ 2,910,324</u>	<u>\$ 2,086,376</u>

九九年及九十八年十二月三十一日之備抵存貨損失分別為206,584千元及175,185千元。

九十九及九十八年度與存貨相關之營業成本分別為50,633,615千元及35,554,473千元，其中分別包括存貨損失76,763千元及112,025千元。

八、以成本衡量之金融資產－非流動

	九九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
國外非上市(櫃)公司特別股		
ID Solutions, Inc.	\$ 1,166	\$ 1,166
國內非上市(櫃)公司普通股		
漢麟創業投資公司	59,137	73,921
有限合夥		
Ripley Cable Holdings I, L.P.	304,248	297,881
上櫃公司私募普通股		
元隆電子公司	<u>—</u>	<u>94,500</u>
	<u>\$ 364,551</u>	<u>\$ 467,468</u>

本公司持有上述金融資產，因無活絡市場公開報價且其公平價值無法可靠衡量，故以成本衡量。

本公司所投資之元隆電子公司股票係買賣受限制之私募股票，本公司於九十八年十二月三十一日因無法可靠衡量其公平價值，故分類為以成本衡量之金融資產，後續因已能可靠衡量股票受限制之影響，且衡量結果與一般市場參與者評估之結果相當，故於九十九年十二月三十一日將其轉列為備供出售金融資產－非流動，九十九年度衡量產生金融商品未實現損失9,290千元。

九、採權益法之長期股權投資

	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
	帳面金額	股權%	帳面金額	股權%
上市公司				
宏璟建設公司(宏璟)	\$ 1,106,338	26.2	\$ 936,370	26.2
環電	-	-	3,039,493	16.6
非上市(櫃)公司				
J & R Holding Limited (J&R Holding)	39,254,567	100.0	36,682,882	100.0
台灣福雷電子公司(台灣福雷)	20,709,444	100.0	19,063,385	100.0
環電	15,041,086	74.2	-	-
A.S.E. Holding Limited (ASE Holding)	12,614,154	100.0	12,540,726	100.0
Omniquest Industrial Limited (Omniquest)	8,853,484	70.6	8,484,669	76.2
Innosource Limited (Innosource)	3,142,761	100.0	2,144,554	100.0
日月鴻科技公司(日月鴻)	2,270,597	55.7	2,778,474	56.0
宏錦光公司(宏錦光)	332,224	27.3	326,609	27.3
晶鍍科技公司(晶鍍)	61,824	33.3	82,010	33.3
ASE Marketing & Service Japan Co.,Ltd. (ASE MS Japan)	30,973	100.0	28,959	100.0
	103,417,452		86,108,131	
減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益	300,149		300,149	
轉列庫藏股票	1,959,107		5,934,491	
累計減損	41,739		-	
	\$ 101,116,457		\$ 79,873,491	

(一)採權益法之上市公司股權投資依九九年及九八年十二月三十一日股票收盤價計算之市價資訊如下：

	九九年十二月三十一日	九八年十二月三十一日
宏璟	\$ 1,314,260	\$ 1,221,610
環電 (已於九九年六月終止上市)	-	3,574,996
	\$ 1,314,260	\$ 4,796,606

(二)重大新增投資

1. 本公司為增加對環電之持股以強化與其技術及業務合作關係，於九九年二月以每股21元（部分對價以子公司 J&R Holding 及 ASE Test Limited (ASE Test) 持有之本公司普通股股票0.34股支付，該股票乘以收購期間屆滿日時價與收購價之差額則由本公司以現金支付）與子公司 J&R Holding 及 ASE Test 共同公開收購環電，收購價款計13,475,056千元。其中由子公司交付持有之本公司普通股股票218,167千股（附註十五）。又本公司再於九九年八月繼續收購環電，收購價款計4,667,117千元。環電嗣於九九年十二月買回其庫藏股，截至九九年十二月三十一日止，本公司及子公司合計對環電持股比例提高為99.07%。又九九年八月本公司透過子公司ASE Singapore Pte. Ltd.向EEMS Asia Pte. Ltd.收購其子公司EEMS Test Singapore Pte. Ltd.100%股權 (EEMS Test Singapore Pte. Ltd.並更名為ASE Singapore II Pte. Ltd.)，收購價格原為美金67,680千元，嗣於九九年十二月依合約規定再調整交易完成日與九八年十二月三十一日被收購公司股權淨值變動之差額，收購價格合計為美金72,163千元。

上述併購股權之會計處理係按財務會計準則公報第二十五號「企業合併－購買法之會計處理」辦理。倘本公司於九十八年初即收購上述環電及EEMS Test Singapore Pte. Ltd.股權，則九十九及九十八年度之擬制性經營結果資訊如下：

	九十九年度	九十八年度
營業收入淨額	\$ 67,339,406	\$ 46,134,314
營業外收益－權益法認列之投資收益	10,369,213	3,513,103
本期淨利	18,735,968	7,266,233
基本稅後每股盈餘(元)	3.16	1.23
稀釋稅後每股盈餘(元)	3.09	1.21

2. 本公司分別於九十九及九十八年度增加投資Innosource 835,560千元(美金26,000千元)及197,100千元(美金6,000千元)，由其轉投資日月光半導體(昆山)有限公司。
3. 本公司為配合集團組織調整，於九十八年三月將持有之ASE Test全部股權以29,608,501千元(美金853,517千元)轉讓予子公司J&R Holding，其中8,794,470千元於九十八年九月轉作對J&R Holding之增資。另九十八年三月本公司以20,694,585千元(美金596,545千元)向子公司ASE Test購入其持有之台灣福雷全部股權。
九十八年度另增加投資J&R Holding 2,639,040千元(美金80,000千元)，再由其分別轉投資日月光半導體(威海)有限公司美金20,000千元及日月光封裝測試(上海)有限公司(日月光上海封測)美金60,000千元。
4. 本公司於九十八年十月投資晶碩84,000千元，取得33.3%股權，該公司主要從事LED驅動IC之設計、生產及銷售。本公司於九十九年十二月經評估認列上述長期股權投資之減損損失41,739千元。

(三)日月鴻以九十九年十二月二十二日為減資基準日，退回本公司投資款904,587千元，截至九九年十二月三十一日止尚未收回，列入其他應收款—關係人項下。

(四)集耀已於九十八年十二月清算完結，並於九九年一月退回本公司投資款3,169千元。

(五)投資成本與股權淨值間差額屬非攤銷性資產、攤銷性資產及商譽，九十九及九十八年度變動如下：

	非攤銷性資產	攤銷性資產	商譽
	九十九年度	九十八年度	九十九年度
年初餘額	(\$ 300,149)	\$ -	\$ 402,533
本年度重分類	-	16,185	(16,185)
本年度增加	(29,328)	3,039,626	250,005
本年度攤銷	-	(389,609)	-
本年度認列減損	-	(12,923)	(28,816)
年底餘額	<u>(\$ 329,477)</u>	<u>\$ 2,653,279</u>	<u>\$ 607,537</u>
年初餘額	(\$ 300,149)	\$ 1,816,942	\$ 6,964,541
本年度增加	-	-	45,001
本年度攤銷	-	(53,960)	-
本年度減少	-	(1,762,982)	(6,607,009)
年底餘額	<u>(\$ 300,149)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 402,533</u>

上述九十九及九十八年度攤銷性資產及商譽之變動分別主係因收購環電及將本公司持有之ASE Test全部股份轉讓予子公司J&R Holding所致。

(六)本公司採權益法認列之投資(損)益，係依據各被投資公司同期間財務報表及本公司持股比例認列，其明細如下：

	九十九年度	九十八年度
台灣福雷	\$ 3,168,105	\$ 1,449,865
J&R Holding	3,029,993	383,453
環電	1,027,706	276,019
ASE Holding	1,039,355	551,802
Omniquest	839,185	86,307
日月鴻	513,961	116,623
Innosource	256,196	29,334
ASE Test	-	(159,254)
其他	43,622	28,087
	<u>\$ 9,918,123</u>	<u>\$ 2,762,236</u>

(七)本公司已編製包括所有子公司財務報表之九十九及九十八年度合併財務報表。

(八)採權益法之長期股權投資相關資訊請參閱附表八。

十、固定資產

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
累計折舊		
建築物及附屬設備	\$ 6,861,599	\$ 6,054,039
機器設備	41,823,063	41,554,669
運輸設備	45,310	46,192
辦公設備	723,090	808,798
租賃資產	15,407	28,781
	<u>\$ 49,468,469</u>	<u>\$ 48,492,479</u>

本公司有關利息費用之資訊如下：

	九十九年度	九十八年度
利息費用總額	\$ 1,103,879	\$ 1,093,321
利息資本化金額(列入固定資產項下)	<u>43,533</u>	<u>22,603</u>
列入損益表項下之利息費用	<u>\$ 1,060,346</u>	<u>\$ 1,070,718</u>

利息資本化年利率(%) 1.10~1.76 1.23~2.69

十一、出租資產

	成本	累計折舊	累計減損	未折減餘額
九十九年十二月三十一日				
建築物及附屬設備	\$ 3,401,432	(\$ 1,550,808)	(\$ 55,213)	\$ 1,795,411
機器設備	<u>106,366</u>	<u>(95,353)</u>	<u>-</u>	<u>11,013</u>
	<u>\$ 3,507,798</u>	<u>(\$ 1,646,161)</u>	<u>(\$ 55,213)</u>	<u>\$ 1,806,424</u>
九十八年十二月三十一日				
建築物及附屬設備	\$ 3,865,726	(\$ 1,446,367)	\$ -	\$ 2,419,359
機器設備	<u>46,534</u>	<u>(26,441)</u>	<u>-</u>	<u>20,093</u>
	<u>\$ 3,912,260</u>	<u>(\$ 1,472,808)</u>	<u>\$ -</u>	<u>\$ 2,439,452</u>

上述出租建築物及附屬設備主係分別出租予子公司日月光電子及日月鴻並按月收取租金。九十九及九十八年度屬出租予關係人之租金收入分別為241,564千元及250,175千元（列入其他收入項下），其中建築物及附屬設備之租金係依當地市場行情議定，機器設備則依雙方協議計算租金。截至九十九年十二月三十一日止，依租約未來可收取之租金列示如下：

期間	金額
一〇〇年度	\$ 159,164
一〇一年度	21,348
一〇二年度	12,458

十二、應付費用

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
應付員工紅利及董監酬勞	\$ 1,827,760	\$ 728,411
應付薪資及獎金	1,099,488	772,974
應付修繕物料費用	323,060	347,872
應付水電費	129,894	104,704
應付勞健保費	110,138	85,688
應付專業服務費	91,633	78,532
其他	<u>705,682</u>	<u>455,921</u>
	<u>\$ 4,287,655</u>	<u>\$ 2,574,102</u>

十三、長期借款

	九九年十二月三十一日	九八年十二月三十一日
(一) 指定用途專案借款	\$ 18,515,500	\$ 22,768,500
(二) 週轉性借款	28,782,840	19,443,900
(三) 機器設備抵押借款	<u>—</u>	<u>23,520</u>
	<u>47,298,340</u>	<u>42,235,920</u>
減：未攤銷遞延主辦費	<u>84,114</u>	<u>70,316</u>
	<u>\$ 47,214,226</u>	<u>\$ 42,165,604</u>

(一) 指定用途專案借款

	九九年十二月三十一日	九八年十二月三十一日
花旗銀行主辦之銀行團		
每半年為一期償還至一〇二年三月，每期償還 2,537,500千元，年利率九十九年十二月三十 一日1.96%；九十八年十二月三十一日1.97% 美金2億元之聯貸，將於一〇〇年五月到期一次清 償，年利率九十九年十二月三十一日1.02%： 九十八年十二月三十一日1.09%	\$ 12,687,500	\$ 16,362,500
	<u>5,828,000</u>	<u>6,406,000</u>
	<u>\$ 18,515,500</u>	<u>\$ 22,768,500</u>

上述借款係供收購ASE Test股權之用。依該融資合約，本公司於借款期間對ASE Test應隨時直接或間接持有不少於51%之股權，並隨時維持對ASE Test之實質經營控制權。

(二)週轉性借款

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
1.花旗銀行主辦之銀行團		
自一〇〇年六月起，每半年為一期平均償還至一〇三年六月，年利率九十九年十二月三十一日1.56%；九十八年十二月三十一日1.90%	\$ 12,000,000	\$ 2,500,000
美金0.7億元及新台幣25億元，自一〇一年六月起，每半年為一期平均償還至一〇四年六月，年利率0.95%～1.30%	4,539,800	-
2.國泰世華商業銀行		
將於一〇一年五月到期一次清償，年利率九十九年十二月三十一日0.90%；九十八年十二月三十一日1.01%	1,300,000	900,000
3.台新國際商業銀行		
美金36,000千元，將於一〇一年六月到期一次清償，年利率1.02%	1,049,040	-
4.第一商業銀行		
將於一〇一年九月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.96%；九十八年十二月三十一日 1.05%	1,000,000	700,000
5.星展銀行		
將於一〇一年十月到期一次清償，年利率0.95%	900,000	-
美金30,000千元，將於一〇一年九月到期一次清償，年利率1.07%	874,200	-
6.台北富邦商業銀行		
美金30,000千元，將於一〇一年六月到期一次清償，年利率0.81%	874,200	-
7.永豐商業銀行		
將於一〇一年十二月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.92%；九十八年十二月三十一日1.09%	660,000	600,000
8.香港東亞銀行		
將於一〇一年十月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.90%；九十八年十二月三十一日1.05%～1.09%	620,000	450,000
9.台灣土地銀行		
將於一〇一年十二月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.98%；九十八年十二月三十一日0.89%～0.95%	600,000	1,100,000
10.澳盛銀行		
美金20,000千元，將於一〇一年四月到期一次清償，年利率0.89%	582,800	-
11.法國巴黎銀行		
美金20,000千元，將於一〇一年一月到期一次清償，年利率1.03%	582,800	-
12.美國商業銀行		
自一〇一年三月起，每半年為一期平均償還至一〇一年九月，年利率九九年十二月三十一日1.45%；九十八年十二月三十一日1.87%	500,000	1,000,000
13.台灣銀行		
將於一〇一年八月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.98%；九十八年十二月三十一日0.80%	500,000	600,000
14.其他		
將於一〇一年三月至一〇二年一月到期一次清償，年利率九九年十二月三十一日0.90%～0.99%；九十八年十二月三十一日0.78%～2.73%	2,200,000 \$ 28,782,840	11,593,900 \$ 19,443,900

(三)機器設備抵押借款

九十八年十二月三十一日餘額已於九九年三月償還，年利率1.31%。

上述銀行團聯合融資合約，除其他有關規定外，尚規定本公司以經會計師查核或核閱之年度或半年度合併財務報表為計算基礎，於貸款存續期間內，應維持特定流動比率、負債比率、有形淨值比率及利息償付能力。本公司於九九年及九十八年十二月三十一日均符合上述規定。

本公司九九年及九十八年十二月三十一日之借款，分別有14,331,571千元及6,298,520千元將於一年內到期，本公司預計分別以九九年及九十八年十二月三十一日前已取得之融資額度清償該借款，是以未列入一年內到期部分。

十四、退休金

「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬確定提撥退休辦法，依適用員工每月薪資百分之六提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。本公司九十九及九十八年度認列之退休金成本分別為319,578千元及261,636千元。

本公司另提列委任經理人退休金準備，九十九及九十八年度認列之退休金成本分別為23,667千元及18,095千元(列入應計退休金負債項下)，並支付經理人退休金分別為2,666千元及15,966千元。截至九十九年及九十八年十二月三十一日止，本公司屬委任經理人之應計退休金負債分別為121,960千元及100,959千元。

本公司依「勞動基準法」訂定之員工退休辦法係屬確定給付退休辦法，員工退休金係根據服務年資及核准退休日前六個月平均工資(基數)計付。

本公司依規定每月按員工薪資總額百分之二提撥員工退休準備金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶。

本公司屬確定給付退休辦法之相關退休金精算資訊揭露如下：

(一)淨退休金成本組成項目

	九十九年度	九十八年度
服務成本	\$ 42,877	\$ 48,162
利息成本	61,430	53,478
退休基金資產預期報酬	(12,966)	(19,356)
攤銷數	49,547	48,867
	<u>\$ 140,888</u>	<u>\$ 131,151</u>

(二)退休基金提撥狀況與應計退休金負債之調節

	九九年十二月三十一日	九八年十二月三十一日
給付義務		
既得給付義務	\$ 311,139	\$ 143,234
非既得給付義務	1,681,820	1,564,919
累積給付義務	1,992,959	1,708,153
未來薪資增加之影響數	1,151,182	1,033,504
預計給付義務	3,144,141	2,741,657
退休基金資產公平價值	(915,015)	(831,640)
提撥狀況	2,229,126	1,910,017
未認列過渡性淨給付義務	(37,882)	(43,971)
未認列前期服務成本	(10,165)	(10,891)
未認列退休金損失	(1,456,860)	(1,170,605)
補列之應計退休金負債	414,113	293,121
列入應付費用	(8,335)	(6,618)
應計退休金負債	<u>\$ 1,129,997</u>	<u>\$ 971,053</u>
既得給付	<u>\$ 387,059</u>	<u>\$ 192,542</u>

(三)退休金給付義務之精算假設

折現率	1.75%	2.25%
未來薪資水準增加率	3.00%	3.00%
退休基金資產預期投資報酬率	2.00%	1.50%

(四)提撥至退休基金金額

	九十九年度	九十八年度
	<u>\$ 101,218</u>	<u>\$ 82,541</u>

(五)由退休基金支付金額

	<u>\$ 31,669</u>	<u>\$ 190,076</u>
--	------------------	-------------------

十五、股東權益

股本

本公司為發行員工認股權憑證所保留之股本為8,000,000千元，依本公司員工認股權憑證發行及認股辦法(附註十六)，認股權人得以約定之行使價格執行認股權利。九十九及九十八年度，員工行使認股權繳交股款分別計499,404千元及238,789千元，股數分別為28,563千股及16,061千股。其中截至九十九年及九十八年十二月三十一日止尚未辦妥變更登記，列入預收股本分別為299,698千元及135,205千元，股數分別為14,902千股及8,951千股。另本公司於九十八年度辦理註銷庫藏股減資2,179,740千元，股數217,974千股(詳庫藏股票說明)。本公司股東會亦於九十九年六月決議以資本公積879,195千元(資本公積－應付利息補償金656,827千元及發行股票溢價222,368千元)及盈餘4,615,775千元轉增資發行549,497千股，金額計5,494,970千元。以上增減資均已完成變更登記。

發行海外存託憑證

本公司發行ADR，每單位表彰本公司普通股5股，截至九十九年及九十八年十二月三十一日止，流通在外之ADR分別為53,110千單位及46,256千單位，折合普通股分別約265,552千股及231,280千股。

資本公積

依相關法令規定，發行股票溢價、庫藏股票交易及轉換公司債應付利息補償金所產生之資本公積，得用以撥充股本，惟每年以股本之一定比率為限。長期股權投資所產生之資本公積，不得作為任何用途。

盈餘分派及股利政策

依本公司章程規定，每年度有純益時，依下列順序分派之：

- (一)彌補虧損。
- (二)提存百分之十為法定盈餘公積。
- (三)依法令或主管機關規定提列特別盈餘公積。
- (四)長期投資採權益法計算之投資收益內屬於現金股利以外未實現部分，得就當期盈餘項下轉列特別盈餘公積，俟實現後再列入盈餘分配。

(五)如尚有盈餘分派如下：

1. 董事、監察人酬勞金係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之二(含)以下。
2. 員工紅利係依一至四款規定數額扣除後剩餘之數提撥百分之七(含)以上，百分之十(含)以下，其中百分之七部分係按員工紅利發放辦法分配予全體員工，另其超過百分之七部分則授權董事會就特定員工之個別貢獻度另行訂定辦法分派之。
3. 其餘由董事會擬定盈餘分派案，按股份總數比例分派之。

第2.款所稱之員工，其對象包括符合一定條件之從屬公司員工，其條件由董事會訂定之。

本公司正處於企業穩定成長階段，為因應目前及未來業務擴展之資金需求，並滿足股東對現金流入之需求，本公司之股利政策係採取剩餘股利政策分派股利，其中現金股利發放之比例不低於股利總額百分之三十，餘額則配發股票股利，並由董事會擬具盈餘分配案，經股東會決議後辦理。

九十九及九十八年度應付員工紅利估列金額分別為1,523,133千元及607,009千元；應付董監酬勞估列金額分別為304,627千元及121,402千元。前述員工紅利及董監酬勞係分別按稅後淨利(已扣除員工紅利及董監酬勞之金額)之10%及2%計算。年度終了後，董事會決議之發放金額有重大變動時，該變動調整原提列年度費用，於股東會決議日時，若金額仍有變動，則依會計估計變動處理，於股東會決議年度調整入帳。如股東會決議採股票發放員工紅利，股票紅利股數按決議紅利之金額除以股票公平價值決定，股票公平價值係指股東會決議日前一日之收盤價(考量除權除息之影響後)。

本公司分配盈餘時，必須依法令規定就股東權益減項(包括金融商品未實現損益、累積換算調整數及未認列為退休金成本之淨損失)淨額提列特別盈餘公積；另子公司於年底持有本公司股票市價低於帳面價值之差額，應依持股比例計算提列相同數額之特別盈餘公積。嗣後股東權益減項數額如有減少時，可就減少金額自特別盈餘公積轉回未分配盈餘。

法定盈餘公積，應提撥至其餘額達公司股本總額時為止。法定盈餘公積得用於彌補虧損；當其餘額已達實收股本50%，在公司無盈餘時，得以其超過部分派充股息及紅利；或在公司無虧損時，得保留法定盈餘公積達實收股本50%之半數，其餘部分得撥充股本。

本公司股東會分別於九十九年及九十八年六月通過董事會擬議之九十八及九十七年度盈餘分配案如下：

	盈餘分配案		每股股利(元)	
	九十八年度	九十七年度	九十八年度	九十七年度
法定盈餘公積	\$ 674,455	\$ 616,005		
股票股利	4,615,775	-	\$ 0.84	\$ -
現金股利	1,978,190	2,736,568	0.36	0.50
	<u>\$ 7,268,420</u>	<u>\$ 3,352,573</u>	<u>\$ 1.20</u>	<u>\$ 0.50</u>

上述股東會亦決議以現金配發九十八及九十七年度員工紅利及董監酬勞內容如下：

	九十八年度	九十七年度
員工紅利	\$ 607,009	\$ 554,404
董監酬勞	120,000	88,800

上述九十八及九十七年度員工紅利及董監酬勞與各年度財務報表估列之員工紅利及董監酬勞之差異分別為1,402千元及22,082千元，主要係因估計改變，已分別調整為九十九及九十八年度之損益。

截至會計師查核報告日止，本公司九十九年度盈餘分配案尚未經董事會通過，有關董事會通過擬議及股東會決議之盈餘分配、員工紅利及董監酬勞資訊，請至台灣證券交易所「公開資訊觀測站」查詢。

金融商品未實現損益

	備供出售金融資產	長期股權投資依持股比例認列	現金流量避險未實現損失(附註二十)	合計
九十九年度				
年初餘額	\$ -	\$ 332,721	(\$ 307,223)	\$ 25,498
直接認列為股東權益調整項目	(9,117)	124,744	(169,399)	(53,772)
轉列損益項目	(173)	-	274,750	274,577
年底餘額	<u>(\$ 9,290)</u>	<u>\$ 457,465</u>	<u>(\$ 201,872)</u>	<u>\$ 246,303</u>
九十八年度				
年初餘額	\$ -	(\$ 47,743)	(\$ 391,695)	(\$ 439,438)
直接認列為股東權益調整項目	58	380,464	(165,552)	214,970
轉列損益項目	(58)	-	250,024	249,966
年底餘額	<u>\$ -</u>	<u>\$ 332,721</u>	<u>(\$ 307,223)</u>	<u>\$ 25,498</u>

庫藏股票(股數為千股)

	年初股數	本年度增加	本年度減少	年底股數
九十九年度				
子公司持有母公司股票	322,532	10,427	218,167	114,792
維護股東權益	-	37,000	-	37,000
	<u>322,532</u>	<u>47,427</u>	<u>218,167</u>	<u>151,792</u>
九十八年度				
子公司持有母公司股票	322,532	-	-	322,532
維護股東權益	108,700	109,274	217,974	-
	<u>431,232</u>	<u>109,274</u>	<u>217,974</u>	<u>322,532</u>

如附註九所述，子公司於九九年二月以其持有之本公司股票作為收購環電之交易對價5,246,916千元而轉讓218,167千股。交易對價與庫藏股票帳面價值之差額1,271,532千元，列入資本公積－庫藏股票交易項下。另九十九年度因無償配股而增加10,427千股。

本公司董事會於九九年十一月決議，自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股，並於九九年十二月執行完畢，共買回37,000千股，已於一〇〇年一月辦妥註銷之變更登記。

本公司董事會分別於九十七年十一月及九十八年一月決議，自台灣證券集中交易市場買回本公司普通股，共買回217,974千股，已於九十八年度辦妥註銷之變更登記。

截至九九年及九十八年十二月三十一日止，上述庫藏股票帳面價值分別為3,144,312千元及5,934,491千元，市價分別為5,122,964千元及9,305,047千元。

本公司持有之庫藏股票，依證券交易法規定不得質押，亦不得享有股利之分派及表決等權利。子公司持有本公司股票視同庫藏股票處理，除不得參與本公司之現金增資及無表決權外，其餘與一般股東權利相同。

十六、員工認股權憑證

本公司為吸引並留任公司所需之專業人才，激勵員工並提昇員工向心力，業經主管機關核准發行四次員工認股權憑證(其中九十九年度核准發行200,000千單位)，每單位得認購本公司普通股一股，並以等於或不低於給與日當日之普通股股票收盤價為行使價格。該認股權憑證給與對象包含本公司及子公司之全職正式員工，且存續期間為十年，不得轉讓，持有認股權憑證之員工自被給與後屆滿二年才可行使認股權。另一公司USI Enterprise Limited(環誠公司)於九九年四月亦發行員工認股權憑證，發行條件與本公司相同，並給與本公司員工6,821千單位，每單位公平價值為美金0.88~1.06元，截至九十九年十二月三十一日止，該認股權尚無法行使。

本公司發行之員工認股權憑證相關資訊如下：

認股權憑證	九十九年度		九十八年度	
	單位(千)	加權平均行使價(元)	單位(千)	加權平均行使價(元)
年初流通在外	246,566	\$ 25.6	271,838	\$ 25.0
本年度給與	187,720	28.6	-	-
本年度沒收	(8,096)	27.2	(9,211)	26.7
本年度行使	(28,563)	17.5	(16,061)	14.9
年底流通在外	<u>397,627</u>	24.9	<u>246,566</u>	25.6
年底可行使	<u>144,815</u>	22.7	<u>140,003</u>	22.7
本年度給與之認股權憑證加權平均公平價值(元)	\$ 6.2~6.3		\$ -	

上述認股權計畫之行使價格遇有無償配股時，則依照本公司員工認股權憑證發行辦法，調整無償配股之影響。

九十九及九十八年度員工執行之認股權憑證，其於執行日之加權平均股價分別為27.22元及20.47元。

截至九九年十二月三十一日止，本公司發行之流通在外及可行使之員工認股權憑證相關資訊如下：

行使價格之範圍(元)	流通在外單位(千)	剩餘存續期限(年)	可行使單位(千)	可行使之認股權加權平均行使價格(元)
\$ 8.5	9,336	2.0	9,295	\$ 8.5
12.1~17.2	42,184	3.5	41,810	16.3
26.0~26.9	<u>346,107</u>	8.2	<u>93,710</u>	26.9
	<u>397,627</u>		<u>144,815</u>	

本公司及環誠公司於九九年發行之員工認股權係採用Hull&White(2004)結合Ritchken(1995)三項樹模型以估計給與日認股權憑證之公平價值，評價模式所採用之參數分別如下：

	本公司	環誠公司
給與日股價／市價	28.6元	美金2.49元
行使價格	28.6元	美金2.42元
預期股價波動率	28.59%	35.63%
合約期間	10年	10年
預期股利率	4%	-
無風險利率	1.8087%	1.7997%

本公司及環誠公司之預期股價波動率係分別基於本公司及同業過去十年歷史股票價格波動情形，且為將提早執行之效果納入考量，均假設於既得期間屆滿後之股票價格為行使價格1.58倍時，員工將執行認股權。

九十九年度因員工離職而放棄本公司及環誠公司九九年給與之認股權分別為2,099千單位及0單位。於九九年十二月三十一日，本公司及環誠公司估計於未來剩餘既得期間因員工離職而放棄認股權之比率分別為4%及2%。

九十九年度本公司及子公司認列九十七年一月一日以後發行之員工認股權之酬勞成本分別為240,108千元及79,039千元；九十八年度均為0千元。

若本公司及子公司將給與日於九十六年十二月三十一日(含)以前之員工認股權依財務會計準則第三十九號公報規定衡量時，九十九及九十八年度擬制性資訊如下：

	九十九年度	九十八年度
本期淨利	<u>\$ 17,804,442</u>	<u>\$ 6,127,405</u>
稅後基本每股盈餘(元)	<u>\$ 3.01</u>	<u>\$ 1.08</u>

十七、所得稅

(一)依法定稅率(九十九及九十八年度分別為17%及25%)計算之所得稅費用與損益表所列示所得稅費用之調節如下：

	九十九年度	九十八年度
稅前淨利按法定稅率計算之所得稅	<u>\$ 3,235,540</u>	<u>\$ 1,916,923</u>
調整項目之稅額影響數		
永久性差異		
免稅所得額	(420,751)	(1,169,767)
國內投資收益	(807,983)	(516,269)
暫時性差異		
處分國外投資收益	-	824,798
國外投資收益	(878,098)	(223,334)
未實現兌換利益	(135,768)	(65,135)
其他	<u>(73,512)</u>	<u>(2,811)</u>
按課稅所得估列之稅額	1,066,452	764,405
未分配盈餘課徵10%稅額	-	280,748
當年度抵用之投資抵減	(439,127)	(433,222)
以前年度所得稅調整	<u>(63,726)</u>	<u>29,855</u>
當期所得稅費用	563,599	641,786
遞延所得稅費用	<u>131,490</u>	<u>281,359</u>
所得稅費用	<u>\$ 695,089</u>	<u>\$ 923,145</u>

上列九十九及九十八年度免稅所得額係包含增資擴展之五年免稅租稅優惠分別為418,967千元及404,346千元與適用營運總部租稅獎勵分別為0千元及765,421千元。

立法院於九十八年五月修正所得稅法第五條條文，將營利事業所得稅稅率由25%調降為20%，嗣於九十九年五月再度修正調降為17%，並自九十九年度施行。

立法院於九九年四月十六日通過「產業創新條例」，其中第十條規定公司得在投資於研究發展支出15%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅，並以不超過當年度應納營利事業所得稅30%為限，該條例之施行期間自九九年一月一日起至一〇八年十二月三十一日止。

(二)遞延所得稅資產(負債)之內容列示如下：

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
流動		
未使用投資抵減	\$ 359,052	\$ 557,488
其他	<u>102,365</u>	<u>142,869</u>
	<u>461,417</u>	<u>700,357</u>
非流動		
未使用投資抵減	1,377,513	974,383
應計退休金負債	109,374	117,236
折舊財稅差	(421,909)	(432,706)
其他	<u>66,817</u>	<u>35,756</u>
	<u>1,131,795</u>	<u>694,669</u>
減：備抵評價	290,655	-
	<u>841,140</u>	<u>694,669</u>
遞延所得稅資產合計	<u>\$ 1,302,557</u>	<u>\$ 1,395,026</u>

(三)本公司增資擴展經營積體電路封裝之投資計畫，經核准部分產品就其新增所得分別自九十三年十月及九十八年一月起連續五年免徵營利事業所得稅。另本公司因合併承受日月欣半導體公司增資擴展之五年免稅租稅優惠，均將至一〇〇年十二月屆滿。

(四)截至九九年十二月三十一日止，本公司依據促進產業升級條例得適用之所得稅抵減相關資訊如下：

抵減項目	可抵減總額	尚未抵減餘額及最後抵減年度					合計
		一〇〇年	一〇一年	一〇二年	一〇三年		
機器設備	\$ 1,275,018	\$ 198,345	\$ 190,842	\$ 334,292	\$ 551,539	\$ 1,275,018	
研究發展	461,547	160,707	148,831	152,009	-	461,547	
	<u>\$ 1,736,565</u>	<u>\$ 359,052</u>	<u>\$ 339,673</u>	<u>\$ 486,301</u>	<u>\$ 551,539</u>	<u>\$ 1,736,565</u>	

(五)本公司之所得稅結算申報案件，業經稅捐稽徵機關核定至九十五年度止，惟本公司對九十一至九十五年度核定之內容不服，已依法提起行政救濟或程序。上述相關所得稅影響數已分別估列於核定年度所得稅費用項下。

(六)兩稅合一相關資訊如下：

九九年及九八年十二月三十一日本公司之未分配盈餘均屬八十七年度以後產生，股東可扣抵稅額帳戶餘額九九年及九八年十二月三十一日分別為430,107千元及517,526千元。九九及九八年度盈餘分配適用之稅額扣抵比率分別為5.09% (預計) 及12.47% (實際)。

依所得稅法規定，本公司分配屬於八十七年度(含)以後之盈餘時，本國股東可按股利分配日之稅額扣抵比率計算可獲配之股東可扣抵稅額，外國股東僅能就未分配盈餘加徵10% 稅額部分獲配股東可扣抵稅額以抵減股利扣繳稅款。由於實際分配予股東之可扣抵稅額，應以股利分配日之股東可扣抵稅額帳戶餘額為準，因此本公司預計九九年度盈餘分配之稅額扣抵比率可能與將來實際分配予股東時所適用之稅額扣抵比率有所差異。

十八、用人費用、折舊及攤銷

	九十九年度			九十八年度			
	營業成本	營業費用	合計	營業成本	營業費用	合計	
用人費用							
薪資	\$ 7,848,215	\$ 3,078,217	\$ 10,926,432	\$ 5,212,805	\$ 1,876,429	\$ 7,089,234	
退休金	344,639	139,494	484,133	291,896	118,986	410,882	
伙食費	378,280	77,692	455,972	296,294	64,637	360,931	
福利金	127,054	42,613	169,667	71,624	24,712	96,336	
員工保險費	501,543	149,501	651,044	378,226	119,468	497,694	
其他用人費用	103,371	188,179	291,550	27,170	9,924	37,094	
	<u>\$ 9,303,102</u>	<u>\$ 3,675,696</u>	<u>\$ 12,978,798</u>	<u>\$ 6,278,015</u>	<u>\$ 2,214,156</u>	<u>\$ 8,492,171</u>	
折舊	\$ 5,621,643	\$ 527,575	\$ 6,149,218	\$ 5,087,620	\$ 524,044	\$ 5,611,664	
攤銷	177,892	167,107	344,999	119,689	229,928	349,617	

十九、每股盈餘

	九十九年度		九十八年度	
	稅前	稅後	稅前	稅後
基本每股盈餘(元)	\$ 3.22	\$ 3.10	\$ 1.35	\$ 1.19
稀釋每股盈餘(元)	3.16	3.04	1.33	1.17

計算每股盈餘之分子及分母揭露如下：

	金額(分子)		股數(分母)(千股)	每股盈餘(元)	
	稅前	稅後		稅前	稅後
九十九年度					
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利	\$ 19,032,589	\$ 18,337,500	5,906,666	\$ 3.22	\$ 3.10
具稀釋作用之潛在普通股之影響					
員工紅利	–	–	36,589		
本公司發行之員工認股權憑證	–	–	38,519		
子公司發行之員工認股權憑證及員工紅利	(144,397)	(144,397)	–		
稀釋每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	\$ 18,888,192	\$ 18,193,103	\$ 5,981,774	3.16	3.04
 九十八年度					
基本每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利	\$ 7,667,691	\$ 6,744,546	5,678,720	\$ 1.35	\$ 1.19
具稀釋作用之潛在普通股之影響					
員工紅利	–	–	29,019		
本公司發行之員工認股權憑證	–	–	20,137		
子公司發行之員工認股權憑證及員工紅利	(26,472)	(26,472)	–		
稀釋每股盈餘					
屬於普通股股東之本期淨利加潛在普通股之影響	\$ 7,641,219	\$ 6,718,074	\$ 5,727,876	1.33	1.17

本公司自九十七年一月一日起，採用(九六)基秘字第〇五二號函，將員工分紅及董監酬勞視為費用而非盈餘之分配，若企業得選擇以股票或現金發放員工分紅，則計算稀釋每股盈餘時，應假設員工紅利將採發放股票方式，並於該潛在普通股具有稀釋作用時計入加權平均流通在外股數，以計算稀釋每股盈餘。計算稀釋每股盈餘時，以該潛在普通股資產負債表日之收盤價，並考量除權除息之影響後，作為發行股數之判斷基礎。於次年度股東會決議員工紅利發放股數前計算稀釋每股盈餘時，亦繼續考量該等潛在普通股之稀釋作用。

計算每股盈餘時，無償配股之影響已列入追溯調整。因追溯調整，九十八年度稅後基本每股盈餘及稀釋每股盈餘，分別由1.31元及1.29元減少為1.19元及1.17元。

二十、金融商品資訊之揭露

(一)公平價值之資訊

	九九年十二月三十一日				九十八年十二月三十一日											
	帳面價值		公平價值		帳面價值		公平價值									
非衍生性金融商品																
資產																
備供出售金融資產－非流動	\$ 102,790	\$ 102,790	\$ -	\$ -												
以成本衡量之金融資產－非流動	364,551				467,468											
存出保證金	12,950		12,950		12,193		12,193									
受限制資產	149,447		149,447		84,447		84,447									
負債																
長期借款	47,214,226		47,214,226		42,165,604		42,165,604									
應付租賃款(含一年內到期)	1,742		1,742		10,797		10,797									
衍生性金融商品																
資產																
換匯合約	\$ 42,398	\$ 42,398	\$ 1,024	\$ 1,024												
遠期外匯合約	30,188		30,188		14,723		14,723									
負債																
換匯換利合約	507,546		507,546		122,495		122,495									
換匯合約	394,747		394,747		50,468		50,468									
利率交換合約	189,541		189,541		311,778		311,778									
遠期外匯合約	13,708		13,708		10,727		10,727									

(二)本公司估計金融商品公平價值所使用之方法及假設如下：

- 上述金融商品不包含現金、應收帳款(含關係人)、其他應收款(含關係人)、應付帳款(含關係人)、應付費用、其他應付款(含關係人)及應付設備款。此類短期金融商品之到期日甚近，其帳面價值應屬估計公平價值之合理基礎。
- 衍生性金融商品及備供出售金融資產－非流動因無市場價格可供參考，是以採用評價方法估計。本公司採用評價方法所使用之估計及假設，與市場參與者於金融商品訂價時用以作為估計及假設之資訊相近。
- 以成本衡量之金融資產因無活絡市場公開報價且實務上須以超過合理成本之金額方能取得可驗證公平價值，因此不列示公平價值。
- 存出保證金及受限制資產係以現金方式存出，以其帳面價值為公平價值。
- 長期借款主係屬浮動利率，其帳面價值即為公平價值。

(三)本公司於九十九及九十八年度因以評價方法估計金融商品公平價值之變動而分別認列損失417,803千元及利益235,633千元。

(四)本公司九九年及九十八年十二月三十一日具利率變動之公平價值風險之金融資產均為0千元，金融負債分別為238千元及101,749千元；具利率變動之現金流量風險之金融資產分別為1,690,081千元及4,157,107千元，金融負債分別為55,284,846千元及46,946,804千元。

(五)本公司九十九及九十八年度非以公平價值衡量且公平價值變動列入損益之金融資產或金融負債，其利息收入分別為10,559千元及19,363千元，利息費用(含利息資本化金額)分別為1,103,879千元及1,093,107千元。

(六)財務風險策略

本公司從事衍生性金融商品交易之經營避險策略，主要係以確保公司穩健、安全經營為原則。從事衍生性金融商品交易時，應依其交易目的區分為「避險性」及「非避險性」兩種交易，除依規定分別適用不同部位限制外，以避險為目的之交易其商品的選擇應以規避本公司業務經營所產生之收入、支出、資產或負債等風險為主，持有之幣別必須與公司實際進出口交易之外幣需求相符。

(七) 財務風險資訊

1. 市場風險

從事衍生性金融商品交易即在規避外幣資產或負債因匯率或利率波動所產生之風險，因此匯率變動產生之損益大致會與被避險項目之損益相抵銷；而利率風險亦因預期之資金成本已固定，故市場風險並不重大。

2. 信用風險

金融資產受到本公司之交易對方或他方未履行合約義務之潛在影響。本公司信用風險金額係以資產負債表日公平價值為正數之合約為評估對象，其九九年及九八年十二月三十一日之最大曝險金額與其帳面價值相同。

另截至九九年及九八年十二月三十一日止，本公司為子公司背書保證之最大信用曝險金額分別為0千元及762,314千元。

3. 流動性風險

本公司有足夠之營運資金及借款額度，未有因無法籌措資金以履行合約義務之流動性風險。本公司持有之備供出售金融資產—非流動及以成本衡量之金融資產因無活絡市場，預期具有流動性風險。

4. 利率變動之現金流量風險

本公司之借款，主係屬浮動利率之債務，市場利率變動將使借款之有效利率隨之變動，而使其未來現金流量產生波動，當利率提高1%，在匯率不變之情況下，本公司現金流出每年將增加約455,000千元。

(八) 公平價值避險及現金流量避險

本公司從事利率交換合約及換匯換利合約係為規避長期借款可能因市場利率及匯率變動而使未來現金流量及公平價值產生波動之風險。

1. 於九九年及九八年十二月三十一日尚未到期之利率交換合約之公平價值分別為損失189,541千元及311,778千元，合約相關資訊如下：

到期日	名目本金(千元)	支付利率(%)	收取利率(%)	現金流量預期產生期間	相關損益預期於 損益表認列期間
九九年十二月三十一日					
102.03.01	NTD8,700,000	2.45~2.48	0.625	97年至102年	97年至102年
102.03.01	NTD3,987,500	0.96~0.99	0.625	98年至102年	98年至102年
100.05.27	USD200,000	1.48~1.55	0.261	98年至100年	98年至100年
九八年十二月三十一日					
102.03.01	NTD11,220,000	2.45~2.48	0.497	97年至102年	97年至102年
102.03.01	NTD5,142,500	0.96~0.99	0.497	98年至102年	98年至102年
100.05.27	USD200,000	1.48~1.55	0.234	98年至100年	98年至100年

2. 於九九年及九八年十二月三十一日尚未到期之換匯換利合約之公平價值分別為損失427,232千元及122,495千元，合約相關資訊如下：

到期期間	名目本金(千元)	新台幣(收)付利率(%)	美金收取利率(%)	現金流量預期產生期間	相關損益預期於 損益表認列期間
九九年十二月三十一日					
100.03.10~100.09.07	NTD4,338,920 /USD136,000	(0.55)~(0.22)	0.262~0.265	99年至100年	99年至100年
九八年十二月三十一日					
99.03.15~99.09.28	NTD4,290,950 /USD130,000	(0.21)~0.90	0.231~0.908	98年至99年	98年至99年

九十九及九十八年度現金流量避險未實現損失變動請參閱附註十五。

二十一、關係人交易

(一) 關係人之名稱及關係，除宏璟新投資公司(採權益法之被投資公司之子公司)外，詳附註九及附表八所述。

(二) 與關係人間之重大交易事項

除前述附註已揭露外，本公司與關係人間之重大交易如下：

當年度

	九十九年度		九十八年度	
	金額	佔進貨淨額%	金額	佔進貨淨額%
1. 購置材料款				
日月光電子	\$ 1,793,220	6	\$ 1,858	-
日月光上海	1,621,187	6	191,744	1
日月光香港	1,261,849	5	3,353,778	18
其他	84,362	-	64,206	-
	\$ 4,760,618	17	\$ 3,611,586	19
2. 購置固定資產				
ASE Korea	\$ 94,847	1	\$ -	-
台灣福雷	23,008	-	68,510	1
日月鴻	10,949	-	325,684	5
日月光上海封測	2,086	-	69,362	1
其他	-	-	79,919	1
	\$ 130,890	1	\$ 543,475	8
3. 出售固定資產				
日月光上海封測	\$ 45,085	19	\$ 51,750	37
日月鴻	26,813	12	-	-
ASE Korea	26,020	11	3,961	3
台灣福雷	25,257	11	2,768	2
ASE Singapore Pte. Ltd.	-	-	38,131	27
其他	17,810	8	10,307	7
	\$ 140,985	61	\$ 106,917	76

本公司向關係人進貨之交易條件與一般廠商相當，付款條件為月結三十至六十天不等。關係人交易產生之未實現銷貨毛利業已銷除。

本公司與關係人間之固定資產交易，交易價格係以帳面價值為主，並按買方當地政府核定金額調整之，付款期限為驗收後一至二個月，與一般交易條件相當。

4. 服務費支出

本公司委託ASE (U.S.) Inc.及ASE MS Japan等提供市場行銷支援及客戶服務，按各該公司所發生費用之約定比率計算並訂有費用上限，九十九及九十八年度之服務費支出分別為631,210千元及710,788千元。

5. 資金融通

本公司與關係人之資金融通情形如下：

<u>九十九年度</u>	最高餘額		年底餘額		利率區間(%)	利息費用
其他應付款－關係人						
ASE Test	\$ 4,067,028 (美金 126,000千元)	\$ 990,760 (美金 34,000千元)			0.64～1.06	\$ 10,573
台灣福雷	3,600,000	3,575,000			0.60～0.74	22,161
日月光電子	450,000	420,000			0.67～0.74	1,533
日月瑞	200,000	200,000			0.61～0.74	725
J&R Holding	2,010,660 (美金 69,000千元)	2,010,660 (美金 69,000千元)			0.66	522
ASE Korea	874,200 (美金 30,000千元)	874,200 (美金 30,000千元)			3.30	739

九十八年度

其他應付款－關係人

台灣福雷	3,600,000	3,600,000	0.59~0.60	3,792
ASE Test	1,287,400	1,281,200	0.64~0.65	1,199
(美金 40,000千元)	(美金 40,000千元)			

年底餘額

	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
	金額	佔各該科目%	金額	佔各該科目%
應收帳款				
日月鴻	\$ 51,865	1	\$ 2,453	-
環電	23,339	-	8,807	-
台灣福雷	10,574	-	9,084	-
ISE Labs, Inc.	7,757	-	22,151	1
其他	5,999	-	9,537	-
	<u>\$ 99,534</u>	<u>1</u>	<u>\$ 52,032</u>	<u>1</u>
其他應收款				
日月鴻	\$ 927,574	52	\$ 16,476	2
日月光上海封測	60,499	3	25,438	2
日月光電子	48,233	3	52,090	5
ASE Singapore Pte. Ltd.	-	-	38,222	4
其他	44,089	2	31,628	3
	<u>\$ 1,080,395</u>	<u>60</u>	<u>\$ 163,854</u>	<u>16</u>
應付帳款				
日月光電子	\$ 623,299	9	\$ -	-
日月光上海	466,512	6	40,582	1
日月光香港	370	-	1,017,121	16
其他	493	-	3,412	-
	<u>\$ 1,090,674</u>	<u>15</u>	<u>\$ 1,061,115</u>	<u>17</u>
其他應付款				
台灣福雷	\$ 4,757,624	48	\$ 4,445,666	73
J&R Holding	2,010,660	21	-	-
ASE Test	990,760	10	1,281,200	21
其他	1,589,531	17	148,797	3
	<u>\$ 9,348,575</u>	<u>96</u>	<u>\$ 5,875,663</u>	<u>97</u>

其他應收款主係應收減資款、租賃款及代墊款；其他應付款主係應付融資款及代收應付測試費等。

背書保證

截至九十八年十二月三十一日止，本公司為子公司日月光上海背書保證之餘額為762,314千元。

(三)董事、監察人及管理階層薪酬資訊

	九十九年度		九十八年度	
	薪資、獎金及特支費	\$ 528,403	薪資、獎金及特支費	\$ 242,273
紅利		86,760		37,413
		<u>\$ 615,163</u>		<u>\$ 279,686</u>

二十二、質抵押之資產

本公司下列資產業經提供作為長期借款之擔保品、進口原物料之關稅擔保及雇用外籍勞工之保證金：

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
受限制資產－質押定存	\$ 149,447	\$ 84,447
機器設備－淨額	-	93,348
	<u>\$ 149,447</u>	<u>\$ 177,795</u>

二十三、重大承諾事項及或有事項

- (一) 九十九年十二月三十一日尚未到期之衍生性金融商品合約及銀行團聯合融資合約之規定，詳前述附註說明。
- (二) 本公司廠房用地係向政府租用，其租期將陸續於一〇九年六月底屆滿。租期屆滿時本公司得予續約，但政府得於該土地公告現值調高時調整租金，並得在若干條件下終止租約。九十九及九十八年度租金(包括公共設施建設費)分別約13,000千元及12,000千元。
- (三) 截至九十九年十二月三十一日止，本公司已開立未使用之信用狀金額約92,000千元。
- (四) 截至九十九年十二月三十一日止，本公司已承諾購置之機器設備金額約1,837,000千元，其中已支付金額為71,443千元。
- (五) 截至九十九年十二月三十一日止，本公司已承諾購置之廠房工程金額約856,000千元，其中已支付金額為238,989千元。
- (六) 本公司依合約應按部分產品銷售數量或依議定之固定金額支付權利金予若干外國公司，該等合約將陸續於一〇二年前到期，九十九及九十八年度權利金支出分別為321,414千元及182,715千元。
- (七) 九十五年二月美商Tessera Inc.於美國加州地方法院對本公司及子公司ASE(U.S.)Inc.提起專利侵權訴訟(加州訴訟案)，惟目前美國加州地方法院已取消本公司訴訟案相關審訊安排並延緩所有訴訟程序。另美國專利商標局亦著手對美商Tessera Inc.於加州訴訟案所堅稱其擁有之專利進行再審查。截至會計師查核報告日止，本公司及子公司尚無法估計美國專利商標局再審查之結果，及其對上述專利侵權訴訟案可能之影響。

二十四、其他

本公司具重大影響之外幣金融資產及負債資訊如下：

單位：外幣千元

	九十九年十二月三十一日	九十八年十二月三十一日
貨幣性金融資產		
美金	\$ 876,450	\$ 658,985
日幣	1,791,983	2,257,949
非貨幣性金融資產		
美金	9,910	9,700
採權益法之長期股權投資		
美金	2,218,870	2,034,419
日幣	86,421	83,383
貨幣性金融負債		
美金	918,883	688,369
日幣	1,624,051	1,859,368
外幣換算匯率		
美金	USD1=NTD29.1400	USD1=NTD32.0300
日幣	JPY1=NTD0.3584	JPY1=NTD0.3473

二十五、附註揭露事項

九十九年度應揭露事項如下：

(一)重大交易事項及(二)轉投資事業相關資訊

1. 資金貸與他人：詳附表一。
2. 為他人背書保證：詳附表二。
3. 期末持有有價證券情形：詳附表三。
4. 累積買進或賣出同一有價證券之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：詳附表四。
5. 取得不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：詳附表五。
6. 處分不動產之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：無。
7. 與關係人進、銷貨之金額達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：詳附表六。
8. 應收關係人款項達新台幣一億元或實收資本額百分之二十以上：詳附表七。
9. 具重大影響力或控制力之被投資公司相關資訊：詳附表八。
10. 從事衍生性商品交易：詳附註五、二十及附表九。

(三)大陸投資資訊

1. 大陸被投資公司名稱、主要營業項目、實收資本額、投資方式、資金匯出入情形、持股比例、投資損益、年底投資帳面價值、已匯回投資損益及赴大陸地區投資限額：詳附表十。
2. 與大陸被投資公司直接或間接經由第三地區所發生下列之重大交易事項，暨其價格、付款條件、未實現損益：
 - (1) 進貨金額及百分比與相關應付款項之年底餘額及百分比：詳附註二一及附表六。
 - (2) 銷貨金額及百分比與相關應收款項之年底餘額及百分比：無。
 - (3) 財產交易金額及其所產生之損益數額：詳附註二一。
 - (4) 票據背書保證或提供擔保品之年底餘額及其目的：無。
 - (5) 資金融通之最高餘額、年底餘額、利率區間及當年度利息總額：無。
 - (6) 其他對當年度損益或財務狀況有重大影響之交易事項，如勞務之提供或收受等：無。

二十六、部門別財務資訊

本公司係屬各型積體電路之封裝及測試產業，惟測試部門未達揭露標準，是以不予單獨揭露，另營運部門皆屬國內營運部門，且未有單一客戶銷售比例達10%，依照財務會計準則公報第二十號規定，僅揭露外銷資訊如下：

單位：外幣千元

地區	九十九年度		九十八年度	
	外銷收入金額	佔銷貨淨額%	外銷收入金額	佔銷貨淨額%
美洲	\$ 32,384,983	48	\$ 21,497,074	47
歐洲	9,752,815	14	6,597,370	14
亞洲及其他	6,535,794	10	4,301,112	9
	\$ 48,673,592	72	\$ 32,395,556	70

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

資金貸與他人

民國九十九年度

附表一

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象資金貸與 限額(註一)	本年度最高額度餘額	年底額度餘額
0	本公司	力晶科技公司	其他應收款	\$ 17,711,274	\$ 450,000	\$ -
1	日月光半導體(上海) 公司	上海鼎匯房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,505,735	1,090,205 (人民幣 231,000千元)	-
		上海鼎威房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,505,735	1,283,337 (人民幣 270,000千元)	1,012,000 (人民幣 230,000千元)
		上海鼎裕房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,505,735	540,645 (人民幣 117,000千元)	514,800 (人民幣 117,000千元)
2	A.S.E. Holding Limited	ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	長期應收款－關係人	(註三)	64,556 (美金 2,000千元)	58,280 (美金 2,000千元)
		J&R Holding Limited	其他應收款－關係人	(註三)	1,613,900 (美金 50,000千元)	1,457,000 (美金 50,000千元)
3	J&R Holding Limited	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	長期應收款－關係人 及其他應收款－關 係人	(註三)	497,081 (美金 15,400千元)	448,756 (美金 15,400千元)
		日月光半導體(威海) 有限公司	其他應收款－關係人	(註三)	645,560 (美金 20,000千元)	582,800 (美金 20,000千元)
		Omniquest Industrial Limited	其他應收款－關係人	(註三)	64,556 (美金 2,000千元)	58,280 (美金 2,000千元)
		日月光半導體(昆山) 有限公司	其他應收款－關係人	(註三)	968,340 (美金 30,000千元)	874,200 (美金 30,000千元)
		本公司	其他應收款－關係人	7,928,796	2,468,000 (美金 80,000千元)	2,331,200 (美金 80,000千元)
4	日月光封裝測試(上海) 有限公司	上海威宇宏欣半導體 有限公司	其他應收款－關係人	(註三)	166,359 (人民幣 35,000千元)	127,600 (人民幣 29,000千元)
		上海鼎匯房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,846,846	1,030,876 (人民幣 220,000千元)	-
		上海鼎威房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,846,846	1,606,225 (人民幣 347,600千元)	-
		上海鼎裕房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,846,846	462,090 (人民幣 100,000千元)	440,000 (人民幣 100,000千元)
5	ASE Test Limited	J&R Holding Limited	其他應收款－關係人	(註三)	3,227,800 (美金 100,000千元)	2,914,000 (美金 100,000千元)
		ASE Singapore Pte. Ltd.	其他應收款－關係人	(註三)	2,308,896 (美金 72,000千元)	2,098,080 (美金 72,000千元)
		本公司	其他應收款－關係人	4,226,786	4,067,028 (美金 126,000千元)	990,760 (美金 34,000千元)

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

年底實際動支餘額	利率區間(%)	資金貸與原因	提列備抵 呆帳金額	擔保品		業務往來金額	資金貸與最高 限額(註二)
				名稱	價值		
\$ -	2.50~2.51	策略性目的	\$ -	-	\$ -	\$ -	\$ 35,422,548
-	4.78	營業週轉	-	-	-	-	3,011,470
1,012,000 (人民幣 230,000千元)	4.78~5.00	營業週轉	-	-	-	-	3,011,470
514,800 (人民幣 117,000千元)	5.00	營業週轉	-	-	-	-	3,011,470
58,280 (美金 2,000千元)	0.73~0.85	償還借款	-	-	-	-	(註三)
1,457,000 (美金 50,000千元)	0.66~1.14	償還借款	-	-	-	-	(註三)
448,756 (美金 15,400千元)	0.73~0.87	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
582,800 (美金 20,000千元)	0.64~0.77	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
58,280 (美金 2,000千元)	0.75~0.85	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
874,200 (美金 30,000千元)	0.69~0.94	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
2,010,660 (美金 69,000千元)	0.66	營業週轉	-	-	-	-	15,857,591
127,600 (人民幣 29,000千元)	4.37~4.86	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
-	5.31	營業週轉	-	-	-	-	3,693,693
-	4.78~5.00	營業週轉	-	-	-	-	3,693,693
440,000 (人民幣 100,000千元)	5.00	營業週轉	-	-	-	-	3,693,693
2,914,000 (美金 100,000千元)	0.64~1.14	償還借款	-	-	-	-	(註三)
2,098,080 (美金 72,000千元)	0.64~1.10	營業週轉	-	-	-	-	(註三)
990,760 (美金 34,000千元)	0.64~1.06	營業週轉	-	-	-	-	8,453,572

編號	資金貸與他人者 公司名稱	貸與對象	往來科目	對個別對象資金貸與 限額(註一)	本年度最高額度餘額	年底額度餘額
6	台灣福雷電子公司	本公司	其他應收款－關係人	\$ 4,181,037	\$ 3,600,000	\$ 3,575,000
		J&R Holding Limited	其他應收款－關係人	4,181,037 (美金 39,000千元)	1,203,150 (美金 39,000千元)	1,136,460 (美金 39,000千元)
		ASE Test Limited	其他應收款－關係人	4,181,037 (美金 86,000千元)	2,775,908 (美金 46,000千元)	1,340,440 (美金 46,000千元)
		日月光電子公司	其他應收款－關係人	4,181,037	200,000	–
7	上海鼎匯房地產開發 有限公司	上海鼎威房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,400,617 (人民幣 122,600千元)	582,730	–
		上海鼎裕房地產開發 有限公司	其他應收款－關係人	1,400,617 (人民幣 210,000千元)	998,151	–
8	日月光電子元器件 (上海)有限公司	日月光封裝測試 (上海)有限公司	其他應收款－關係人	(註三) (人民幣 90,000千元)	427,779	396,000 (人民幣 90,000千元)
9	日月光電子公司	本公司	其他應收款－關係人	542,916	450,000	420,000
10	日月瑞公司	本公司	其他應收款－關係人	200,336	200,000	200,000
11	ISE Labs, Inc.	J&R Holding Limited	其他應收款－關係人	(註三) (美金 30,000千元)	968,340	874,200 (美金 30,000千元)
12	ASE (Korea) Inc.	日月光半導體（威海） 有限公司	其他應收款－關係人	(註三) (美金 45,000千元)	1,311,300	1,311,300 (美金 45,000千元)
		本公司	其他應收款－關係人	2,343,338 (美金 30,000千元)	874,200	874,200 (美金 30,000千元)
13	日月光高新科技 (上海)有限公司	日月光封裝測試 (上海)有限公司	其他應收款－關係人	(註三) (美金 14,000千元 及人民幣 15,600千元)	525,731	476,600 (美金 14,000千元 及人民幣 15,600千元)
14	日月光電子元器件 (昆山)有限公司	日月光半導體（威海） 有限公司	其他應收款－關係人	(註三) (美金 4,000千元)	116,560	116,560 (美金 4,000千元)
15	ASE Japan Co., Ltd.	J&R Holding Limited	其他應收款－關係人	(註三)	1,615,680 (日幣 4,400,000千元)	1,576,960 (日幣 4,400,000千元)

註一：對個別對象資金貸與限額為不超過該公司淨值之百分之二十。

註二：因公司間或與行號間有短期融通資金之必要而將資金貸與他人之總額度，以不超過該公司淨值百分之四十為限。

註三：本公司直接及間接持有表決權股份百分之百之國外公司間，從事資金貸與，其貸與金額不受單一限額及總額度之限制。

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

為他人背書保證

民國九十九年度

附表二

編號	背書保證者公司名稱	被背書保證對象		對單一企業背書 保證限額(註一)
		公司名稱	關係	
0	本公司	日月光半導體（上海）公司	間接持有表決權股份100%之子公司	\$ 26,566,911

註一：依本公司「背書保證作業程序」，對單一企業之背書保證額度以不超過股東權益總額之百分之三十為限。

註二：依本公司「背書保證作業程序」，背書保證責任總額以不超過股東權益總額之百分之四十為限。

年底實際動支餘額	利率區間(%)	資金貸與原因	提列備抵呆帳金額	擔保品		業務往來金額	資金貸與最高限額(註二)
				名稱	價值		
\$ 3,575,000	0.60~0.74	營業週轉	\$ -	- \$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,362,074
(美金 942,478 32,343千元)	0.64~0.77	營業週轉	-	- -	-	-	8,362,074
(美金 1,340,440 46,000千元)	0.75~1.06	營業週轉	-	- -	-	-	8,362,074
-	0.67	營業週轉	-	- -	-	-	8,362,074
-	5.31	營業週轉	-	- -	-	-	2,801,235
-	5.31	營業週轉	-	- -	-	-	2,801,235
(人民幣 396,000 90,000千元)	4.78	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)
420,000	0.67~0.74	營業週轉	-	- -	-	-	1,085,832
200,000	0.61~0.74	營業週轉	-	- -	-	-	400,672
(美金 874,200 30,000千元)	0.69~0.94	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)
(美金 1,311,300 45,000千元)	3.29~3.53	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)
(美金 874,200 30,000千元)	3.30	營業週轉	-	- -	-	-	4,686,676
(美金及人民幣 476,600 14,000千元 15,600千元)	1.72~4.78	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)
(美金 116,560 4,000千元)	1.29	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)
(日幣 1,498,580 4,100,000千元 及美金 1,000千元)	0.58~0.66	營業週轉	-	- -	-	-	(註三)

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

本年度最高背書保證餘額	年底背書保證餘額	以財產擔保之 背書保證金額	累計背書保證金額 佔最近期財務報表 淨值之比率(%)	背書保證最高限額 (註二)
\$ 763,623 (美金23,800千元)	\$ -	\$ -	-	\$ 35,422,548

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

期末持有有價證券情形明細表

民國九十九年十二月三十一日

附表三

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
本公司	股票 A.S.E. Holding Limited J&R Holding Limited ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd. Omniquest Industrial Limited Innosource Limited 宏錦光公司 宏璟建設公司 環隆電氣公司 日月鴻科技公司 台灣福雷電子公司 晶鍊科技公司 減：以土地作價投資宏錦光之未實現利益 轉列庫藏股票 累計減損 特別股A(可轉換特別股) ID Solutions, Inc.	被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 -	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產-非流動
	股票 漢驛創業投資公司 元隆電子公司	- -	以成本衡量之金融資產-非流動 備供出售金融資產-非流動
	有限合夥 Ripley Cable Holdings I, L.P.	-	以成本衡量之金融資產-非流動
台灣福雷電子公司	股票 日月光半導體製造公司 Alto Enterprises Limited Super Zone Holdings Limited	母公司 被投資公司 被投資公司	備供出售金融資產-非流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
	債券 USD Average Libor Rate Note	-	公平價值變動列入損益之金融資產-流動
日月瑞公司	基金 日盛債券基金 華南永昌麒麟債券基金 華南永昌鳳翔債券基金 群益安穩基金 摩根富林明JF第一債券基金 元大萬泰基金	- - - - - -	公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動
A.S.E. Holding Limited	股票 Oplink Communications, Inc. ASEP Realty Corporation ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated ASE Test Limited 環隆電氣公司 ASE Investment (Labuan) Inc. Global Strategic Investment Inc. InveStar Burgeon Venture Capital, Inc. ID Solutions, Inc. 特別股B(可轉換特別股) ID Solutions, Inc.	被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 -	備供出售金融資產-流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動

單位：新台幣千元(除另予註明者)

股數／單位	帳面金額	持股比例(%)	年底		備註
			市價／股權淨額		
243,966	\$ 12,614,154	100	\$ 12,779,348		
435,128	39,254,567	100	39,643,977		
1,200	30,973	100	30,973		
250,504,067	8,853,484	71	9,072,180		
86,000,000	3,142,761	100	3,162,370		
39,047,000	332,224	27	332,224		
68,629,782	1,106,338	26	1,314,260		
791,039,874	15,041,086	74	11,809,599		
135,688,085	2,270,597	56	2,270,597		
361,409,622	20,709,444	100	20,905,185		
6,000,000	<u>61,824</u>	33	<u>20,085</u>		
	103,417,452		\$ 101,340,798		
	(300,149)				
	(1,959,107)				
	(41,739)				
	<u>\$ 101,116,457</u>				
1,666,667	1,166	—	866		
5,913,660	59,137	15	65,687		
9,997,370	102,790	6	102,790		
—	304,248	4	1,008,681		
8,638,913(註)	291,563	—	291,563		
24,000,000	613,821	100	613,821		
100,000,000	2,914,964	100	2,914,964		
—	288,486	—	288,486		
6,781,801	96,087	—	96,087		
2,618,768	30,135	—	30,135		
2,834,498	44,290	—	44,290		
12,979,512	200,706	—	200,706		
3,317,701	48,351	—	48,351		
11,753,261	170,599	—	170,599		
50,210	美金 927千元	—	美金 927千元		
20,000	美金 39千元	100	美金 39千元		
2,423,733	美金 862千元	100	美金 862千元		
11,148,000	美金 82,469千元	10	美金 73,903千元		
15,964,200	美金 8,676千元	2	美金 8,198千元		
126,642,842	美金 284,249千元	70	美金 284,249千元		
2,000,000	美金 2,000千元	3	美金 1,580千元		
455	美金 0.2千元	13	美金 2千元		
840,000	—	—	美金 15千元		
11,406,844	美金 199千元	3	美金 203千元		

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	特別股C(可轉換特別股) ID Solutions, Inc.	-	以成本衡量之金融資產-非流動
	特別股D(可轉換特別股) ID Solutions, Inc.	-	以成本衡量之金融資產-非流動
	可轉換公司債 SiPhoton, Inc.	-	無活絡市場之債券投資-非流動
J&R Holding Limited	股票 日月光半導體製造公司 ASE Test Limited Omniquest Industrial Limited 環隆電氣公司 日月瑞公司 ASE Japan Co., Ltd. ASE (U.S.) Inc. Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	母公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司	備供出售金融資產-非流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
	股權憑證 蘇州日月新半導體有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	有限合夥 Crimson Velocity Fund, L.P. H&QAP Mega Investment Holdings Fund, L.P.	- -	以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動
Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	股票 ASE Assembly & Test (HK) Limited	被投資公司	採權益法之長期股權投資
	股權憑證 日月光封裝測試(上海)有限公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
日月光封裝測試(上海) 有限公司	股權憑證 上海威宇宏欣半導體有限公司 上海鼎匯房地產開發有限公司	被投資公司 被投資公司	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
	股票 日月光半導體(上海)公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	股票 ASE(Korea) Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Test Limited	股票 日月光半導體製造公司 環隆電氣公司 ASE Holdings(Singapore) Pte Ltd ASE Test Holdings, Ltd. ASE Test Finance Limited ASE Investment(Labuan) Inc. ASE Singapore Pte. Ltd. UC Fund II	最終母公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 -	備供出售金融資產-非流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 以成本衡量之金融資產-非流動
ASE Test Holdings, Ltd.	股票 ISE Labs, Inc.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	股票 ASE Electronics(M) Sdn. Bhd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資
ASE Singapore Pte. Ltd.	股票 ASE Singapore II Pte. Ltd.	被投資公司	採權益法之長期股權投資

年底					備註
股數／單位	帳面金額	持股比例(%)	市價／股權淨額		
4,200,000	美金 77千元		1 美金 75千元		
6,000,000	美金 300千元		2 美金 107千元		
-	美金 3,000千元		- 美金 3,000千元		
36,749,966	美金 42,564千元		1 美金 42,564千元		
98,276,087	美金 875,970千元		90 美金 651,351千元		
30,200,000	美金 37,511千元		9 美金 37,511千元		
87,448,562	美金 59,785千元		8 美金 44,818千元		
170,000,006	美金 34,375千元		100 美金 34,375千元		
7,200	美金 92,121千元		100 美金 91,400千元		
1,000	美金 7,587千元		100 美金 7,103千元		
190,000,000	美金 314,244千元		100 美金 301,361千元		
-	美金 32,543千元		60 美金 32,543千元		
-	美金 2,289千元		- 美金 2,761千元		
-	美金 1,800千元		8 美金 1,689千元		
1,000,000	美金 2千元		100 美金 2千元		
-	美金 316,892千元		100 美金 316,892千元		
-	人民幣 66,020千元		100 人民幣 67,832千元		
-	人民幣 1,108,393千元		70 人民幣 1,108,393千元		
6,283,605	美金 1,615千元		1 美金 1,615千元		
7,613,363	美金 406,039千元		100 美金 402,083千元		
69,402,638(註)	美金 80,382千元		1 美金 80,382千元		
162,404,554	美金 111,031千元		15 美金 83,186千元		
71,428,902	美金 98,317千元		100 美金 98,317千元		
5	美金 86,476千元		100 美金 86,476千元		
2	美金 46千元		100 美金 46千元		
54,304,040	美金 121,821千元		30 美金 121,821千元		
30,100,000	美金 63,755千元		100 美金 63,755千元		
1,000,000	美金 600千元		7 美金 530千元		
26,250,000	美金 86,473千元		100 美金 65,827千元		
159,715,000	美金 98,317千元		100 美金 98,317千元		
普通股192,000,000					
特別股40,000,000	美金 59,463千元		100 美金 47,888千元		

年底						備註
股數／單位	帳面金額	持股比例(%)	市價／股權淨額			
352,784,067	美金 440,795千元	100	美金	440,795千元		
217,800,000	美金 346,878千元	100	美金	346,878千元		
126,184,067	美金 93,746千元	100	美金	93,746千元		
992,809,610	美金 255,132千元	99	美金	255,132千元		
-	美金 16,919千元	100	美金	16,919千元		
-	美金 64,948千元	76	美金	64,948千元		
-	美金 6,138千元	100	美金	6,138千元		
398,981,900	美金 93,156千元	100	美金	93,156千元		
-	美金 16,554千元	100	美金	16,554千元		
74,000,000	美金 91,949千元	21	美金	91,949千元		
-	人民幣 311,347千元	20	人民幣	324,051千元		
-	美金 6,442千元	100	美金	6,962千元		
4,524,619	人民幣 8,548千元	1	人民幣	8,548千元		
6,283,605	美金 1,615千元	1	美金	1,615千元		
-	人民幣 1,066,947千元	100	人民幣	1,066,947千元		
-	人民幣 499,205千元	100	人民幣	499,205千元		
-	美金 25,913千元	100	美金	25,913千元		
-	美金 100,033千元	100	美金	100,033千元		
-	美金 21,065千元	24	美金	21,065千元		
4,360,072	50,213	-		50,213		
3,209,345	50,202	-		50,202		
3,376,029	50,168	-		50,168		
4,142,639	50,144	-		50,144		
2,054,879	30,096	-		30,096		
1,902,274	30,095	-		30,095		
1,876,677	30,086	-		30,086		
117,356	20,066	-		20,066		

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
	股票 正華通訊公司 全球創業投資公司 博智電子公司 精磁科技公司 HHI公司 展毅公司 達基公司	- - - - 被投資公司 被投資公司 被投資公司	備供出售金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
展毅公司	股票 環隆電氣公司 勤誠興業公司	母公司 -	以成本衡量之金融資產-非流動 備供出售金融資產-非流動
達基公司	股票 聯強國際公司	-	公平價值變動列入損益之金融資產-流動
HHI公司	股票 United Pacific Industrial Ltd. Cadence Design SYS Inc. 環隆墨西哥公司 環隆英國公司 UHI公司 環隆日本公司 UI公司 RTH公司 USI@Work 環茂控股公司 Techgains Corporation Techgains International Corporation Solid Gain Investments Limited	- - 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司	公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
UHI公司	股票 Wacom Co., Ltd. United Pacific Industrial Ltd. Wacom Co., Ltd. Sequans Communications SA Asia Global Venture Co., Ltd. 三朋友電有限公司	- - - - - -	公平價值變動列入損益之金融資產-流動 公平價值變動列入損益之金融資產-流動 備供出售金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動 以成本衡量之金融資產-非流動
RTH公司	股票 UEHC公司 股權憑證 環勝深圳公司 環旭昆山公司	被投資公司 被投資公司 被投資公司	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
環勝深圳公司	股票 環旭上海公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
UEHC公司	股票 環誠公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環誠公司	股票 環旭上海公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資
環旭上海公司	股票 環鴻公司 股權憑證 環鴻深圳公司	被投資公司 被投資公司	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資

年底					備註
股數／單位	帳面金額	持股比例(%)	市價／股權淨額		
321,819	\$ 1,609	1	\$ 1,609		
6,200,000	72,000	5	67,853		
527,563	9,769	2	10,370		
733,000	-	2	-		
250,856,840	15,761,463	100	15,803,011		
39,329,700	524,298	100	592,825		
5,000,000	64,839	100	64,839		
20,028,758	420,604	2	293,053		
1,370,967	67,452	1	67,452		
690,806	54,366	-	54,366		
5,548,800	美金 222千元	-	美金 222千元		
9,633	美金 80千元	-	美金 80千元		
601,082,435	美金 25,269千元	100	美金 25,269千元		
25,419,968	美金 5,486千元	100	美金 5,486千元		
3,000,000	美金 15,002千元	100	美金 15,002千元		
6,400	美金 877千元	100	美金 877千元		
101,100	美金 2,334千元	100	美金 2,334千元		
149,151,000	美金 483,099千元	100	美金 483,099千元		
250,000	美金 673千元	100	美金 673千元		
90,000,000	美金 1,599千元	100	美金 1,599千元		
2,000,000	美金 942千元	10	美金 605千元		
1,500,000	美金 605千元	4	美金 322千元		
2,000,000	美金 2,000千元	20	美金 1,702千元		
540	美金 857千元	-	美金 857千元		
5,613,600	美金 224千元	-	美金 224千元		
2,995	美金 4,756千元	1	美金 4,756千元		
741,108	美金 2,366千元	1	美金 292千元		
1,000,000	美金 1,000千元	10	美金 1,019千元		
11,934,000	美金 1,836千元	-	-		
160,950,000	美金 307,948千元	100	美金 307,948千元		
-	美金 96,835千元	100	美金 96,835千元		
-	美金 13,087千元	100	美金 13,087千元		
4,524,619	人民幣 5,856千元	1	人民幣 8,574千元		
160,900,000	美金 307,916千元	100	美金 307,916千元		
895,874,563	美金 256,330千元	99	美金 256,330千元		
77,922,000	人民幣 85,467千元	100	人民幣 85,467千元		
-	人民幣 27,554千元	50	人民幣 29,957千元		

持有之公司	有價證券種類及名稱	與有價證券發行人之關係	帳列科目
環鴻公司	股票 環旭香港公司 環鴻台灣公司 USI-CA公司 股權憑證 環鴻深圳公司	被投資公司 被投資公司 被投資公司 被投資公司	採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資 採權益法之長期股權投資
環茂控股公司	股票 環茂荷蘭公司	被投資公司	採權益法之長期股權投資

註：台灣福雷電子公司持有本公司股票，其中7,554,162股以非保留運用決定權信託專戶保管，另1,084,751股納入集保；ASE Test Limited持有本公司股票69,402,638股，則全數以非保留運用決定權信託專戶保管。

股數／單位	年底				備註
	帳面金額	持股比例(%)	市價／股權淨額		
7,800,000	美金 33千元	100	美金 33千元		
98,000,000	美金 33,714千元	100	美金 33,714千元		
250,000	美金 4,215千元	100	美金 4,215千元		
-	美金 4,523千元	50	美金 4,523千元		
38,006	美金 1,434千元	100	美金 1,434千元		

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

重大累積買進或賣出同一有價證券明細表

民國九十九年度

附表四

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額(註一)
本公司	股票					
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	-	-	176,980,013	\$ 3,039,493
	Innosource Limited	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	60,000,000	2,144,554
	基金					
	復華債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	日盛債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	寶來得寶基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
台灣福雷電子公司	基金					
	台壽保所羅門債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	富邦吉祥債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	13,328,890	200,003
	新光吉星債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	日盛債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	42,503,755	600,021
	第一金全家福債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	3,520,610	600,042
	華南永昌鳳翔債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	19,902,542	310,002
	華南永昌麒麟債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	25,283,127	290,003
	復華債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	43,450,559	600,282
	元大萬泰基金	備供出售金融資產-流動	-	-	25,571,559	370,010
	台新真吉利基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	保德信債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	26,432,126	400,069
	第一金台灣債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	27,396,134	400,003
	群益安穩基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	寶來得利基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	保誠威寶基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	債券					
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	140,000
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	160,000
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	-
	97國泰世華無擔保次順位公司債	備供出售金融資產-流動	-	-	-	99,404
	98國泰世華無擔保次順位公司債	備供出售金融資產-流動	-	-	-	99,326
	USD Average Libor Rate Note	公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	-	-
	股票					
	Super Zone Holdings Limited	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	-	-
	Alto Enterprises Limited	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	-	-
日月瑞公司	基金					
	日盛債券基金	公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	19,856,755	280,316
	群益安穩基金	公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	12,979,512	200,064
	摩根富林明JF第一債券基金	公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	17,201,164	250,069
	元大萬泰基金	公平價值變動列入損益之 金融資產-流動	-	-	11,753,261	170,065
日月光電子公司	債券					
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	-
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	30,000
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	-
	基金					
	台新真吉利基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	寶來得寶基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
614,059,861	\$ 12,895,257	-	\$ -	\$ -	\$ -	791,039,874	\$ 15,041,086
26,000,000	835,560	-	-	-	-	86,000,000	3,142,761
40,518,517	560,000	40,518,517	560,099	560,000	99	-	-
41,025,218	580,000	41,025,218	580,039	580,000	39	-	-
24,342,217	280,000	24,342,217	280,032	280,000	32	-	-
45,544,284	550,000	45,544,284	550,095	550,000	95	-	-
46,609,323	700,000	59,938,213	900,199	900,000	199	-	-
16,874,083	250,000	16,874,083	250,033	250,000	33	-	-
152,104,364	2,150,000	194,608,119	2,750,613	2,750,000	613	-	-
6,158,140	1,050,000	9,678,750	1,650,284	1,650,000	284	-	-
109,042,215	1,700,000	128,944,757	2,010,376	2,010,000	376	-	-
179,443,320	2,060,000	204,726,447	2,350,427	2,350,000	427	-	-
180,819,654	2,500,000	224,270,213	3,101,062	3,100,000	1,062	-	-
37,973,018	550,000	63,544,577	920,206	920,000	206	-	-
65,793,372	700,000	65,793,372	700,127	700,000	127	-	-
26,412,798	400,000	52,844,924	800,153	800,000	153	-	-
13,678,441	200,000	41,074,575	600,151	600,000	151	-	-
48,604,096	750,000	48,604,096	750,281	750,000	281	-	-
9,608,529	150,000	9,608,529	150,029	150,000	29	-	-
15,381,836	200,000	15,381,836	200,072	200,000	72	-	-
-	1,470,000	-	1,610,219	1,610,000	219(註四)	-	-
-	2,055,000	-	2,215,322	2,215,000	322(註四)	-	-
-	560,000	-	560,039	560,000	39(註四)	-	-
-	-	-	108,173	100,000	8,173	-	-
-	-	-	106,482	100,000	6,482	-	-
-	319,138	-	-	-	-	-	288,486
100,000,000	3,149,000	-	-	-	-	100,000,000	2,914,964
24,000,000	728,160	-	-	-	-	24,000,000	613,821
12,756,805	180,200	25,831,759	365,399	364,738	661	6,781,801	96,087
12,979,512	200,167	12,979,512	200,167	200,064	103	12,979,512	200,706
17,201,164	250,155	31,084,627	452,156	451,973	183	3,317,701	48,351
11,753,261	170,150	11,753,261	170,150	170,065	85	11,753,261	170,599
-	2,400,000	-	2,400,173	2,400,000	173(註四)	-	-
-	497,000	-	527,027	527,000	27(註四)	-	-
-	200,000	-	200,016	200,000	16(註四)	-	-
15,042,410	160,000	15,042,410	160,025	160,000	25	-	-
8,699,586	100,000	8,699,586	100,040	100,000	40	-	-

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額(註一)
日月鴻科技公司	債券					
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	\$ 240,183
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	298,745
	附買回政府債券	現金及約當現金	-	-	-	100,020
	基金					
	日盛債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	元大萬泰債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	聯邦債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	群益安穩債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
	台灣工銀大眾債券基金	備供出售金融資產-流動	-	-	-	-
J & R Holding Limited	股票					
	日月光半導體製造公司	備供出售金融資產-非流動	-	-	109,770,444	美金 98,872千元
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	-	-	-	-
	股權憑證					
ASE Test Limited	股票					
	日月光半導體製造公司	備供出售金融資產-非流動	-	-	204,907,278	美金 184,564千元
	環隆電氣公司	採權益法之長期股權投資	-	-	-	-
Innosource Limited	股票					
Omnivquest Industrial Limited	股票					
ASE Corporation	股票					
ASE Mauritius Inc.	股權憑證					
日月光半導體(上海)公司	股權憑證					
日月光封裝測試(上海)有限公司	股權憑證					
ASE Singapore Pte. Ltd.	股票					
上海鼎匯房地產開發有限公司	股權憑證					
ASE(Korea) Inc.	股權憑證					
Super Zone Holdings Limited	股權憑證					

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
-	\$ 3,291,927	-	\$ 3,532,542	\$ 3,532,111	\$ 431(註四)	-	\$ -
-	2,641,857	-	2,941,560	2,940,602	958(註四)	-	-
-	1,901,191	-	2,001,530	2,001,211	319(註四)	-	-
14,140,280	200,000	14,140,280	200,193	200,000	193	-	-
6,904,742	100,000	6,904,742	100,113	100,000	113	-	-
15,831,564	200,000	15,831,564	200,215	200,000	215	-	-
6,481,133	100,000	6,481,133	100,116	100,000	116	-	-
14,731,562	200,000	14,731,562	200,189	200,000	189	-	-
-	-	76,358,486	美金57,406千元 (註五)	美金28,643千元 (註五)	美金 28,763千元 (註五)	36,749,966 (註六)	美金 42,564千元
87,448,562	美金 57,406千元	-	-	-	-	87,448,562	美金 59,785千元
-	-	-	美金21,500千元 (註三)	美金21,411千元 (註三)	-(註三)	-	-
-	-	141,808,499	美金106,611千元 (註五)	美金53,219千元 (註五)	美金 53,39千元 (註五)	69,402,638 (註六)	美金 80,382千元
162,404,554	美金106,611千元	-	-	-	-	162,404,554	美金111,031千元
26,000,000	美金 26,000千元	-	-	-	-	74,000,000	美金 91,949千元
26,000,000	美金 26,000千元	-	-	-	-	352,784,067	美金440,795千元
26,000,000	美金 26,000千元	-	-	-	-	217,800,000	美金346,878千元
-	美金 26,000千元	-	-	-	-	-	美金 64,948千元
-	人民幣200,000千元	-	-	-	-	-	人民幣311,347千元
-	人民幣520,000千元	-	-	-	-	-	人民幣1,108,393千元
普通股 192,000,000	美金 72,163千元	-	-	-	-	普通股 192,000,000	美金 59,463千元
特別股 40,000,000						特別股 40,000,000	
-	人民幣400,000千元	-	-	-	-	-	人民幣1,066,947千元
-	人民幣500,000千元	-	-	-	-	-	人民幣499,205千元
-	美金 21,500千元 (註三)	-	-	-	-	-	美金 25,913千元
-	美金100,000千元	-	-	-	-	-	美金100,033千元

買、賣之公司	有價證券種類及名稱	帳列科目	交易對象	關係	年初	
					股數	金額(註一)
Alto Enterprises Limited	股權憑證 日月光半導體(昆山)有限公司	採權益法之長期股權投資	(註二)	聯屬公司	-	\$ -
環鴻公司	股權憑證 環旭昆山公司	採權益法之長期股權投資	RTH公司	母公司	-	美金 12,861千元
RTH公司	股權憑證 環旭昆山公司	採權益法之長期股權投資	環鴻公司	子公司	-	-
環隆電氣公司	股票 HHI公司	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	200,856,840	13,179,869
HHI公司	股票 RTH公司	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	99,151,000	美金 352,145千元
RTH公司	股票 UEHC公司	採權益法之長期股權投資	(註七)	子公司	50,000	美金 39千元
	環誠公司	採權益法之長期股權投資	UEHC公司	子公司	110,900,000	美金 195,618千元
UEHC公司	股票 環誠公司	採權益法之長期股權投資	(註七)	子公司	-	-
環旭上海公司	股票 環鴻公司	採權益法之長期股權投資	(註二)	子公司	23,400,000	人民幣 26,871千元

註一：採權益法之長期股權投資金額係包括權益法認列之投資損益、金融商品未實現損益、未認列為退休金成本之淨損失及累積換算調整數等。其他金融資產金額則包括以公平價值衡量之評價調整數。

註二：係辦理現金增資。

註三：係組織架構調整。

註四：係帳列利息收入。

註五：係收購環隆電氣公司之交易對價，其與帳面價值之差額，列入資本公積—庫藏股票交易項下。

註六：係包含資本公積及盈餘配股。

註七：其中美金50,000千元(50,000千股)係現金增資；美金195,618千元(110,900千股)係組織架構調整。

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

取得重大不動產明細表

民國九十九年度

附表五

取得之公司	財產名稱	交易日或事實發生日	交易金額	價款支付情形	交易對象	關係
本公司	廠房建物	99.04.29	\$450,000	分四期付款，已付訖	楠梓電子公司	無

買入		賣出				年底	
股數	金額	股數	售價	帳面成本	處分(損)益	股數	金額(註一)
-	美金 24,000千元	-	\$ -	\$ -	\$ -	-	美金 21,065千元
-	-	-	美金11,800千元 (註三)	美金11,782千元 (註三)	-	-	-
-	美金 11,800千元 (註三)	-	-	-	-	-	美金 13,087千元
50,000,000	1,596,000	-	-	-	-	250,856,840	15,761,463
50,000,000	美金 50,00千元	-	-	-	-	149,151,000	美金483,099千元
160,900,000 (註七)	美金245,618千元 (註七)	-	-	-	-	160,950,000	美金307,948千元
-	-	110,900,000 (註三)	美金195,618千元 (註三)	美金195,618千元 (註三)	-	-	-
160,900,000 (註七)	美金245,618千元 (註七)	-	-	-	-	160,900,000	美金307,916千元
54,522,000	人民幣47,724千元	-	-	-	-	77,922,000	人民幣85,467千元

單位：新台幣千元

交易對象為關係人者，其前次移轉資料				價格決定之參考依據	取得目的及使用情形	其他約定事項
所有人	與發行人之關係	移轉日期	金額			
-	-	-	\$ -	參酌鑑價機構鑑價 結果議定之	因應未來產能擴充 之需求	無

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

重大與關係人進、銷貨明細表

民國九十九年度

附表六

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形			
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間
本公司	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	進貨	\$ 1,261,849	5	月結60天
	日月光半導體(上海)公司	子公司	進貨	1,621,187	6	月結60天
	日月光電子公司	子公司	進貨	1,793,220	6	月結60天
日月光封裝測試(上海)有限公司	日月光半導體(上海)公司	聯屬公司	進貨	1,915,760	25	月結60天
日月光半導體(香港)有限公司	日月光半導體(上海)公司	母公司	進貨	1,817,297	65	月結90天
	日月光電子公司	聯屬公司	進貨	997,989	35	月結60天
ASE Electronics(M) Sdn. Bhd.	日月光電子公司	聯屬公司	進貨	196,425	10	發票日後60天
日月鴻科技公司	日月光半導體(上海)公司	聯屬公司	進貨	201,911	37	發票日後60天
ASE Assembly&Test (HK) Limited	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	進貨	2,803,569	100	發票日後45天
ASE Japan Co., Ltd.	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	進貨	1,692,437	63	月結60天
日月光半導體(上海)公司	本公司	最終母公司	銷貨	(1,621,187)	(26)	月結60天
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	銷貨	(1,915,760)	(30)	月結60天
	日月光半導體(香港)有限公司	子公司	銷貨	(1,817,297)	(29)	月結90天
	日月鴻科技公司	聯屬公司	銷貨	(201,911)	(3)	發票日後60天
日月光封裝測試(上海)有限公司	ASE Assembly&Test(HK) Limited	聯屬公司	銷貨	(2,803,569)	(20)	發票日後45天
日月光半導體(香港)有限公司	本公司	最終母公司	銷貨	(1,261,849)	(42)	月結60天
日月光電子公司	日月光半導體(香港)有限公司	聯屬公司	銷貨	(997,989)	(28)	月結60天
	本公司	最終母公司	銷貨	(1,793,220)	(51)	月結60天
	ASE Electronics(M) Sdn. Bhd.	聯屬公司	銷貨	(196,425)	(6)	發票日後60天
日月鴻科技公司	力晶半導體公司	對日月鴻科技公司採權益法評價之股東	銷貨	(3,164,517)	(96)	月結90~150天
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司	銷貨	(1,190,203)	(66)	月結90天
環隆電氣公司	UI公司	子公司	進貨	9,657,790	56	75天
			銷貨	(4,926,877)	(27)	75天
	環旭上海公司	子公司	銷貨	(112,249)	(1)	75天
	環旭香港公司	子公司	進貨	604,983	4	75天
	環隆墨西哥公司	子公司	銷貨	(295,081)	(2)	75天
	環鴻台灣公司	子公司	銷貨	(825,737)	(4)	75天

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	
\$ -	- (\$	370)	-	
	- (-	466,512)	(6)	
	- (-	623,299)	(9)	
	- (-	180,414)	(15)	
	- (-	33,645)	(98)	
	- (-	533)	(2)	
	- (-	37,313)	(13)	
	- (-	91,797)	(60)	
	- (-	107,986)	(100)	
	- (-	355,639)	(55)	
	- -	475,157	52	
	- -	180,371	20	
	- -	33,645	4	
	- -	88,484	10	
	- -	107,986	7	
	- -	752	1	
	- -	731	-	
	- -	637,211	76	
	- -	37,400	4	
	註	1,615,563	96	
	- -	530,074	83	
	- (-	1,900,826)	(62)	
	- -	563,717	19	
	- -	-	-	
	- -	-	-	
	- -	255	-	
	- -	18,408	1	

進(銷)貨之公司	交易對象	關係	交易情形				
			進(銷)貨	金額	佔總進(銷)貨之比率%	授信期間	
UI公司	環隆電氣公司	最終母公司	進貨 銷貨	美金 166,467千元 (美金 294,809千元)	(36 64)	75天	
	環勝深圳公司	聯屬公司	進貨 銷貨	美金 171,323千元 (美金 152,423千元)	(37 33)	75天	
	環旭上海公司	聯屬公司	進貨 銷貨	美金 124,750千元 (美金 8,915千元)	(27 2)	75天	
	環鴻深圳公司	聯屬公司	銷貨	(美金 6,209千元)	(1)	75天	
環隆墨西哥公司	環隆電氣公司	最終母公司	進貨	披索 123,414千元	18	75天	
環勝深圳公司	UI公司	聯屬公司	進貨 銷貨	人民幣 1,346,639千元 (人民幣 1,159,041千元)	(41 31)	75天	
	環旭香港公司	聯屬公司	銷貨	(人民幣 243,700千元)	(7)	75天	
環旭上海公司	UI公司	聯屬公司	銷貨	(人民幣 858,640千元)	(11)	75天	
	環鴻公司	子公司	進貨	人民幣 44,419千元	1	75天	
	環旭香港公司	子公司	銷貨	(人民幣 2,147,646千元 (人民幣 179,007千元)	(30 2)	75天	
環鴻公司	環旭上海公司	母公司	進貨 銷貨	人民幣 50,934千元 (美金 316,695千元)	(1 96)	75天	
	環旭香港公司	最終母公司	銷貨	(美金 18,944千元)	(12)	75天	
環旭香港公司	環勝深圳公司	聯屬公司	進貨	美金 35,889千元	22	75天	
	環旭上海公司	母公司	進貨 銷貨	美金 27,197千元 (美金 7,807千元)	(16 5)	75天	
	環鴻深圳公司	聯屬公司	進貨 銷貨	美金 78,743千元 (美金 11,152千元)	(47 7)	75天	
	環鴻台灣公司	聯屬公司	銷貨	(美金 28,946千元)	(18)	75天	
			進貨	美金 13,380千元	8	75天	
	環旭香港公司	聯屬公司	銷貨	(人民幣 531,743千元)	(92)	75天	
環鴻深圳公司	UI公司	聯屬公司	進貨	人民幣 81,923千元	16	75天	
			進貨	人民幣 41,864千元	8	75天	
環鴻台灣公司	環隆電氣公司	最終母公司	進貨	825,737	24	75天	
	環旭上海公司	子公司	銷貨	(349,125)	(8)	75天	
	環旭香港公司	聯屬公司	進貨 銷貨	912,800 (417,130)	(27 10)	75天	

註：交易條件因其他客戶銷貨金額並不重大，是以不予以比較。

交易條件與一般交易不同之情形及原因		應收(付)票據、帳款		備註
單價	授信期間	餘額	佔總應收(付)票據、帳款之比率(%)	
-	- (美金	25,368千元)	(27)	
-	- 美金	64,288千元	68	
-	- (美金	43,404千元)	(46)	
-	- 美金	25,453千元	27	
-	- (美金	24,854千元)	(27)	
-	- 美金	4,559千元	5	
-	-	-	-	
-	- (披索	227千元)	-	
-	- (人民幣	174,966千元)	(26)	
-	- 人民幣	287,535千元	40	
-	- 人民幣	72,868千元	10	
-	- 人民幣	170,500千元	10	
-	- (人民幣	30,411千元)	(2)	
-	- (人民幣	373,939千元)	(27)	
-	- 人民幣	108,661千元	6	
-	- (人民幣	32,861千元)	(2)	
-	- 美金	56,463千元	100	
-	-	-	-	
-	- (美金	11,003千元)	(18)	
-	- (美金	16,435千元)	(28)	
-	- 美金	4,962千元	8	
-	- (美金	19,446千元)	(33)	
-	- 美金	7,945千元	12	
-	- 美金	7,506千元	12	
-	- (美金	4,886千元)	(8)	
-	- 人民幣	128,783千元	83	
-	- (人民幣	52,631千元)	(23)	
-	-	-	-	
-	-	-	-	
-	-	93,600	6	
-	- (218,520)	(21)	
-	-	142,149	9	

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

重大應收關係人款項明細表

民國九十九年十二月三十一日

附表七

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額(註一)
本公司	日月鴻科技公司	子公司	\$ 979,439(註五)
日月光電子公司	本公司	最終母公司	1,060,610(註三)
ISE Labs, Inc.	J&R Holding Limited	母公司	874,337(註三)
ASE Singapore II Pte. Ltd.	ASE Singapore Pte. Ltd.	母公司	305,496(註六)
A.S.E. Holding Limited	J&R Holding Limited	聯屬公司	1,489,716(註三)
台灣福雷電子公司	本公司	母公司	4,757,886(註三)
	ASE Test Limited	聯屬公司	1,340,440(註三)
	J&R Holding Limited	聯屬公司	947,316(註三)
ASE Test Limited	本公司	最終母公司	990,760(註三)
	J&R Holding Limited	母公司	2,979,431(註三)
	ASE Singapore Pte. Ltd.	子公司	2,099,712(註三)
ASE(Korea) Inc.	日月光半導體(威海)有限公司	子公司	1,322,052(註三)
	本公司	母公司	879,989(註三)
日月光封裝測試(上海)有限公司	ASE Japan Co., Ltd.	聯屬公司	355,639
	上海威宇宏欣半導體有限公司	子公司	146,918(註三)
	ASE Assembly & Test(HK) Limited	聯屬公司	107,986
	日月光半導體(昆山)有限公司	聯屬公司	405,720(註四)
	上海鼎裕房地產開發有限公司	子公司	442,963(註三)
J&R Holding Limited	日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司	586,880(註三)
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	子公司	456,003(註三)
	日月光半導體(昆山)有限公司	聯屬公司	874,320(註三)
	本公司	母公司	2,010,660(註三)
日月瑞股份有限公司	本公司	最終母公司	200,000(註三)
ASE Japan Co., Ltd.	J&R Holding Limited	聯屬公司	1,499,153(註三)
日月光半導體(上海)公司	本公司	最終母公司	475,157
	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	187,378
	上海鼎威房地產開發有限公司	子公司	1,072,474(註三)
	上海鼎裕房地產開發有限公司	子公司	518,192(註三)
日月光電子元器件(昆山)有限公司	日月光半導體(威海)有限公司	聯屬公司	116,661(註三)
日月光高新科技(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	482,735(註三)
日月光電子元器件(上海)有限公司	日月光封裝測試(上海)有限公司	聯屬公司	407,534(註三)
蘇州日月新半導體有限公司	台灣恩智浦半導體公司	對蘇州日月新半導體有限公司有重大影響力公司之子公司	530,126

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

週轉率(次)(註二)	逾期應收關係人款項(註一)		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵呆帳金額
	金額	處理方式		
1	\$ -	-	\$ 952,871	\$ -
6	-	-	603,850	-
-	-	-	-	-
-	-	-	305,496	-
-	-	-	-	-
-	-	-	1,102,293	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	101,990	-
-	-	-	-	-
-	-	-	2,464	-
-	589,745	持續催收	-	-
-	-	-	879,989	-
6	-	-	239,736	-
-	-	-	-	-
21	1,603	持續催收	106,443	-
-	270,780	持續催收	5,098	-
-	-	-	-	-
-	-	-	4,080	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	437,100	-
-	-	-	-	-
-	-	-	29,140	-
6	21,131	持續催收	311,615	-
9	9,345	持續催收	166,614	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
2	179,691	持續催收	320,718	-

帳列應收款項之公司	交易對象	關係	應收關係人款項餘額(註一)	
日月鴻科技公司	力晶科技公司	對日月鴻科技公司採權益法評價之股東	\$	1,615,563
環隆電氣公司	UI公司	子公司		563,717
UI公司	環隆電氣公司	母公司	美金	65,191千元
	環勝深圳公司	聯屬公司	美金	25,481千元
	環旭上海公司	聯屬公司	美金	4,592千元
RTH公司	環勝深圳公司	子公司	美金	14,783千元
環勝深圳公司	UI公司	聯屬公司	人民幣	287,535千元
	環旭香港公司	聯屬公司	人民幣	72,868千元
環旭上海公司	UI公司	聯屬公司	人民幣	170,500千元
	環旭香港公司	子公司	人民幣	108,661千元
環鴻公司	環旭上海公司	母公司	美金	56,463千元
環旭香港公司	環鴻台灣公司	聯屬公司	美金	7,506千元
	環鴻深圳公司	聯屬公司	美金	7,945千元
	環旭上海公司	聯屬公司	美金	4,962千元
環鴻深圳公司	環旭香港公司	聯屬公司	人民幣	128,783千元
環鴻台灣公司	環旭香港公司	聯屬公司		142,149

註一：係包含應收帳款及其他應收款。

註二：不含其他應收款。

註三：主係應收融資款；詳附表-說明。

註四：主係應收設備款。

註五：主係應收減資款。

註六：主係代收測試款。

週轉率(次)(註二)	逾期應收關係人款項(註一)		應收關係人款項 期後收回金額	提列備抵呆帳金額
	金額	處理方式		
3	\$ -	-	\$ 190,000	\$ -
4	-	-	349,735	-
4	-	-	美金 21,921千元	-
3	-	-	美金 12,002千元	-
2	-	-	美金 32千元	-
-	-	-	-	-
4	-	-	人民幣 82,219千元	-
7	-	-	人民幣 19,286千元	-
5	-	-	人民幣 62,194千元	-
3	-	-	人民幣 23,063千元	-
7	-	-	美金 28,145千元	-
8	-	-	美金 1,004千元	-
3	-	-	美金 2,558千元	-
3	-	-	-	-
8	-	-	人民幣 21,958千元	-
6	-	-	55,313	-

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

被投資公司名稱、所在地區…等相關資訊

民國九十九年度

附表八

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		
				本年年底	去年年底	
本公司	A.S.E. Holding Limited	百慕達	從事專業性投資活動	美金 283,966千元	美金 283,96千元	
	J&R Holding Limited	百慕達	從事專業性投資活動	美金 479,693千元	美金 479,69千元	
	ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	日本	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務	日幣 60,000千圓	日幣 60,000千圓	
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金 250,504千元	美金 250,50千元	
	Innosource Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金 86,000千元	美金 60,000千元	
	宏錦光公司	台北市	自有剩餘攤位及辦公大樓出租	\$ 390,470	\$ 390,470	
	宏璟建設公司	台北市	委託營造廠商興建國民住宅及商業大樓 出租業務、買賣各種建材及其進出口業務、房屋租售之介紹業務、室內設計裝潢工程	2,845,913	2,845,913	
	環隆電氣公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣	16,519,092	3,623,835	
	日月鴻科技公司	桃園縣	從事電腦零組件、電腦及週邊設備、其他電機及電子機械器材、電子材料批發及零售業、國際貿易、其他顧問服務及租賃業務	1,907,781	2,823,560	
	台灣福雷電子公司	楠梓加工區	半導體產品測試服務	20,694,585	20,694,585	
A.S.E. Holding Limited	晶錡科技公司	新竹市	從事電子零組件製造業、智慧財產權業、產品設計業、國際貿易業	84,000	84,000	
	ASEP Realty Corporation	菲律賓	房地產投資、買賣及出租	美金 234千元	美金 234千元	
	ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	菲律賓	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售	美金 57,141千元	美金 57,141千元	
	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動	美金 84,889千元	美金 84,889千元	
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動	美金 126,643千元	美金 126,643千元	
J&R Holding Limited	環隆電氣公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣	美金 7,044千元	美金 7,044千元	
	ASE Test Limited	新加坡	從事專業性投資活動	美金 964,524千元	美金 964,524千元	
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金 30,200千元	美金 30,200千元	
	環隆電氣公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與買賣	美金 57,406千元	-	
	日月瑞公司	楠梓加工區	各型積體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等	美金 51,344千元	美金 51,344千元	
	ASE Japan Co., Ltd.	日本	積體電路之封裝及製造	美金 25,606千元	美金 25,606千元	
	ASE (U.S.) Inc.	美國	從事市場行銷支援及客戶服務等業務	美金 4,600千元	美金 4,600千元	
	Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	英屬開曼群島	從事專業性投資活動	美金 190,000千元	美金 190,00千元	
	蘇州日月新半導體有限公司	中國大陸蘇州	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務等業務	美金 21,600千元	美金 21,600千元	
	日月光半導體（威海）有限公司	中國大陸山東	一般類之分離式元器件封裝及測試	-	美金 40,000千元	
日月光電子元器件（上海）有限公司	日月光半導體（上海）公司	中國大陸上海	從事半導體材料製造業務	美金 1,000千元	美金 1,000千元	
上海鼎匯房地產開發有限公司	上海鼎威房地產開發有限公司	中國大陸上海	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣1,068,000千元	人民幣 668,000千元	
	上海鼎裕房地產開發有限公司	中國大陸上海	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣 500,000千元	-	

單位：新台幣千元（除另予註明者外）

年底持有			被投資公司本年度(損)益	本年度認列之投資(損)益		備註
股數	比率	帳面金額		\$	\$	
243,966	100	\$ 12,614,154	\$ 1,215,813	\$ 1,039,355		子公司
435,128	100	39,254,567	5,548,731	3,029,993		子公司
1,200	100	30,973	553	553		子公司
250,504,067	71	8,853,484	1,232,510	839,185		子公司
86,000,000	100	3,142,761	268,272	256,196		子公司
39,047,000	27	332,224	20,560	5,615		被投資公司
68,629,782	26	1,106,338	196,707	57,640		被投資公司
791,039,874	74	15,041,086	2,396,268	1,027,706		子公司
135,688,085	56	2,270,597	926,103	513,961		子公司
361,409,622	100	20,709,444	3,171,103			子公司
6,000,000	33	20,085 (美金)	(50,778) (美金)	(20,186) (美金)		被投資公司
20,000	100	39千元 (美金)	2千元			子公司
2,423,733	100	862千元 (美金)	278千元			子公司
11,148,000	10	82,469千元 美金	91,478千元			子公司
126,642,842	70	284,249千元 美金	40,136千元			子公司
15,964,200	2	8,676千元 美金	75,641千元			子公司
98,276,087	90	875,970千元 美金	91,478千元			子公司
30,200,000	9	37,511千元 美金	39,354千元			子公司
87,448,562	8	59,785千元 美金	75,641千元			子公司
170,000,006	100	34,375千元 (美金)	245千元			子公司
7,200	100	92,121千元 美金	1,794千元			子公司
1,000	100	7,587千元 (美金)	18千元			子公司
190,000,000	100	314,244千元 美金	67,135千元			子公司
-	60	32,543千元 美金	3,904千元			子公司
-	-	- 美金	1,383千元			子公司
6,283,605	1	1,615千元 美金	41,353千元			子公司
-	100	1,066,947千元 (人民幣)	1,053千元			子公司
-	100	499,205千元 (人民幣)	795千元			子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額			
				本年年底		去年年底	
ASE Test Limited	環隆電氣公司	南投縣	各種電腦資訊之週邊設備，厚膜混合積體電路，電子零件配件及個人電腦及其零件之製造、加工與貿易	美金	106,611千元	\$	-
	ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	新加坡	從事專業性投資活動	美金	65,520千元	美金	65,520千元
	ASE Test Holdings, Ltd.	英屬開曼群島	從事專業性投資活動	美金	222,399千元	美金	222,399千元
	ASE Test Finance Limited	模里西斯	從事專業性理財活動	美金	2元	美金	2元
	ASE Singapore Pte. Ltd.	新加坡	半導體產品測試服務	美金	55,815千元	美金	55,815千元
	ASE Investment (Labuan) Inc.	馬來西亞	從事專業性投資活動	美金	54,304千元	美金	54,304千元
ASE Test Holdings, Ltd.	ISE Labs, Inc.	美國	半導體產品測試服務	美金	221,145千元	美金	221,145千元
ASE Investment (Labuan) Inc.	ASE (Korea) Inc.	韓國	電子零組件，通信機械器材製造	美金	100,000千元	美金	100,000千元
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	馬來西亞	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售	美金	60,000千元	美金	60,000千元
ASE Singapore Pte. Ltd.	ASE Singapore II Pte. Ltd.	新加坡	半導體產品測試服務	美金	72,163千元		-
Omniquest Industrial Limited	ASE Corporation	英屬開曼群島	從事專業性投資活動	美金	352,784千元	美金	326,784千元
ASE Corporation	ASE Mauritius Inc. ASE Labuan Inc.	模里西斯 馬來西亞	從事專業性投資活動 從事專業性投資活動	美金 美金	217,800千元 126,184千元	美金 美金	191,800千元 126,184千元
ASE Mauritius Inc.	日月光半導體(上海)公司	中國大陸上海	從事半導體材料製造業務	美金	121,265千元	美金	121,265千元
	日月光高新科技(上海)有限公司	中國大陸上海	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金	15,000千元	美金	15,000千元
	日月光半導體(昆山)有限公司	中國大陸昆山	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	美金	74,000千元	美金	48,000千元
	日月光電子元器件(昆山)有限公司	中國大陸昆山	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金	6,000千元	美金	6,000千元
ASE Labuan Inc.	日月光電子公司	楠梓加工區	電子材料批發業、電子材料零售業及國際貿易業	美金	125,813千元	美金	125,813千元
Innosource Limited	日月光電子元器件(上海)有限公司	中國大陸上海	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金	12,000千元	美金	12,000千元
	Omniquest Industrial Limited	英屬維京群島	從事專業性投資活動	美金	74,000千元	美金	48,000千元
日月光半導體(上海)公司	上海鼎匯房地產開發有限公司	中國大陸上海	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣	281,000千元	人民幣	81,000千元
	日月光半導體(香港)有限公司 環旭上海公司	香港 中國大陸上海	從事貿易相關業務活動 提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、銷售自產產品，及提供相關服務	美金 人民幣	1,000千元 5,850千元	美金 人民幣	1,000千元 5,850千元
Global Advanced Packaging Technology Limited, Cayman Islands	ASE Assembly & Test (HK) Limited	香港	從事貿易相關業務活動	港幣	1,000千元	港幣	1,000千元
	日月光封裝測試(上海)有限公司	中國大陸上海	半導體產品封裝及測試業務	美金	203,580千元	美金	203,580千元
日月光封裝測試(上海)有限公司	上海威宇宏欣半導體有限公司	中國大陸上海	半導體產品封裝及測試業務	人民幣	76,000千元	人民幣	76,000千元
	上海鼎匯房地產開發有限公司	中國大陸上海	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣	961,000千元	人民幣	441,000千元
	日月光半導體(上海)公司	中國大陸上海	從事半導體材料製造業務	美金	1,000千元	美金	1,000千元

年底持有			被投資公司本年度(損)益		本年度認列之投資(損)益	備註
股數	比率	帳面金額				
162,404,554	15	美金 111,031千元	美金	75,641千元		子公司
71,428,902	100	美金 98,317千元	美金	15,478千元		子公司
5	100	美金 86,476千元	美金	1,622千元		子公司
2	100	美金 46千元	(美金 15千元)			子公司
30,100,000	100	美金 63,755千元	美金	2,940千元		子公司
54,304,040	30	美金 121,821千元	美金	40,136千元		子公司
26,250,000	100	美金 86,473千元	美金	1,624千元		子公司
7,613,363	100	美金 406,039千元	美金	39,892千元		子公司
159,715,000	100	美金 98,317千元	美金	15,478千元		子公司
普通股	192,000,000	美金 59,463千元	(美金	829千元)		子公司
特別股	40,000,000					
352,784,067	100	美金 440,795千元	美金	40,004千元		子公司
217,800,000	100	美金 346,878千元	美金	27,254千元		子公司
126,184,067	100	美金 93,746千元	美金	12,759千元		子公司
992,809,610	99	美金 255,132千元	美金	41,353千元		子公司
-	100	美金 16,919千元	(美金 493千元)			子公司
-	76	美金 64,948千元	(美金	13,461千元)		子公司
-	100	美金 6,138千元	(美金	105千元)		子公司
398,981,900	100	美金 93,156千元	美金	12,758千元		子公司
-	100	美金 16,554千元	美金	707千元		子公司
74,000,000	21	美金 91,494千元	美金	39,354千元		子公司
-	20	人民幣 311,347千元	人民幣	222,321千元		子公司
-	100	美金 6,442千元	(美金 1,806千元)			子公司
4,524,619	1	人民幣 8,548千元	人民幣	372,410千元		子公司
1,000,000	100	美金 2千元	(美金	36千元)		子公司
-	100	美金 316,892千元	美金	67,309千元		子公司
-	100	人民幣 66,020千元	(人民幣 3,300千元)			子公司
-	70	人民幣 1,108,393千元	人民幣	222,321千元		子公司
6,283,605	1	美金 1,615千元	美金	41,353千元		子公司

投資公司名稱	被投資公司名稱	所在地區	主要營業項目	原始投資金額		
				本年年底	去年年底	
台灣福雷電子公司	Alto Enterprises Limited Super Zone Holdings Limited	英屬維京群島 香港	從事專業性投資活動 從事專業性投資活動	美金 24,000千元 美金 100,000千元	\$ - - -	-
ASE(Korea) Inc.	日月光半導體（威海）有限公司	中國大陸山東	一般類之分離式元器件封裝及測試業務	美金 21,500千元	-	-
Super Zone Holdings Limited	日月光集成電路製造（中國）有限公司	中國大陸上海	從事半導體封裝測試，售後服務及諮詢	美金 100,000千元	-	-
Alto Enterprises Limited	日月光半導體（昆山）有限公司	中國大陸昆山	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	美金 24,000千元	-	-
環隆電氣公司	HHI公司	英屬維京群島	控股公司	8,223,156	6,627,156	
	展毅公司	南投縣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資	393,298	662,000	
	達基公司	南投縣	對各種生產事業、創投公司、證券公司等之投資	50,000	50,000	
HHI公司	環隆墨西哥公司	墨西哥	主機板及電腦系統組裝	美金 63,709千元	美金 63,709千元	
	環隆英國公司	英國	海外售後服務	美金 39,410千元	美金 39,410千元	
	UHI公司	英屬維京群島	控股公司	美金 3,000千元	美金 3,000千元	
	環隆日本公司	日本	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造販賣	美金 885千元	美金 2,982千元	
	UI公司	香港	主機板及相關電腦週邊設備之買賣	美金 101千元	美金 101千元	
	RTH公司	英屬維京群島	控股公司	美金 149,151千元	美金 99,151千元	
	USI@Work	美國	海外售後服務	美金 250千元	美金 250千元	
	環茂控股公司	英屬開曼群島	控股公司	美金 28,125千元	美金 28,125千元	
	環勝深圳公司	中國大陸深圳	生產經營電腦主機板和其他相關電腦週邊設備及通訊和工業控制等產品之設計、製造及銷售	美金 67,000千元	美金 67,000千元	
	環旭昆山公司	中國大陸昆山	生產計算機輔助系統、計算機高性能主板、無線網路通訊卡、其他電子產品、銷售自產產品	美金 12,000千元	-	-
UEHC公司	UEHC公司	英屬開曼群島	控股公司	美金 160,950千元	美金 50千元	
	環誠公司	香港	控股公司	-	美金 110,900千元	
環誠公司	環旭上海公司	中國大陸上海	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、銷售自產產品，並提供相關技術諮詢服務	美金 116,731千元	美金 51,000千元	
環旭上海公司	環鴻公司	香港	控股公司	人民幣 68,213千元	人民幣 20,489千元	
	環鴻深圳公司	中國大陸深圳	新型電子元器件等之研發設計及生產	人民幣 27,314千元	人民幣 27,314千元	
環鴻公司	環旭昆山公司	中國大陸昆山	生產計算機輔助系統、計算機高性能主板、無線網路通訊卡、其他電子產品、銷售自產產品	-	美金 12,000千元	
	環鴻深圳公司	中國大陸深圳	新型電子元器件等之研發設計及生產	美金 4,000千元	美金 4,000千元	
	環旭香港公司	香港	製造、貿易及投資控股公司	美金 1,000千元	美金 10千元	
	環鴻台灣公司	南投縣	有線通信機械器材、無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業	美金 30,400千元	美金 30,400千元	
環茂控股公司	USI-CA公司	美國	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務	美金 9,500千元	美金 9,500千元	
	環茂荷蘭公司	荷蘭	主機板及相關電腦週邊設備之買賣	美金 4,851千元	美金 4,851千元	
	環瑞上海公司	中國大陸上海	主機板及相關電腦週邊設備之買賣	-	美金 250千元	

年底持有			被投資公司本年度(損)益		本年度認列之投資(損)益		備註
股數	比率	帳面金額					
24,000,000	100	\$ 613,821	(\$ 13,941)				子公司
100,000,000	100	2,914,964	(15,471)				子公司
-	100	美金 25,913千元	美金 1,383千元				子公司
-	100	美金 100,033千元	(美金 525千元)				子公司
-	24	美金 21,065千元	(美金 13,461千元)				子公司
250,856,840	100	15,761,463		2,105,224			子公司
39,329,700	100	524,298		51,223			子公司
5,000,000	100	64,839		11,973			子公司
601,082,435	100	美金 25,269千元	美金 2,662千元				子公司
25,419,968	100	美金 5,486千元	(美金 202千元)				子公司
3,000,000	100	美金 15,002千元	(美金 148千元)				子公司
6,400	100	美金 877千元	(美金 883千元)				子公司
101,100	100	美金 2,334千元	美金 44千元				子公司
149,151,000	100	美金 483,099千元	美金 65,804千元				子公司
250,000	100	美金 673千元	美金 49千元				子公司
90,000,000	100	美金 1,599千元	(美金 1,341千元)				子公司
-	100	美金 96,835千元	美金 17,055千元				子公司
-	100	美金 13,087千元	(美金 170千元)				子公司
160,950,000	100	美金 307,948千元	美金 53,091千元				子公司
-	-	- 美金	53,682千元				子公司
160,900,000	100	美金 307,916千元	美金 53,098千元				子公司
895,874,563	99	美金 256,330千元	美金 54,432千元				子公司
77,922,000	100	人民幣 85,467千元	(人民幣 3,253千元)				子公司
-	50	人民幣 27,554千元	人民幣 7,797千元				子公司
-	-	- (美金	170千元)				子公司
-	50	美金 4,523千元	美金 1,166千元				子公司
7,800,000	100	美金 33千元	(美金 965千元)				子公司
98,000,000	100	美金 33,714千元	(美金 141千元)				子公司
250,000	100	美金 4,215千元	美金 74千元				子公司
38,006	100	美金 1,434千元	(美金 319千元)				子公司
-	-	- (美金 3千元)					子公司

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

衍生性金融商品資訊

民國九十九年度

附表九

非避險之衍生性金融商品

各子公司從事衍生性金融商品交易之目的，主要係為規避已認列資產或負債因匯率波動產生之風險。

一、遠期外匯合約

各子公司於九十九年十二月三十一日尚未到期之遠期外匯合約如下：

子公司名稱	幣別	到期期間	合約金額(千元)
台灣福雷	美金兌日幣	100.01.27	USD200～JPY16,583
日月光電子	美金兌日幣	100.01.27	USD1,500～JPY124,372
日月鴻	美金兌日幣 新台幣兌美金	100.01.27 100.01.18	USD1,250～JPY103,644 NTD119,396～USD4,000
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	美金兌馬幣	100.01.27～100.03.28	USD13,000～MYR40,706
ASE Singapore Pte. Ltd.	美金兌新加坡幣	100.01.07～100.01.25	USD4,300～SGD5,633
日月光上海封測	美金兌日幣	100.01.11	USD3,500～JPY291,876
環旭上海	美金兌人民幣 歐元兌美金	100.01.12 100.01.27～100.02.28	USD3,000～CNY19,995 EUR2,900～USD3,911
環勝深圳	美金兌人民幣	100.01.11～100.01.28	USD10,000～CNY66,495

二、換匯合約

各子公司於九十九年十二月三十一日尚未到期之換匯合約如下：

子公司名稱	幣別	到期期間	合約金額(千元)
台灣福雷	美金兌新台幣	100.01.03～100.01.10	USD91,843～NTD2,762,092
日月光電子	美金兌新台幣	100.01.05～100.02.11	USD24,000～NTD713,368
日月鴻	新台幣兌美金	100.02.24	NTD59,726～USD2,000
J&R Holding	美金兌日幣	100.12.13～100.12.27	USD49,264～JPY4,100,000

上述金融商品於九十九年十二月三十一日經評價產生淨利益149,323千元。

各子公司九十九年度承作非避險之衍生性金融商品產生淨利益514,623千元。

避險之衍生性金融商品

一、子公司日月光上海封測從事利率交換合約係為規避長期借款因利率變動而產生之現金流量風險，截至九十九年十二月三十一日之未實現利益為27,898千元（列入金融商品未實現損益項下），該未實現利益將於被避險項目—長期借款之合約期間內轉列為利息費用減項，到期日為一〇二年三月。九十九年度列入利息費用減項為22,217千元。

二、子公司台灣福雷從事換匯換利合約係為規避資金貸與聯屬公司可能因市場利率及匯率變動而使未來現金流量產生波動之風險。於九十九年十二月三十一日尚未到期之換匯換利合約如下：

到期日	名目本金(千元)	新台幣收取利率(%)	美金支付利率(%)	現金流量預期產生期間	相關損益預期於損益表認列期間
100.04.28	USD19,000／NTD596,030	-	0.35	99年至100年	99年至100年
100.05.10	USD40,000／NTD1,267,200	-	0.42	99年至100年	99年至100年
100.05.20	USD6,000／NTD191,100	-	0.61	99年至100年	99年至100年

上述換匯換利合約於九十九年十二月三十一日公平價值為利益163,670千元。九十九年度股東權益當期調減金額為3,883千元；由股東權益轉列損益之金額為7,619千元。

日月光半導體製造股份有限公司及子公司

大陸投資資訊

民國九十九年度

附表十

單位：新台幣千元（除非另註明者外）

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初自台灣匯出累積投資金額
日月光半導體(上海)公司	從事半導體材料製造業務	美金 122,800千元	註一	\$ 3,919,776 (美金 122,800千元)
日月光半導體(昆山)有限公司	從事半導體材料製造及半導體產品之封裝測試業務	美金 98,000千元	註一	1,584,705 (美金 48,000千元)
日月光電子元器件(上海)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金 12,000千元	註一	383,640 (美金 12,000千元)
日月光電子元器件(昆山)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金 6,000千元	註二	201,599 (美金 6,000千元)
日月光高新科技(上海)有限公司	從事新型電子元器件產銷及提供技術諮詢服務	美金 15,000千元	註一	478,800 (美金 15,000千元)
日月光封裝測試(上海)有限公司	半導體產品封裝及測試業務	美金 203,580千元	註二	5,792,530 (美金 180,000千元)
蘇州日月新半導體有限公司	從事半導體封裝測試及技術諮詢等業務	美金 48,672千元	註二	711,180 (美金 21,600千元)
日月光半導體(威海)有限公司	一般類之分離式元器件封裝及測試	美金 47,200千元	註二	1,295,307 (美金 40,000千元)
上海鼎匯房地產開發有限公司	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣 1,380,000千元	註三	註三
上海威宇宏欣半導體有限公司	半導體產品封裝及測試業務	人民幣 76,000千元	註三	註三
上海鼎威房地產開發有限公司	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣 1,068,000千元	註三	註三
上海鼎裕房地產開發有限公司	房地產項目開發建設及商品房銷售物業管理	人民幣 500,000千元	註三	註三
日月光集成電路製造(中國)有限公司	從事半導體封裝測試之售後服務及諮詢等業務	美金 100,000千元	註二	-

大陸被投資公司名稱	本年度匯出或收回投資金額		本公司直接或間接投資之持股比例 (%)	本年度認列投資(損)益	年底投資帳面價值	截至本年底已匯回投資收益
	匯出	收回				
日月光半導體(上海)公司	\$ - \$ 3,919,776 (美金 122,800千元)	-	100	\$ 1,295,550(註八) (美金 41,377千元)	\$ 7,528,676 (美金 258,362千元)	無
日月光半導體(昆山)有限公司	1,563,720 (美金50,000千元)	- 3,148,425 (美金 98,000千元)	100	(422,196)(註七) (美金 -13,461千元)	2,506,415 (美金 86,013千元)	無
日月光電子元器件(上海)有限公司	-	- 383,640 (美金 12,000千元)	100	22,203(註八) (美金 707千元)	482,376 (美金 16,554千元)	無
日月光電子元器件(昆山)有限公司	-	- 201,599 (美金 6,000千元)	100	(3,301)(註七) (美金 -105千元)	178,849 (美金 6,138千元)	無
日月光高新科技(上海)有限公司	-	- 478,800 (美金 15,000千元)	100	(15,602)(註八) (美金 -493千元)	493,027 (美金 16,919千元)	無
日月光封裝測試(上海)有限公司	-	- 5,792,530 (美金 180,000千元)	100	2,099,574(註七) (美金 67,309千元)	9,234,232 (美金 316,892千元)	無
蘇州日月新半導體有限公司	-	- 711,180 (美金 21,600千元)	60	72,658(註八) (美金 2,342千元)	948,293 (美金 32,543千元)	無
日月光半導體(威海)有限公司	-	- 1,295,307 (美金 40,000千元)	100	40,380(註八) (美金 1,383千元)	755,105 (美金 25,913千元)	無
上海鼎匯房地產開發有限公司	-	註三 90		936,280(註八) (人民幣 206,033千元)	6,246,883 (人民幣1,419,740千元)	無
上海威宇宏欣半導體有限公司	-	註三 100		(15,372)(註七) (人民幣 -3,300千元)	290,488 (人民幣66,020千元)	無
上海鼎威房地產開發有限公司	-	註三 90		(4,397)(註八) (人民幣 -948千元)	4,225,129 (人民幣960,252千元)	無
上海鼎裕房地產開發有限公司	-	註三 90		(3,336)(註八) (人民幣 -716千元)	1,976,860 (人民幣449,285千元)	無
日月光集成電路製造(中國)有限公司	3,149,000 (美金100,000千元)	- 3,149,000 (美金 100,000千元)	100	(15,471)(註七) (美金 -525千元)	2,914,964 (美金 100,033千元)	無

大陸被投資公司名稱	主要營業項目	實收資本額	投資方式	本年年初自台灣匯出累積投資金額
環勝深圳公司	生產經營電腦主機板、其他相關電腦周邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售	美金 67,000千元	註一	\$ 1,180,746(註六)
環旭上海公司	提供電子產品設計製造服務，生產及加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、銷售自產產品，並提供相關技術諮詢服務	人民幣 904,924千元	註一	1,668,233(註六)
環旭昆山公司	生產計算機輔助系統、計算機高性能主板、無線網路通訊卡、其他電子產品、銷售自產產品	美金 12,000千元	註一	383,201(註六)
環瑞上海公司	主機板及其他相關電腦週邊設備之買賣	美金 250千元	註一	8,107(註六)
環鴻深圳公司	新型電子元器件之研發設計及生產	美金 8,000千元	註一	-(註三)
珠海航電電纜有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	美金 3,000千元	註四	13,406(註六)
三朋友電子(深圳)有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	美金 500千元	註四	2,483(註六)
昆山三朋友電子有限公司	電線及電纜連接器與接頭之產銷業務	美金 4,224千元	註四	20,973(註六)
矽翔微機電系統(上海)有限公司	氣體流量暨感測器之製造及批發零售	美金 7,500千元	註五	3,035(註六)

大陸被投資公司名稱	本年度匯出或收回投資金額		本年年底自台灣匯出累積投資金額	本公司直接或間接投資之持股比例%	本年度認列投資(損)益	年底投資帳面價值	截至本年年底已匯回投資收益
	匯出	收回					
環勝深圳公司	\$ -	\$ -	\$ 1,180,746(註六)	99	\$ 448,159(註八) (美金 15,282千元)	\$ 2,795,534 (美金 95,934千元)	無
環旭上海公司	-	-	1,668,233(註六)	99	1,383,055(註八) (美金 47,299千元)	7,474,638 (美金 256,504千元)	無
環旭昆山公司	-	-	383,201(註六)	99	(4,770)(註九) (美金 -155千元)	377,809 (美金 12,965千元)	無
環瑞上海公司	-	-	8,107(註六)	-	(64)(註九) (美金 -2千元)	-	無
環鴻深圳公司	-	-	-(註三)	99	11,627(註八) (美金 397千元)	249,406 (美金 8,603千元)	無
珠海航電電纜有限公司	-	-	13,406(註六)	14	-	-	無
三朋友電子(深圳)有限公司	-	-	2,483(註六)	14	-	-	無
昆山三朋友電子有限公司	-	-	20,973(註六)	14	-	-	無
矽翔微機電系統(上海)有限公司	-	-	3,035(註六)	1	-	-	無

投資公司名稱	本年年底累計自台灣匯出赴大陸地區投資金額	經濟部投審會核准投資金額	本公司赴大陸地區投資限額
本公司	\$ 15,203,097 (美金 471,400千元)	\$ 15,203,097 (美金 471,400千元)	註十
環隆電氣公司	3,280,184	6,068,871 (美金 208,266千元)	註十
台灣福雷電子公司	3,877,160 (美金 124,000千元)	3,877,160 (美金 124,000千元)	\$ 12,543,111(註十一)

註一：係透過第三地區投資設立公司再投資大陸公司。

註二：係透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司。

註三：係由大陸地區現有公司再投資。

註四：係子公司UHI公司於九十六年八月投資以成本衡量之金融資產三朋友電子有限公司新發行之特別股計美金1,836仟元，該公司計有上述三家現有大陸子公司，對大陸公司之投資金額係依間接投資之持股比例計算。

註五：係子公司UHI公司所投資以成本衡量之金融資產Asia Global Venture Co., Ltd.以自有資金間接投資大陸公司，對大陸公司之投資金額係依間接投資之持股比例計算。

註六：係子公司環隆電氣公司匯出之投資金額。

註七：依經台灣母公司簽證會計師查核之財務報表揭露。

註八：依經與中華民國會計師事務所有合作關係之國際性會計師事務所查核之財務報表揭露。

註九：依經台灣母公司簽證會計師所屬事務所之其他會計師查核之財務報表揭露。

註十：依經濟部九十七年八月二十九日經審字第09704604680號令修正發布並自同年八月一日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點，本公司及子公司環隆電氣公司係取得經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。

註十一：台灣福雷電子公司赴大陸地區投資投資限額計算如下：\$20,905,185×60%=\$12,543,111

日月光半導體製造股份有限公司

現金明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表一

單位：新台幣千元(除另予註明者外)

項目	摘要	金額
庫存現金	包括美金10千元及新台幣890千元	\$ 1,194
銀行存款		
支票及活期存款		752,915
外幣活期存款	包括美金21,233千元、日幣369,385千圓、歐元953千元及法郎74千元	790,573
定期存款	99.08.16~100.05.16，年利率1.50%，美金3,000千元	87,420
		\$ 1,632,102

註：美金匯率按USD1=NTD29.1400換算。

日幣匯率按JPY1=NTD0.3584換算。

歐元匯率按EUR1=NTD38.9398換算。

法郎匯率按CHF1=NTD31.5339換算。

日月光半導體製造股份有限公司

應收帳款明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表二

單位：新台幣千元

客戶名稱	金額	帳款結欠逾一年以上者
非關係人		
Infineon Technologies Asia Pacific Pte. Ltd.	\$ 844,701	\$ -
Broadcom Singapore Pte. Ltd.	825,668	3
Qualcomm Global Trading, Inc.	744,103	-
Marvell Asia Pte. Ltd.	489,589	-
其他(註)	6,811,121	776
	9,715,182	\$ 779
關係人(註)	99,534	
	9,814,716	
減：備抵呆帳	22,921	
備抵銷貨折讓	105,199	
	\$ 9,686,596	

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

其他應收款明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表三

單位：新台幣千元

名稱／項目	金額	備註
非關係人		
代收付款項	\$ 627,822	主係代墊客戶原物料款及Turnkey款
其他(註)	86,566	
	<hr/>	
	714,388	
關係人		
日月鴻	927,574	主係應收減資款
其他(註)	152,821	
	<hr/>	
	1,080,395	
	<hr/>	
	\$ 1,794,783	

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

存貨明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表四

單位：新台幣千元

項目	金額	
	成本	淨變現價值
原料	\$ 2,320,365	\$ 2,330,548
物料	145,428	149,793
在製品	176,755	264,218
製成品	177,812	279,369
在途原物料	89,964	89,964
	<hr/>	<hr/>
	\$ 2,910,324	\$ 3,113,892

日月光半導體製造股份有限公司

其他流動資產明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表五

單位：新台幣千元

項目	金額
設備零件	\$ 53,285
預付貨款	40,287
進項稅額	26,983
代付款	20,071
預付保險費	13,808
其他(註)	40,345
	<hr/>
	\$ 194,779

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

採權益法評價之長期股權投資變動明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表六

單位：新台幣千元(除非另註明者外)

投資公司	年初餘額		本年度增加(註一)		本年度減少(註一)	
	股數	金額	股數	金額	股數	金額
普通股						
上市公司						
宏璟	68,629,782	\$ 936,370	-	\$ 169,968	-	\$ -
未上市櫃公司						
J & R Holding	435,128	36,682,882	-	2,571,685	-	-
台灣福雷	361,409,622	19,063,385	-	1,646,059	-	-
環電	176,980,013	3,039,493	614,059,861	12,001,593	-	-
ASE Holding	243,966	12,540,726	-	73,428	-	-
Omniquest	250,504,067	8,484,669	-	368,815	-	-
Innosource	60,000,000	2,144,554	26,000,000	998,207	-	-
日月鴻	227,046,809	2,778,474	-	-	91,358,724	507,877
宏錦光	39,047,000	326,609	-	5,615	-	-
晶鍍	6,000,000	82,010	-	-	-	20,186
ASE MS Japan	1,200	28,959	-	2,014	-	-
		86,108,131		17,837,384		528,063
減：以土地作價投資宏錦光 之未實現利益		300,149		-		-
轉列庫藏股票		5,934,491		-		3,975,384
累計減損		-		41,739		-
	\$ 79,873,491		\$ 17,795,645		\$ 3,447,321	
投資公司						
	年底餘額		市價或股權淨值(註二)		提供擔保或 質押情形	
	股數	持股%	金額	單價(元)	總金額	
普通股						
上市公司						
宏璟	68,629,782	26.2	\$ 1,106,338	\$ 19.2	\$ 1,314,260	無
未上市櫃公司						
J & R Holding	435,128	100.0	39,254,567	91,108.8	39,643,977	無
台灣福雷	361,409,622	100.0	20,709,444	57.8	20,905,185	無
環電	791,039,874	74.2	15,041,086	14.9	11,809,599	無
ASE Holding	243,966	100.0	12,614,154	52,381.7	12,779,348	無
Omniquest	250,504,067	70.6	8,853,484	36.2	9,072,180	無
Innosource	86,000,000	100.0	3,142,761	36.8	3,162,370	無
日月鴻	135,688,085	55.7	2,270,597	16.7	2,270,597	無
宏錦光	39,047,000	27.3	332,224	8.5	332,224	無
晶鍍	6,000,000	33.3	61,824	3.3	20,085	無
ASE MS Japan	1,200	100.0	30,973	25,810.8	30,973	無
			103,417,452		\$ 101,340,798	
減：以土地作價投資宏錦光 之未實現利益		300,149				
轉列庫藏股票		1,959,107				
累計減損		41,739				
	\$ 101,116,457					

註一：本年度變動包括增加及處分投資、採權益法認列投資損益、股東權益相關調整項目及獲配現金股利等。

註二：市價係指資產負債表日之普通股收盤價；股權淨值係依據各被投資公司之財務報表及本公司持股比例計算。

註三：依權益法認列之投資損益請參閱財務報表附註九。

日月光半導體製造股份有限公司

固定資產變動明細表

民國九十九年度
明細表七

單位：新台幣千元

	年初餘額	本年度增加	本年度減少	重分類(註)	年底餘額	提供擔保或質押情形
成本						
土地	\$ 1,558,201	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,558,201	無
建築物及附屬設備	18,278,699	1,815,808	(496,255)	502,489	20,100,741	無
機器設備	54,595,445	13,867,469	(4,906,094)	31,097	63,587,917	無
運輸設備	66,613	3,821	(7,332)	-	63,102	無
辦公設備	968,773	33,436	(52,536)	(103,560)	846,113	無
租賃資產	39,825	-	-	(22,604)	17,221	無
	75,507,556	15,720,534	(5,462,217)	407,422	86,173,295	
未完工程	128,315	336,688	-	-	465,003	無
在途機器及預付設備款	3,239,679	(1,458,849)	(76,520)	(491)	1,703,819	無
	78,875,550	\$ 14,598,373	(\$ 5,538,737)	\$ 406,931	88,342,117	
累計折舊						
建築物及附屬設備	(6,054,039)	(\$ 982,812)	\$ 353,469	(\$ 178,217)	(6,861,599)	
機器設備	(41,554,669)	(5,088,580)	4,772,816	47,370	(41,823,063)	
運輸設備	(46,192)	(6,267)	7,149	-	(45,310)	
辦公設備	(808,798)	(62,977)	51,971	96,714	(723,090)	
租賃資產	(28,781)	(8,582)	-	21,956	(15,407)	
	(48,492,479)	(\$ 6,149,218)	\$ 5,185,405	(\$ 12,177)	(49,468,469)	
累計減損						
建築物及附屬設備	-	(\$ 64,072)	\$ -	\$ -	(64,072)	
	\$ 30,383,071				\$ 38,809,576	

註：本期重分類係出租資產轉回324,180千元、閒置資產轉回72,213千元及轉列遞延費用1,639千元。

日月光半導體製造股份有限公司

應付帳款明細表

民國九十九年十二月三十一日
明細表八

單位：新台幣千元

廠商名稱	金額
非關係人	
Heraeus Materials Singapore Pte. Ltd.	\$ 674,673
欣興電子公司	593,303
景碩科技公司	539,369
南亞電路板公司	515,349
Tanaka Kikinzoku International K.K.	421,822
其他(註)	3,487,080
	6,231,596
關係人	
日月光電子	623,299
日月光上海	466,512
其他(註)	863
	1,090,674
	\$ 7,322,270

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

其他應付款明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表九

單位：新台幣千元

名稱／項目	金額	備註
關係人		
台灣福雷	\$ 4,757,624	主係應付融資款及代收應付測試費
J & R Holding	2,010,660	主係應付融資款
ASE Test	990,760	主係應付融資款
ASE Korea	879,989	主係應付融資款
其他(註)	709,542	主係應付融資款
	<u>9,348,575</u>	
非關係人		
應付火災損失款項及代收款等	383,581	
	<u>\$ 9,732,156</u>	

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

應付設備款明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表十

單位：新台幣千元

廠商名稱	金額
藝仟科技有限公司	\$ 101,204
Hanmi Semiconductor Co., Ltd.	80,401
Towa Corporation	71,074
Suss MicroTec Lithography GmbH	69,678
其他(註)	922,479
	<u>\$ 1,244,836</u>

註：各項餘額皆未超過本科目餘額之百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

其他流動負債明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表十一

單位：新台幣千元

項目	金額
暫收款	\$ 98,807
代扣款項	65,047
其他(註)	693
	<u>\$ 164,547</u>

註：各項餘額皆未超過本科目餘額百分之五。

日月光半導體製造股份有限公司

長期借款明細表

民國九十九年十二月三十一日

明細表十二

債權銀行	期限及償還辦法	年利率(%)
(一)指定用途專案借款		
花旗銀行主辦之銀行團	每半年為一期償還至一〇二年三月，每期償還2,537,500千元	1.96
花旗銀行主辦之銀行團	將於一〇〇年五月到期一次清償	1.02
(二)週轉性借款		
花旗銀行主辦之銀行團	自一〇〇年六月起，每半年為一期平均償還至一〇三年六月	1.56
花旗銀行主辦之銀行團	自一〇一年六月起，每半年為一期平均償還至一〇四年六月	0.95~1.30
國泰世華商業銀行	將於一〇一年五月到期一次清償	0.90
澳盛銀行	將於一〇一年四月到期一次清償	0.89
台新國際商業銀行	將於一〇一年六月到期一次清償	1.02
第一商業銀行	將於一〇一年九月到期一次清償	0.96
台北富邦商業銀行	將於一〇一年六月到期一次清償	0.81
星展銀行	將於一〇一年九月到期一次清償	1.07
星展銀行	將於一〇一年十月到期一次清償	0.95
永豐商業銀行	將於一〇一年十二月到期一次清償	0.92
香港東亞銀行	將於一〇一年十月到期一次清償	0.90
台灣土地銀行	將於一〇一年十二月到期一次清償	0.98
法國巴黎銀行	將於一〇一年一月到期一次清償	1.03
美國商業銀行	自一〇一年三月起，每半年為一期平均償還至一〇一年九月	1.45
台灣銀行	將於一〇一年八月到期一次清償	0.98
高雄銀行	六個月循環動用，本金屆期自動展延至一〇一年九月	0.99
合作金庫商業銀行	將於一〇一年三月到期一次清償	0.94
台灣工業銀行	將於一〇一年三月到期一次清償	0.90
台灣新光商業銀行	將於一〇一年十二月到期一次清償	0.93
中華開發銀行	將於一〇二年一月到期一次清償	0.95

註一：銀行團包括(二十八家)

花旗銀行、東方匯理銀行、國泰世華商業銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、第一商業銀行、香港上海匯豐銀行、華南商業銀行、澳盛銀行、台灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、三井住友銀行、台北富邦商業銀行、台灣銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、台新國際商業銀行、新加坡華僑銀行、玉山商業銀行、瑞穗實業銀行、台灣中小企業銀行、大華銀行、台灣工業銀行、永豐商業銀行、台灣新光商業銀行、台中商銀、日盛商業銀行及遠東國際商業銀行。

註二：銀行團包括(十二家)

花旗銀行、上海商業儲蓄銀行、中國信託商業銀行、台新國際商業銀行、東方匯理銀行、渣打國際商業銀行、香港上海匯豐銀行、華南商業銀行、台灣銀行、兆豐國際商業銀行、三菱東京日聯銀行及國泰世華商業銀行。

註三：銀行團包括(二十家)

花旗銀行、台北富邦商業銀行、台灣銀行、東方匯理銀行、第一商業銀行、元大商業銀行、中國信託商業銀行、中華開發工業銀行、玉山商業銀行、合作金庫商業銀行、兆豐國際商業銀行、國泰世華商業銀行、華南商業銀行、彰化商業銀行、三菱東京日聯銀行、台灣新光商業銀行、上海商業儲蓄銀行、台灣工業銀行、永豐銀行及全國農業金庫。

註四：銀行團包括(二十四家)

花旗銀行、東方匯理銀行、中國信託商業銀行、星展銀行、第一商業銀行、香港上海匯豐銀行、華南商業銀行、台灣土地銀行、兆豐國際商業銀行、三井住友銀行、台北富邦商業銀行、台灣銀行、合作金庫商業銀行、彰化商業銀行、台新國際商業銀行、新加坡華僑銀行、玉山商業銀行、瑞穗實業銀行、台灣中小企業銀行、渣打國際商業銀行、三菱東京日聯銀行、中華開發工業銀行、上海商業儲蓄銀行及泰國盤谷銀行。

註五：其中14,331,571千元將於一年內到期，本公司預計以九十九年十二月三十一日前已取得之融資額度清償該借款，是以未列入一年內到期部分。

單位：新台幣千元（除另予註明者外）

金額						
一年內到期		一年後到期		合計	抵押或擔保	備註
\$	-	\$	12,687,500	\$ 12,687,500	無	註一
	-		5,828,000	5,828,000	無	註二
	-		18,515,500	18,515,500		
	-		12,000,000	12,000,000	無	註三
	-		4,539,800	4,539,800	無	註四
	-		1,300,000	1,300,000	無	
	-		1,082,800	1,082,800	無	
	-		1,049,040	1,049,040	無	
	-		1,000,000	1,000,000	無	
	-		874,200	874,200	無	
	-		874,200	874,200	無	
	-		900,000	900,000	無	
	-		660,000	660,000	無	
	-		620,000	620,000	無	
	-		600,000	600,000	無	
	-		582,800	582,800	無	
	-		500,000	500,000	無	
	-		500,000	500,000	無	
	-		460,000	460,000	無	
	-		400,000	400,000	無	
	-		390,000	390,000	無	
	-		300,000	300,000	無	
	-		150,000	150,000	無	
	-		28,782,840	28,782,840		
\$	-	\$	47,298,340	\$ 47,298,340		註五

日月光半導體製造股份有限公司

營業收入明細表

民國九十九年度
明細表十三

單位：新台幣千元（除另註明者外）

項目	數量(千個)	金額
先進基板或導線架型積體電路(QFP, Flip Chip, BGA等)	5,078,213	\$ 54,707,808
其他(註)		\$ 12,631,598
		\$ 67,339,406

註：各項金額皆未超過本科目金額之百分之十。

日月光半導體製造股份有限公司

營業成本明細表

民國九十九年度
明細表十四

單位：新台幣千元

項目	金額
直接材料耗用	
年初原料	\$ 1,418,849
本年度進料	28,552,528
減：出售原料	(249,002)
其他	(103,044)
年底原料	(2,320,365)
本年度耗料	27,298,966
直接人工	5,367,535
製造費用	17,914,849
製造成本	50,581,350
加：年初在製品	190,678
減：年底在製品	(176,755)
製成品成本	50,595,273
加：年初製成品	208,754
減：其他	(58,392)
年底製成品	(177,812)
	50,567,823
提列存貨損失	76,763
出售原料成本	249,002
出售間材及模具成本	37,517
下腳及廢料收入	(297,490)
	\$ 50,633,615

日月光半導體製造股份有限公司

營業費用明細表

民國九十九年度
明細表十五

單位：新台幣千元

項目	研究發展費用	推銷費用	管理及總務費用	合計
薪資	\$ 1,506,603	\$ 46,587	\$ 1,525,027	\$ 3,078,217
銷售服務費	–	631,210	–	631,210
折舊	330,170	1,042	196,363	527,575
專業服務費	67,210	–	135,482	202,692
攤銷	72,927	45	94,135	167,107
試產材料	155,035	–	–	155,035
員工保險費	81,404	2,255	65,842	149,501
退休金	62,618	2,086	74,790	139,494
間接物料	102,905	–	26,727	129,632
其他	396,735	62,070	705,320	1,164,125
	\$ 2,775,607	\$ 745,295	\$ 2,823,686	\$ 6,344,588

五、最近年度會計師查核簽證之母子公司合併財務報表

會計師查核報告

日月光半導體製造股份有限公司 公鑒：

日月光半導體製造股份有限公司(日月光公司)及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併資產負債表，暨民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日之合併損益表、合併股東權益變動表及合併現金流量表，業經本會計師查核竣事。上開合併財務報表之編製係管理階層之責任，本會計師之責任則為根據查核結果對上開合併財務報表表示意見。

本會計師依照會計師查核簽證財務報表規則及一般公認審計準則規劃並執行查核工作，以合理確信合併財務報表有無重大不實表達。此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報表所列金額及所揭露事項之查核證據、評估管理階層編製合併財務報表所採用之會計原則及所作之重大會計估計，暨評估合併財務報表整體之表達。本會計師相信此項查核工作可對所表示之意見提供合理之依據。

依本會計師之意見，第一段所述合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則及一般公認會計原則編製，足以允當表達日月光公司及其子公司民國九十九年及九十八年十二月三十一日之合併財務狀況，暨民國九十九及九十八年度之合併經營成果與合併現金流量。

如合併財務報表附註二所述，日月光公司及其子公司分別於民國九十九年二月及八月公開收購環隆電氣股份有限公司(環電)之股權，收購完成後對環電之持股比例提高為98.9%。是以日月光公司自民國九九年二月起將環電及其子公司之收益及費用編入合併財務報表中。

如合併財務報表附註三所述，日月光公司及其子公司自民國九十八年一月一日起，採用新修訂之財務會計準則公報第十號「存貨之會計處理準則」。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 龔俊吉

龔俊吉



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

會計師 邱慧吟

邱慧吟



財政部證券暨期貨管理委員會核准文號
台財證六字第0920123784號

中華民國一〇〇年三月十七日



日月光半導體製造股份有限公司及子公司
合併資產負債表

民國九十九年及九十八年十二月三十一日

代碼	資產	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動資產					
1100	現金及約當現金	\$ 23,397,557	11	\$ 22,557,494	14
1310	公平價值變動列入損益之金融資產 －流動	1,195,273	1	1,024,711	1
1320	備供出售金融資產－流動	338,094	—	3,995,524	2
1340	避險之衍生性金融資產－流動	163,670	—	—	—
1140	應收帳款淨額	32,870,448	16	17,811,541	11
1160	其他應收款	1,590,006	1	1,226,747	1
1190	存出保證金－流動	14,914	—	256,876	—
1210	存貨	13,170,779	6	4,955,227	3
1220	存貨－營建房地	10,125,370	5	7,251,193	4
1286	遞延所得稅資產－流動	919,261	—	893,622	1
1298	其他流動資產	1,813,553	1	1,425,810	1
11XX	流動資產合計	85,598,925	41	61,398,745	38
基金及投資					
1450	備供出售金融資產－非流動	310,426	—	—	—
1480	以成本衡量之金融資產－非流動	843,740	—	692,059	—
1490	無活絡市場之債券投資－非流動	87,420	—	96,090	—
1421	採權益法之長期股權投資	1,158,498	1	4,371,841	3
14XX	基金及投資合計	2,400,084	1	5,159,990	3
固定資產					
1501	土地	3,065,169	2	2,374,530	2
1521	建築物及附屬設備	50,322,341	24	41,186,763	26
1531	機器設備	157,001,044	75	131,206,473	81
1551	運輸設備	247,876	—	201,003	—
1561	辦公設備	5,097,742	3	3,800,859	2
1611	租賃資產及租賃改良	436,640	—	343,204	—
15X1	成本合計	216,170,812	104	179,112,832	111
15X9	減：累計折舊	122,437,240	59	109,231,262	68
1599	累計減損	191,210	—	5,401	—
		93,542,362	45	69,876,169	43
1671	未完工程	1,773,002	1	4,167,279	3
1672	在途機器及預付設備款	4,538,548	2	5,320,412	3
15XX	固定資產合計	99,853,912	48	79,363,860	49
無形資產					
1760	商譽	10,408,023	5	9,419,005	6
1782	土地使用權	2,173,907	1	1,385,144	1
17XX	無形資產合計	15,248,120	7	12,232,698	8
其他資產					
1800	出租資產	20,889	—	586,067	—
1810	閒置資產	1,249,047	1	419,781	—
1820	存出保證金－非流動	78,453	—	50,628	—
1830	遞延費用	1,381,510	1	958,560	1
1860	遞延所得稅資產－非流動	2,067,877	1	1,621,017	1
1887	受限制資產	236,516	—	177,565	—
1888	其他	4,432	—	5,884	—
18XX	其他資產合計	5,038,724	3	3,819,502	2
1XXX	資產總計	\$ 208,139,765	100	\$ 161,974,795	100

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

單位：新台幣千元，惟每股面額為新台幣元

代碼	負債及股東權益	九十九年十二月三十一日		九十八年十二月三十一日	
		金額	%	金額	%
流動負債					
2100	短期借款	\$ 14,154,518	7	\$ 13,024,993	8
2180	公平價值變動列入損益之金融負債 －流動	488,818	—	74,530	—
2200	避險之衍生性金融負債－流動	457,494	—	122,495	—
2140	應付帳款	24,389,249	12	8,954,015	5
2160	應付所得稅	2,739,711	1	1,181,485	1
2170	應付費用	7,843,657	4	4,346,028	3
2224	應付設備款	4,085,408	2	3,433,235	2
2262	預收房地款	41,375	—	1,507,472	1
2272	一年內到期長期借款	2,990,176	2	923,284	—
2288	一年內到期應付租賃款	28,838	—	12,055	—
2298	其他流動負債	2,515,258	1	994,497	1
21XX	流動負債合計	<u>59,734,502</u>	<u>29</u>	<u>34,574,089</u>	<u>21</u>
長期負債					
2430	避險之衍生性金融負債－非流動	159,279	—	311,778	—
2420	長期借款	52,363,718	25	48,990,517	31
2446	應付租賃款	10,782	—	3,718	—
24XX	長期負債合計	<u>52,533,779</u>	<u>25</u>	<u>49,306,013</u>	<u>31</u>
其他負債					
2810	應計退休金負債	3,250,439	2	2,729,844	2
2860	遞延所得稅負債	372,525	—	180,955	—
2888	其他	409,195	—	470,200	—
28XX	其他負債合計	<u>4,032,159</u>	<u>2</u>	<u>3,380,999</u>	<u>2</u>
2XXX	負債合計	<u>116,300,440</u>	<u>56</u>	<u>87,261,101</u>	<u>54</u>
母公司股東權益					
股本					
3110	普通股股本－每股面額10元， 額定股數為8,000,000千股： 發行股數九十九年及九十八年十二月三十一日 分別為6,051,987千股及5,479,878千股	60,519,872	29	54,798,783	34
3140	預收股本	299,698	—	135,205	—
31XX	股本合計	<u>60,819,570</u>	<u>29</u>	<u>54,933,988</u>	<u>34</u>
資本公積					
3210	發行股票溢價	1,197,845	—	1,311,421	1
3220	庫藏股票交易	2,136,353	1	827,285	1
3260	長期投資	3,527,240	2	3,538,222	2
3271	員工認股權	319,147	—	—	—
3281	轉換公司債應付利息補償金	—	—	656,827	—
32XX	資本公積合計	<u>7,180,585</u>	<u>3</u>	<u>6,333,755</u>	<u>4</u>
33XX	保留盈餘	<u>24,972,944</u>	<u>12</u>	<u>13,229,409</u>	<u>8</u>
股東權益其他項目					
3450	金融商品未實現損益	246,303	—	25,498	—
3420	累積換算調整數	(1,120,618)	(1)	3,276,508	2
3430	未認列為退休金成本之淨損失	(398,103)	— ()	248,641	—
3480	庫藏股票－九十九年及九十八年十二月三十一日 分別為151,792千股及322,532千股	(3,144,312)	(1)	(5,934,491)	(4)
34XX	股東權益其他項目淨額 母公司股東權益合計	<u>(4,416,730)</u>	<u>(2)</u>	<u>(2,881,126)</u>	<u>(2)</u>
3610	少數股權	<u>3,282,956</u>	<u>2</u>	<u>3,097,668</u>	<u>2</u>
3XXX	股東權益合計	<u>91,839,325</u>	<u>44</u>	<u>74,713,694</u>	<u>46</u>
負債及股東權益總計					
		<u>\$ 208,139,765</u>	<u>100</u>	<u>\$ 161,974,795</u>	<u>100</u>

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司及子公司
合併損益表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元，惟每股盈餘為新台幣元

代碼	九十九年度			九十八年度		
	金額	%		金額	%	
營業收入						
4110 銷貨收入	\$ 190,236,211	101		\$ 86,827,998	101	
4190 減：銷貨退回及折讓	1,493,414	1		1,052,684	1	
4100 營業收入淨額	188,742,797	100		85,775,314	100	
5000 營業成本	148,198,224	78		67,433,644	78	
5910 營業毛利	40,544,573	22		18,341,670	22	
營業費用						
6300 研究發展費用	6,162,191	3		3,611,950	4	
6100 推銷費用	2,909,643	2		1,209,199	2	
6200 管理及總務費用	7,373,733	4		4,310,692	5	
6000 合計	16,445,567	9		9,131,841	11	
6900 營業淨利	24,099,006	13		9,209,829	11	
營業外收入及利益						
7110 利息收入	215,228	–		173,870	–	
7310 金融資產評價利益	1,169,434	1		934,938	1	
7121 權益法認列之投資收益	72,980	–		330,117	–	
7160 兌換利益－淨額	317,553	–		4,203	–	
7480 其他	781,752	–		620,194	1	
7100 合計	2,556,947	1		2,063,322	2	
營業外費用及損失						
7510 利息費用	1,386,011	1		1,508,023	2	
7650 金融負債評價損失	1,092,316	–		645,774	–	
7880 其他	1,353,997	1		730,964	1	
7500 合計	3,832,324	2		2,884,761	3	
7900 稅前淨利	22,823,629	12		8,388,390	10	
8110 所得稅費用	3,628,740	2		1,484,922	2	
9600XX 合併總純益	\$ 19,194,889	10		\$ 6,903,468	8	
歸屬予：						
9601 母公司股東	\$ 18,337,500			\$ 6,744,546		

代碼		九十九年度		九十八年度	
		金額	%	金額	%
9602	少數股權	857,389		158,922	
		\$ 19,194,889		\$ 6,903,468	

代碼		九十九年度		九十八年度	
		稅前	稅後	稅前	稅後
	母公司股東每股盈餘				
9750	基本每股盈餘	\$ 3.22	\$ 3.10	\$ 1.35	\$ 1.19
9850	稀釋每股盈餘	\$ 3.16	\$ 3.04	\$ 1.33	\$ 1.17

後附之附註係本合併財務報表之一部分。
(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司及子公司

合併股東權益變動表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

代碼	股本			保留盈餘	
	普通股股本	預收股本	資本公積	法定盈餘公積	
A1 九十八年一月一日餘額	\$ 56,904,278	\$ 3,387	\$ 6,373,287	\$ 2,915,029	
九十七年度盈餘分配					
N1 提列法定盈餘公積	-	-	-	616,005	
P1 普通股現金紅利 -5.0%	-	-	-	-	
S5 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	-	1,369	-	
J8 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	160,895	-	
Q7 現金流量避險未實現損益增減	-	-	-	-	
G1 員工認股權行使	74,245	131,818	32,726	-	
M1 九十八年度合併總純益	-	-	-	-	
S1 少數股權增減	-	-	-	-	
R5 外幣財務報表換算產生兌換差額增減	-	-	-	-	
R1 未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	
J1 庫藏股票買回 -109,274千股	-	-	-	-	
J3 庫藏股票註銷 -217,974千股	(2,179,740)	- (234,522)	-	-	
Z1 九十八年十二月三十一日餘額	54,798,783	135,205	6,333,755	3,531,034	
九十八年度盈餘分配					
N1 提列法定盈餘公積	-	-	-	674,455	
P5 盈餘轉增資 -8.4%	4,615,775	-	-	-	
P1 普通股現金紅利 -3.6%	-	-	-	-	
E3 資本公積轉增資	879,195	- (879,195)	-	-	
S5 採權益法評價之被投資公司股權淨值增減	-	- (9,510)	-	-	
Q5 備供出售金融資產未實現損益增減	-	-	-	-	
J7 子公司處分母公司股票視同庫藏股交易	-	-	1,271,532	-	
K5 處分長期股權投資	-	- (1,472)	-	-	
J8 發放予子公司股利調整資本公積	-	-	37,536	-	
Q7 現金流量避險未實現損益增減	-	-	-	-	
L1 員工認股權	-	-	319,147	-	
G1 員工認股權行使	226,119	164,493	108,792	-	
M1 九十九年度合併總純益	-	-	-	-	
S1 少數股權增減	-	-	-	-	
T1 收購子公司股權後少數股權變動影響數	-	-	-	-	
R5 外幣財務報表換算產生兌換差額增減	-	-	-	-	
R1 未認列為退休金成本之淨損失增減	-	-	-	-	
J1 庫藏股票買回 -37,000千股	-	-	-	-	
Z1 九十九年十二月三十一日餘額	\$ 60,519,872	\$ 299,698	\$ 7,180,585	\$ 4,205,489	

後附之附註係本合併財務報表之一部分。

(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

單位：新台幣千元

股東權益其他項目								
保留盈餘		金融商品		累積換算		未認列為退休金		
未分配盈餘	合計	未實現損益		調整數		成本之淨損失	庫藏股票	少數股權
\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
6,306,375	9,221,404	(439,438)		4,873,957		(230,401)	(7,034,480)	2,288,748
(616,005)	-	-		-		-	-	-
(2,736,568)	(2,736,568)	-		-		-	-	(2,736,568)
27	27	380,464		-	8,793	-	-	390,653
-	-	-		-	-	-	-	160,895
-	-	84,472		-	-	-	-	84,472
-	-	-		-	-	-	-	238,789
6,744,546	6,744,546	-		-	-	-	158,922	6,903,468
-	-	-		-	-	-	213,335	213,335
-	-	-	(1,597,449)	-	-	-	433,118	(1,164,331)
-	-	-		- (27,033)	-	-	3,545	(23,488)
-	-	-		-	- (1,314,273)	-	- (1,314,273)	
-	-	-		-	-	2,414,262	-	-
9,698,375	13,229,409	25,498		3,276,508	(248,641)	(5,934,491)	3,097,668	74,713,694
(674,455)	-	-		-	-	-	-	-
(4,615,775)	(4,615,775)	-		-	-	-	-	-
(1,978,190)	(1,978,190)	-		-	-	-	- (1,978,190)	
-	-	-		-	-	-	-	-
-	-	124,744		- (22,109)	-	-	-	93,125
-	-	(9,290)		-	-	-	(2,467) (11,757)	
-	-	-		-	-	3,975,384	-	5,246,916
-	-	-		-	8	-	- (1,464)	
-	-	-		-	-	-	-	37,536
-	-	105,351		-	-	-	-	105,351
-	-	-		-	-	-	-	319,147
-	-	-		-	-	-	-	499,404
18,337,500	18,337,500	-		-	-	-	857,389	19,194,889
-	-	-		-	-	-	(453,713) (453,713)	
-	-	-		-	-	-	(130,034) (130,034)	
-	-	-	(4,397,126)	-	-	-	(82,906) (4,480,032)	
-	-	-		- (127,361)	-	-	(2,981) (130,342)	
-	-	-		-	- (1,185,205)	-	- (1,185,205)	
\$ 20,767,455	\$ 24,972,944	\$ 246,303	(\$ 1,120,618)	\$ 398,103	\$ 3,144,312	\$ 3,282,956	\$ 91,839,325	

董事長：張虔生



經理人：張洪本



會計主管：董宏思





日月光半導體製造股份有限公司及子公司
合併現金流量表

民國九十九及九十八年一月一日至十二月三十一日

單位：新台幣千元

代碼		九十九年度	九十八年度
	營業活動之現金流量		
A10000	合併總純益	\$ 19,194,889	\$ 6,903,468
A20000	調整項目		
A20300	折舊費用	18,473,333	16,775,929
A20400	攤銷費用	1,381,140	862,153
A21200	股份基礎給付酬勞成本	319,147	-
A22200	存貨跌價、報廢及呆滯損失	340,268	191,904
A22400	權益法認列之投資收益	(72,980)	(330,117)
A22500	收到權益法被投資公司現金股利	20,589	82,299
A24800	遞延所得稅費用	55,764	229,744
A29900	其他調整項目	(86,857)	417,533
A30000	營業資產及負債之淨變動		
A31110	交易目的金融資產增加	(75,120)	(487,231)
A31140	應收帳款增加	(1,248,494)	(6,470,810)
A31160	其他應收款增加	(617,803)	(129,022)
A31180	存貨增加	(2,171,624)	(1,509,143)
A31190	存貨—營建房地增加	(2,874,177)	(6,107,080)
A31211	其他流動資產增加	(132,716)	(411,045)
A32110	交易目的金融負債增加(減少)	410,778	(8,346)
A32140	應付帳款增加	1,656,567	3,786,668
A32160	應付所得稅增加(減少)	1,462,879	(83,789)
A32170	應付費用增加	2,239,267	259,250
A32200	預收房地款增加(減少)	(1,466,097)	1,507,472
A32212	其他流動負債增加	156,341	37,391
AAAA	營業活動之淨現金流入	<u>36,965,094</u>	<u>15,517,228</u>
	投資活動之現金流量		
B00300	取得備供出售金融資產	(16,670,994)	(42,695,001)
B00400	處分備供出售金融資產價款	20,883,928	38,971,185
B00500	購買無活絡市場之債券投資	-	(97,740)
B00600	處分無活絡市場之債券投資價款	-	450,000
B00900	取得以成本衡量之金融資產	(42,892)	(154,544)
B01000	處分以成本衡量之金融資產價款	28,556	3,203
B01400	採權益法之長期股權投資增加		(\$84,000)
B01600	取得子公司股權價款淨額	(6,181,583)	-
B01800	採權益法之被投資公司減資退回股款	3,169	-
B01900	購置固定資產	(34,109,113)	(11,445,621)
B02000	處分固定資產價款	261,010	93,116
B02500	存出保證金(增加)減少	255,260	(246,280)
B02700	其他應收款(增加)減少	450,000	(450,000)
B02800	受限制資產(增加)減少	(17,834)	13,851
B02900	無形資產增加	(231,813)	(1,020)
B04800	其他資產增加	(713,149)	(337,864)
BBBB	投資活動之淨現金流出	<u>(36,085,455)</u>	<u>(15,980,715)</u>
	融資活動之現金流量		
C00100	短期借款增加(減少)	(2,714,111)	4,245,726
C00500	償還公司債	-	(1,375,000)
C00900	舉借長期借款	32,586,219	31,145,664
C01000	償還長期借款及應付租賃款	(25,792,377)	(33,385,917)
C01600	存入保證金增加(減少)	(2,269)	28,800
C02100	母公司發放現金股利(扣除子公司獲配數)	(1,940,654)	(2,575,673)
C02400	員工執行認股權	499,404	238,789
C02500	庫藏股票買回成本	(1,185,205)	(1,314,273)
C03300	少數股權增加	250,448	213,335
CCCC	融資活動之淨現金流入(出)	<u>1,701,455</u>	<u>(2,778,549)</u>
DDDD	匯率影響數	(1,741,031)	(339,400)
EEEE	本年度現金及約當現金淨增加(減少)金額	840,063	(3,581,436)
E00100	年初現金及約當現金餘額	<u>22,557,494</u>	<u>26,138,930</u>
E00200	年底現金及約當現金餘額	<u>\$ 23,397,557</u>	<u>\$ 22,557,494</u>
	現金流量資訊之補充揭露		
F00100	本期支付利息	\$ 1,683,056	\$ 1,832,333
F00200	減：資本化利息	296,827	173,169
F00300	不含資本化利息之本年度支付利息	<u>\$ 1,386,229</u>	<u>\$ 1,659,164</u>

代碼		九十九年度	九十八年度
F00400	支付所得稅	\$ 2,110,097	\$ 1,338,967
同時影響現金及非現金項目之投資活動			
H00300	固定資產增加數	\$ 34,761,050	\$ 12,631,932
H00500	應付購買設備款增加	(651,937)	(1,186,311)
H00800	購買固定資產支付現金數	\$ 34,109,113	\$ 11,445,621
H00900	出售固定資產價款	\$ 290,165	\$ 115,263
H01000	其他應收款增減－出售固定資產	(29,155)	(22,147)
H01100	出售固定資產收取現金數	\$ 261,010	\$ 93,116
不影響現金流量之融資活動			
G00100	一年內到期長期負債	\$ 2,990,176	\$ 923,284
G00200	一年內到期應付租賃款	28,838	12,055

本公司及子公司於九十九年二月以總價款13,475,056千元共同收購環電60.07%股權，併購日所支付之淨現金及環電之合併資產與負債之公平價值分別列示如下：

流動資產	\$ 29,599,348
基金及投資	497,508
固定資產	6,866,077
其他資產	4,743,627
流動負債	(19,490,014)
長期借款(含一年內到期)	(100,000)
其他負債	(333,735)
少數股權	(32,142)
乘以取得股權百分比	21,750,669
	60.07%
商譽	13,065,626
併購總價款	409,430
減：以庫藏股交換	13,475,056
	(5,246,916)
減：併購日取得之現金	8,228,140
	(8,842,323)
取得環電股權之淨現金流入	(\$ 614,183)

本公司嗣於九十九年八月以現金4,667,117千元再收購環電20.8%股權。

另本公司於九十九年八月以美金72,163千元透過子公司ASE Singapore Pte. Ltd. (ASE Singapore) 向EEMS Asia Pte. Ltd.收購其子公司EEMS Test Singapore Pte. Ltd. 100%股權，併購日所支付之淨現金及所取得資產與負債之帳面價值如下：

流動資產	\$ 653,487
固定資產	1,352,212
其他資產	145,239
流動負債	(102,224)
長期借款(含一年內到期)	(105,773)
商譽	1,942,941
併購總價款	361,384
減：併購日取得之現金	2,304,325
	(175,676)
取得子公司股權之淨現金流出	\$ 2,128,649

後附之附註係本合併財務報表之一部分。(參閱勤業衆信聯合會計師事務所民國一〇〇年三月十七日查核報告)

董事長：張虔生

經理人：張洪本

會計主管：董宏思

六、公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止，發生財務週轉困難之情事：無。

柒、財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項

一、財務狀況：最近二年度資產、負債及股東權益發生重大變動之主要原因及其影響，若影響重大者應說明未來因應計畫。

- (一)固定資產增加主要係本期營運成長致購置固定資產增加所致。
- (二)資產總額增加主要係本期營運成長致購置固定資產增加及長期投資因併購環電增加所致。
- (三)流動負債增加主要係擴充購置固定資產增加及併購環電，是以向子公司融通資金致其他應付款項增加所致。
- (四)長期負債增加主要係本期因應營運成長購置固定資產及環電併購所需資金之長期借款增加。
- (五)保留盈餘較上年度增加，主要係本年度獲利較上年度增加及配發上年度盈餘金額較少所致。

二、經營結果：最近二年度營業收入、營業純益及稅前純益重大變動之主要原因及預期銷售數量與其依據，對公司未來財務業務之可能影響及因應計畫。

- (一)營業收入增加主係本年度全球景氣回溫及開發新製程投入生產致市佔率增加所致。
- (二)稅前純益增加主係本年度全球景氣回溫及開發新製程投入生產致市佔率增加，以及依權益法認列之投資收益增加所致。

三、現金流量：最近年度現金流量變動之分析說明、流動性不足之改善計畫及未來一年現金流動性分析。

(一)最近年度現金流量分析

現金流量比率及現金再投資比率增加，主因係本期淨利之現金流入較上年度增加所致。

(二)未來一年現金流動性分析

單位：新台幣仟元

年初現金餘額①	預計全年來自營業活動 淨現金流量②	預計全年現金流出量③	預計現金剩餘(不足)數額 ①+②-③	預計現金不足額之補救措施	
				投資計劃	理財計劃
\$ 1,632,102	\$ 21,409,034	(\$ 19,448,473)	\$ 3,592,663	—	—

1. 現金流量變動情形分析

- (1)營業活動：預計100年度營業淨利增加、營業資產及負債淨變動所產生之淨現金流入增加所致。
- (2)投資活動：預計100年度購置固定資產。
- (3)融資活動：預計100年度將償還部份銀行借款及母子公司間資金貸與款項。

2. 預計現金不足額之補救措施及流動性分析：無。

四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：

(一)重大資本支出之運用情形及資金來源

單位：新台幣仟元

計劃項目	實際或預期之資金來源	實際或預期完工日期	所需資金總額	實際或預定資金運用情形	
				一〇〇年度	
擴建廠房	營運資金及銀行借款	100.12	2,675,004		2,675,004
購置機器設備	銀行借款及營運資金	100.12	10,396,883		10,396,883

本公司截至目前為止對於未來二至五年之資本支出及預計可能產生效益情況尚無法合理估計。

(二)預計可能產生效益

A. 預計將增加之產銷量、值及毛利

單位：數量仟個／新台幣仟元

年度	項目	生產量	銷售量	銷售額	毛利
一〇〇	半導體製造封裝	3,288,478	3,288,478	12,181,411	3,275,207
一〇〇	半導體製造測試	14,595	14,595	193,747	119,034

註：僅針對一〇〇年度重大之資本支出於一〇〇年度預計產生之效益估算。

B. 其他效益說明：無。

五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫：

本公司最近年度之轉投資政策主要係以大陸投資事業之投資為主，並以核心競爭力為主要考量，對每一投資案皆經審慎評估後為之。有關大陸地區投資九十七年度依經濟部九十七年八月二十九日經審字第09704604680號令修正發布並自同年八月一日生效之「在大陸地區從事投資或技術合作審查原則」第參點修正案，由於本公司係取得經經濟部工業局核發符合營運總部營業範圍證明文件並具跨國企業條件之公司，是以對大陸地區投資金額無上限之規定。

本公司轉投資事業普遍均經營良善，有不等之獲利狀況，部分投資公司產生虧損或因處於初期發展階段，或因階段任務完成，計劃結束營業之故，相信經一段時日，即可獲得改變。

六、風險事項分析評估：

(一)最近年度利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：

金融風暴後，2010年全球經濟逐漸復甦，部分國家因為當地通膨數據升溫，各國央行逐步調高利率，我國中央銀行亦於6月起啓動升息。有鑑於市場之資金成本上升之趨勢，公司未來將持續以維持低融資成本，達到降低利息支出為主要操作方向，採舉借利率相對較低之借款幣別及融資工具，且評估融資成本將現有之借款進行再融資或提前清償之策略。對於匯率變動之風險管理策略，未來將以鎖定國際經濟事件並觀察其變化為管理焦點、降低市場波動性風險為主要管理方向。配置低風險、短天期、安全且避險性高之投資標的為主要方針，並檢視公司資金配置，達有效管理之目標。因此，避險策略以採短天期現金流量避險為主，對長天期之資本支出或經常性風險部位，則採自然避險為原則。因全球景氣逐漸復甦，各國的通膨升溫，恐導致原物料持續漲價，則公司之經營成本會墊高，將以更有效率之管理提高產品良率及品質，降低耗損，以減低對公司獲利之不利影響。

(二)從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：

本公司並未從事高風險、高槓桿之投資，本公司已依據證期局的相關法令及規定，訂定了以健全財務及營運為基礎的內部管理辦法及作業程序。這些管理辦法包括「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」(含衍生性金融商品處理程序)及「背書保證作業程序」。對於背書保證之政策，則以事先評估其必要性及合理性為執行依據；對於衍生性商品交易政策，均視避險標的之部位大小與避險之必要性，於自然避險後採取適時適量之穩健避險方式執行財務風險管理，並經適當授權及簽呈核准。

(三)未來研發計畫及預計投入之進度與研發費用：

1. 未來研發計劃

封裝技術

	New Package
先進封裝 (APT)	1. 晶粒-晶粒、晶粒-晶圓堆疊技術 (Die-to-Die, Die-to-Wafer Stacking)
	2. 微間距銅柱覆晶封裝技術 (Fine Pitch Cu Pillar FC Solution)
	3. 砂材基板系統封裝技術 (Si Interposer SiP Technology)
	4. 熱壓融接技術 (Thermo-compression Bonding Technology)
	5. 晶圓級微機電封裝 (Wafer Level MEMS Packaging)
	6. DDR3、DDR4封裝測試方案 (DDR3, DDR4 Assembly and Test Solution)
光電封裝 (OEP)	1. 高功率、高亮度LED封裝方案 (High Power/High Brightness LED Packaging Solution)
	2. 晶圓級白光LED封裝方案 (Wafer Level White Light LED Packaging Solution)
	3. 光感測元件透明封膠技術 (ALS Clear Compound Packaging Solution)
晶圓級封裝 (WLCSP)	1. 晶圓穿導孔技術 (Through Silicon Via)
	2. 砂基板封裝技術 (Silicon Substrate Technology)
	3. 疊層晶圓之薄化技術 (Bonded Wafer Thinning Technology)
	4. 雙層PI晶圓RDL電鍍銅技術 (2-layer PI, Cu-Plated RDL Technology)
	5. 300mm二維外引腳式晶圓級封裝 (300mm Wafer 2D Fan-out WLP)
	6. 200mm 三維外引腳式晶圓級封裝 (200mm Wafer 3D Fan-out WLP)

New Package	
覆晶封裝 (Flip Chip)	1.綠色環保覆晶封裝(Flip Chip Green Package Solution)
	2.無核心層機板之覆晶封裝(Coreless Flip Chip Package)
	3.45/40奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(45/40 nm Cu/ELK Lead-free FC Solution)
	4.32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之無鉛覆晶封裝(32/28 nm ELK Wafer Lead-free FC)
	5.300mm晶圓50微米厚度研磨技術(300 mm Wafer 50um Backgrind Technology)
	6.300mm晶圓穿導孔晶圓50微米厚度CMP研磨技術(300 mm TSV Wafer 50um CMP Technology)
	7.銅製程/超低介電常數薄晶圓之隱匿式雷射切割技術(SD Laser Technology on Thin ELK Wafer)
	8.微間距非導電覆晶薄膜底材(Fine Pitch NCF Underfill Technology)
	9.壓合式晶圓級覆晶封技術(Laminated FC CSP)
系統封裝 (SiP)	1.內引腳式Map PoP堆疊技術(Fan-in Map PoP Technology)
	2.外引腳式Map PoP堆疊技術(Fan-out Map PoP Technology)
	3.薄基板核層覆晶PoP堆疊技術(Thin Core FC PoP Technology)
	4.整合被動元件封裝技術(Integrated Passive Device)
	5.整合電阻動元件封裝技術(Integrated Passive Resistor Device)
	6.有機基板內埋被動元件技術(Embedded Passives Laminate Substrate)
	7.矽材基板內埋被動元件技術(Embedded Passive Si Substrate)
	8.矽材基板內埋主動元件技術(Embedded Active Si Substrate)
	9.異質晶片整合系統封裝(Heterogeneous Chip Integration SiP)
	10.微間距面對面堆疊系統封裝(Fine Pitch CoC SiP Solution)
射頻模組 (RF Module)	1.Blue Tooth模組完整方案(BT Module Total Solution)
	2.Wi-Fi模組完整方案(Wi-Fi Module Total Solution)
	3.GPS模組完整方案(GPS Module Total Solution)
	4.Conformal/Compartment式電磁干擾遮敝方案(Conformal/Compartment EMI Shielding Solution)
	5.有機基板內埋被動元件通訊模組(Embedded Substrate Wireless Module)
鍍線封裝 (Wire Bond Package)	1.28/22奈米銅製程/超低介電係數晶圓之鍍線封裝(28/22 nm Cu/ELK Wafer Wire Bond Solution)
	2.18微米銅線製程開發(18 um Cu Wire Bond Technology Development)
	3.32/28奈米銅製程/超低介電係數晶圓之銅鍍線封裝(32/28 nm Cu/ELK Wafer Cu Wire Bond)
	4.雷射晶圓切割技術(Laser Wafer Grooving Technology)
	5.低成本、高效能aQFN封裝方案(Low Cost, High Performance aQFN Packaging Solution)

Bumping

印刷製程 (Printing)	1.晶圓PI凸塊技術(Wafer Bumping Technology with PI Bump)
	2.無助焊劑晶圓凸塊技術(Fluxless Wafer Bumping Technology)
	3.多層PI晶圓凸塊技術(Wafer Bumping Technology with Multi-PI-Layers)
	4.300mm凸塊晶圓75微米厚度研磨技術(300 mm Bumped Wafer 75 um Backgrind Technology)
電鍍製程 (Plating)	1.錫銀無鉛電鍍晶圓凸塊技術(Sn/Ag Lead-Free Bump Plating Technology)
	2.40微米微間距銅柱凸塊晶圓電鍍技術開發(40 um Fine Pitch Cu Pillar Wafer Bumping)
	3.高深寬比銅柱電鍍凸塊技術(High Aspect Ratio Cu Pillar Plating Technology)
	4.高長寬比銅柱凸塊技術(Non-circular High Aspect Ratio Cu Pillar Bumping)

測試技術

New Test Technology

晶圓測試 (Wafer probe)	12吋晶圓測試能力與技術(12" Wafer probe testing capability & Technology)
	1.晶圓凸塊垂直探針技術(Wafer Bumping vertical probing Technology)
	2.射頻晶圓測試技術(RF wafer probing Testing Technology)
後段封裝測試 (Final Test)	3.超低介電係數晶圓測試方案(Ultra Low K wafer probing Solution)
	1.射頻藍芽無線產品測試技術(RF Bluetooth/wireless device testing technology)
	2.箇入式與堆疊式記憶體測試能力(Embedded/stack memory testing capability)
	3.邏輯電路/消費性元件測試服務(Logic/consumer Device Testing Service)
	4.多工並列元件測試能力(Multiple site testing capability)
	5.三重溫度測試技術(Tri-temp testing technology)
	6.超高速介面元件測試技術(USB3.0 testing technology)
	7.微機電產品測試技術(MEMS testing technology)

2. 預計再投入之進度與研發費用

封裝試產預計投入之研發費用為新台幣200,000仟元，另其他封裝研發費用預計投入新台幣2,300,000仟元。

測試試產預計投入之研發費用為新台幣23,500仟元，另其他測試研發費用預計投入新台幣1,000仟元。

3. 未來研發得以成功之主要影響因素

- 先進封裝技術能力的建立並與現有封裝技術整合
- 現有封裝技術低成本最佳化方案
- 產業鏈整合暨流程、製程標準化
- 關鍵新設備量產化驗證暨即時導入
- 封裝、測試、基板、模組、系統整合能力的建立與深耕
- 基板、元件、模組設計能力的建立與深耕
- 完善的產品研發流程及專案管理系統
- 結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 充分掌握市場行銷之供需狀況，並依據市場分析結果，先行開發先進技術以確保技術領先地位，適時提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案
- 研發人才培育機制之強化
- 知識管理系統之落實與強化
- 強化智慧財產權策略與管理
- 符合環保法規之產品設計
- 研發效益、研發風險、時程及人員能夠有效管控
- 標竿客戶產品藍圖並和客戶策略聯盟資源共享降低研發風險
- 依據市場分析結果，先行開發先進Substrate技術以確保技術領先地位
- 客戶導向的組織設計與內部運作機制
- 晶片-封裝體-系統一元化設計 (IC-package-system Co-design)

(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 本公司設有專責人員隨時注意國內外重要政策及法律變動之情形，負責適時諮詢法務及會計等相關專家之評估、建議及規劃因應措施。
2. 立法院於九十九年四月十六日通過「產業創新條例」，其中第十條規定公司得在投資於研究發展支出15%限度內，抵減當年度應納營利事業所得稅，並以不超過當年度應納營利事業所得稅30%為限，該條例之施行期間自九十九年一月一日起至一〇八年十二月三十一日止。
3. 立法院九十九年五月修正所得稅法調降利事業所得稅稅率為17%，並自九十九年度施行，其對國內所得稅費用將有下降的作用。
4. 我國行政院金融監督管理委員會於98年5月14日宣布之我國會計準則直接採用IFRS之推動架構。同時，依照台灣證券交易所98年6月8日臺證治字第0980012027號之規定，本公司應按季將採用IFRS之因應計畫暨執行情形提報董事會控管。本公司為上市公司，依主管機關規定屬第一階段採用者，應於2011年度、2012年期中及年度財務報告附註揭露採用IFRS之計畫及影響等事項。本公司為因應採用IFRS編製財務報告，已成立專案小組負責推動IFRS之轉換計畫，且轉換計畫之部分活動也委由外部專家協助進行，並且按季提報董事會採用IFRS之因應計畫暨執行情形。

(五) 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：

1. 經濟的不確定性(Uncertainty)與不連續性之影響：經濟的不確定性(Uncertainty)與不連續性為半導體產業的一大挑戰。因應措施是日月光透過與客戶及廠商的共同開發來符合客戶需求與降低成本，並強化市場資訊的蒐集與分析來降低科技改變所帶來的影響。
2. 客戶市場競爭力與上市時程需求之影響：客戶市場競爭力與上市時程是新技術研發是否順利上市之關鍵。因應措施為充分掌握市場行銷之供需狀況，並依據市場分析結果規畫標竿客戶產品藍圖，先行開發關鍵技術暨專利以確保技術領先地位，結合產品開發和現有生產設備相容性以降低研發成本，提供客戶新產品上市時程之最佳解決方案。日月光定期拜訪產業領先客戶，透過技術研討會標竿客戶產品藍圖與產品規範，確保研發技術能符合客戶上市需求。

3. 研發經費暨資源之影響：新技術研發創新的經驗中，開發經費與關鍵新設備扮演重要一環。因應措施為確保新技術和日月光未來藍圖發展一致，並積極和客戶策略聯盟資源共享以降低研發風險。

(六)企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：

本公司一向秉持誠信、守法及善盡社會責任之經營理念，故本公司之企業形象一向良好，最近年度亦無企業形象改變之情事。

(七)進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：

本公司為強化與轉投資事業環隆電氣股份有限公司(下稱「環隆電氣」)技術整合效益及活化子公司資產之目的，於2009年11月17日董事會中通過以現金及子公司J&R Holding Limited與ASE Test Limited所分別持有之本公司普通股合計306,596,000股作為對價，透過公開收購方式收購環隆電氣流通在外之所有普通股，本公司(含子公司)並已於2010年2月9日完成該公開收購案，共收購環隆電氣流通在外股份641,669,316股，收購金額約新台幣135億元，若加計本公司(含子公司)原持有環電18.1%股份計算，本公司(含子公司)持有環隆電氣之股份已達78.1%。本公司為持續強化與環隆電氣在無線通訊SiP模組之技術整合效益，進而取得本公司在SiP產業未來競爭勝出之關鍵優勢，並提高本公司對環隆電氣之持股比例於2010年4月19日經董事會決議通過同意環隆電氣之股票終止上市申請案，同時承諾收購環隆電氣之股票，本公司並已於2010年8月5日完成該公開收購案，共收購環隆電氣流通在外股份222,243,661股，收購金額約新台幣47億元，若加計本公司(含子公司)原持有環電78.1%股份計算，本公司(含子公司)持有環隆電氣之股份已達99.1%。由於手持式的消費性電子設備不斷推陳出新，包括手機、MP3、PND、PMP等產品除希望能達到更輕薄短小、更省電、更可靠以及更省成本等目標外；同時在功能面上亦往往需要具備Wi-Fi、藍芽、GPS、Mobile TV、FM radio、WiMAX等無線通訊能力。為了滿足這些需求，無線通訊SiP模組(Wireless SiP Module)成為市場上備受矚目的解決方案。本公司(含子公司)於取得環隆電氣99.1%股權後，將結合本公司先進的封裝技術及環隆電氣於無線通訊產品及小型系統模組之經驗，預計將可達到本公司上下游整合之效益，進而取得在SiP產業未來競爭勝出的關鍵優勢。

(八)擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：

由於半導體市場成長前景樂觀，預計日月光集團2011年之成長幅度會超越2010年的成長率。至於投資部分，鑑於落實現有產能之充分及有效利用，日月光集團前幾年在產能上之擴充已能滿足部分成長之訂單，為提昇實質報酬率並降低投資風險，對於市場之成長乃以現有產能與設備為主，新設備之投資案，除因應新廠房之使用外，將以市場實際需求之必要性再做新投資的考量。

(九)進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：

1. 進貨過度集中容易因為供應端的生產異常或品質異常造成斷料，同時削減對供應端的議價能力，本公司對於直接材料、機器設備等供貨來源，訂定有分散供應來源的政策，針對少數供應集中的資材進行開發替代廠商(2nd Source)；另外對於市場寡佔的國外供應來源，積極培植具技術研發潛力的國內協力廠商供貨，以達分散風險、降低成本的企業目標。
2. 本公司銷貨並無過度集中之情事。

(十)董事、監察人或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十一)經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。

(十二)訴訟或非訟事件：無。

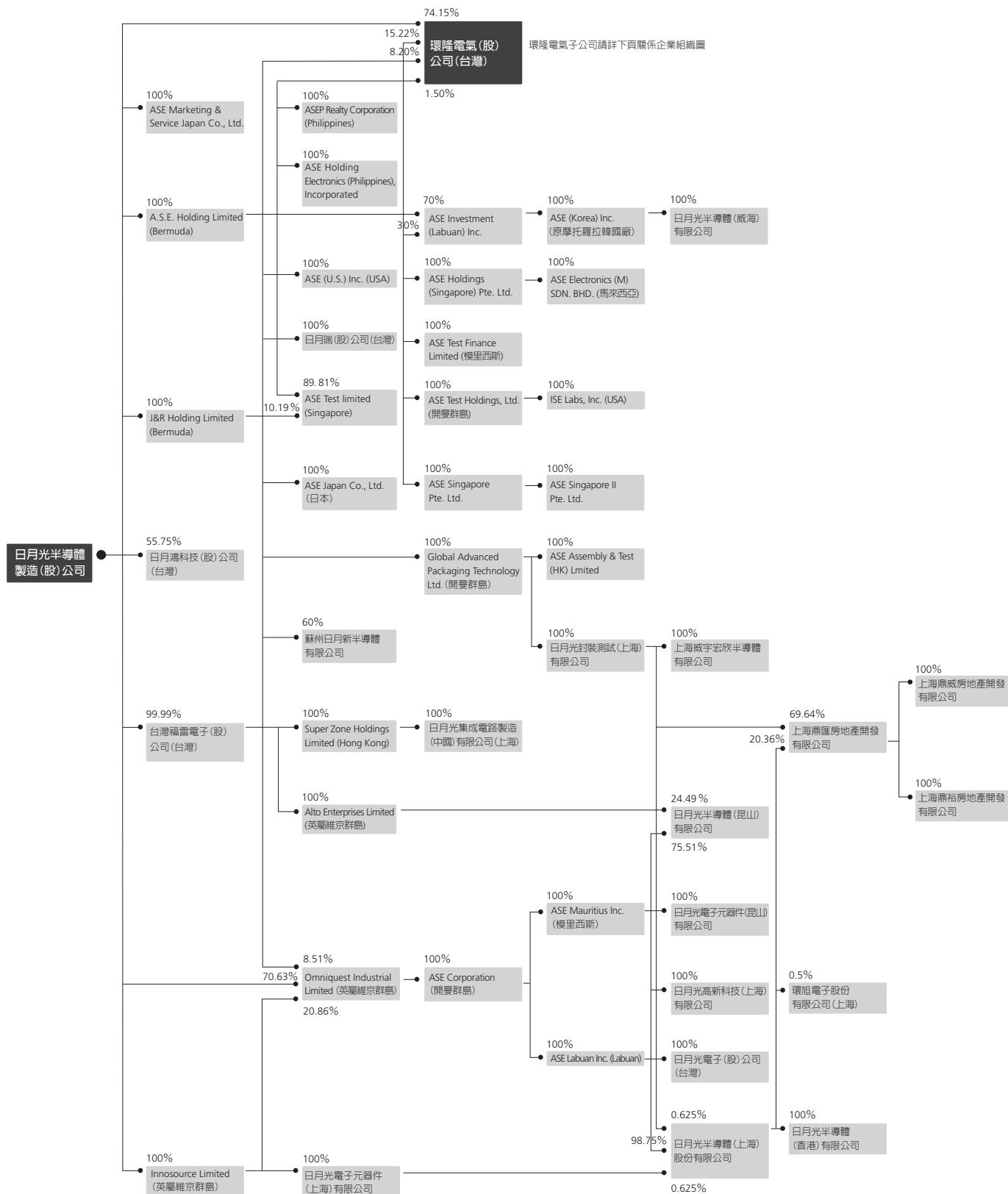
(十三)其他重要風險及因應措施：無。

七、其他重要事項：無。

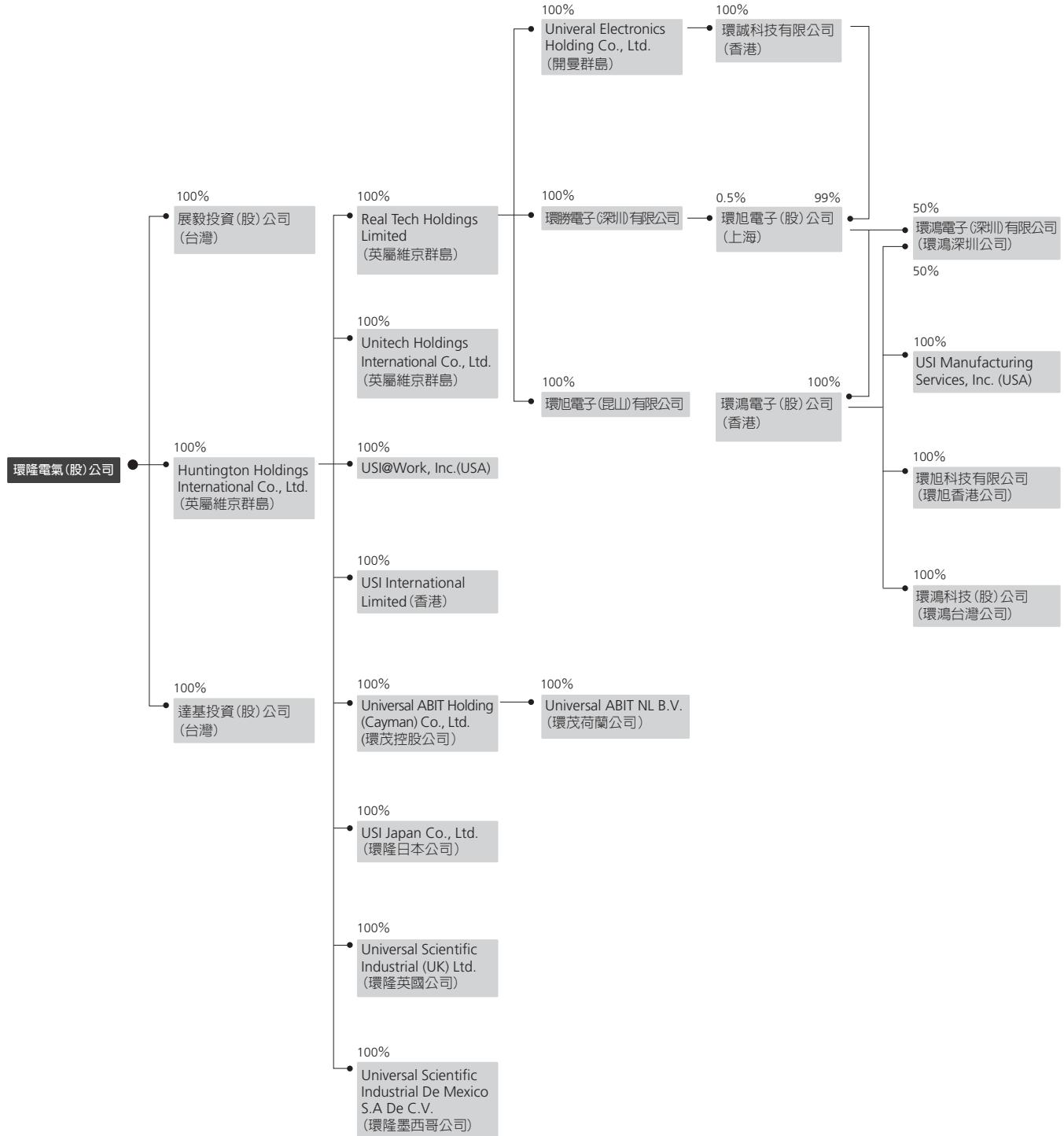
捌、特別記載事項

一、關係企業相關資料

(一) 關係企業組織圖(99.12.31)



子公司環隆電氣股份有限公司
關係企業組織圖 (99.12.31)



(二)各關係企業基本資料

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
日月光半導體製造(股)公司	73年3月	高雄市楠梓加工出口區經三路二十六號	NT\$60,519,872仟元	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASE Corporation	95年3月	Walkers SPV Limited, Walker House, Mary Street, P.O.Box 908 GT, Grant Cayman, Cayman Islands	NT\$11,425,922仟元 (USD\$352,784仟元)	從事專業性投資
日月光半導體(上海)公司	90年12月	上海張江高科園區金科路2300號	NT\$3,984,000仟元 (USD\$122,800仟元)	從事半導體材料製造業務
日月光電子股份有限公司	95年3月	高雄市楠梓加工出口區開發路73號	NT\$3,989,819仟元	電子材料批發業，電子材料零售業，國際貿易業
日月光半導體(昆山)有限公司	93年8月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大樓北側	NT\$3,087,300仟元 (USD\$98,000仟元)	從事半導體材料製造及半導體產品封裝測試業務
日月光高新科技(上海)有限公司	95年1月	上海市浦東康橋工業區康橋東路1號辦公樓201室	NT\$486,645仟元 (USD\$15,000仟元)	從事新型電子元器件產銷及提供技術支援服務
日月光電子元器件(昆山)有限公司	96年1月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側中央大樓北側	NT\$199,770仟元 (USD\$6,000仟元)	從事新型電子元器件產銷及提供技術支援服務
ASE Labuan Inc.	95年3月	Labuan F.T. Malaysia	NT\$4,099,954仟元 (USD\$126,184仟元)	從事專業性投資
ASE Mauritius Inc.	95年4月	608, St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Republic of Mauritius	NT\$7,046,629仟元 (USD\$217,800仟元)	從事專業性投資
日月光半導體(香港)有限公司	97年4月	RMS 2702-3, 27/F Bank of EAST ASIA Harbour view Centre, 56 Gloucester RD, Wan Chai, HK	NT\$32,130仟元 (USD\$1,000仟元)	從事貿易活動
ASE Test Limited (Singapore)	84年12月	36 Robinson Road. #18-01, City House, Singapore	NT\$659,075仟元 (USD\$27,356仟元)	從事專業性投資
ASE Electronics (M) Sdn. Bhd.	80年2月	Plot 20, Phase IV, Bayan Lepas Free Industrial Zone, 11900 Bayan Lepas, Penang	NT\$2,019,907仟元 (USD\$62,260仟元)	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ISE Labs, Inc.	72年11月	46800 Bayside Parkway Fremont, CA94538, U.S.A	NT\$852仟元 (USD\$26仟元)	半導體產品測試服務
ASE Singapore Pte. Ltd.	87年2月	2 Woodlands Loop Singapore 738074	NT\$984,851仟元 (USD\$30,056仟元)	半導體產品測試服務
ASE Singapore II Pte. Ltd.	93年7月	Blk 211 Woodlands Avenue 9, Woodlands East Industrial Estate, #01-86, Singapore 738960	NT\$873,174仟元 (USD\$27,200仟元)	半導體產品測試服務
ASE Test Holdings, Ltd.	88年4月	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.	NT\$162元 (USD\$5元)	從事專業性投資
ASE Holdings (Singapor) Pte. Ltd.	83年12月	10, Hoe Chiang Road, #17-02 Keppel Towers, Singapore	NT\$1,633,708仟元 (SGD\$71,429仟元)	從事專業性投資
ASE Test Finance Limited	88年6月	608 St. James Court, St. Denis Street, Port Louis, Mauritius	NT\$65元 (USD\$2元)	從事專業性理財活動
台灣福雷電子(股)公司	76年12月	高雄市楠梓加工出口區西五街十號	NT\$3,614,600仟元	半導體產品測試服務
ASE (Korea) Inc.	56年3月	494, Munbal-Ri, Kyoha, Paju-Si, Kyunggi-Do, Korea	NT\$1,232,071仟元 (USD\$37,976仟元)	電子零組件，通訊機械器材製造
ASE Japan Co., Ltd.	93年5月	1863, Iryuda,Takahata-machi, Higashikitamagun,Yamagata, 992-0324, Japan	NT\$105,802仟元 (¥ 360,000仟元)	積體電路之封裝及製造
日月光電子元器件(上海)有限公司	94年1月	上海市張江高科園區金科路2300號六號樓2層	NT\$389,316仟元 (USD\$12,000仟元)	從事新型電子元器件產銷及提供技術支援服務
日月光封裝測試(上海)有限公司	89年12月	上海張江高科園區郭守敬路669號	NT\$6,501,336仟元 (USD\$203,580仟元)	半導體產品封裝及測試業務
日月鴻科技股份有限公司	95年6月	桃園縣中壢市中華路一段556號9樓	NT\$2,433,976仟元	從事電腦零組件、電腦及週邊設備、其他電機及電子機械器材、電子材料批發及零售業、國際貿易、其他顧問服務及租賃業務
蘇州日月新半導體有限公司	90年5月	蘇州工業園區蘇虹西路188號	NT\$1,568,467仟元 (USD\$48,672仟元)	從事半導體封裝測試及技術諮詢服務
日月光半導體(威海)有限公司	90年12月	威海市經濟技術發展區出口加入區海南路16-1號	NT\$1,500,454仟元 (USD\$47,200仟元)	一般類之分離件封裝及測試

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
上海威宇宏欣半導體有限公司	95年12月	上海浦東華東路5001號T3-11-105	NT\$337,499仟元 (RMB\$76,000仟元)	半導體產品封裝及測試業務
日月光集成電路製造(中國)有限公司	99年7月	上海市浦東新區華東路5001號T3-10-202室	NT\$3,082,400仟元 (USD\$100,000仟元)	從事半導體封裝及測試之市場行銷及客戶服務等業務
ASE Assembly & Test (HK) Limited	90年9月	34th Floor, The Lee Gardens, 33 Hysan Avenue, Causeway Bay, Hong Kong	NT\$4,159仟元 (USD\$128仟元)	從事貿易相關業務活動
GAPT-Cayman	89年10月	Walkers House 87 Mary Street, Grand Cayman, KY1- 9002, Cayman Islands	NT\$6,119,380仟元 (USD\$190,000仟元)	從事專業性投資
A.S.E Holding Limited (Bermuda)	79年2月	百慕達	NT\$7,915,000仟元 (USD\$243,966仟元)	從事專業性投資
J&R Holding Limited (Bermuda)	84年12月	百慕達	NT\$13,907,259仟元 (USD\$435,128仟元)	從事專業性投資
ASE Investment (Labuan) Inc.	88年6月	Lot 2 & 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kema-juan, 87000 Labuan, F.T. Labuan, Malaysia	NT\$5,870,460仟元 (USD\$180,947仟元)	從事專業性投資
Omniquest Industrial Limited	89年9月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$11,457,298仟元 (USD\$354,704仟元)	從事專業性投資
Innosource Limited	90年6月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$2,770,696仟元 (USD\$86,000仟元)	從事專業性投資
日月瑞(股)公司	88年4月	高雄市楠梓加工出口區內環北路107號	NT\$1,700,000仟元	各型積體電路封裝測試用機器設備及引線架機器設備之租賃等
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	92年11月	Sumitomo Fudosan Shinyokohama Bldg., 10F, 2-5-5, Shinyokohama, Kohoku-ku, Yokohama, Kanagawa, Japan 222-0033	NT\$18,298仟元 (¥ 60,000仟元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
ASE (U.S.) Inc.	72年12月	1255 E. Arques Ave. Sunnyvale, CA 94085, USA	NT\$649仟元 (USD\$20仟元)	從事市場行銷及顧客服務等業務
ASE Holding Electronics (Philippines), Incorporated	84年11月	Lot 3,4& 5, Block 7, First Cavite Industrial Estate, Bo. Langkaan, Dasmariñas, Cavite 4114	NT\$1,853,812仟元 (Peso\$2,423,733仟元)	各型積體電路之製造、組合、加工、測試及銷售
ASEP Realty Corporation (Philippines)	84年10月	Lot 3,4& 5, Block 7, First Cavite Industrial Estate, Bo. Langkaan, Dasmariñas, Cavite 4114	NT\$2,465仟元 (Peso\$2,000仟元)	房地產投資、買賣及出租
上海鼎匯房地產開發有限公司	94年8月	上海市浦東新區郭守敬路351號2號樓602A-04室	NT\$6,561,623仟元 (人民幣1,380,000仟元)	房地產項目開發、建設及商品房銷售物業管理
上海鼎威房地產開發有限公司	98年10月	上海市漕溪路270號1號樓338室	NT\$4,997,463仟 (人民幣1,068,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
上海鼎裕房地產開發有限公司	99年3月	上海市寶山區錦秋路48號E192	NT\$2,330,618仟元 (人民幣500,000仟元)	房地產開發經營、物業管理
Alto Enterprises Limited	99年3月	P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, British Virgin Islands	NT\$699,320仟元 (USD\$24,000仟元)	從事專業性投資活動
Super Zone Holdings Limited	97年6月	1408 World-Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Hong Kong	NT\$3,082,400仟元 (USD\$100,000仟元)	從事專業性投資活動
環隆電氣股份有限公司	63年2月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$10,885,087仟元	各種電腦資訊之週邊設備、厚膜混合積體電路、電子零件配件及個人電腦暨其零件之製造、加工與買賣
展毅投資(股)公司	85年10月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$393,297仟元	專業投資
達基投資(股)公司	87年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$50,000仟元	專業投資
Huntington Holdings International Co., Ltd. (HHI公司)	85年10月	Drake Chambers, Tortola, British Virgin Islands	NT\$8,223,156仟元 (US\$250,857仟元)	控股公司
Universal Scientific Industrial De Mexico S.A. De C.V. (環隆墨西哥公司)	86年9月	Anillo Periferico ManuelGomez Morin No 656R. Santa Isabel C.P. 44290Guadalajara, Jalisco, Mexico	NT\$2,063,716仟元 (US\$63,709仟元)	主機板及電腦系統組裝
Universal Scientific Industrial (UK) Ltd. (環隆英國公司)	87年4月	Steadman Place RiversideBusiness Park Irvine, AyrshireScotland UK KALL 5DN	NT\$1,291,062仟元 (GBP\$25,420仟元)	海外售後服務
USI Japan Co., Ltd. (環隆日本公司)	89年3月	8F West Tower, YokohamaBusiness Park, 134 Godo-cho, Hodogaya-ku, Yokohama-shi, Kanagawa 240-0005	NT\$27,231仟元 (JPY\$95,000仟元)	電腦資訊之週邊設備、積體電路、電子零件等之製造買賣
Real Tech Holdings Litimted (RTH公司)	89年3月	Trust Net Chambers, P.O. Box3444, Road Town, Tortola, B.V. I.	NT\$4,831,294仟元 (US\$149,151仟元)	控股公司

企業名稱	設立日期	地址	實收資本額	主要營業項目
環勝電子(深圳)有限公司 (環勝深圳公司)	89年7月	深圳市南山區高新技術產業園北區 環旭電子園	NT\$2,186,502仟元 (US\$67,000仟元)	生產經營電腦主機板、其他相關電腦週邊設備及通訊工業控制等產品之設計、製造及銷售
環旭電子股份有限公司 (環旭上海公司)	92年1月	上海市浦東新區張江高科技園區 張東路1558號	NT\$3,778,184仟元 (US\$116,731仟元)	提供電子產品設計製造服務、生產加工新型電子元器件、計算機高性能主機板、無線網路通信元器件、銷售自產產品及提供相關技術諮詢服務
環旭電子(昆山)有限公司 (環旭昆山公司)	94年8月	江蘇省昆山市千燈鎮黃浦江路東側 中央大道北側	NT\$383,201仟元 (US\$12,000仟元)	生產計算機輔助系統、無線網路通訊卡、計算機高性能主機板及銷售自產產品。
USI International Limited (UI公司)	89年2月	6F, UNITED CHINESE BANKBUILDING, 31-37 DES VOEUXROAD CENTRAL, HONG KONG	NT\$3,342仟元 (US\$101仟元)	主機板及相關電腦週邊設備之買賣
USI Manufacturing Service, Inc. (USI-CA公司)	89年10月	3600 PETERSON WAY, SANTA CLARA, CA95054, USA	NT\$314,015仟元 (US\$9,500仟元)	新型主機板組裝與製作、無線通訊產品製作、維修服務
USI@Work	89年12月	2000 REGENCY PARKWAY, SUITE420 CARY, NC 27518 USA	NT\$8,089仟元 (US\$250仟元)	海外售後服務
Unitech Holdings International Co., Ltd. (UHI公司)	85年10月	P.O. BOX 3321 ROAD TOWNTORTOLA BVI	NT\$111,256仟元 (US\$3,000仟元)	控股公司
USI Electronics Holdings Co., Ltd. (UEHC公司)	95年6月	MARQUEE PLACESUITE 300, 430 WEST BAYROADP.O. BOX 30691 GRAND CAYMAN KY1-1203 CAYMAN ISLANDS	NT\$5,093,180仟元 (US\$160,950仟元)	控股公司
Universal Global Technology Co., Limited (環鴻香港公司)	97年3月	RMS 2702-3 27/F, BANK OF EAST ASIA HAR- BOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTER RD, WAN CHAI, HK	NT\$321,315仟元 (US\$9,990仟元)	控股公司
USI Enterprise Limited(環誠科技公司)	96年11月	香港灣仔港灣道23號鷹君中心23字樓2303室	NT\$5,607,155仟元 (US\$160,900仟元)	控股公司
Universal ABIT Holding Co., Ltd. (環茂控股公司)	95年2月	P.O. BOX 30691 SMB, GRAND CAYMAN.	NT\$906,249仟元 (US\$28,125仟元)	控股公司
Universal ABIT NL B.V. (環茂荷蘭公司)	95年6月	JAN VAN RIEBEECKWEG 15 5928 LG VENLO, THE NETHERLANDS	NT\$141,363仟元 (EUR\$3,800仟元)	主機板及相關週邊商品之貿易
環鴻電子(深圳)有限公司 (環鴻深圳公司)	98年4月	深圳市南山區朗山路環勝電子(深圳)有限公司B 棟1樓、2樓、4樓及C棟2樓	NT\$259,226仟元 (US\$8,000仟元)	新型電子元器件等之研發設計及生產
環旭科技有限公司(環旭香港公司)	98年10月	RMS 2702-3 27/F, BANK OF EAST ASIA HAR- BOUR VIEWCENTRE, 56 GLOUCESTER RD, WAN CHAI, HK	NT\$32,080仟元 (US\$1,000仟元)	貿易及投資控股公司
環鴻科技(股)公司(環鴻台灣公司)	98年12月	南投縣草屯鎮太平路一段351巷141號	NT\$980,000仟元	有線及無線通信機械器材、電子零組件、電腦及其週邊設備、汽車及其零件製造業、產品設計業及研究發展服務業

(三)推定為有控制與從屬關係者其相同股東資料：無此情形。

(四)整體關係企業經營業務所涵蓋之行業：

- 本公司整體關係企業經營業務所涵蓋之行業包括電子製造業、電子服務業、投資業、租賃業及建設業。
- 日月光集團長久以來專注於提供半導體客戶完整之半導體封裝及測試服務，包括晶片前段測試及晶圓針測至後段之封裝材料及性能測試之服務。此外，客戶也可透過關係企業環隆電氣(股)公司獲得完善的電子製造服務整體解決方案。
- 大體而言本公司各關係企業間所經營業務互有關聯，其往來分工情形向以透過技術、產能、行銷以及服務之相互支援，以發揮集團最大競爭實力，創造最大綜效，鞏固本公司在業界的領導地位。

(五)各關係企業董事、監察人及總經理資料

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
日月光半導體製造股份有限公司	董事	香港商微電子國際公司	1,044,341,034股	17.26%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	-
	副董事長兼總經理	張洪本	80,792,217股	1.33%
	董事(代表人)	羅瑞榮	-	-
	董事(代表人)	董宏思	-	-
	董事(代表人)	陳昌益	-	-
	董事(代表人)	吳田玉	-	-
	董事	張能傑	25,981股	0.00%
	獨立董事	游勝福	-	-
	獨立董事	徐大麟	-	-
	監察人	宏環建設股份有限公司	67,347,182股	1.11%
	監察人(代表人)	曾元一	-	-
	監察人	張能超	377,590股	0.01%
	監察人	台灣福雷電子(股)公司	1,084,751股	0.02%
J&R Holding Limited(Bermuda)	監察人(代表人)	陳天賜	-	-
	監察人(代表人)	何弘	-	-
	監察人(代表人)	劉曉明	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
日月瑞股份有限公司	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	J&R Holding Limited(Bermuda)	170,000,006股	100%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	-
	董事(代表人)	張洪本	-	-
	董事(代表人)	董宏思	-	-
A.S.E Holding Limited(Bermuda)	監察人(代表人)	馮美珍	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
Omniquest Industrial Limited	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Jeffrey Chen	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
Innosource Limited	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
ASE Corporation	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
ASE Mauritius Inc.	董事	M. Aslam Koomar	-	-
	董事	M. Shariff Golam Hossen	-	-
	董事	Joseph Hung-Szu Tung	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
ASE Labuan Inc.	董事	Joseph Hung-Szu Tung	-	-
	董事	Chau Siew Ha	-	-
	董事兼董事長	張虔生	-	-
日月光半導體(上海)股份有限公司	董事	張洪本	-	-
	董事	張能超	-	-
	董事	張能傑	-	-
	董事	李俊哲	-	-
	董事	李智強	-	-
	董事	呂巍	-	-
	董事	朱菁	-	-
	董事	包 敏	-	-
日月光半導體(昆山)有限公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	張虔生	-	-
	董事	陳昌益	-	-
日月光電子元器件(上海)有限公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	張虔生	-	-
	董事	陳昌益	-	-
日月光高新科技(上海)有限公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	張虔生	-	-
	董事	陳昌益	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
上海鼎匯房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	-	-
	董事	李智強	-	-
	董事	俞旭濬	-	-
	監事	鄭世欣	-	-
上海鼎威房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	-	-
	董事	李智強	-	-
	董事	俞旭濬	-	-
	監事	鄭世欣	-	-
上海鼎裕房地產開發有限公司	董事兼董事長	陳昌益	-	-
	董事	李智強	-	-
	董事	俞旭濬	-	-
	監事	鄭世欣	-	-
日月光半導體(香港)有限公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	陳昌益	-	-
	董事	鄭世欣	-	-
日月光電子元器件(昆山)有限公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	張虔生	-	-
	董事	陳昌益	-	-
ASE Holding Electronics (Philippines) Incorporation	董事長	Chang, Fu Sing	-	-
	董事	Chiu, Tong Chin	-	-
	董事	Wang, Yung Kang	-	-
	董事	Bautista, Liezl T.	-	-
	董事	Wu, Chung Ting	-	-
ASEP Realty Corporation. (Philippines)	董事長	Arias, Benjamin M.	-	-
	董事	Chang, Fu Sing	-	-
	董事	Wu, Chung Ting	-	-
	董事	Bautista, Liezl T.	-	-
	董事	Zarate, Jonathan B.	-	-
ASE Investment (Labuan)Inc.	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Mathew-Willie	-	-
	董事	Jeffrey Chen	-	-
ASE (Korea)Inc.	董事	Ung Bae	-	-
	董事	Richard H. P. Chang	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	監察人	Alan Cheng	-	-
ASE Test Limited (Singapore)	董事長	Jason C.S. Chang	-	-
	董事	Richard H.P. Chang	-	-
	董事	Lee Kwai Mun	-	-
	董事	Jeffrey Chen	-	-
台灣福雷電子(股)公司	董事&監察人	日月光半導體製造股份有限公司	361,409,622股	99.99%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生(Jason C. S. Chang)	-	-
	董事(代表人)	張洪本	-	-
	董事(代表人)	李俊哲	-	-
	董事(代表人)	陳天賜	-	-
	董事(代表人)	李智強	-	-
	董事(代表人)	陳昌益	-	-
	董事(代表人)兼總經理	羅瑞榮	-	-
	董事	劉詩亮	-	-
	董事	鄭天正	-	-
	監察人(代表人)	董宏思	-	-
ASE Test Holdings,Ltd.	監察人(代表人)	唐和明	-	-
	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	David Pan	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
ASE Holdings (Singapore)Pte. Ltd.	董事	Jeffrey Chen	-	-
	董事	Hsiang De Way	-	-
	董事	Choong Lai Heng	-	-
ASE Test Finance Limited	董事	Jeswant Singh s/o Darshan Singh	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	David Hsiang	-	-
	董事	M.Shariif Golam Hossen	-	-
	董事	M.Aslam Koomar(Mr.)	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
ASE Electronics (M) Sdn, Bhd.	董事	Richard H. P. Chang	-	-
	董事	Mei-Jean Chang	-	-
	董事	Hsiang, De-Way	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Choong Lai Heng	-	-
	董事	Lee Kwai Mun	-	-
ISE Labs, Inc.	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Tien Wu	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
	董事	Jeffrey Chen	-	-
ASE Singapore Pte. Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Kuo Hung-Ming	-	-
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	-	-
ASE Singapore II Pte. Ltd.	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Kuo Hung-Ming	-	-
	董事	Kenneth Hsiang Shih-Jye	-	-
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	董事	Tien Wu	-	-
	董事	John Ho	-	-
	董事	Nobukatsu Manabe	-	-
	監察人	Joseph Tung	-	-
ASE Japan Co., Ltd.	董事	Tien Wu	-	-
	董事	John Ho	-	-
	董事	Nobukatsu Manabe	-	-
	董事	Jason C.S. Chang	-	-
	董事	Richard H.P. Chang	-	-
	監察人	Joseph Tung	-	-
ASE (U.S.) Inc.	董事	Kenneth Shih-Jye Hsiang	-	-
	總經理	Tien Wu	-	-
日月光電子股份有限公司	董事&監察人	ASE Labuan Inc.	398,981,900股	100%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	-
	董事(代表人)	董宏思	-	-
	董事(代表人)	陳昌益	-	-
	監察人(代表人)	何弘	-	-
	總經理	林國洸	-	-
日月鴻科技股份有限公司	董事	日月光半導體製造(股)公司	135,688,085股	55.75%
	董事(代表人)兼董事長	張虔生	-	-
	董事(代表人)	張洪本	-	-
	董事(代表人)	陳天賜	-	-
	董事	力信投資(股)公司	16,161,100股	6.64%
	董事(代表人)	黃崇仁	-	-
	董事(代表人)	王其國	-	-
	監察人	瑞旺投資(股)公司	3,966,974股	1.63%
GAPT-Cayman	監察人(代表人)	謝明霖	-	-
	監察人	何弘	338,516股	0.14%
	董事	張洪本	-	-
日月光封裝測試(上海)有限公司	董事	Chih-Chiang Lee	-	-
	董事	Tien-Yue Wu	-	-
	董事	張洪本	-	-
ASE Assembly & Test (HK) Limited	董事及總經理	李智強	-	-
	董事	Tien-Yue Wu	-	-
	董事	張洪本	-	-
Alto Enterprises Limited	董事	李智強	-	-
	董事	Tien Wu	-	-
	董事	Joseph Tung	-	-
Super Zone Holdings Limited	董事	Jason C. S. Chang	-	-
	董事	Richard H.P. Chang	-	-
	董事	Jeffrey chen	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
上海威宇宏欣半導體有限公司	董事	陸濤	-	-
	董事	張虔生	-	-
日月光集成電路製造(中國)有限公司	董事	張洪本	-	-
	董事	張能傑	-	-
	董事	鄭世欣	-	-
	董事長	張虔生	-	-
	董事	吳田玉	-	-
蘇州日月新半導體有限公司	董事	陳昌益	-	-
	董事	Julien Charles Deregnaucourt	-	-
	董事	Martinus Maria Franciscus Verguld	-	-
	監事	David Siu Kee Kiang	-	-
	監事	李智強	-	-
	董事	吳田玉	-	-
日月光半導體(威海)有限公司	董事	裴熊	-	-
	董事	李智強	-	-
	監察人	金首虎	-	-
	董事	日月光半導體製造股份有限公司	791,039,874股	72.67%
	董事(代表人)兼董事長	張洪本	-	-
	董事(代表人)	張虔生	-	-
	董事(代表人)	潘士華	-	-
	董事(代表人)兼總經理	馮源泉	-	-
環隆電氣股份有限公司	董事兼董事長	魏振隆	-	-
	董事	新加坡福雷電子股份有限公司	162,404,554股	14.92%
	董事	陳昌益	-	-
	董事	J&R Holding Limited	87,448,562股	8.03%
	董事	何弘	-	-
	監察人	日月光投資(百慕達)股份有限公司	15,964,200股	1.47%
	監察人(代表人)	董宏思	-	-
	監察人(代表人)	俞旭濬	-	-
	董事	環隆電氣股份有限公司	39,329,700股	100%
展毅投資(股)公司	董事(代表人)兼董事長	魏振隆	-	-
	董事(代表人)	何弘	-	-
	董事(代表人)	陳昌益	-	-
	監察人	環隆電氣股份有限公司	39,329,700股	100%
	監察人(代表人)	石孟國	-	-
	董事	環隆電氣股份有限公司	5,000,000股	100%
達基投資(股)公司	董事(代表人)兼董事長	魏振隆	-	-
	董事(代表人)	何弘	-	-
	董事(代表人)	陳昌益	-	-
	監察人	環隆電氣股份有限公司	5,000,000股	100%
	監察人(代表人)	石孟國	-	-
	董事兼董事長	魏振隆	-	-
HHI公司	董事	何弘	-	-
	董事	陳昌益	-	-
	董事兼董事長	魏振隆	-	-
環隆墨西哥公司	董事	侯爵	-	-
	董事	林大毅	-	-
	董事	石孟國	-	-
	董事	Hector Escobedo	-	-
環隆英國公司	董事兼董事長	魏振隆	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事兼董事長	魏振隆	-	-
環隆日本公司	董事	何弘	-	-
	董事	侯爵	-	-
	董事	金子憲幸	-	-
	監察人	石孟國	-	-
RTH公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
環誠科技公司	董事	張洪本	-	-

企業名稱	職稱	姓名或代表人	持有股份	
			股數	持股比例
環勝深圳公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	魏振隆	-	-
	董事	林大毅	-	-
	董事	石孟國	-	-
環旭昆山公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	魏振隆	-	-
	監察人	石孟國	-	-
環鴻香港公司	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	劉丹陽	-	-
環旭上海公司	董事	張虔生	-	-
	董事兼董事長	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	張能傑	-	-
	董事	魏鎮炎	-	-
	董事	吳福輝	-	-
	獨立董事	李扣慶	-	-
	獨立董事	董偉	-	-
	獨立董事	盧文彬	-	-
	監察人	董宏思	-	-
UI公司	監察人	石孟國	-	-
	監察人	黃添一	-	-
USI-CA公司	董事兼董事長	魏振隆	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	石孟國	-	-
USI@WORK公司	董事兼董事長	魏振隆	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	石孟國	-	-
UEHC公司	董事	陳麗華	-	-
	董事	林大毅	-	-
UHI公司	董事	何弘	-	-
	董事	石孟國	-	-
環茂控股公司	董事	魏振隆	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	吳國相	-	-
	董事	林大毅	-	-
環茂荷蘭公司	董事	魏振隆	-	-
	董事	吳國相	-	-
	董事	石孟國	-	-
環鴻深圳公司	董事	張洪本	-	-
	董事	張虔生	-	-
	董事	魏鎮炎	-	-
	監察人	石孟國	-	-
環旭香港公司	董事	張洪本	-	-
	董事	何弘	-	-
	董事	石孟國	-	-
環鴻台灣公司	董事	環鴻公司	98,000,000股	100%
	董事(代表人)	張洪本	-	-
	董事(代表人)	何弘	-	-
	董事(代表人)	石孟國	-	-
	監察人(代表人)	董宏思	-	-

(六)各關係企業營運概況

單位：新台幣仟元/每股盈餘為新台幣元

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)
日月光半導體製造(股)公司	60,519,872	161,626,460	73,070,091	88,556,369	67,339,406	10,361,203	18,337,500	3.04
ASE Corporation	11,425,922	12,844,822	55	12,844,767	0	(303)	1,252,936	3.55
日月光半導體(上海)股份有限公司	3,984,000	10,941,546	3,412,870	7,528,676	6,328,283	1,023,657	1,294,766	1.29
日月光電子股份有限公司	3,989,819	3,423,532	708,952	2,714,580	3,529,765	606,003	401,272	1.01
日月光半導體(昆山)有限公司	3,087,300	5,644,508	3,138,093	2,506,415	254,231	(299,780)	(422,196)	不適用
日月光高新科技(上海)有限公司	486,645	493,341	314	493,027	0	(323)	(15,602)	不適用
日月光電子元器件(昆山)有限公司	199,770	178,849	0	178,849	0	(241)	(3,301)	不適用
ASE Labuan Inc.	4,099,954	2,731,745	0	2,731,745	0	(71)	401,301	3.18
ASE Mauritius Inc.	7,046,629	10,108,164	141	10,108,023	0	(523)	851,911	3.91
日月光半導體(香港)有限公司	32,130	252,690	49,805	202,886	2,981,897	77,214	57,438	不適用
ASE Test Ltd. (Singapore)	659,075	22,477,415	1,343,486	21,133,929	0	(18,762)	2,917,986	26.67
ASE Electronics (M) Sdn,Bhd.	2,019,907	3,585,606	720,657	2,864,949	4,160,103	597,396	489,125	3.06
ISE Labs,Inc.	852	2,045,215	127,003	1,918,212	1,070,173	107,125	50,949	1.94
ASE Singapore Pte. Ltd.	984,851	5,110,436	3,252,630	1,857,806	2,088,239	250,585	99,191	3.3
ASE Singapore II Pte. Ltd.	873,174	1,593,222	197,760	1,395,462	561,075	46,430	(24,416)	(0.11)
ASE Test Holdings,Ltd.	0(註一)	2,519,913	0	2,519,913	0	(68)	50,881	10,176,290.20
ASE Holdings (Singapore) Pte. Ltd.	1,633,708	1,653,893	128	1,653,765	0	0	19,959	0.28
ASE Test Finance Ltd.	0(註二)	1,425	87	1,338	0	(457)	(457)	(228,483.50)
台灣福雷電子(股)公司	3,614,600	22,243,817	1,338,632	20,905,185	8,586,577	3,327,253	3,171,103	8.77
ASE (Korea) Inc.	1,232,071	14,336,651	2,619,961	11,716,690	13,835,294	1,495,769	1,258,963	165.36
ASE Japan Co., Ltd.	105,802	4,603,091	1,939,687	2,663,404	5,817,337	88,396	57,185	7,942.3
日月光電子元器件(上海)有限公司	389,316	482,952	577	482,376	0	(311)	22,203	不適用
日月光封裝測試(上海)有限公司	6,501,336	19,590,143	10,355,911	9,234,232	13,993,415	1,472,744	2,099,574	不適用
日月鴻科技股份有限公司	2,433,976	6,377,603	2,304,783	4,072,820	3,313,542	1,007,590	926,103	2.31
蘇州日月新半導體有限公司	1,568,467	3,738,786	2,158,297	1,580,489	1,815,204	287,333	121,097	不適用
日月光半導體(威海)有限公司	1,500,454	5,544,143	4,789,039	755,105	2,563,756	74,679	40,380	不適用
上海威宇宏欣半導體有限公司	337,499	445,455	146,992	298,464	0	(7,280)	(15,372)	不適用
日月光集成電路製造(中國)有限公司	3,082,400	2,914,973	9	2,914,964	0	(6,449)	(15,471)	不適用
ASE Assembly & Test (HK) Limited	4,159	108,096	108,030	66	2,803,560	(998)	(1,094)	1.09
GAPT-Cayman	6,119,380	9,237,755	456,104	8,781,651	0	(491)	2,094,116	11.02
A.S.E Holding Limited (Bermuda)	7,915,000	12,779,944	595	12,779,348	0	(6,419)	1,215,813	4,983.54
J&R Holding Limited (Bermuda)	13,907,259	47,794,880	8,150,902	39,643,978	0	(30,292)	5,548,731	12,751.95
ASE Investment(Labuan) Inc.	5,870,460	11,832,946	55	11,832,890	0	(189)	1,266,680	7.00
Omniquest Industrial Limited	11,457,298	12,903,214	58,559	12,844,655	0	(1)	1,232,510	3.47
Innosource Limited	2,770,696	3,162,370	0	3,162,370	0	0	268,272	3.12
日月瑞(股)公司	1,700,000	1,004,012	2,333	1,001,680	0	(13,204)	(7,860)	(0.05)
ASE Marketing & Service Japan Co., Ltd.	18,298	48,796	17,823	30,973	82,166	673	553	461.07
ASE (U.S) Inc.	649	255,082	48,089	206,993	900,326	13,190	(404)	(404.1)
ASE Holding Electronics (Philippines)	1,853,812	88,257	63,144	25,112	0	0	(8,841)	(3.65)

企業名稱	資本額	資產總額	負債總額	淨值	營業收入	營業淨利	本期損益 (稅後)	每股盈餘 (稅後)
ASEP Realty Co. (Philippines)	2,465	36,394	35,261	1,134	0	0	(74)	(3.71)
上海鼎匯房地產開發有限公司	6,561,623	8,215,092	1,212,005	7,003,087	3,481,179	1,905,441	1,010,375	不適用
上海鼎威房地產開發有限公司	4,997,463	6,126,629	1,432,042	4,694,588	0	(4,953)	(4,866)	不適用
上海鼎裕房地產開發有限公司	2,330,618	3,158,659	962,148	2,196,511	0	(3,900)	(3,707)	不適用
Super Zone Holdings Limited	3,082,400	2,914,964	0	2,914,964	0	0	(15,471)	(0.15)
Alto Enterprises Limited	699,360	613,812	0	613,812	0	0	(13,941)	(0.58)
環隆電氣股份有限公司	10,885,087	22,483,458	6,556,825	15,926,633	18,590,495	249,514	2,396,268	2.24
展毅公司	393,297	594,410	1,585	592,825	63,102	53,162	51,223	1.3
達基公司	50,000	64,915	76	64,839	1509	1,204	11,973	2.39
HHI公司	8,223,156	15,813,881	10,870	15,803,011	113	(22,630)	2,073,352	8.27
環隆墨西哥公司	2,063,716	1,074,860	338,522	736,338	1,931,298	106,297	85,105	0.14
環隆英國公司	1,291,062	166,746	6,884	159,862	234	(7,364)	(6,381)	(0.25)
環隆日本公司	27,231	27,470	1,912	25,558	14,466	(25,644)	(9,452)	(1,476.88)
UI公司	3,342	2,824,607	2,756,603	68,004	14,621,623	(475)	1,405	13.9
UHI公司	111,256	437,190	46	437,144	7,151	6,950	(4,962)	(1.65)
USI@Work	8,089	20,336	727	19,609	35,403	1,031	1,551	6.2
RTH公司	4,831,294	14,160,948	83,456	14,077,492	0	(329)	2,086,067	13.99
環勝電子(深圳)公司	2,186,502	6,975,088	4,169,673	2,805,415	17,394,868	650,728	181,316	不適用
UEHC公司	5,093,180	8,973,627	28	8,973,599	0	(421)	1,675,951	10.41
環誠科技公司	5,607,155	8,977,169	99	8,977,070	0	(3,294)	1,676,173	10.42
環旭上海公司	3,778,184	17,954,228	10,409,310	7,544,918	36,974,693	1,848,588	1,677,152	1.85
環鴻香港公司	321,315	4,335,343	3,959,288	376,055	10,359,745	(1,145)	(10,661)	(0.14)
環旭昆山公司	383,201	381,906	550	381,356	0	(3,653)	(5,342)	不適用
環鴻深圳公司	259,226	1,295,374	1,031,757	263,617	2,684,811	29,607	36,032	不適用
環旭香港公司	32,080	2,015,166	2,014,211	955	5,140,425	(29,861)	(31,132)	(3.99)
環鴻台灣公司	980,000	3,040,659	2,058,226	982,433	4,200,371	113,371	2,435	0.02
USI-CA公司	314,015	131,124	8,285	122,839	83,081	1,937	2,351	9.4
環茂控股公司	906,249	46,703	145,821	(99,118)	0	(999)	(10,769)	(0.12)
環茂荷蘭公司	141,363	44,457	676	41,781	(30)	(12,830)	10,056	(264.59)

註一：設立資本額為美金5元。

註二：設立資本額為美金2元。

(七) 關係企業合併財務報表

本公司民國九十九年度依「關係企業合併營業報告書關係企業合併財務報表及關係報告書編製準則」應納入編製關係企業合併財務報表之公司與依財務會計準則公報第七號應納入編製母子公司合併財務報表之公司均相同，且關係企業合併財務報表所應揭露相關資訊於前揭母子公司合併財務報表中均已揭露，爰不再另行編製關係企業合併財務報表。

(八)本公司業已於本年報財務報告第88-91頁及第120頁揭露所有關係企業從事背書保證、資金貸與他人及衍生性商品交易資訊，其他未列示之關係企業即無從事上述之交易。

二、私募有價證券辦理情形：無。

三、子公司持有或處分本公司股票情形：

99年12月31日單位：新台幣仟元(除另有註明者外)；股：%

子公司名稱	實收資本額	資金來源	本公司持股比例	取得或處分日期	取得股數及金額	處分股數及金額	投資(損)益(註二)	截至年報刊印日止 持有股數及金額	設定質權情形	本公司為子公 司背書保證金額	本公司貸與子 公司金額
台灣福雷電子(股)公司	3,614,600	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	99年	784,674股	—	—	8,638,913股(註一) 帳面金額\$291,563 轉列庫藏股金額\$196,677	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	—	—	—	8,638,913股(註一) 帳面金額\$291,563 轉列庫藏股金額\$196,677	—	—	—
ASE Test Limited	659,075	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	99年	6,303,859股	141,808,499股 3,410,494	307,455	69,402,638股(註一) 帳面金額\$2,342,339 轉列庫藏股金額\$1,380,721	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	—	—	—	69,402,638股(註一) 帳面金額\$2,342,339 轉列庫藏股金額\$1,380,721	—	—	—
J&R Holding Limited (Bermuda)	13,907,259	日月光合併日月宏及日月欣三合一換股及盈餘分配取得	100%	99年	3,338,008股	76,358,486股 1,836,422	964,077	36,749,966股 帳面金額\$1,240,311 轉列庫藏股金額\$381,709	—	—	—
				本年度截至年報刊印日止	—	—	—	36,749,966股 帳面金額\$1,240,311 轉列庫藏股金額\$381,709	—	—	—

註一：為配合ASE Test Limited當地法令規定，台灣福雷電子(股)公司取得本公司之股票7,554,162股信託予中國信託商業銀行，另1,084,751股集保：ASE Test Limited取得本公司之股票69,402,638股全數信託予中國信託商業銀行。

註二：係以庫藏股會計處理，是以轉列資本公積。

四、其他必要補充說明事項：無。

玖、其他事項

最近年度及截至年報刊印日止，如發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：

99.04.07勤高9900389號

受文者：日月光半導體製造股份有限公司

主 旨：貴公司與子公司J&R Holding Limited (J&R Holding) 及ASE Test Limited (ASE Test) 共同公開收購環隆電氣股份有限公司(環電)普通股，係屬證券交易法第三十六條第二項第二款規定對股東權益或證券價格有重大影響之事項，本會計師依「發行人募集與發行有價證券處理準則」第五條之規定，就其對財務報告之影響表示意見，敬請 查照。

說 明：

一、貴公司董事會於民國九十八年十一月十七日決議通過與子公司J&R Holding及ASE Test共同公開收購環電普通股，並於民國九十九年二月三日(收購期間屆滿日)完成公開收購。依證券交易法第三十六條第二項第二款及證券交易法施行細則第七條之規定，係屬對股東權益或證券價格有重大影響之事項。

二、貴公司與子公司J&R Holding及ASE Test以每股新台幣21元(部分對價以子公司J&R Holding及ASE Test持有之 貴公司普通股股票0.34股支付，該股票乘以收購期間屆滿日時價與收購價之差額則由 貴公司以現金支付)共同公開收購環電流通在外普通股，收購期間為民國九十八年十一月十八日至九十九年二月三日。依 貴公司民國九十九年四月六日之說明截至收購期間屆滿日共收購環電普通股641,669千股，收購價款共計13,475,056千元。其中由子公司J&R Holding及ASE Test交付持有之 貴公司普通股股票計218,167千股，差額新台幣8,228,140千元主由 貴公司以長期借款支付之。經本次收購後， 貴公司對環電具有控制能力。

三、貴公司針對前述事項已依據相關規定辦理公告及申報，並出具對民國九十八年度財務報告無重大影響之聲明如附件。本會計師就 貴公司之聲明予以覆核，並未發現有重大不合理之處。

勤業衆信聯合會計師事務所

會計師 龔俊吉



日月光半導體製造股份有限公司



負責人：張虔生



中華民國一〇〇年二月二十八日 刊印

本年報採用大豆油墨印刷與環保紙張，
符合FSC認證。

